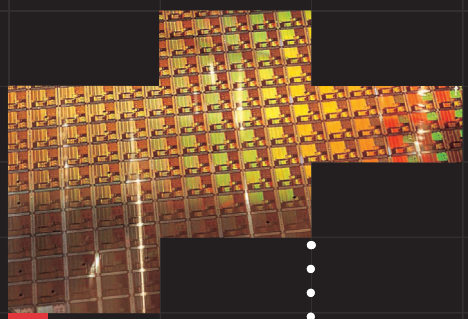
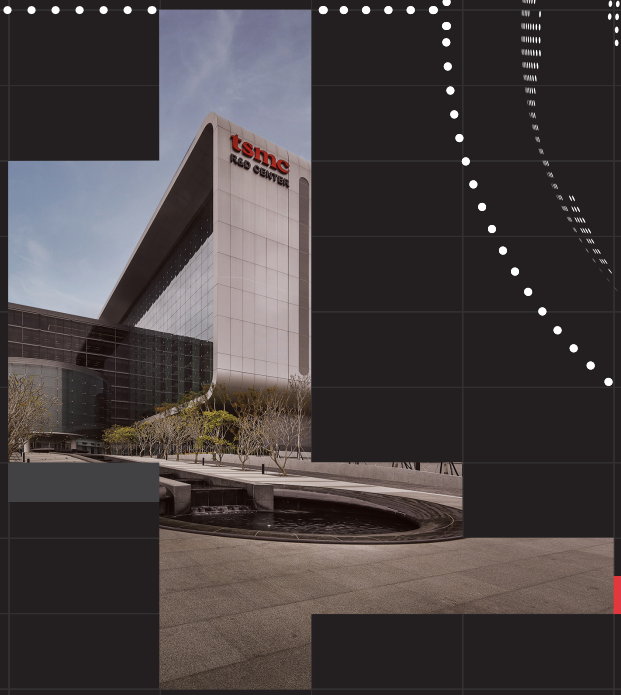
刊印時間 民國一百一十五年三月十二日
股票代號 2330
NYSE TSM

台灣積體電路製造股份有限公司

民國一百一十四年度年報





台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw
台積公司年報網址：https://investor.tsmc.com/chinese/annual-reports

聯絡資訊

台灣

公司總部及晶圓十二A廠
300-096新竹科學園區力行六路8號
電話：+886-3-5636688

全球研發中心
308-001新竹科學園區科環路168號
電話：+886-3-5636688

晶圓十二B廠
300-091新竹科學園區園區二路168號
電話：+886-3-5636688

晶圓二廠、五廠
300-096新竹科學園區園區三路121號
電話：+886-3-5636688

晶圓三廠
300-092新竹科學園區研新一路9號
電話：+886-3-5636688

晶圓六廠
741-014南部科學園區南科北路1號
電話：+886-6-5056688 傳真：+886-6-5052057

晶圓八廠
300-094新竹科學園區力行路25號
電話：+886-3-5636688

晶圓十四A廠
741-014南部科學園區南科北路1號之1
電話：+886-6-5056688 傳真：+886-6-5051262

晶圓十四B廠
741-014南部科學園區南科九路17號
電話：+886-6-5056688 傳真：+886-6-5055217

晶圓十五A廠
428-303中部科學園區科雅六路1號
電話：+886-4-27026688 傳真：+886-4-25607548

晶圓十五B廠
407-728中部科學園區新科路1號
電話：+886-4-27026688 傳真：+886-4-24630372

晶圓十八A廠
745-093南部科學園區北園二路8號
電話：+886-6-5056688 傳真：+886-6-5050363

晶圓十八B廠
745-093南部科學園區北園二路8號
電話：+886-6-5056688

晶圓二十廠
308-001新竹科學園區科環路1號
電話：+886-3-5636688

晶圓二十二廠
811-019高雄市楠梓區園區北路1號
電話：+886-6-5056688

先進封測一廠
300-077新竹科學園區研新二路6號
電話：+886-3-5636688

先進封測二廠
741-013南部科學園區三抱竹路1號
電話：+886-6-5056688 傳真：+886-6-5057223

先進封測三廠
325-002桃園市龍潭區龍園六路101號
電話：+886-3-5636688

先進封測五廠
428-303中部科學園區科雅西路5號
電話：+886-4-27026688 傳真：+886-4-25609631

先進封測六廠
350-012苗栗縣竹南鎮科專一路1號
電話：+886-3-5636688

先進封測七廠
612-013嘉義縣太保市嘉科五路68號
電話：+886-6-5056688

先進封測八廠
744-010台南市新市區豐華168號
電話：+886-6-5056688

采鈺科技股份有限公司
300-096新竹科學園區篤行一路12號
電話：+886-3-6668788 傳真：+886-3-6662858

亞洲

台積電（中國）有限公司
上海市松江區文翔路4000號
郵政編碼：201616
電話：+86-21-57768000

台積電（南京）有限公司
江蘇省南京市浦口經濟開發區紫峰路16號
郵政編碼：211806
電話：+86-25-57668000

台積電韓國有限會社
Rm 2104-2105 west, Hanshin Inter Valley 24 Building, 322, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06211, Korea
電話：+82-2-21831688

TSMC Japan Limited
21F, Queen's Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan
電話：+81-45-682-0670

TSMC Design Technology Japan, Inc.
10F, Minatomirai Grand Central Tower, 4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012, Japan
電話：+81-45-664-4500

TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.
2F, 7D Bldg., West, 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki, 305-8569, Japan
電話：+81-29-893-2968

Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.
4106-1, Haramizu, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto, 869-1102, Japan
電話：+81-96-340-5888

歐洲／北美洲

TSMC Europe B.V.
World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands
電話：+31-20-3059900

TSMC Design Technology Canada Inc.
1000 Innovation Drive, Suite 400, Kanata, ON K2K 3E7, Canada
電話：+613-576-1990

TSMC North America
2851 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：+1-408-3828000 傳真：+1-408-3828008

TSMC Technology, Inc.
2851 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：+1-408-3828000

TSMC Washington, LLC
5509 N.W. Parker Street, Camas, WA 98607-9299, U.S.A.
電話：+1-360-8173000 傳真：+1-360-8173009

TSMC Arizona Corporation
5088 W. Innovation Circle, Phoenix, AZ 85083, U.S.A.
電話：+1-602-567-1688

European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH
Rosenstrasse 32, 01067 Dresden, Germany
電話：+49 351 5013 6688

公司發言人
姓名：黃仁昭
職稱：資深副總經理暨財務長
電話：+886-3-5636688 傳真：+886-3-5637000
電子信箱：press@tsmc.com

代理發言人
姓名：高孟華
職稱：企業公共關係處主管
電話：+886-3-5636688 傳真：+886-3-5637000
電子信箱：press@tsmc.com

簽證會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：吳世宗、林尚志
110-421台北市信義區松仁路100號20樓
電話：+886-2-27259988 傳真：+886-2-40516888
網址：http://www.deloitte.com.tw

辦理股票過戶機構
名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地址：100-003臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話：+886-2-66365566
網址：https://www.ctbcbank.com

ADR美國存託憑證存託銀行
Company: Citibank, N.A.
Depositary Receipts Services
Address: 388 Greenwich Street, 26th Floor, New York, NY 10013, U.S.A.
Website: https://www.citi.com/dr
電話：+1-877-2484237 (toll free)
電話：+1-781-5754555 (out of US) 傳真：+1-201-3243284
電子信箱：citibank@shareholders-online.com

台積公司的美國存託憑證（ADR）在美國紐約證券交易所（NYSE）以TSM為代號掛牌交易。查詢海外有價證券資訊之方式：https://www.nyse.com以及https://mops.twse.com.tw

「台積」、「台積電」、「TSMC」、「tsmc」、「Open Innovation Platform」、「Open Innovation」、「GIGAFAB」、「CoWoS」、「TSMC-SoIC」、「3DFabric」、「TSMC 3DFabric」、「N12e」、「N6e」、「TSMC-COUPE」、「TSMC-SoW」及「TSMC A16」為本公司於各國（包括台灣在內）使用之部分註冊及／或申請中商標。本公司保留所有商標法上之權利。

本年報著作人為台灣積體電路製造股份有限公司，並保留所有著作權法上之權利。

台積公司願景、使命與核心價值

願景

成為全球最先進及最大的專業積體電路技術及製造服務業者，並且與我們無晶圓廠設計公司及整合元件製造商的客戶群共同組成半導體產業中堅強的競爭團隊。為了實現此一願景，我們必須擁有三位一體的能力：

1. 是技術領導者，能與整合元件製造商中的佼佼者匹敵
2. 是製造領導者
3. 是最具聲譽、以服務為導向，以及客戶最大整體利益的提供者

使命

作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。

企業核心價值

誠信正直

這是我們最基本也是最重要的理念。我們說真話；我們不誇張、不作秀；對客戶我們不輕易承諾，一旦做出承諾，必定不計代價，全力以赴；對同業我們在合法範圍內全力競爭，我們也尊重同業的智慧財產權；對供應商我們以客觀、清廉、公正的態度進行挑選及合作。在公司內部，我們絕不容許貪污；不容許有派系；也不容許「公司政治」。我們用人的首要條件是品格與才能，絕不是「關係」。

承諾

台積公司堅守對客戶、供應商、員工、股東及社會的承諾。所有這些利害關係人對台積公司的成功都相當重要，台積公司會盡力照顧所有利害關係人的權益。同樣地，我們也希望所有利害關係人能對台積公司信守其承諾。

創新

創新是我們的成長的泉源。我們追求的是全面，涵蓋策略、行銷、管理、技術、製造等各方面的創新。創新不僅僅是有新的想法，還需要執行力，做出改變，否則只是空想，沒有益處。

客戶信任

客戶是我們的夥伴，因此我們優先考慮客戶的需求。我們視客戶的競爭力為台積公司的競爭力，而客戶的成功也是台積公司的成功。我們努力與客戶建立深遠的夥伴關係，並成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴。

目錄

1 致股東報告書 06

2 公司概況 14

2.1 公司簡介 - 16
2.2 市場概況 - 16
2.3 董事會成員 - 22
2.4 主要經理人 - 32

3 公司治理 42

3.1 概述 - 44
3.2 董事會 - 44
3.3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形 - 55
3.4 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 - 56
3.5 從業道德 - 58
3.6 法規遵循 - 63
3.7 內部控制制度執行狀況 - 65
3.8 與公司財務有關人士之資訊 - 66
3.9 會計師資訊 - 66

4 資本及股份 68

4.1 資本及股份 - 70
4.2 公司債辦理情形 - 75
4.3 特別股辦理情形 - 82
4.4 海外存託憑證辦理情形 - 82
4.5 員工認股權憑證辦理情形 - 84
4.6 限制員工權利新股辦理情形 - 84
4.7 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 - 94
4.8 資金運用計劃執行情形 - 94

5 營運概況 96

5.1 業務內容 - 98
5.2 技術領導地位 - 100
5.3 卓越製造 - 107
5.4 客戶信任 - 111
5.5 資通安全管理 - 113
5.6 人才資本 - 114
5.7 重要契約 - 121

6 財務概況 122

6.1 財務狀況及經營結果 - 124
6.2 風險管理 - 129

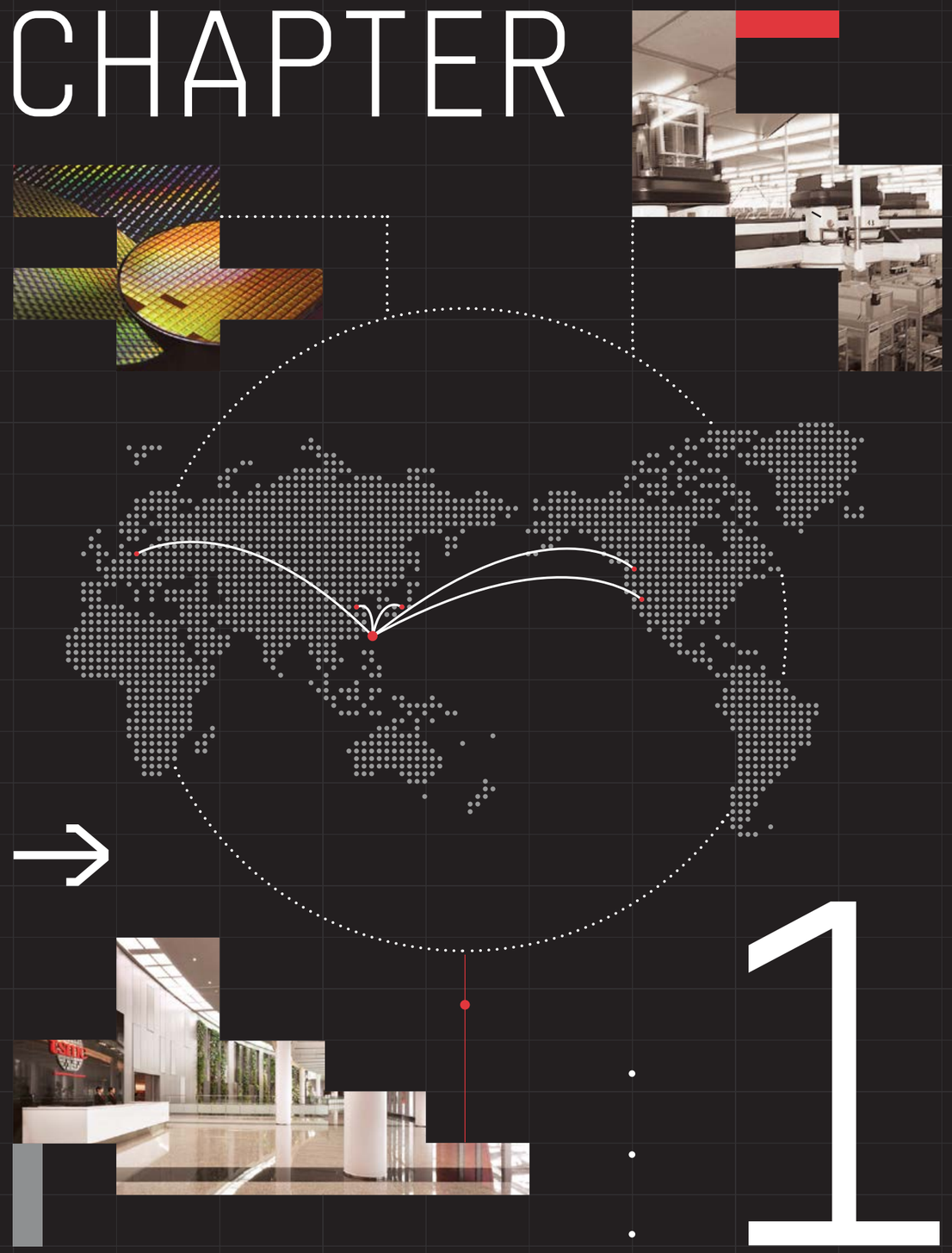
7 企業永續 (ESG) 146

7.1 概述 - 148
7.2 環保、安全與衛生管理 - 152
7.3 台積電文教基金會 - 165
7.4 台積電慈善基金會 - 167
7.5 台積i公益平台 - 168
7.6 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 - 169
7.7 上市上櫃公司氣候相關資訊執行情形 - 171

8 關係企業暨其他特別記載事項 172

8.1 關係企業相關資料 - 174
8.2 其他特別記載事項 - 178

CHAPTER



致股東報告書

1

台積公司使命

作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者

各位股東女士、先生：

民國一百一十四年對台積公司而言又是強勁成長的一年。我們觀察到人工智慧（AI）相關的需求在全年間保持強勁，與此同時，非AI相關的終端市場則已觸底並呈現溫和復甦。民國一百一十四年，全球晶圓製造2.0產業年成長率達16%。憑藉著我們顯著的技術領先及廣泛的客戶基礎，若以美元計，台積公司的營收年增35.9%，並且營收和每股盈餘雙雙創下歷史新高。

民國一百一十四年AI市場持續有非常正面的發展，大型語言模型處理文本的詞元（token）數量呈現爆炸式成長，顯示消費端AI模型的採用正在增加。企業AI（Enterprise AI）也是另一個需求的來源，因為包括台積公司等企業正在內部運用AI來提高生產力和效率，創造更多價值。此外，我們持續觀察到主權AI（Sovereign AI）需求正日益興起。

因此，我們對人工智慧（AI）長期發展趨勢的信念越來越堅定，並且相信市場對於半導體的結構性需求至關重要。

作為晶圓製造服務的提供者，台積公司的首要責任在於提供最先進的技術和充足的產能，全力支持客戶釋放其產品的創新。

台積公司持續投資研發和技術發展以支持客戶的成長。在智慧型手機、高效能運算（HPC）、汽車及物聯網（IoT）應用的驅動下，市場對我們先進製程技術（7奈米及以下先進製程）的需求持續強勁。我們的3奈米製程技術已進入量產的第三個完整年度，占台積公司一百一十四年整體晶圓銷售金額的24%。

台積公司的2奈米製程技術於民國一百一十四年第四季成功進入量產，並展現優異的良率表現，我們預期在民國一百一十五年該製程產能將快速攀升。依循我們持續精進製程的策略，我們也推出了N2P和A16製程技術，作為2奈米家族的延伸。N2P在N2的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢。A16則採用了業界最佳的超級電軌（Super Power Rail, SPR）技術，極適合具有複雜訊號佈線及密集供電網路的特定HPC產品。N2P和A16皆預計於民國一百一十五年下半年進入量產。

A14技術採用台積公司第二代奈米片電晶體結構，將會是比N2更先進的完整節點技術，並且具備效能與功耗優勢，以因應高效能與節能運算日益增長的結構性需求。A14的開發進展順利，預計於民國一百一十七年量產。

我們也持續開發先進封裝和3D晶片堆疊技術，包括CoWoS®、整合型扇出（Integrated Fan-Out, InFO）、TSMC-SoIC®（系統整合晶片）和TSMC-COUPE™（緊湊型通用光子引擎），在可負擔的成本下實現更低功耗的大規模互連，以支持客戶需求。

在成熟製程技術方面，我們與策略性客戶緊密合作，開發滿足其特定需求的特殊製程技術解決方案。這些夥伴關係使我們能夠創造技術差異化，並為客戶提供持久的價值。

我們相信台積公司的先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝和晶片堆疊解決方案，引領著產業因應對節能運算永無止境的需求，並讓台積公司在未來進一步延續我們技術的領先地位。

為了因應長期市場需求的結構性成長，台積公司在堅守專業紀律的同時，與我們的客戶以及客戶的客戶密切合作以妥善規劃產能。我們著眼於整體潛在市場的大趨勢以決定適當的產能建置，並投資於先進製程、特殊製程和先進封裝技術以支持我們客戶的成長。

這項策略的其中一部分包括根據客戶對地緣彈性的需求以及一定程度的政府支持來擴展我們的全球製造版圖。如此將使台積公司股東價值最大化。

民國一百一十四年三月，我們宣布了一項額外的投資計劃以進一步拓展美國佈局，支援客戶強勁且未來多年度的需求。我們正在美國亞利桑那州取得實質進展，加速產能的擴充，並按計劃順利進行。

我們在亞利桑那州的第一座晶圓廠已經在民國一百一十三年第四季順利以優異的良率成功進入量產；我們正加速第二座晶圓廠的生產計劃，預計於民國一百一十六年下半年進入量產；第三座晶圓廠則已經於民國一百一十四年開始動工興建。

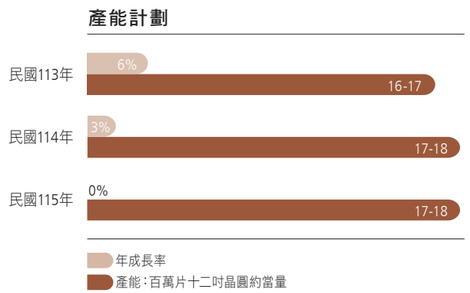
此外，我們也剛在現有廠區附近購得第二塊大面積土地，以支持目前的擴展計劃，並為我們提供更多彈性，以因應非常強勁且多年成長的AI相關需求。

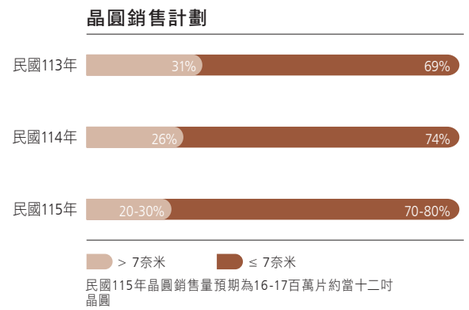
我們的計劃將使台積公司在亞利桑那州擴展成為一個獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB®）聚落，以支援智慧型手機、AI和HPC應用的領先客戶的需求。

在日本，我們在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已於民國一百一十三年底以非常好的良率開始量產，目前於熊本興建中的第二座晶圓廠正規劃將採用3奈米製程技術生產，以滿足AI帶動的強勁需求。在歐洲，我們在德國德勒斯登興建的特殊製程技術晶圓廠進展順利，該晶圓廠將專注於汽車和工業應用。

在台灣，我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，我們將繼續在台灣的多個地區投資先進製程和先進封裝設施，並高度重視營建現場的安全管理。

透過擴大全球製造布局並持續深耕台灣，台積公司將在未來數年持續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。





民國一百一十四年，我們在實現永續目標方面也取得了顯著的進展。在四月，我們宣布依循科學基礎減量目標倡議（The Science Based Targets Initiative, SBTi），並設定了關鍵里程碑，於民國一百二十九年達成100%使用再生能源，並於民國一百三十九年實現淨零排放的目標。

台積公司民國一百一十四年主要成就包括：

- 晶圓出貨量達1,500萬片十二吋晶圓約當量，民國一百一十三年為1,290萬片十二吋晶圓約當量。
- 先進製程技術（7奈米及以下先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的74%，高於民國一百一十三年的69%。
- 提供305種不同的製程技術，為534個客戶生產1萬2,682種不同產品。

財務表現

台積公司民國一百一十四年全年合併營收為新台幣3兆8,090億5,000萬元，較前一年的新台幣2兆8,943億1,000萬元增加31.6%；稅後淨利為新台幣1兆7,178億8,000萬元，每股盈餘為新台幣66.25元，較前一年稅後淨利新台幣1兆1,732億7,000萬元及每股盈餘新台幣45.25元均增加了46.4%。

若以美元計算，台積公司民國一百一十四年全年合併營收為1,224億2,000萬美元，稅後淨利為552億1,000萬美元，較前一年度的全年合併營收900億8,000萬美元增加了35.9%，較前一年度的稅後淨利365億2,000萬美元增加了51.2%。

台積公司民國一百一十四年毛利率為59.9%，前一年為56.1%；營業利益率為50.8%，前一年則為45.7%。稅後純益率為45.1%，較前一年稅後純益率40.5%增加了4.6個百分點。

台積公司民國一百一十四年現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣14.0元提高至每股新台幣18.0元。

未來展望

進入民國一百一十五年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，我們有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長。

展望未來，我們觀察到AI模型在消費端、企業端和主權AI領域的採用率持續提升。這個趨勢帶動了對更多運算能力的需求，進而支持了對先進半導體晶片的強勁需求。

我們正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。

我們的成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，我們將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，同時堅持我們的專業領域，確保我們的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

台積公司的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。我們將專注於台積公司的業務基礎－技術領先、卓越製造與客戶信任，以進一步強化我們的競爭地位，同時為客戶提供服務，並幫助他們取得成功。

在這個瞬息萬變的世界中，台積公司始終秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值來因應各種不確定性。我們從不輕忽自己的責任，並將持續專注於投資技術與產能，以支持客戶的成長、實現獲利成長，並最大化股東價值。感謝您的支持，我們期待未來幾年與您一同成長。

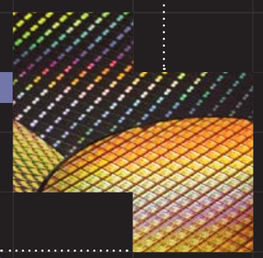
魏哲家
董事長暨總裁

台積公司財務、營運與永續成就

財務績效

合併營收新台幣**3兆8,090億5,000萬**元，較前一年增加**31.6%**，創歷史新高

毛利率
59.9%



每股盈餘**66.25**元，創歷史新高

現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣14.0元提高至每股新台幣**18.0**元

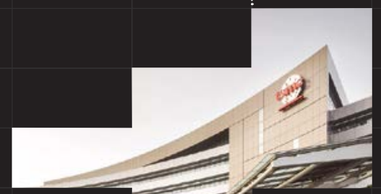
稅後淨利為新台幣**1兆7,178億8,000萬**元，較前一年增加了46.4%

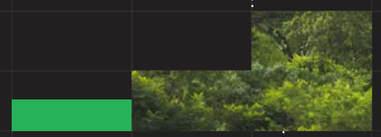
永續成果

擴大供應鏈減碳補助計畫，補助總額提升至新台幣1.6億元，創造**8萬**公噸減碳效益

全公司生產營運據點 **>20%** 用電量為再生能源

依循科學基礎減量目標倡議**(SBTi)**承諾減碳目標





2050年實現
淨零排放

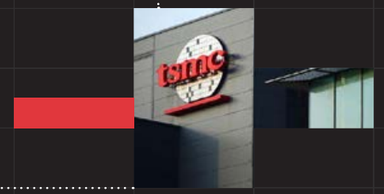
獲選道瓊領先世界指數的組成企業，是全球唯一連續**24**年[註]入選的半導體公司

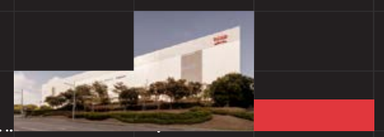
營運成就

先進製程技術（7奈米及以下先進製程）的銷售金額佔整體晶圓銷售金額的**74%**

提供**305**種不同的製程技術為**534**個客戶生產**12,682**種不同產品

台積公司晶圓出貨量達**1,500萬**片十二吋晶圓約當量



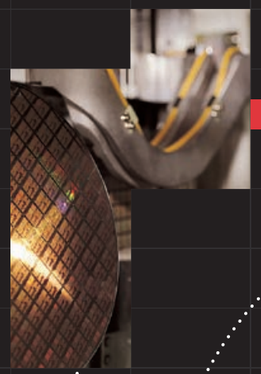


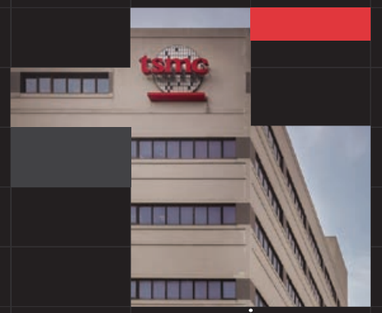
2奈米
製程技術成功以優異的良率表現進入量產

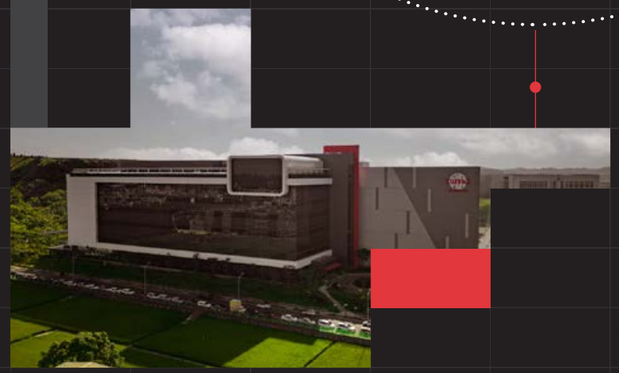
研發費用達**79億2,000萬**美元

註：原道瓊永續指數；截至2026年3月，道瓊領先指數尚未公告其2025年成分股

CHAPTER







2

公司概況

民國一百一十四年，台積公司晶圓出貨量達1,500 萬片
十二吋晶圓約當量

2.1 公司簡介

台積公司成立於民國七十六年，將總部設立於台灣新竹科學園區，並開創了專業積體電路製造服務商業模式。台積公司專注於生產由客戶所設計的晶片，本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保絕不與客戶競爭。基於這個創始的原則，台積公司成功的關鍵就在於協助客戶獲得成功。台積公司的專業積體電路製造服務商業模式造就了全球無晶圓廠IC設計產業的崛起。自創立以來，台積公司一直是世界領先的專業積體電路製造服務公司，單單在民國一百一十四年，台積公司就以305種製程技術，為534個客戶生產1萬2,682種不同產品。

台積公司的眾多客戶遍布全球，為客戶生產的晶片廣泛地被運用在各種終端市場，例如高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品等。如此多樣化的晶片生產有助於緩和需求的波動性，使公司得以維持高產能利用率及獲利率，以及穩健的投資報酬以因應未來的投資。

民國一百一十四年，台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,700萬片十二吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠（GIGAFAB® Facilities）、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家百分之百持有之海外子公司－台積電（南京）有限公司之十二吋晶圓廠及TSMC Arizona Corporation之二座十二吋晶圓廠、一家持有多數股權之海外子公司－JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.）之十二吋晶圓廠，及二家百分之百持有之海外子公司－TSMC Washington、台積電（中國）有限公司之八吋晶圓廠的產能支援。

亞利桑那州第一座晶圓廠已於民國一百一十三年第四季開始生產4奈米製程技術，第二座晶圓廠的廠房興建工程已經完成，目前正在進行廠務系統設施安裝工程，預計此晶圓廠將採用3奈米或更先進的製程技術。第三座晶圓廠於民國一百一十四年開始興建。台積公司於民國一百一十四年宣布有意增加投資於美國先進半導體製造，這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、二座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。

JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.）的第一座晶圓廠已於民國一百一十三年底開始生產，第二座晶圓廠於民國一百一十四年開始興建。藉由這二座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠將為汽車、工業、消費性電子和高效能運算（High Performance Computing, HPC）相關應用提供40奈米、22/28奈米、12/16奈米、6/7奈米和3奈米的製程技術。

在民國一百一十三年，台積公司開始其於德國德勒斯登興建特殊製程晶圓廠的工程，並預計生產台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術。

在台灣以外，台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸，以及南韓等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務與技術服務。至民國一百一十四年年底，台積公司及其子公司員工總數超過9萬人。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為TSM。

2.2 市場概況

2.2.1 台積公司卓越表現

擁有先進的製程技術是台積公司在該領域取得強大市場地位的重要關鍵。民國一百一十四年，有74%的晶圓營收來自先進製程技術（7奈米及以下更先進製程），高於民國一百一十三年的69%。

台積公司提供客戶完備的製程技術，並且持續投資先進製程技術、特殊製程技術，以及先進矽堆疊與封裝技術，以滿足客戶需求，並提供更多附加價值。

除了擁有在先進製程技術和特殊製程技術的領導地位，台積公司亦提供TSMC 3DFabric®－完備的三維矽堆疊（3D Silicon Stacking）和先進封裝系列解決方案，與其製程技術發揮相輔相成的效益。TSMC 3DFabric®解決方案為客戶提供更靈活的晶片設計彈性來釋放創新，是台積公司有別於競爭對手的另一差異化競爭優勢。

2.2.2 市場分析

台積公司估計民國一百一十四年全球半導體（不含記憶體）市場產值將達到6,105億美元，較民國一百一十三年增長19%。至於積體電路製造服務方面，台積公司將我們對積體電路製造服務產業的原始定義擴展為「積體電路製造2.0」，其中也包括封裝、測試、光罩製造等，以及所有整合元件製造（不含記憶體）。以下所有「積體電路製造」即為新定義之「積體電路製造2.0」，因此更好地反映了台積公司未來可擴展之市場機會。「積體電路製造」產業的規模估計在民國一百一十四年達到3,053億美元，較民國一百一十三年增長16%。

2.2.3 產業未來展望、機會與挑戰

積體電路製造服務市場的需求與供給

民國一百一十四年，台積公司在積體電路製造服務領域從民國一百一十三年強力反彈後進一步加速。民國一百一十四年全年人工智慧（AI）部署仍然強力，推動對先進製程半導體晶片的強勁需求，有利於在先進製程技術及先進封裝技術均處於領導地位的積體電路製造商如台積公司。除此之外，智慧型手機和個人電腦的終端需求健康，而其他市場諸如物聯網（Internet of Things, IoT）、汽車和工業領域也從民國一百一十二年至民國一百一十三年的庫存調整週期中復甦。

展望民國一百一十五年，全球貿易衝突與保護主義持續，為電子設備終端需求帶來風險與不確定性。然而，台積公司預計AI的強勁需求將持續，而其他非AI市場料將趨於疲軟。台積公司預計先進製程及先進封裝需求將持續強勁。在成熟製程方面，整體需求預計在庫存消化後改善，儘管尤以中國為主的產能增加將對非中國積體電路製造服務領域構成挑戰，包括台積公司。從長遠來看，由於AI、5G/6G、數位化轉型以及大多數電子設備中半導體含量增加等大趨勢的推動，台積公司預測至民國一百一十九年全球半導體（不含記憶體）市場成長約為10%的年複合成長率。

作為半導體產業鏈的上游供應商，積體電路製造服務領域與主要產品的市場健康性息息相關，包含高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品（Digital Consumer Electronics, DCE）。

●高效能運算

高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器、基地台等。民國一百一十四年，主要高效能運算產品單位出貨量成長9%，主要受到個人電腦升級與強勁商用需求、遊戲機新機上市，以及最重要的－受AI應用（尤其是生成式AI）普及推動並配備有AI加速器的伺服器和資料中心持續強勁增長勢頭的驅動。

對於民國一百一十五年，台積公司預計PC出貨量將衰退，而受AI軍備競賽加劇的推動，伺服器單位出貨量將呈現低雙位數增長。長期來說，隨著產業開始邁入5G時代，一個更智慧化且更加互聯的世界，將會需求大量運算能力及低耗能運算。這兩項趨勢都需要更高性能及更佳功耗效率的中央處理器（Central Processing Units, CPUs）、繪圖處理器（Graphics Processing Units, GPUs）、網路處理器（Network Processing Units, NPUs）、人工智慧相關的特殊應用積體電路，並將驅動整體高效能運算平台朝向更豐富的半導體含量、更先進製程技術與3D封裝邁進。基於台積公司在這些領域的技術領先地位，這些趨勢對台積公司是有利的。

●智慧型手機

智慧型手機在民國一百一十四年持續成長約3%，穩定的增加主要是因為5G全球商用化的持續發展、新興國家需求成長和週期性換機需求。此外中國的補貼措施也促進智慧型手機的銷售。展望民國一百一十五年台積公司預估智慧型手機市場將因記憶體短缺和價格上漲的影響呈

現衰退。儘管如此，長期來看，由於智慧型手機持續演進至5G，加上擁有更高性能、更長電池使用時間、先進的生理感應器及更多邊緣人工智慧應用，這些共同驅動力將持續推動智慧型手機成長。

高性能與節能高效率的積體電路技術是手機製造商的基本要求，而高度整合的晶片和先進的封裝設計是最佳化成本、功耗及外型尺寸（晶片面積與高度）的首選解決方案。對高效能晶片的需求日益迫切，這對於執行邊緣人工智慧應用、複雜的軟體運算以及處理高解析度影像和視訊至關重要，因此將持續驅動採用先進製程技術。作為製造高度整合晶片與先進封裝設計製程技術方面公認的領導者，台積公司在滿足智慧型手機市場不斷演進的需求方面具有得天獨厚的位置。

● 物聯網

物聯網市場從民國一百一十三年的低迷中反彈，於民國一百一十四年實現了11%的出貨量成長。此次成長涵蓋廣泛領域，包括個人連網設備像是穿戴式設備（例如人工智慧眼鏡、智慧手錶）、智慧家庭（例如具備邊緣人工智慧功能的智慧家電）、智慧城市，以及工業物聯網應用（例如智慧零售、能源監測和製造自動化）。預計這種穩健成長將持續到民國一百一十五年，呈現高個位數增長。從長遠來看，隨著更多人工智慧、連接性和相互可操作性功能整合到物聯網設備中，預計整體物聯網市場將繼續保持高速成長。

物聯網設備日益增長的人工智慧整合和對能源效率的要求，推動了對高效能、低功耗晶片的需求。台積公司憑藉其全面的製造製程組合，包括高性價比的先進技術和業界領先的超低功耗技術，滿足這些不斷變化的需求，從而支援客戶在人工智慧物聯網（AIoT）領域的產品創新。

● 車用電子

汽車市場在民國一百一十四年經歷了健康的復甦，全球汽車產量增長了3%。這一增長主要得益於政府補貼計劃以及關稅不確定性所驅動的預防性採購。台積公司預測民國一百一十五年汽車產量將持平或略有下降，預期宏觀經濟的不確定性以及補貼和提前採購影響的減弱將導致需求環境充滿挑戰。

從長遠來看，汽車產業更環保、更安全與更智慧化的大趨勢將持續加速電動車（Electric Vehicle, EV）、先進駕駛輔助系統（Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS）與智慧座艙資訊娛樂系統的普及。這些日益複雜的系統將進一步推動應用處理器（Application Processor, AP）、微控制器（Microcontroller, MCU）、車內網路、感測器和電源管理IC的需求，從而使每輛汽車的半導體含量不斷提升。台積公司憑藉提供先進的製程技術和製造解決方案，在支持汽車產業轉型的大趨勢方面擁有獨特的優勢，使客戶能夠在汽車市場上開發極具競爭力的產品。此外，台積公司還提供一系列汽車級製造流程，包括AEC-Q100和ISO 26262認證，以確保汽車應用的最高品質水準和可靠性。

● 消費性電子產品（DCE）

民國一百一十四年，整體DCE市場出現輕微萎縮。消費者行為變化、螢幕時間轉移以及更多功能整合到行動產品等結構性逆風，對機上盒（STB）和數位相機（DSC）等幾種主要DCE產品的需求造成壓力。另一主要DCE產品－數位電視的出貨量大致持平，部分受到民國一百一十三年下半年的中國補貼計劃而提前拉動效應影響。

展望民國一百一十五年，FIFA世界盃和冬季奧運等重大體育賽事可能會在一定程度上刺激DTV和機上盒的需求。然而，我們預期結構性逆風將持續存在，加上不利的記憶體定價環境，預計整體DCE市場的成長將持平或略有下滑。儘管市場可能疲軟，台積公司的先進製程技術依然至關重要，賦能我們的DCE客戶，使其得以創造出獨特且創新的產品。

產業供應鏈

電子產品的供應鏈冗長而複雜，且各個環節環環相扣。身處產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供充足且彈性的供貨以因應市場需求的激烈變化，而積體電路製造服務產業更是確保產業鏈健康、穩健的重要角色。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者之一，將持續提供下游產業鏈創新所需的先進製程技術及具規模的產能。

2.2.4 台積公司之市場定位、差異化與策略

台積公司的市場定位

台積公司在先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝技術的發展上，是全球積體電路製造服務領域的領導公司之一。民國一百一十四年，台積公司產出占「積體電路製造2.0」市場產值的40%，較民國一百一十三年的34%增加。台積公司營業收入淨額以地區劃分（主要依據客戶營運總部所在地），北美市場占75%、亞太市場（不含中國大陸與日本）占9%、中國大陸市場占9%、日本市場占4%、歐洲、中東及非洲市場占3%。依據產品平台來區分，高效能運算占58%、智慧型手機占29%、物聯網占5%、車用電子占5%。此外，消費性電子產品占1%，其他產品則為剩餘的2%。

台積公司的差異化優勢

台積公司的領導地位奠基於三大明確的競爭優勢，以及根植於其承襲的業務策略。公司憑藉對「技術領先、卓越製造和客戶信任」的堅定承諾而脫穎而出。

台積公司作為技術領導者，始終是首家推出最新世代積體電路製造服務技術的公司。同時，台積公司將開發先進技術所累積的經驗應用於精進其成熟製程專業技術，使其在較成熟的製程技術領域中也保持領先地位。除了製程技術，台積公司卓越的前段及後段製程整合能力，包括封裝、測試和先進系統的整合，提供「功耗、效能及晶片尺寸」最佳化的競爭優勢，協助客戶更快實現量產。

台積公司領先業界的積體電路製造能力已獲得高度肯定；並藉由「開放創新平台」（Open Innovation Platform®）以及台積大同盟（TSMC Grand Alliance），進一步強化了台積公司的領導地位。台積公司的「開放創新平台」加速了半導體設計產業與台積公司設計生態系統合作夥伴的創新，也加速了台積公司在自有矽智財開發、設計技術協同優化能力（Design-Technology Co-Optimization, DTCO）、先進製程技術，以及應用先進封裝服務的系統技術協同優化能力（System-Technology Co-Optimization, STCO）等方面的創新。「開放創新平台」是一個完整的設計生態系統，透過台積公司開發與支援的協同合作平台，加速供應鏈各方面的創新。而台積大同盟則是半導體產業中最具創新力的力量之一，匯集了客戶、電子設計自動化（EDA）工具供應商、矽智財（IP）夥伴、設計服務和雲端基礎設施供應商，以及台積公司3DFabric®聯盟的合作夥伴，其中還包括設備和材料供應商，進而實現更高層次的協作。透過這個生態系統，大同盟旨在協助客戶和聯盟成員加速創新、降低開發成本、提高互通性，並實現新的架構和系統，同時確保台積公司在贏得業務方面的競爭力。

台積公司自民國七十六年成立以來，始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，而這正是客戶信任台積公司的基礎。秉持此一承諾，台積公司從未設計、生產或銷售任何自有品牌的晶片產品或積體電路元件，而是投注公司所有努力與資源成為客戶所信賴的專業積體電路製造服務公司。

台積公司策略

台積公司深信，差異化的競爭優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。針對高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子，以及消費性電子產品這五個主要市場，並因應客戶需求從以製程技術為中心轉變為以產品應用為中心，台積公司已經分別建構五個對應的技術平台，提供客戶完備且具競爭優勢的邏輯製程技術、特殊製程技術、矽智財，以及封裝測試技術，協助客戶縮短晶片設計時程及加速產品上市速度。這五個技術平台分別為：

高效能運算：在巨量數據運算和人工智慧應用創新的驅動下，高效能運算已成為台積公司業務增長的主要動力。台積公司為無晶圓廠設計公司及系統公司客戶提供領先的邏輯製程技術，例如2奈米奈米片（2nm Nanosheet, N2）電晶體、3奈米鰭式場效（3nm FinFET, N3）電晶

體、4奈米鰭式場效（4nm FinFET, N4）電晶體、5奈米鰭式場效（5nm FinFET, N5）電晶體、6奈米鰭式場效（6nm FinFET, N6）電晶體、7奈米鰭式場效（7nm FinFET, N7）電晶體等，以及包括高速互連技術等完備的矽智財，以滿足客戶產品在任何地點和時間傳輸和處理大量資料的需求。尤其是台積公司推出了為高效能運算產品所量身打造的製程技術－N4X、N3X和N2X，分別在台積公司5奈米、3奈米和2奈米系列製程技術中，展現極致效能與最高運作時脈。基於先進製程技術，多種高效能運算產品已被導入市場，例如人工智慧加速器（人工智慧繪圖處理器和人工智慧特殊應用元件）、個人電腦中央處理器、消費性繪圖處理器、可程式邏輯閘陣列（Field Programmable Gate Array, FPGA）、伺服器處理器、高速網路晶片等。這些產品可以應用於當前及未來的5G/6G通訊基礎設備、人工智慧、雲端（Cloud）和企業資料中心（Data Center）。台積公司也提供多種TSMC 3DFabric®先進矽堆疊與封裝解決方案，例如TSMC-SoIC®製造服務和CoWoS®先進封裝服務，協助完成同質和異質晶片整合，達到客戶對高效能、高計算密度和高能源效率、低延遲以及高度整合的需求。台積公司將持續優化高效能運算平台，並強化與客戶協同合作，以幫助客戶掌握高效能運算領域的市場成長。

智慧型手機：針對客戶在頂級產品的應用，台積公司提供領先的N2強效版（N2 Plus, N2P）、N3強效版（N3 Plus, N3P）、N3增強型（N3 Enhanced, N3E）、N3、N4強效版（N4 Plus, N4P）、N4、N5強效版（N5 Plus, N5P）及N5等邏輯製程技術以及完備的矽智財，更進一步提升晶片效能、降低功耗及晶片尺寸。針對客戶在主流產品的應用，則提供廣泛多樣的邏輯製程技術，包括N3精簡型（N3 Compact, N3C）、N4精簡型（N4 Compact, N4C）、N6鰭式場效電晶體、7奈米強效版（N7 Plus, N7+）鰭式場效電晶體、N7、12奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+）、12奈米鰭式場效電晶體FinFET精簡型（12nm FinFET Compact, 12FFC）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（16nm FinFET Compact Plus, 16FFC+）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型（16nm FinFET Compact, 16FFC）、28奈米高效能精簡型強效版製程技術（28nm High Performance Compact Plus, 28HPC+）、28奈米高效能精簡型製程技術（28nm High Performance Compact, 28HPC）和22奈米超低功耗（22nm Ultra-Low Power, 22ULP）等，以及完備的矽智財，滿足客戶對高效能、低功耗晶片產品的需求。此外，不論頂級與主流產品應用，台積公司也提供客戶領先業界且具高度競爭力的特殊製程技術為客戶產出配搭邏輯應用處理器的特殊製程晶片，包括射頻、射頻前端、嵌入式非揮發性記憶體、電源管理、感測器、顯示晶片等特殊製程技術，以及多種TSMC 3DFabric®先進封裝服務，例如台積公司領先產業的整合型扇出技術。

物聯網：因應物聯網領域在多元聯網、智能和節能的三大發展趨勢，台積公司除了提供客戶堅實的邏輯技術，包括4奈米、5奈米、6奈米、7奈米、12奈米、16奈米、28奈米等，亦以其邏輯技術為基礎，建構了領先、完備，且高整合度的超低功耗技術平台來實現客戶智慧物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIoT）與邊緣人工智慧（Edge AI）的產品創新。

台積公司領先業界的超低功耗（Ultra Low Power, ULP）技術具備能源效率與高效能，能夠提供更多運算及人工智慧推論（AI Inferencing）能力，並降低系統功耗。採用FinFET架構的6奈米－N6e® ULP技術服務和12奈米－N12e® ULP技術服務皆已進入量產，更新一代的4奈米ULP技術已著手進行開發。此外，基於平面電晶體架構的主流技術，例如22奈米超低漏電（Ultra-Low Leakage, ULL）技術、28奈米ULP技術、40奈米ULP技術，以及55奈米ULP技術，也已被各種物聯網系統單晶片（IoT System-on-a-Chip, IoT SoC）和電池供電的產品所廣泛採用以延長電池壽命。

同時，台積公司ULP技術平台也提供客戶完備的特殊製程技術，涵蓋射頻、強化版類比元件、嵌入式非揮發性記憶體、感測器、顯示器元件和電源管理晶片等需求。對於極低功耗產品應用，台積公司更進一步擴展低操作電壓（Low Operating Voltage, Low Vdd）技術，並提供更寬操作電壓範圍的電子電路模擬模型（Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE）及設計指南，以降低採用門檻及導入時間，協助客戶成功推出創新產品。

車用電子：台積公司提供完備的技術與服務，以滿足車用電子產業中的三大應用趨勢：建造更安全、更智慧和更環保的交通工具。同時，也是業界推出堅實的車用矽智財生態系統的領導公司之一，提供3奈米、4奈米、5奈米、7奈米與16奈米鰭式場效電晶體技術，以滿足下一世代交通工具內燃機引擎（Internal Combustion Engine, ICE）及電動車對先進駕駛輔助系統、先進座艙系統（In-Vehicle Infotainment, IVI），及針對新型電氣／電子架構的區域控制器的需求。N3A是基於其N3E技術，為台積公司迄今為止最先進的車用規格（Automotive Grade）技術，已於民國一百一十四年提供給客戶。

除了先進邏輯技術平台外，台積公司亦提供完備的車用規格特殊製程技術，包括28奈米嵌入式快閃記憶體、用於毫米波應用的28奈米、22奈米、16奈米射頻、高動態範圍（High Dynamic Range, HDR）及高靈敏度的互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）、光學雷達（Light Detection and Ranging, LiDAR）感測器和電源管理晶片技術。在磁性隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random-Access Memory, MRAM）方面，16奈米技術為第二代的技術，也於民國一百一十四年通過汽車Grade-1標準的驗證。22奈米超低漏電電阻式隨機存取記憶體（Resistive Random-Access Memory, RRAM）亦於民國一百一十四年通過汽車Grade-1標準的驗證。

消費性電子：台積公司提供客戶領先且全面的技術，為消費性電子產品應用提供卓越性能的8K/4K視訊串流、人工智慧功能，以及更高的電源效率和無縫連接效能，包括智能數位電視（Digital TV, DTV）、機上盒（Set-Top Box, STB）、具備人工智慧的智能數位相機（AI-Embedded Smart Camera）及相關的無線區域網路（Wireless Local Area Network, WLAN）、電源管理晶片等。台積公司先進的N5、N7/N6、N16/N12及22ULP/ULL技術，已被全球領先的8K/4K數位電視及機上盒、4K串流媒體設備／過頂服務（Over-The-Top, OTT）、數位單眼相機（Digital Single-Lens Reflex, DSLR）等廠商廣泛採用。針對客戶數位密集的晶片設計，台積公司將持續透過設計技術協同優化，推出更具效益的技術，並推出更低功耗的技術，以利採用更具成本效益的封裝。

台積公司將繼續強化其核心競爭力，適切規劃公司長短期技術及業務發展策略，以協助客戶因應電子產品週期短以及市場上激烈競爭的挑戰，以達成投資報酬率與成長目標。

●短期業務發展計劃

1. 持續投資擴充產能及研發，以擴大市場及維持台積公司在先進製程技術領域的領先地位。
2. 開發新客戶及新的應用領域，以維持台積公司在主流技術製程領域的市場占有率。
3. 持續強化高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子及消費性電子產品技術平台的競爭優勢，以擴展台積公司在這些產品應用的專業積體電路製造服務業務。
4. 進一步拓展台積公司在新興市場及發展中市場的業務與服務。

●長期業務發展計劃

1. 持續依照可預測的節奏發展先進製程技術，提升節能運算效能。
2. 進一步發展衍生性半導體製程技術，來增加特殊製程相關應用對營業的貢獻。
3. 提供更多整合服務，涵蓋產品系統整合設計（System-Level Integration Design）、設計技術定義、設計工具發展、晶圓製造、TSMC 3DFabric®先進矽堆疊與封裝解決方案，以及後段封裝與測試等，透過最佳化解決方案為客戶提供更高的價值。

2.3 董事會成員

2.3.1 董事會成員簡介

截至民國一百一十五年二月二十八日止

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選（就）任 日期（註一）	任期至 （註一）	初次選任 日期（註一）	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學／經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率		
董事長 魏哲家	男 71-75	中華民國	113/06/04	116/06/03	106/06/08	6,392,834	0.02%	7,217,009	0.03%	700,261	0.00%	**學歷及專業資格** 國立交通大學電機工程學士及碩士 美國耶魯大學電機工程博士 國立陽明交通大學名譽博士 工業技術研究院院士 **經歷** 新加坡特許半導體公司技術資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 台積公司副董事長 臺灣半導體產業協會理事長	台積公司總裁
董事 曾繁城	男 81-85	中華民國	113/06/04	116/06/03	86/05/13	29,472,675	0.11%	29,472,675	0.11%	5,132,855	0.02%	**學歷及專業資格** 國立成功大學電機工程學士 國立交通大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程博士 國立交通大學名譽博士 國立清華大學名譽博士 **經歷** 世界先進積體電路（股）公司總經理 台積公司總經理 台積公司副總執行長 台積公司副董事長 宏碁（股）公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員 財團法人國家文化藝術基金會董事 **目前兼任非營利組織之職務** 財團法人台積電文教基金會董事長 財團法人雲門文化藝術基金會董事 醫療財團法人竹銘基金會董事	台積電（中國）有限公司董事長（非公開發行公司） 創意電子（股）公司董事長 世界先進積體電路（股）公司副董事長 力旺電子（股）公司董事
董事 行政院國家發展基金管理會 （註三） 代表人： 葉俊顯	男 56-60	中華民國	113/06/04	116/06/03	75/12/10	1,653,709,980	6.38%	1,653,709,980	6.38%	-	-	**學歷及專業資格** 美國紐約羅徹斯特大學經濟學博士 獲頒吳大猷先生紀念獎 獲頒110年度及114年度國家科學及技術委員會傑出研究獎 **經歷** 中央研究院經濟研究所助研究員 國立中央大學經濟系副教授 中央研究院經濟研究所副研究員 中華經濟研究院副院長 臺灣中小企業銀行常務董事 中華經濟研究院院長 臺灣經濟學會理事 **目前兼任非營利組織之職務** 中央研究院經濟研究所研究員 行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員 行政院國家發展基金管理會召集人	臺灣中小企業銀行董事（行政院國家發展基金管理會代表人）
					114/09/01 （註四）	-	-	-	-	-	-		

（接次頁）

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選（就）任 日期（註一）	任期至 （註一）	初次選任 日期（註一）	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學／經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率		
獨立董事 彼得・邦菲爵士	男 81-85	英國	113/06/04	116/06/03	91/05/07	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** 英國Loughborough大學工程學士 英國Loughborough大學Honorary Doctorate of Technology 倫敦皇家工程學院院士 1996年冊封爵士勳銜 1989年獲頒CBE勳章 獲頒the Lion of Finland勳章 獲頒Institute of Management金質獎章 National Electronics Council頒發Mountbatten獎章 2019年獲頒FT ODX傑出董事獎 獲頒授名譽博士學位計11個 2024年獲頒奧倫治拿索司令勳章 **經歷** 德州儀器公司半導體工程師（美國） 恩智浦半導體公司董事長（荷蘭） ICL Plc董事長暨執行長（英國） 英國電信公司執行長及Executive Committee主席 GlobalLogic公司董事長（美國） 英國品質基金會副總裁 Mentor Graphics公司董事（美國） Sony公司董事（日本） L.M. Ericsson公司董事（瑞典） AstraZeneca資深獨立董事（英國） Loughborough大學Chair of Council and Senior Pro-Chancellor（英國） Board Member, EastWest Institute（紐約） Alix Partners LLP資深顧問（倫敦） The Longreach Group公司諮詢委員會委員（香港） Citigroup公司國際諮詢委員會委員（美國） Board Mentor, Chairman Mentors International（CMi）公司（倫敦） Darktrace公司非執行董事（英國）	Imagination Technologies Group公司非執行董事（英國） （非公開發行公司）
獨立董事 麥克・史賓林特	男 71-75	美國	113/06/04	116/06/03	104/06/09	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** 美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士 美國威斯康辛大學麥迪森分校工程榮譽博士 獲頒美國半導體產業協會最高榮譽2013 Robert N. Noyce Award 美國國家工程院院士 獲頒美國公司董事協會之2020 Directorship Certified™認證 **經歷** 英特爾公司技術與製造事業群執行副總裁（美國） 英特爾公司全球業務行銷執行副總裁（美國） 應用材料公司執行長（美國） 應用材料公司董事長（美國） The NASDAQ OMX Group公司董事（美國） 矽谷領袖集團董事（Silicon Valley Leadership Group） 國際半導體產業協會（SEMI）董事 Meyer Burger Technology公司董事（瑞士） NASDAQ公司董事長（美國） Pica8公司董事（美國） 威斯康辛大學基金會董事（美國） 美台商業協會理事主席 Gogoro公司（英屬開曼群島）獨立董事及薪資報酬委員會主席 美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席 美國Natcast Trustees主席	NASDAQ公司首席獨立董事（美國） Tigo Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨公司治理委員會委員（美國） Kioxia Holdings公司獨立董事（日本） WISC Partners創投基金合夥人（美國） MRS商業和技術顧問公司合夥人（美國） （非公開發行公司）
獨立董事 摩西・蓋弗瑞洛夫	男 71-75	美國	113/06/04	116/06/03	108/06/05	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** Technion以色列理工學院電機工程學士 Technion以色列理工學院電腦科學碩士 **經歷** National Semiconductor公司及Digital Equipment公司歷任多項工程師及管理工程師職務（美國） LSI Logic公司歷任多項經理人職務近10年（美國） Verisity公司執行長（美國） Cadence Design Systems公司執行副總經理及驗證處General Manager（美國） 賽靈思公司總經理暨執行長（美國） 賽靈思公司董事（美國） Wind River Systems公司執行董事長（美國） San Jose Institute of Contemporary Art董事（美國） Matrix Capital Management公司顧問（美國）	SiMa Technologies公司董事長（美國）（非公開發行公司） Foretellix公司董事長（以色列）（非公開發行公司） 恩智浦半導體公司獨立董事（荷蘭） Cadence Design Systems公司獨立董事（美國）

（接次頁）

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選（就）任 日期（註一）	任期至 （註一）	初次選任 日期（註一）	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學／經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率		
獨立董事 拉斐爾·萊夫	男 71-75	美國	113/06/04	116/06/03	110/07/26	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** 委內瑞拉Carabobo大學電機工程學士 美國史丹佛大學電機工程碩士及博士 香港中文大學榮譽法學博士（2015） 清華大學（2016）、以色列Technion學院（2017）、亞利桑那州立大學（2018）及邁阿密大學（2022）榮譽博士 Tau Beta Pi, the Engineering Honor Society會員 The Electrochemical Society會員 Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）院士 美國文理科學院、美國國家工程院及中國工程院院士 美國國家發明家科學院院士 獲頒美國總統青年學者獎（1984） 美國Semiconductor Research Corporation頒發Aristotle獎（2000） 獲頒Tribeca Disruptive Innovation獎（2012） 美國Woodrow Wilson National Fellowship Foundation 頒發Frank E. Taplin, Jr. Public Intellectual獎（2015） 獲頒Great Minds in STEM年度工程師（2018） 美國國家工程院美國國家工程院Simon Ramo Founders獎（2022） 發明或共同發明13項專利、編輯或共同編輯5本書，及指導38篇博士論文 **經歷** 委內瑞拉Simón Bolívar大學助理教授 美國史丹佛大學電機工程客座助理教授 美國麻省理工學院（MIT）教職（1980-） MIT材料科學與工程中心IBM院士 MIT電機工程Analog Devices職涯發展教授 MIT Fariborz Maseeh新興技術教授（2004-2012） MIT微系統技術實驗室主任 MIT電機工程系副主任 MIT電機暨電腦資訊系主任 MIT教務長 Alcoa公司獨立董事（美國） Arconic公司董事（美國） Schlumberger公司董事 MIT校長（2012-2022） Massachusetts General Hospital Trustees成員（美國） **目前兼任非營利組織之職務** MIT榮譽校長（2023-） MIT Ray and Maria Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授（2023-） 卡內基國際和平基金會Trustees成員 美國外交關係協會董事 Waverley Street基金會董事（美國） Instituto Tecnológico de Monterrey Trustees成員（墨西哥）	應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席（美國） Engine No. 1 LP董事（美國）（非公開發行公司）
獨立董事 烏蘇拉·伯恩斯	女 66-70	美國	113/06/04	116/06/03	113/06/04	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** 美國紐約大學Polytechnic Institute機械工程學士 美國哥倫比亞大學機械工程碩士 美國國家工程院院士 美國文理科學院院士 倫敦皇家工程學院院士 **經歷** 全錄公司董事長、執行長及總裁（美國） VEON公司董事長及執行長（荷蘭） 美國運通公司董事 雀巢公司董事（瑞士） ExxonMobil公司董事（美國） Plum Acquisition Corp. I執行董事長（美國） 美國"White House National Program on Science, Technology, Engineering and Math (STEM)" Leader 美國President's Export Council主席 G7性別平等諮詢委員會委員 Endeavor Group Holdings公司董事（美國） 美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席 **目前兼任非營利組織之職務** 美國福特基金會Trustees成員 MIT Corp. Trustees成員 美國大都會藝術博物館Trustees成員 美國Mayo Clinic Trustees成員 美國Scratch Foundation Trustees成員 美國The High Line Trustees成員 美國FIRST Trustees成員 美國NAF Trustees成員 美國Columbia Engineering Trustees成員 美國University of Rochester Trustees成員	Teneo Holdings公司非執行董事長（美國）（非公開發行公司） IHS Holding公司獨立非執行董事（英屬開曼群島） Uber Technologies公司董事（美國） Evertree保險服務公司董事（美國）（非公開發行公司） CleanCo創投有限公司董事（英國）（非公開發行公司） CardioSignal公司董事（美國）（非公開發行公司） True Partner Capital公司董事（美國）（非公開發行公司） Integrum Holdings公司創始合夥人（美國）（非公開發行公司）

（接次頁）

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選（就）任 日期（註一）	任期至 （註一）	初次選任 日期（註一）	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學／經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率		
獨立董事 琳恩・埃爾森漢斯	女 66-70	美國	113/06/04	116/06/03	113/06/04	-	-	-	-	-	-	**學歷及專業資格** 美國萊斯大學應用數學學士 美國哈佛大學企業管理碩士 **經歷** Sunoco公司董事長、總裁及執行長（美國） Sunoco Logistics Partners公司董事長及執行長（美國） Shell Downstream公司全球製造執行副總裁（美國） Shell Oil Products公司總裁及執行長（美國） Shell Oil公司總裁及Country Chair for Shell（美國） International Paper公司獨立董事（美國） Flowserve公司獨立董事（美國） GlaxoSmithKline公司獨立董事（英國） 沙烏地阿拉伯石油公司審計委員會主席（2020-2024） **目前兼任非營利組織之職務** Johns Hopkins Whiting School of Engineering諮詢委員會委員	Baker Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席（美國） 沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事、審計委員會委員及提名委員會委員 Peter Kiewit and Sons公司獨立董事（美國）（非公開發行公司）
獨立董事 林全	男 71-75	中華民國	113/06/04	116/06/03	113/06/04	126,826	0.00%	126,826	0.00%	16,003	0.00%	**學歷及專業資格** 輔仁大學經濟學士 國立政治大學財政學碩士 美國伊利諾大學香檳校區經濟學博士 **經歷** 中華經濟研究院研究員 國立政治大學財政學系教授及系主任 台北市政府財政局局長 行政院主計處主計長 財政部部長 行政院院長 世界先進積體電路（股）公司董事長 鎧勝控股有限公司獨立董事 華亞科技（股）公司獨立董事 智擎生技製藥（股）公司董事 美亞產物保險（股）公司董事 新境界文教基金會執行長 **目前兼任非營利組織之職務** 總統府資政	台灣東洋藥品工業（股）公司董事長 東生華製藥（股）公司董事長（台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人） 和碩聯合科技（股）公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員

附註：
1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無
2. 董事與其他主管或董事具配偶或二親等以內關係：無
3. 董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：為因應當前快速變化與激烈競爭的半導體產業，台積公司董事會於民國113年6月4日股東會董事改選後，推舉魏哲家博士擔任董事長暨總裁，相信在魏哲家博士的領導下，將能有效連結董事會與管理階層，發揮決策與執行的高效性，以最大化股東價值。本公司目前獨立董事人數有七名，占全體董事席次的70%，其餘董事皆未兼任經理人或員工，因此董事會在決策過程中能夠保持獨立性，提供專業的監督及指導，符合股東和市場對公司穩定性和長期價值的期望。

註一：民國年/月/日。
註二：不含美國存託憑證表彰之股數。
註三：該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例占前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

註四：行政院國家發展基金管理會原派任本公司董事代表人劉鏡清先生，於民國一百一十四年九月一日改派葉俊顯博士擔任。

2.3.2 一般董事及獨立董事之酬金（註一）

單位：新台幣元

職稱 姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後淨利之比例 (%)		兼任員工領取之相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後淨利之比例 (%) (註六)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
	報酬 (A)		退職退休金 (B) (註三)		董事酬勞 (C) (註四)		業務執行費用 (D) (註五)				薪資、獎金及特支費等 (E) (註五)		退職退休金 (F) (註三)		酬勞（分紅）(G)						
															本公司		財務報告內所有公司				
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長暨總裁 魏哲家	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	1,974,517,640	1,974,517,640	276,489	276,489	447,900,290	-	447,900,290	-	2,422,694,419 0.1410%	2,422,694,419 0.1410%	-
董事 曾繁城	-	-	-	-	12,144,000	12,144,000	1,061,305	1,061,305	13,205,305 0.0008%	13,205,305 0.0008%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,205,305 0.0008%	13,205,305 0.0008%	18,591,667
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人： 葉俊顯（註二）	-	-	-	-	12,144,000	12,144,000	-	-	12,144,000 0.0007%	12,144,000 0.0007%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,144,000 0.0007%	12,144,000 0.0007%	-
獨立董事 彼得・邦菲爵士	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 麥克・史賓林特	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 摩西・蓋弗瑞洛夫	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 拉斐爾・萊夫	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 烏蘇拉・伯恩斯	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 琳恩・埃爾森漢斯	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
獨立董事 林全	-	-	-	-	18,859,632	18,859,632	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,859,632 0.0011%	18,859,632 0.0011%	-
總計	0	0	0	0	156,305,424	156,305,424	1,061,305	1,061,305	157,366,729 0.0092%	157,366,729 0.0092%	1,974,517,640	1,974,517,640	276,489	276,489	447,900,290	0	447,900,290	0	2,580,061,148 0.1502%	2,580,061,148 0.1502%	18,591,667

*除上表揭露外，民國一百一十四年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任母公司／財務報告內所有公司／轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：曾繁城博士，新台幣19,891,747元。

註一：台積公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司公司章程規定，本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之0.3%作為董事酬勞，且給付之對象不包括兼任經理人之董事。依本公司薪酬暨人才發展委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事酬勞給付辦法」辦理，原則如下：(1) 董事兼任經理人者，不參與董事酬勞之分配；(2) 因所有獨立董事皆會擔任不同委員會的委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其酬勞得高於一般董事。

註二：行政院國家發展基金管理會原派任本公司董事代表人劉鏡清先生，於民國一百一十四年九月一日改派葉俊顯博士擔任。

註三：此為依法提繳之退休金。

註四：董事酬勞係依預期發放金額估計入帳，若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於完成發放年度調整入帳。

註五：此費用包含配車費用、油資補貼，但不包括給付司機之相關報酬計新台幣6,971,338元。

註六：本公司及財務報告內所有公司民國一百一十三年董事酬金（含兼任員工之相關酬金）占民國一百一十三年度稅後淨利之比例皆為0.1239%。

2.4 主要經理人

2.4.1 主要經理人資料

截至民國一百一十五年二月二十八日止

職稱 姓名	性別	國籍	就任日期 （註一）	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學／經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管		
				股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率			職稱	姓名	關係
魏哲家 董事長暨總裁（註三）	男	中華民國	87/02/01	7,217,009	0.03%	700,261	0.00%	-	-	美國耶魯大學電機工程博士 台積公司總裁 台積公司總經理暨共同執行長 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 新加坡特許半導體公司資深副總經理	無	無	無	無
秦永沛 執行副總經理暨共同營運長 共同營運長辦公室、營運	男	中華民國	76/01/01	5,107,526	0.02%	4,190,107	0.02%	-	-	國立成功大學電機工程碩士 台積公司營運及海外營運辦公室資深副總經理 台積公司產品發展資深副總經理 台積公司先進技術事業副總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
米玉傑 執行副總經理暨共同營運長 共同營運長辦公室、研究發展	男	中華民國	83/11/14	1,189,648	0.00%	-	-	-	-	美國加州大學洛杉磯分校電機工程博士 台積公司研究發展資深副總經理 台積公司技術發展副總經理 台積公司平台一處資深處長	無	無	無	無
侯永清 資深副總經理暨副共同營運長 資訊安全長	男	中華民國	86/12/15	597,994	0.00%	60,802	0.00%	-	-	美國紐約雪城大學電機博士 台積公司歐亞業務及研究發展／技術研究資深副總經理 台積公司技術發展資深副總經理 台積公司設計暨技術平台副總經理 台積公司設計暨技術平台資深處長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
張曉強 資深副總經理暨副共同營運長 業務開發、全球業務	男	美國	105/11/01	265,254	0.00%	-	-	-	-	美國杜克大學電機工程博士 台積公司業務開發及海外營運辦公室資深副總經理 台積公司設計暨技術平台副總經理 美國英特爾公司技術與製造副總經理	無	無	無	無
何麗梅 資深副總經理 企業策略發展組織	女	中華民國	88/06/01	4,579,603	0.02%	2,039,530	0.01%	-	-	國立台灣大學商學碩士 台積公司人力資源資深副總經理 台積公司歐亞業務資深副總經理 台積公司財務資深副總經理暨財務長兼發言人 台積公司會計處協理 德碁半導體公司副總經理暨財務長	台積公司所屬子公司董事／監察人	無	無	無
方淑華 資深副總經理暨法務長 公司治理主管 法務	女	中華民國	84/03/20	817,518	0.00%	67,906	0.00%	384,000	0.00%	美國愛荷華大學比較法學碩士 台灣律師資格 台積公司法務副總經理暨法務長 台積公司副法務長 台灣國際專利法律事務所資深法務專員	台積公司所屬子公司董事／監察人	無	無	無
黃仁昭 資深副總經理暨財務長兼發言人 財務	男	中華民國	88/05/03	1,770,669	0.01%	-	-	-	-	美國康乃爾大學企管碩士 台積公司財務副總經理暨財務長 台積公司副財務長 台積公司財務處資深處長 英國霸菱銀行企業財務副總經理 美國大通銀行企業財務副總經理 美商信孚銀行企業財務副總經理	台積公司所屬子公司董事／監察人／總經理 台積公司轉投資公司董事	無	無	無
王英郎 資深副總經理 營運／晶圓廠營運一（註四）	男	中華民國	81/06/01	321,518	0.00%	1,135,529	0.00%	-	-	國立交通大學電子工程博士 台積公司晶圓廠營運一副總經理 台積公司亞利桑那子公司執行長 台積公司晶圓廠營運副總經理 台積公司技術發展副總經理 台積公司十四B廠副總經理 台積公司十四B廠資深廠長	無	無	無	無
張宗生 資深副總經理、台積資深科技院士 營運／先進技術暨光罩工程 （註四、五）	男	中華民國	84/02/06	276,764	0.00%	-	-	-	-	國立清華大學電機工程博士 台積公司先進技術暨光罩工程副總經理 台積公司產品發展副總經理 台積公司十二B廠副總經理 台積公司十二B廠資深廠長	無	無	無	無
吳顯揚 資深副總經理 研究發展／平台技術、研究發展／技術開發效能促進辦公室（註四）	男	中華民國	85/12/09	589,354	0.00%	198,943	0.00%	-	-	美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程博士 台積公司平台技術／技術開發效能促進辦公室副總經理 台積公司平台研發處資深處長	無	無	無	無
葉主輝 資深副總經理 研究發展／平台技術（註四）	男	美國	105/03/21	175,694	0.00%	-	-	-	-	美國德州大學奧斯汀分校電機與計算機工程博士 台積公司平台技術副總經理 台積公司平台研發處資深處長 台積公司先進技術處資深處長 美國高通公司矽科技工程副總經理	無	無	無	無

（接次頁）

職稱 姓名	性別	國籍	就任日期 （註一）	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學／經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管（註三）		
				股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率	股數（註二）	持股比率			職稱	姓名	關係
曹敏 副總經理 研究發展／技術研究、 研究發展／Pathfinding	男	美國	91/07/29	467,005	0.00%	34,470	0.00%	-	-	美國史丹佛大學物理博士 台積公司Pathfinding處資深處長	無	無	無	無
廖永豪 副總經理 營運／晶圓廠營運二 執行長 JASM	男	中華民國	77/08/03	437,044	0.00%	-	-	430,000	0.00%	國立清華大學化學工程碩士 台積公司晶圓廠營運副總經理 台積公司十五B廠副總經理 台積公司十五B廠資深廠長	台積公司所屬子公司董事 台積公司轉投資公司董事	無	無	無
章勳明 副總經理 研究發展／先進設備暨模組發展	男	中華民國	82/09/01	417,869	0.00%	2,000	0.00%	-	-	美國麻省理工學院材料科學與工程博士 台積公司先進設備暨模組發展處資深處長	無	副處長	章勳嵐	妹
游秋山 副總經理 研究發展／特殊技術	男	中華民國	77/06/16	1,771,604	0.01%	219,924	0.00%	851,908	0.00%	美國伍斯特理工學院化學工程博士 台積公司歐亞業務副總經理 台積公司策略客戶專案辦公室資深處長 台積公司電子束作業處資深處長	台積公司轉投資公司董事	無	無	無
何軍 副總經理 營運／先進封裝技術暨服務	男	中華民國	106/05/22	94,109	0.00%	-	-	-	-	美國加州大學聖塔芭芭拉分校材料科學與工程博士 台積公司品質暨可靠性副總經理 台積公司品質暨可靠性資深處長 美國英特爾公司技術暨製造群品質暨可靠性主管暨資深處長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
林宏達 副總經理暨資訊長 企業資訊技術	男	美國	110/01/04	102,174	0.00%	15,000	0.00%	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機工程與計算機科學博士 美國Mozilla公司資訊技術副總經理 美國臉書公司企業平台架構處長	無	無	無	無
李俊賢 副總經理 企業規劃組織	男	中華民國	96/05/28	480,022	0.00%	6,000	0.00%	-	-	美國紐約市立大學柏魯克分校企管碩士 台積公司策略規劃處資深處長	無	無	無	無
莊子壽 副總經理 營運／廠務	男	中華民國	78/01/17	2,669,155	0.01%	1,993,140	0.01%	-	-	國立台灣大學土木工程博士 台積公司廠務處資深處長	台積公司所屬子公司董事	技術副理	莊子安	弟
魯立忠 副總經理、台積資深科技院士 研究發展／設計暨技術平台 （註五）	男	中華民國	89/08/01	245,706	0.00%	15,000	0.00%	-	-	美國耶魯大學資訊工程博士 台積公司數位智慧財產設計方案處資深處長	台積公司所屬子公司董事／總經理 台積公司轉投資公司董事	無	無	無
徐國晉 副總經理 研究發展／Integrated Interconnect & Packaging	男	中華民國	110/11/01	152,914	0.00%	10,000	0.00%	-	-	國立交通大學科技管理碩士 台灣美光公司董事長 WaferTech LLC總經理	無	無	無	無
莊瑞萍 副總經理 營運／晶圓廠營運一 執行長（註六） 台積公司亞利桑那子公司	男	中華民國	86/12/15	224,875	0.00%	106,000	0.00%	-	-	美國史丹佛大學材料科學與工程／工程經濟系統碩士 台積公司十八A廠資深廠長 台積公司十二B廠廠長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
陳培宏 副總經理 人力資源	男	中華民國	79/08/01	433,414	0.00%	83,143	0.00%	-	-	國立中山大學化學系碩士 台積公司專案辦公室資深處長 台積公司十四A廠資深廠長	無	無	無	無
黃遠國 副總經理 資材管理（註七）	男	中華民國	84/07/17	206,418	0.00%	-	-	-	-	美國德克薩斯大學阿靈頓分校企管碩士 台積公司資材管理資深處長 台積公司十八B廠資深廠長 台積公司十八B廠廠長	無	無	無	無
田博仁 副總經理 營運／十二B廠（註七）	男	中華民國	87/02/02	5,051	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學電子工程碩士 台積公司十二B廠資深廠長 台積公司十二B廠廠長	無	無	無	無
林學仕 副總經理 研究發展／平台技術（註七）	男	中華民國	89/10/16	20,269	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學電子工程博士 台積公司平台技術資深處長 台積公司製程整合處資深處長 台積公司平台研發處資深處長 台積公司平台研發處處長	無	無	無	無
袁立本 副總經理 先進技術業務開發（註七）	男	中華民國	100/08/01	2,000	0.00%	1,600	0.00%	-	-	美國伊利諾大學厄巴納－香檳分校電機與電腦工程博士 台積公司先進技術業務開發資深處長 台積公司先進技術業務開發處長 台積公司前瞻設計方案與技術標竿處處長	無	無	無	無

註一：此為加入台積公司之日期（民國年/月/日）。
註二：不含美國存託憑證表彰之股數。
註三：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：為因應當前快速變化與激烈競爭的半導體產業，台積公司董事會於民國一百一十三年六月四日股東會董事改選後，推舉魏哲家博士擔任董事長暨總裁，相信在魏哲家博士的領導下，將能有效連結董事會與管理階層，發揮決策與執行的高效性，以最大化股東價值。本公司目前獨立董事人數有七名，占全體董事席次的70%，其餘董事皆未兼任經理人或員工，因此董事會在決策過程中能夠保持獨立性，提供專業的監督及指導，符合股東和市場對公司穩定性和長期價值的期望。
註四：王英郎博士、張宗生博士、吳顯揚博士及葉主輝博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為資深副總經理。
註五：張宗生博士及魯立忠博士於民國一百一十四年六月十七日獲擢升為台積資深科技院士。
註六：莊瑞萍先生於民國一百一十四年十月一日被任命為亞利桑那子公司執行長。
註七：黃遠國先生、田博仁先生、林學仕博士及袁立本博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為副總經理。

2.4.2 總裁及副總經理之酬金（註一）

單位：新台幣元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)（註六）		獎金及特支費等 (C)（註七）		酬勞（分紅）金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後淨利之比例（%）（註八）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長暨總裁	魏哲家	17,280,600	17,280,600	276,489	276,489	1,957,237,040	1,957,237,040	447,900,290	-	447,900,290	-	2,422,694,419 0.1410%	2,422,694,419 0.1410%	-
資深副總經理暨財務長兼發言人	黃仁昭	6,794,603	6,794,603	108,712	108,712	229,138,027	229,138,027	103,474,760	-	103,474,760	-	339,516,102 0.0198%	339,516,102 0.0198%	-
執行副總經理暨共同營運長	秦永沛	147,605,603	174,505,400	2,361,693	2,884,272	4,156,166,932	4,306,705,897	1,813,719,990	-	1,813,719,990	-	6,119,854,218 0.3562%	6,297,815,559 0.3666%	-
執行副總經理暨共同營運長	米玉傑													
資深副總經理暨副共同營運長／資訊安全長	侯永清													
資深副總經理暨副共同營運長	張曉強													
資深副總經理	何麗梅													
資深副總經理	羅唯仁（註二）													
執行顧問	瑞克·凱希迪（註二）													
資深副總經理／前資訊安全長	林錦坤（註二）													
資深副總經理暨法務長／公司治理主管	方淑華													
資深副總經理	王英郎（註三）													
資深副總經理、台積資深科技院士	張宗生（註三、四）													
資深副總經理	吳顯揚（註三）													
資深副總經理	葉主輝（註三）													
副總經理、台積卓越科技院士	余振華（註二）													
副總經理	曹敏													
副總經理／JASM執行長	廖永豪													
副總經理	章勳明													
副總經理	游秋山													
副總經理	何軍													
副總經理暨資訊長	林宏達													
副總經理	李俊賢													
副總經理	莊子壽													
副總經理、台積資深科技院士	魯立忠（註四）													
副總經理	徐國晉													
副總經理／台積公司亞利桑那子公司執行長	莊瑞萍													
副總經理	李文如（註二）													
副總經理	陳培宏（註五）													
總計		171,680,806	198,580,603	2,746,894	3,269,473	6,342,541,999	6,493,080,964	2,365,095,040	0	2,365,095,040	0	8,882,064,739 0.5170%	9,060,026,080 0.5274%	0

註一：台積公司給付經理人酬金之政策、標準與組合、程序及與經營績效及未來風險之關聯性：本公司經理人獲派之酬金金額，乃依其職務、貢獻、該年度公司經營績效及考量公司未來風險，經薪酬暨人才發展委員會審議並送交董事會決議。

註二：資深副總經理林錦坤先生於民國一百一十四年四月十日退休；資深副總經理瑞克·凱希迪於民國一百一十四年七月一日起轉任執行顧問；副總經理余振華博士於民國一百一十四年七月八日退休；副總經理李文如女士於民國一百一十四年七月十三日離職；資深副總經理羅唯仁博士於民國一百一十四年七月二十七日退休。

註三：王英郎博士、張宗生博士、吳顯揚博士及葉主輝博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為資深副總經理。

註四：張宗生博士及魯立忠博士於民國一百一十四年六月十七日獲擢升為台積資深科技院士。

註五：陳培宏先生於民國一百一十四年二月十二日獲擢升為副總經理。申報金額未含其被擢升前的薪酬。

註六：此為依法提繳之退休金。

註七：此費用包含公司民國一百一十四年五月、八月、十一月及民國一百一十五年二月發放之業績獎金及配車費用、油資補貼。

註八：本公司民國一百一十三年經理人之酬金，占民國一百一十三年度稅後淨利之比例為0.4330%，財務報告內所有公司民國一百一十三年經理人之酬金占民國一百一十三年度稅後淨利之比例為0.4516%。

本公司給付總裁及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定程序，與績效評估之連結及與未來風險之關聯性：

●酬金之政策、標準與組合

本公司給付總裁及經理人之酬金政策，係參酌其經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向，亦與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效。酬金包含薪資、按季發放之業績獎金、特支費，以及公司根據年度獲利狀況所發放之員工酬勞（分紅），並自民國一百一十年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG成果。本公司變動酬金占總體酬金之比例高於固定酬金占總體酬金之比例，並著重長期激勵性獎酬，使總裁及經理人之酬金與公司之長期經營績效、股東利益及ESG成果更加連結。前述酬金將定期由薪酬暨人才發展委員會審核，並經董事會決議核准。

●酬金之訂定程序

每季業績獎金及年度員工酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益。依本公司章程規定，年度如有獲利，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不低於百分之一為員工酬勞。業績獎金及員工酬勞（分紅）之發放次數、發放日期及發放要件，依公司獎金辦法辦理；實際分派比率、金額與分配方式，係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，業績獎金於每季發放，員工酬勞於董事會核准並於股東會報告後發放。

本公司另訂定限制員工權利新股發行辦法，使總裁及經理人之獎酬與股東利益及ESG成果連結，總裁及經理人之限制員工權利新股獲配股數乃參酌公司營運成果、個人職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總裁提出，經薪酬暨人才發展委員會同意並提報董事會核准。

●酬金與績效評估之連結

本公司總裁及經理人酬金依據公司獎金辦法辦理，辦法涵蓋公司營運目標及個人年度目標之達成。公司目標包含財務及非財務指標，個人年度目標含營運目標及ESG指標（著重於綠色製造、打造健康共融職場、建立責任供應鏈、培育人才、關懷弱勢），每位經理人獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。經理人報酬包含限制員工權利新股，既得期間為三年（限制員工權利新股相關資訊，請參閱本年報「4.6.1 限制員工權利新股辦理情形」，第84-91頁），以公司營運成果指標（公司股東總報酬率（TSR）指標相對標準普爾500 IT指數TSR）達成情形以及公司ESG成果為調整項。自民國一百一十四年起，台積公司實施年度長期激勵獎金辦法，以吸引並留任公司高階主管及關鍵人才。符合資格的參與者將以績效指標達成情形決定其取得比例。這些績效指標包含個人年度績效、公司財務指標（營業收入成長率、毛利率、股東權益報酬率）、公司股東總報酬率（TSR）指標相對標竿公司達成情形以及公司ESG成果。透過多元且明確的量化指標可以強化管理階層長期並持續創造公司收益、股東價值同時提高ESG目標達成績效，此與公司經營績效呈高度關聯性。

●酬金與未來風險之關聯性

本公司總裁及經理人之酬金除參考相關同業水準及公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之。公司的財務獎酬計劃與達成風險相關目標掛鉤，並在公司風險承受能力和容忍度範圍內追求公司的目標。

●薪酬索回政策

台積公司於民國一百一十二年訂定薪酬索回政策。（揭露於台積公司官網首頁/投資人關係/公司治理/重要公司內規/薪酬索回政策）

給付總裁及副總經理酬金級距

	民國114年度	
	本公司	本公司及所有轉投資事業
0 元~ 1,000,000元 (不含)	瑞克・凱希迪	無
1,000,000元 (含) ~ 2,000,000元 (不含)	無	無
2,000,000元 (含) ~ 3,500,000元 (不含)	無	無
3,500,000元 (含) ~ 5,000,000元 (不含)	無	無
5,000,000元 (含) ~ 10,000,000元 (不含)	無	無
10,000,000元 (含) ~ 15,000,000元 (不含)	無	無
15,000,000元 (含) ~ 30,000,000元 (不含)	無	無
30,000,000元 (含) ~ 50,000,000元 (不含)	李文如	李文如
50,000,000元 (含) ~ 100,000,000元 (不含)	無	無
100,000,000元以上	魏哲家、黃仁昭、秦永沛、米玉傑、侯永清、張曉強、何麗梅、羅唯仁、林錦坤、方淑華、王英郎、張宗生、吳顯揚、葉主輝、余振華、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、林宏達、李俊賢、莊子壽、魯立忠、徐國晉、莊瑞萍、陳培宏	魏哲家、黃仁昭、秦永沛、米玉傑、侯永清、張曉強、何麗梅、羅唯仁、瑞克・凱希迪、林錦坤、方淑華、王英郎、張宗生、吳顯揚、葉主輝、余振華、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、葉主輝、林宏達、李俊賢、莊子壽、魯立忠、徐國晉、莊瑞萍、陳培宏
總計	29	29

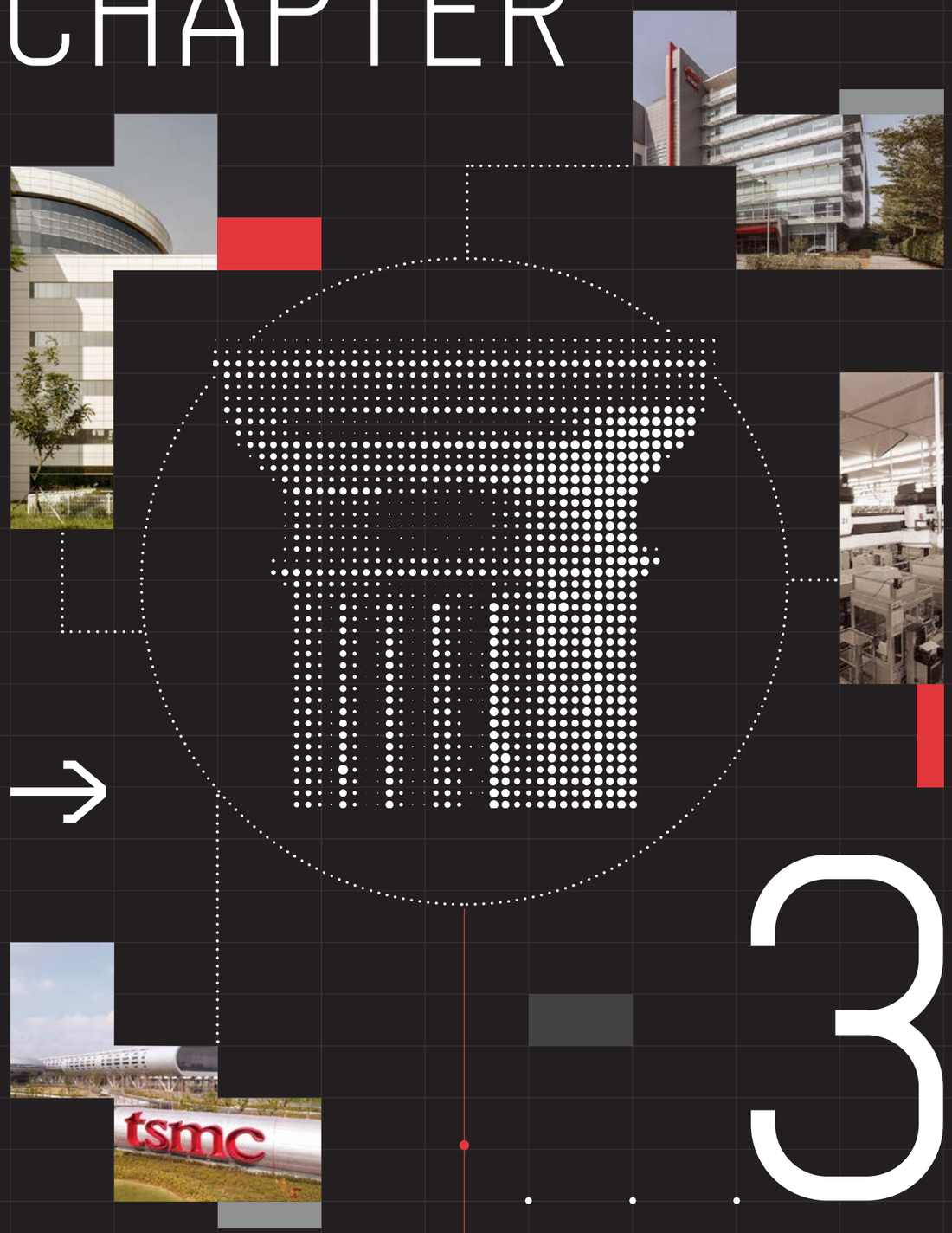
2.4.3 分派員工酬勞（分紅）之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後淨利之比例（%）
董事長暨總裁	魏哲家	-	447,900,290	447,900,290	0.0261%
資深副總經理暨財務長兼發言人	黃仁昭	-	103,474,760	103,474,760	0.0060%
執行副總經理暨共同營運長	秦永沛				
執行副總經理暨共同營運長	米玉傑				
資深副總經理暨副共同營運長／資訊安全長	侯永清				
資深副總經理暨副共同營運長	張曉強				
資深副總經理	何麗梅				
資深副總經理	羅唯仁（註一）				
執行顧問	瑞克・凱希迪（註一）				
資深副總經理／前資訊安全長	林錦坤（註一）				
資深副總經理暨法務長／公司治理主管	方淑華				
資深副總經理	王英郎（註二）				
資深副總經理、台積資深科技院士	張宗生（註二、三）				
資深副總經理	吳顯揚（註二）				
資深副總經理	葉主輝（註二）				
副總經理、台積卓越科技院士	余振華（註一）	-	1,813,719,990	1,813,719,990	0.1056%
副總經理	曹敏				
副總經理／JASM執行長	廖永豪				
副總經理	章勳明				
副總經理	游秋山				
副總經理	何軍				
副總經理暨資訊長	林宏達				
副總經理	李俊賢				
副總經理	莊子壽				
副總經理、台積資深科技院士	魯立忠（註三）				
副總經理	徐國晉				
副總經理／台積公司亞利桑那子公司執行長	莊瑞萍				
副總經理	李文如（註一）				
副總經理	陳培宏（註四）				
總計		0	2,365,095,040	2,365,095,040	0.1377%

註一：資深副總經理林錦坤先生於民國一百一十四年四月十日退休；資深副總經理瑞克・凱希迪於民國一百一十四年七月一日起轉任執行顧問；副總經理余振華博士於民國一百一十四年七月八日退休；副總經理李文如女士於民國一百一十四年七月十三日離職；資深副總經理羅唯仁博士於民國一百一十四年七月二十七日退休。
註二：王英郎博士、張宗生博士、吳顯揚博士及葉主輝博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為資深副總經理。
註三：張宗生博士及魯立忠博士於民國一百一十四年六月十七日獲擢升為台積資深科技院士。
註四：陳培宏先生於民國一百一十四年二月十二日獲擢升為副總經理。申報金額未含其被擢升前的薪酬。

CHAPTER



3

公司治理

台積公司誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值贏得了客戶的信心，與我們共同成長與茁壯

3.1 概述

台積公司堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。基於這樣的理念，台積公司董事會授權其下設立之「審計暨風險委員會」、「薪酬暨人才發展委員會」，及「提名及公司治理暨永續委員會」，分別協助董事會履行其職責，且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

3.2 董事會

董事會組織

台積公司董事會由十名擁有世界級公司經營經驗或專業領域經驗的董事所組成，他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受台積公司倚重。現任董事分別為：董事長魏哲家博士、曾繁城博士、葉俊顯博士（行政院國家發展基金管理會代表人）、彼得．邦菲爵士（獨立董事）、麥克．史賓林特先生（獨立董事）、摩西．蓋弗瑞洛夫先生（獨立董事）、拉斐爾．萊夫博士（獨立董事）、烏蘇拉．伯恩斯女士（獨立董事）、琳恩．埃爾森漢斯女士（獨立董事）以及林全博士（獨立董事）。

董事會職責

承續台積公司創辦人張忠謀博士對公司治理的理念，在魏哲家董事長的領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

董事會的首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有貪污等。為了善盡監督責任，台積公司董事會建立各式組織與管道，例如審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會、提名及公司治理暨永續委員會、隸屬審計暨風險委員會的財務專家顧問、內部稽核等。

董事會的第二個責任是任免經理人、評量經營團隊績效及高階經理人傳承計劃。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會的第三個責任是決議重要事項，例如資本支出、轉投資、股利等。

董事會的第四個責任是指導經營團隊及風險管理。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含企業永續報告），也投入時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略的風險及成功的可能性，也必須定期檢視策略的進展及結果，並在需要時敦促經營團隊進行調整。

董事提名及選舉

台積公司夙負聲譽的董事會，是由具備多元背景、充足專業知識、卓越見識與世界級公司經營經驗，並擁有高度道德標準的專業人士所組成。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，台積公司董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事會提名董事候選人之提名、資格及評估之相關程序及標準。董事會並訂定「公司治理政策」，董事成員的選任標準應綜合考量個人的專業知識、經驗、商業判斷能力、堅守本公司核心價值的承諾及個人在道德行為及領導上的聲譽，並應審酌整體董事會成員背景的多元性（包含性別、年齡與文化）；獨立董事候選人由「提名及公司治理暨永續委員會」向董事會推薦，每位獨立董事候選人的獨立性也根據相關法規進行判斷及評估。

台積公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，董事的任期為三年。依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。

考量董事久任其職有助於培養對於半導體產業的智識經驗與洞察力，並增進對於本公司的了解，對於其有效履行職責並為股東創造價值有積極且正面的助益，因此除相關法令針對獨立董事另有規定者外，台積公司對於個別董事得連任之次數並未加以限制。但董事會將持續進行評估以確保董事會隨時保有創新的觀點。

董事薪酬

依本公司公司章程規定，本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

公司章程中亦明訂不高於年度獲利的0.3%作為董事酬勞，且給付之對象不包括兼任經理人之董事。依本公司薪酬暨人才發展委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事酬勞給付辦法」辦理，原則如下：（1）董事兼任經理人者，不參與董事酬勞之分配；以及（2）因所有獨立董事皆會擔任不同委員會的委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其酬勞得高於一般董事。

董事所具專業資格及獨立董事獨立性情形

條件 姓名及職稱	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他台灣公開發行公司獨立董事家數
魏哲家 董事長暨總裁	董事專業資格與經驗請參閱本年報「2.3.1 董事會成員簡介」(第22-29頁) 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一)	不適用	
曾繁城 董事			
葉俊顯 董事			
彼得・邦菲爵士 獨立董事		1. 所有獨立董事皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2. 獨立董事本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女持有本公司普通股股份之情形請參閱本年報「2.3.1 董事會成員簡介」(第22-29頁) 3. 所有獨立董事最近二年皆無提供本公司或其關係企業審計或商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
麥克・史賓林特 獨立董事			0
摩西・蓋弗瑞洛夫 獨立董事			0
拉斐爾・萊夫 獨立董事			0
烏蘇拉・伯恩斯 獨立董事			0
琳恩・埃爾森漢斯 獨立董事			0
林全 獨立董事			1

註一：1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿。
6. 無行為能力或限制行為能力。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他台灣公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
(1) 公司或其關係企業之受僱人。
(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1% 以上或持股前十名之自然人股東。
(4) (1) 所列之經理人或(2) 、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 直接持有公司已發行股份總數5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

董事會多元化及獨立性

董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序。董事會訂定「董事提名辦法」，明訂董事會提名董事候選人之提名、資格及評估之相關程序及標準，董事會並訂定「公司治理政策」，董事成員的選任標準應綜合考量個人的專業知識、經驗、商業判斷能力、堅守本公司核心價值的承諾及個人在道德行為及領導上的聲譽，並應審酌整體董事會成員背景的多元性(包含性別、年齡與文化)。董事會之多元化及具獨立性為本公司之目標。目前本公司董事會十名成員具備多元背景，包括不同產業及學術等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中七名為獨立董事，占全體董事席次的70%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。

台積公司所在的半導體產業，在產業特性上以男性從業者居多。台積公司為達成董事多元背景的目標，於民國一百一十三年股東會董事改選後，女性董事已由一名增加為二名，雖尚未達董事席次的三分之一，但我們將在未來遴選董事會成員時，秉持用人唯才的理念，持續關注適當的女性候選人。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長暨總裁	董事		獨立董事						
姓名	魏哲家	曾繁城	葉俊顯	彼得・邦菲爵士	麥克・史賓林特	摩西・蓋弗瑞洛夫	拉斐爾・萊夫	烏蘇拉・伯恩斯	琳恩・埃爾森漢斯	林全
性別	男	男	男	男	男	男	男	女	女	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	英國	美國	美國	美國	美國	美國	中華民國
年齡	71-75	81-85	56-60	81-85	71-75	71-75	71-75	66-70	66-70	71-75
兼任本公司員工	V									
專業知識與才能										
商務	V	V	V	V	V	V		V	V	V
科技／創新	V	V		V	V	V	V	V	V	
財務／會計			V					V		V
行銷	V	V	V	V	V	V		V	V	V
資訊安全				V				V		
學術			V				V			V
能力與經驗										
高階領導經驗	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V		V	V	V
半導體產業經驗	V	V	V	V	V	V	V			V
法務或公司治理	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
財務管理能力	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
營運及製造	V	V	V	V	V	V		V	V	V
業務開發	V	V	V	V	V	V		V	V	V
風險管理／危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
人力資源及人才發展	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
環境永續	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
社會參與	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

民國一百一十四年董事進修情形

本公司董事主要進修方式包括：

- 每季董事會由經營團隊做業務、法規變動資訊及其他相關資訊簡報；
- 於董事會為董事安排與政治、經濟、遵法或風險等相關的演講或進修課程；
- 每季審計暨風險委員會由法務長及簽證會計師向委員報告法規變動資訊及公司遵循法規之情況；及
- 各董事視需要自行參加外部提供之相關進修課程。

姓名	日期	主辦單位	課程／演講名稱	時間
魏哲家	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
曾繁城	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
葉俊顯	10/15	ESG世界公民數位治理基金會	Me Too浪潮下機關必知的性騷擾防制責任	3 小時
彼得・邦菲爵士	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
麥克・史賓林特	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
	114年	University of Wisconsin Foundation	Fireside Chat on AI（註）	1.5小時
		Builders	Fireside Chat on AI（註）	1.5小時
		Santa Barbara Investment Company	Speech on AI（註）	1.5小時
		Morgan Stanley	Semiconductor Investors Meeting	16小時
		NASDAQ	Crypto Currency Structures	2小時
		Semiconductor Industry Association (SIA)	Round Table on the Future of Semiconductors	1.5小時
摩西・蓋弗瑞洛夫	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
	09/24-26	McKinsey & Company	Is the world (still) flat?	19小時
拉斐爾・萊夫	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
烏蘇拉・伯恩斯	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
琳恩・埃爾森漢斯	01/16	Egon Zehnder in Houston	Nomination/Governance Chair's	7小時
	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
林全	08/12	台積公司 社團法人中華公司治理協會	董事會在永續風險及危機管理的治理職責	2小時
	09/17	社團法人中華公司治理協會	2025川普對等關稅衝擊下的契約風險管理	3小時
	09/24	社團法人中華公司治理協會	全球稅務新秩序下之挑戰與思維	3小時
	10/15	社團法人中華公司治理協會	投資人視角下的永續揭露與投資價值：闡述ESG揭露框架與風險監控，連結資本市場信任	3小時
	11/12	社團法人中華公司治理協會	內線交易實務的最新發展	3小時

註：主要為受邀就公司治理及其他相關議題擔任講席。

3.2.1 審計暨風險委員會

審計暨風險委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，以及風險管理。

審計暨風險委員會審議的事項主要包括：

- 財務報表；
- 稽核及會計政策與程序；
- 內部控制制度暨相關之政策與程序；
- 重大之資產或衍生性商品交易；
- 重大資金貸與、背書或保證；
- 募集或發行有價證券；
- 衍生性金融商品及現金投資情形；
- 法規遵循；
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突；
- 吹哨者舉報調查報告及申訴報告；
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告；
- 企業資訊安全；
- 企業風險管理；
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量；
- 簽證會計師之委任、解任或報酬；
- 財務、會計或內部稽核主管之任免；
- 委員會職責履行情形；
- 委員會自我績效評量；及
- 其他依法令或本組織章程規定應由本委員會審議之事項或主管機關規定之重大事項。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。台積公司審計暨風險委員會符合上述法令規定。此外，審計暨風險委員會亦聘任了一位符合美國證券交易委員會規定的財務專家顧問。審計暨風險委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

審計暨風險委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師，以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計暨風險委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計暨風險委員會執行職務。

3.2.2 薪酬暨人才發展委員會

薪酬暨人才發展委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬，以及審查公司高階經理人傳承計劃以確保公司長期之永續發展。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據台積公司薪酬暨人才發展委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成，委員會邀請董事長及總裁列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。目前台積公司薪酬暨人才發展委員會由四位獨立董事組成。

薪酬暨人才發展委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估總裁或經理人之薪酬。

薪酬暨人才發展委員會成員資料

條件 姓名及身份別	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他台灣公開發行公司薪酬委員會成員家數
麥克・史賓林特（主席） 獨立董事	本公司薪酬暨人才發展委員會由四名獨立董事組成，委員之工作年資及專業資格與經驗請參閱本年報「2.3.1 董事會成員簡介」（第22-29頁）	1. 所有委員會委員皆符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」（註）相關規定 2. 委員會委員本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女持有本公司普通股股份之情形請參閱本年報「2.3.1 董事會成員簡介」（第22-29頁） 3. 所有委員會委員最近二年皆無提供本公司或其關係企業審計或商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
彼得・邦菲爵士 獨立董事			0
摩西・蓋弗瑞洛夫 獨立董事			0
烏蘇拉・伯恩斯 獨立董事			0

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：
(1) 公司或其關係企業之受僱人。
(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) (1) 所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

3.2.3 提名及公司治理暨永續委員會

提名及公司治理暨永續委員會旨在強化董事的選任機制，建構多元化及專業化的董事會，協助董事會遴選獨立董事候選人提名名單，以及對公司治理及永續發展相關議題提供建言。

依據台積公司提名及公司治理暨永續委員會組織章程，該委員會應由董事長及三至六位獨立董事組成。台積公司提名及公司治理暨永續委員會的成員目前由董事長及三位獨立董事組成。

提名及公司治理暨永續委員會為履行其職責，依其組織章程規定於需要時有權聘請獨立的法律、財務或其他顧問。

3.2.4 公司治理主管

董事會任命本公司資深副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會、提名及公司治理暨永續委員會，以及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

有關公司治理主管業務執行情形，請參閱本年報「3. 公司治理」（第42-67頁）。

3.2.5 出席董事會及委員會

台積公司希望每一位董事皆能出席每次董事會及其所擔任的委員會會議。民國一百一十四年，董事會董事平均出席率為100%，審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會，以及提名及公司治理暨永續委員會委員的出席率皆為100%。

董事會運作情形

一、董事任期：自民國一百一十三年六月四日至民國一百一十六年六月三日止。
二、董事長於民國一百一十四年度共召開四次董事常會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率（%）	備註
董事長暨總裁	魏哲家	4	0	100%	無
董事	行政院國家發展基金管理會代表人： 劉鏡清 葉俊顯	 3 1	 0 0	 100% 100%	行政院國家發展基金管理會於民國114年9月1日改派葉俊顯博士擔任本公司代表人
董事	曾繁城	4	0	100%	無
獨立董事	彼得・邦菲爵士	4	0	100%	無
獨立董事	麥克・史賓林特	4	0	100%	無
獨立董事	摩西・蓋弗瑞洛夫	4	0	100%	無
獨立董事	拉斐爾・萊夫	4	0	100%	無
獨立董事	烏蘇拉・伯恩斯	4	0	100%	無
獨立董事	琳恩・埃爾森漢斯	4	0	100%	無
獨立董事	林全	4	0	100%	無

其他應記載事項：
一、(一) 證券交易法第十四條之三所列事項：本公司已設置審計暨風險委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計暨風險委員會運作情形」。
(二) 其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：(1) 董事長迴避參與有關其薪酬之討論及表決；(2) 曾繁城博士為台積電文教基金會董事長，故迴避參與本公司捐贈台積電文教基金會議案之討論及表決；(3) 曾繁城博士為VIS副董事長，摩西・蓋弗瑞洛夫先生為NXP Semiconductors N.V.（NXP）獨立董事，故二位皆迴避參與本公司出售既有機器設備予關聯企業VIS之子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd.（VSMC）之關係人交易議案之討論及表決。VSMC為VIS與NXP合資成立之公司；(4) 曾繁城博士為世界先進積體電路股份有限公司（VIS）副董事長，行政院國家發展基金管理會同時為台積公司及VIS法人董事，而葉俊顯博士為其在本公司之董事代表人，故二位皆迴避參與本公司出售既有機器設備予關聯企業VIS之關係人交易議案之討論及表決。
三、加強董事會職能之目標：
– 本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業及學術等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含兩名女性董事，且獨立董事人數占全體董事席次的70%。
– 董事進修課程：「董事會在永續風險及危機管理的治理職責」。

審計暨風險委員會運作情形

一、委員任期：自民國一百一十三年六月四日至民國一百一十六年六月三日止。

二、委員會主席於民國一百一十四年度共召開四次常會。除上述會議外，另召開一次臨時會及三次電話會議，審閱有關本公司依中華民國及美國法令規定編製之年報及法人說明會資料。委員及財務專家顧問出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率（%）	電話會議次數	電話會議出席率（%）	備註
主席	彼得・邦菲爵士	5	0	100%	3	100%	無
委員	麥克・史賓林特	5	0	100%	3	100%	無
委員	摩西・蓋弗瑞洛夫	5	0	100%	3	100%	無
委員	拉斐爾・萊夫	5	0	100%	3	100%	無
委員	烏蘇拉・伯恩斯	5	0	100%	3	100%	無
委員	琳恩・埃爾森漢斯	5	0	100%	3	100%	無
委員	林全	5	0	100%	3	100%	無
財務專家顧問	羅貝茲	5	0	100%	3	100%	無

其他應記載事項：

一、(一) 證券交易法第十四條之五所列事項：

審計暨風險委員會開會日期（期別）	議案內容
2月10日 （民國114年第一次常會）	●民國113年度財務報表 ●民國113年度營業報告書 ●民國113年度第四季盈餘分派 ●出售本公司部分既有機器設備予子公司台積電（南京）有限公司及采鈺科技股份有限公司之關係人交易 ●於不超過美金100億元之額度內增資TSMC Global Ltd. ●民國113年度「內部控制制度聲明書」
5月12日 （民國114年第二次常會）	●民國114年第一季財務報表 ●民國114年第一季營業報告書 ●民國114年第一季盈餘分派 ●出售本公司部分既有機器設備予關聯企業之子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd. (VSMC)之關係人交易 ●本公司承租子公司采鈺科技股份有限公司廠房相關費用之關係人交易 ●修訂內部控制相關之政策與程序 ●任命翁銘莉女士為內部稽核主管，自民國114年8月16日起生效 ●任命陳志和先生為會計主管，自民國114年8月16日起生效
8月11日 （民國114年第三次常會）	●民國114年第二季財務報表 ●民國114年第二季營業報告書 ●民國114年第二季盈餘分派 ●於不超過新台幣600億元之額度內發行新台幣公司債 ●於不超過美金100億元之額度內增資TSMC Global Ltd. ●追認本公司非流動有價證券之投資
11月10日 （民國114年第四次常會）	●民國114年第三季財務報表 ●民國114年第三季營業報告書 ●民國114年第三季盈餘分派 ●出售本公司部分既有機器設備予關聯企業世界先進積體電路股份有限公司（VIS）之關係人交易 ●自民國115年起本公司簽證會計師事務所之新委任會簽會計師為陳彥君會計師，以及民國115年簽證會計師服務公費及代墊費用
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無	
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。	

（二）其他未經委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：摩西・蓋弗瑞洛夫先生為NXP Semiconductors N.V.（NXP）獨立董事，故迴避參與本公司出售既有機器設備予關聯企業VIS之子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd.（VSMC）之關係人交易議案之討論及表決。VSMC為VIS與NXP合資成立之公司。

三、獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

（一）本公司內部稽核主管定期與委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向委員會委員報告。民國114年度並無上述特殊狀況。本公司委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

（二）本公司簽證會計師於每季的委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向委員會報告，民國114年度並無上述特殊狀況。本公司委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

審計暨風險委員會開會日期（期別）	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
2月10日 （民國114年第一次常會）	●內部稽核報告（單獨會議） ●民國113年度SOX 404內控自評結果報告（單獨會議） ●民國113年度「內部控制制度聲明書」（單獨會議）	●法規變動報告 ●民國113年度財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
5月12日 （民國114年第二次常會）	●內部稽核報告（單獨會議） ●修訂內部控制相關之政策與程序（單獨會議）	●法規變動報告 ●民國114年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
8月11日 （民國114年第三次常會）	●內部稽核報告（單獨會議）	●法規變動報告 ●民國114年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
11月10日 （民國114年第四次常會）	●內部稽核報告（單獨會議） ●民國115年內部稽核年度計劃（單獨會議）	●法規變動報告 ●民國114年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
結果：上述事項皆經委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。		

薪酬暨人才發展委員會運作情形

一、本公司之薪酬暨人才發展委員會委員計四人。

二、委員任期：民國一百一十三年六月四日至民國一百一十六年六月三日止。

三、委員會主席於民國一百一十四年度共召開四次常會，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率（%）	備註
主席	麥克・史賓林特	4	0	100%	無
委員	彼得・邦菲爵士	4	0	100%	無
委員	摩西・蓋弗瑞洛夫	4	0	100%	無
委員	烏蘇拉・伯恩斯	4	0	100%	無

其他應記載事項：

一、薪酬暨人才發展委員會於民國114年2月10日、5月12日、8月11日、11月10日召開四次常會，討論事由包括：

–員工薪酬相關事項報告
–每季業績獎金總額
–年度酬勞（分紅）總額
–經理人、董事長暨總裁每季業績獎金
–董事及經理人年度酬金與年報資訊揭露
–民國110年度、民國111年度、民國112年度、民國113年度限制員工權利新股既得條件
–民國114年度長期激勵獎金辦法
–組織與經理人傳承計劃討論

上述事項皆經委員會審閱或核准通過。

二、董事會不採納或修正委員會之建議：無。

三、委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

提名及公司治理暨永續委員會成員資料及運作情形

一、依據台積公司提名及公司治理暨永續委員會組織章程，該委員會應由董事長及三至六位獨立董事組成。提名及公司治理暨永續委員會旨在強化董事的選任機制，建構多元化及專業化的董事會，協助董事會遴選獨立董事候選人提名名單，以及對公司治理及永續發展相關議題提供建言。

二、本公司之提名及公司治理暨永續委員會委員計四人。

三、委員任期：自民國一百一十三年六月四日至民國一百一十六年六月三日止。

四、委員會主席於民國一百一十四年度共召開四次會議，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

（接次頁）

條件 姓名及身份別	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數（註）	實際出席率（%）	備註
林全（主席） 獨立董事	本公司提名及公司治理暨永續委員會由董事長及三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報「2.3.1 董事會成員簡介」（第22-29頁）	4	0	100%	無
魏哲家 董事長		4	0	100%	無
拉斐爾・萊夫 獨立董事		4	0	100%	無
琳恩・埃爾森漢斯 獨立董事		4	0	100%	無

其他應計載事項：
一、提名及公司治理暨永續委員會於民國114年2月10日、5月12日、8月11日及11月10日召開四次會議，主要討論事由包括：
–審閱委員會民國113年度評量問卷結果
–審閱民國114年委員會議程
–審閱本公司「公司治理政策」及「提名及公司治理暨永續委員會組織章程」
–審閱本公司之公司治理政策與具可比性之國際公司之分析報告
–審閱民國116年董事選舉中獨立董事候選人之遴選標準及時程規劃之進度報告
–審閱尋找獨立董事候選人最新情況
–聽取董事兼任其他公司董事之限制及可能之利益衝突之通知報告
–審閱ESG季度報告
–審閱民國113年度永續報告書
–審閱年報導入IFRS永續揭露準則之執行進度報告
–審閱工傷通報規則及事故報告
–年度審閱委員會職責履行情形
上述事項皆經委員會審閱、討論或核准通過。
二、委員會之決議事項，成員反對事項內容：無。
三、董事會採納且無修正委員會之建議，核准通過所有議案。

註：委員會委員應以親自出席會議為原則，並無設有委託出席制度。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次	民國114年1月1日至民國114年12月31日	●董事會 ●個別董事成員 ●審計暨風險委員會 ●薪酬暨人才發展委員會 ●提名及公司治理暨永續委員會	●董事會內部自評 ●董事成員自評 ●委員會內部自評	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 各功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 委員會職責認知 3. 委員會決策品質 4. 委員會組成及成員選任 5. 內部控制

本公司已完成民國一百一十四年度委員會及董事會績效自評，評估結果並提送民國一百一十五年第一季各委員會及董事會（開會日期為：民國一百一十五年二月九日及十日）報告。董事會績效自評整體平均分數為4.72（滿分5分），其中一項「董事會有適當討論ESG之參與及執行情形」之平均分數為4.70，個別董事成員績效自評整體平均分數為4.75（滿分5分），顯示整體董事會運作良好；審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會及提名及公司治理暨永續委員會績效自評結果，分別為4.77、4.72及4.53（滿分5分），顯示各功能性委員會運作良好。

3.3 股東會與董事會重要決議事項及執行情形

3.3.1 股東會重要決議事項及執行情形

台積公司於民國一百一十四年六月三日在新竹舉行民國一百一十四年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

一、承認民國一百一十三年度之營業報告書及財務報表
執行情形：承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆8,943億800萬元，稅後淨利約為新台幣1兆1,732億6,800萬元，每股盈餘為新台幣45.25元。

二、核准修訂公司章程
執行情形：決議通過，並已依股東會決議執行。

3.3.2 董事會重要決議事項

本公司於民國一百一十四年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議摘要如下：

一、民國一百一十四年二月十一日董事常會：
- 核准民國一百一十三年營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百一十三年第四季之每股現金股利4.50元，其普通股配息基準日訂定為一百一十四年六月十八日；
- 核准民國一百一十三年員工業績獎金與酬勞（分紅）議案；
- 核准資本預算約美金171億4,140萬元，內容包括：（一）建置及升級先進製程產能；（二）建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；（三）廠房興建及廠務設施工程；
- 核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；
- 核准召集民國一百一十四年股東常會；及
- 核准擢升人力資源組織資深處長陳培宏先生為副總經理。

二、民國一百一十四年五月十二日及十三日董事常會：
- 核准民國一百一十四年第一季營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百一十四年第一季之每股現金股利5.0元，其普通股配息基準日訂定為一百一十四年九月二十二日；
- 核准資本預算約美金152億4,770萬元，內容包括：（一）建置先進製程產能；（二）建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；（三）廠房興建及廠務設施工程；
- 核准出售本公司機器設備予關聯企業之子公司VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd.），總價預估介於美金7,100萬元至7,300萬元；及
- 核准任命現任會計主管翁銘莉女士擔任本公司稽核主管，自民國一百一十四年八月十六日起生效；同時，核准任命陳志和先生為本公司會計主管，自民國一百一十四年八月十六日起生效。

三、民國一百一十四年八月十一日及十二日董事常會：
- 核准民國一百一十四年第二季營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百一十四年第二季之每股現金股利5.0元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十四年十二月十七日；
- 核准資本預算約美金206億5,750萬元，內容包括：（一）建置先進製程產能；（二）建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；（三）廠房興建及廠務設施工程；
- 核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及／或綠色相關支出之資金需求；及
- 核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；

四、民國一百一十四年十一月十日及十一日董事常會：
- 核准民國一百一十四年第三季營業報告書及財務報表；
- 核准民國一百一十四年第三季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十五年三月二十三日；

- 核准資本預算約美金149億8,160萬元，內容包括：（一）廠房興建及廠務設施工程；（二）建置先進製程產能；（三）建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；（四）民國一百一十五年研發資本預算與經常性資本預算；（五）一百一十五年資本化租賃資產；及
- 核准出售本公司機器設備予關聯企業VIS（Vanguard International Semiconductor Corporation），總價預估介於美金2,000萬元至2,300萬元。

五、民國一百一十五年二月九日及十日董事常會：

- 核准民國一百一十四年營業報告書及財務報表；
- 核准配發民國一百一十四年第四季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為民國一百一十五年六月十七日；
- 核准民國一百一十四年員工業績獎金與酬勞（分紅）議案；
- 核准資本預算約美金449億6,200萬元，內容包括：（一）建置及升級先進製程產能；（二）建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；（三）廠房興建及廠務設施工程；
- 核准於不超過美金300億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；
- 核准於不高於新台幣600億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及／或綠色相關支出之資金需求；
- 核准召集民國一百一十五年股東常會；及
- 核准以下人事擢升案：

  擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理；
  擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理；
  擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理；
  擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理；
  擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理；
  擢升本公司營運組織十二B廠資深廠長田博仁先生為副總經理；
  擢升本公司研究發展組織10埃米平台技術資深處長林學仕博士為副總經理；及
  擢升本公司業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本博士為副總經理。

3.3.3 台積公司民國一百一十四年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者之主要內容：無。

3.4 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司經董事會決議通過訂定「公司治理政策」。	無
二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		（一）本公司依內部作業程序責成包括法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部、法務等相關部門處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，並依程序實施。	無
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		（二）本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。	
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		（三）本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」中建立相關控管。	
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		（四）本公司訂有「內線交易防制辦法」，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	

（接次頁）

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		（一）請參閱本年報「3.2 董事會—董事會多元化及獨立性」（第47頁）。	無
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		（二）審計暨風險委員會（民國91年設置審計委員會並於民國112年更名）；薪酬暨人才發展委員會（民國92年設置薪酬委員會並於民國112年更名）；提名及公司治理暨永續委員會（民國112年設置）；ESG指導委員會（民國108年設置）：由經營團隊組成，並由董事長擔任主席；ESG委員會（民國100年設置）：由執行團隊組成，每季向董事會／提名及公司治理暨永續委員會報告執行成果及未來工作計劃。	
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		（三）依本公司對公司治理的理念，董事會主要的責任是監督、評量經營團隊之績效及任免經理人、決議重要事項及指導經營團隊。本公司董事會成員皆擁有豐富的世界級公司經營經驗或專業領域經驗，並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾。每季定期的董事會開會時間都長達二天，除決議各議案，並與經營團隊討論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。以本公司長期以來的營運績效及持續獲得國內外各項最佳公司治理獎項的肯定，足以證明本公司董事會的良好績效。 本公司每年執行董事會績效評估，針對整體董事會、個別董事成員、審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會，以及提名及公司治理暨永續委員會每年定期進行績效評估，評估作業採用問卷方式自評。 本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 本公司個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 本公司各功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 委員會職責認知 3. 委員會決策品質 4. 委員會組成及成員選任 5. 內部控制 本公司已完成民國114年度委員會及董事會績效自評，評估結果並提送民國115年第一季各委員會及董事會報告（開會日期為：民國115年2月9日及10日），作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為4.72（滿分5分），其中一項「董事會有適當討論ESG之參與及執行情形」之平均分數為4.70，個別董事成員績效自評整體平均分數為4.75（滿分5分），顯示整體董事會運作良好，審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會及提名及公司治理暨永續委員會績效自評結果，分別為4.77、4.72及4.53（滿分5分），顯示各功能性委員會運作良好。	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		（四）本公司每年由審計暨風險委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果。請參閱本年報「3.9.4 會計師獨立性及適任性之評估」（第67頁）。	
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V		董事會任命本公司資深副總經理暨法務長方淑華女士擔任公司治理主管。直接向法務長報告的公司法務與法規遵循處負責協助相關事務，包括依法辦理董事會、審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會、提名及公司治理暨永續委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。	無

（接次頁）

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司視不同狀況，責成包括法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部、人力資源、客戶服務、採購及企業永續等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括永續在內之相關議題。詳細內容，請參閱本年報「7. 企業永續（ESG）」（第146-171頁）及本公司永續報告書「重大性分析與利害關係人溝通」。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任中國信託股務代理部辦理股東會事務。	無
七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		（一）本公司透過公司網站（http://www.tsmc.com, 中英文版）隨時揭露相關資訊。本公司美國存託憑證（ADR）在美國紐約證券交易所（NYSE）掛牌交易，為外國發行人，須遵守NYSE相關規定。其中，本公司須依據NYSE上市準則，揭露本公司公司治理執行情形與美國國內公司執行情形之重大差異，有關上述資訊之揭露請參考以下網址：https://www.tsmc.com/download/ir/NYSE_Section_303A.pdf	無
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		（二）本公司責成法人關係處、企業公共關係處、股務及上市法規遵循部等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊。本公司依規定設有發言人及代理發言人。本公司在網站上提供法人說明會現場音訊直播及重播。	
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		（三）本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本年報「5.6 人才資本」（第114-121頁）。 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本年報「7. 企業永續 (ESG)」（第146-171頁）。 董事進修之情形：請參閱本年報「民國一百一十四年董事進修情形」（第48頁）。 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「6.2 風險管理」（第129-145頁）。 客戶政策之執行情形：請參閱本年報「5.4 客戶信任」（第111-113頁）。 本公司已為董事及經理人購買責任保險。	無
九、就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司歷年來「公司治理評鑑」結果皆為前5%公司，加強事項與措施說明如下：本公司於民國110年12月取得經濟部產業發展署之「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」最高等級AAA級驗證，於民國113年再次驗證通過，效期自民國114年1月1日起至民國116年12月31日。				

3.5 從業道德

從業道德規範

「誠信正直」是台積公司的核心價值之首。為了維護得來不易，來自股東、客戶、供應商、員工及社會大眾對本公司的信任，台積公司以最高的從業道德標準自我要求，並持續在日常的言、行中具體落實誠信正直、公平及公開透明等理念。我們對貪腐行為零容忍，不允許任何賄賂、舞弊、濫用、挪用公司資產或犧牲公司利益以換取個人利益的行為。「台積電從業道德規範政策」是實踐以上價值理念的核心指引，它要求每一位同仁都必須肩負起維護高度道德標準及公司良好聲譽的重要責任。同時，我們也制定了「台積公司供應商行為準則」，使供應商能瞭解並共同遵循台積公司的從業道德規範，與我們一同善盡企業社會責任。

具體而言，台積公司的每一份子，都必須做到：

- 絕不犧牲公司利益以換取個人利益，並避免個人利益與公司利益之衝突；
- 不從事任何貪腐（包括與他人串謀）、賄賂、不公平競爭、舞弊、勒索、挪用、浪費及濫用公司資產的行為；
- 拒絕以不當的方式影響其他人的決定；所謂「其他人」，包括如政府官員、政府機構及台積公司的客戶、供應商等；
- 不從事任何有害於公司、環境及社會的行為；
- 向符合社會責任理念的來源進行採購；
- 保護公司、客戶及供應商之機密資訊；及
- 遵守所有相關法令的規範。

智慧財產的保護，也是台積公司從業道德規範的重要一環。為營造與守護科技創新、技術領先與獲利持續成長的環境，台積公司特別強調商業關係的建立，必須奠基在對於台積公司、客戶及其他相關人士的智慧財產權、機密資訊及營業秘密的絕對尊重之上。

就資訊的揭露，台積公司經理人，尤其是董事長暨總裁、財務長及法務長，在董事會的監督之下，必須確保台積公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且易懂的，台積公司並已採取相關措施以確保符合上述要求。

從業道德規範的任何修改，都必須報請審計暨風險委員會審閱與同意，藉由審計暨風險委員會的獨立判斷，持續確保台積公司的高度從業道德標準。

從業道德規範之落實

高標準的從業道德文化：所有台積公司的董事、經理人與同仁均必須共同從四個面向來實踐從業道德規範。首先，台積公司的經營管理階層需身體力行、以身作則，在公司內部形成一個「由上而下」的從業道德文化；第二、責成經理人及各級主管確保其所屬同仁了解、接受並恪守相關從業準則；第三、鼓勵公開透明的溝通，同仁有從業道德相關問題時，除向主管尋求諮詢外，亦可洽人力資源及法務組織以即時取得適當之建議；最後，若同仁察覺有疑似不符合從業道德的情事時，有責任隨時向直屬主管、人力資源最高主管，或循「吹哨者舉報程序」直接通報審計暨風險委員會主席（獨立董事），或向由總裁所指派負責員工申訴直通車(Ombudsman System)之資深主管進行舉報。

組織與同仁的自我檢視：公司內部組織與同仁的自我檢視，亦是落實從業道德規範的重要一環。透過年度企業內控自評（Control Self-Assessment, CSA），台積公司內部各部門及子公司，須自我檢視部門同仁是否對於從業道德規範有足夠的認知，以評量及強化從業道德內部控制效能。另外，從業道德規範要求所有同仁均需主動申報任何利益衝突之情形，新進員工應於入職時申報利益衝突事項，特定職級或職務之同仁更必須每年定期申報利益衝突或有利益衝突疑慮之事項，以使公司得以進行必要的安排及向審計暨風險委員會報告。

內部稽核：台積公司內部稽核部門在確保從業道德與法規遵循上也扮演了重要的角色。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與即時，以及員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。

教育訓練與宣導：為了使同仁時常保持對於從業道德規範的認識，台積公司除將從業道德相關的規章文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過訓練課程、海報、電子郵件等多元方式對同仁進行公司核心價值及遵循制度之宣導。以訓練課程而言，台積公司不僅提供從業道德規範的年度線上課程要求同仁需完訓外，亦就個別項目對於重點宣導對象，進行面對面訓練課程。總計於民國一百一十四年，台積公司包含其子公司同仁接受「年度從業道德與法規遵循」教育訓練（0.5小時線上必修課程），參與課程且通過課程測試者，達85,124人。

除了公司內部之落實外，台積公司期待並且採取實際行動來協助客戶、供應商等商業夥伴或其他有業務往來的各界人士（包括顧問或其他有權代表台積公司從事商業行為之人）瞭解並認同台積公司的從業道德標準及文化，以善盡企業公民責任。舉例而言，台積公司要求其所有第一階供應商出具尊重並願意確實遵行台積公司的從業道德標準及文化的書面承諾。另外，台積公司為全球最大的電子產業聯盟「負責任商業聯盟」（Responsible Business Alliance, RBA），其前身為「電子行業公民聯盟」（Electronics Industry Citizenship Coalition, EICC）之正式會員（Full Member），全面採行RBA行為準則，並根據此準則對供應商及其他商業夥伴進行相關稽核。台積公司也透過實體以及線上研討會，向供應商宣導及提供台積從業道德規範的教育訓練，例如台積公司永續供應鏈環安衛論壇，涵蓋從業道德、環保、職業安全等各項重要議題，與供應商進行實務經驗分享與交流。台積公司也透過各項客戶對於台積公司的稽核與問卷，向客戶傳達台積公司的從業道德規範以及落實情況，並進行相關議題的交流。

舉報管道與舉報者保護

台積公司訂定相關舉報政策，並建立「違反從業道德舉報系統」、「吹哨者舉報程序」及其他多元之舉報管道，以處理並聽取來自內部及外界的聲音，維護利害關係人與公司權益。所有台積公司內、外部舉報管道所收受的舉報事件，均經妥善記錄及追蹤處理，對於善意舉報者或參與調查者予以保密，避免其受到報復。

對於接獲的舉報事件，台積公司依照事件屬性由特定單位進行調查，採取毋枉毋縱的嚴肅態度，謹慎有效處理。同時，從業道德委員會亦會針對違規案件審視其為特殊個案，或是從業道德規範認知不足等系統性問題，以持續評估是否需要改善公司管理流程及內部控制程序，並接續配合各種宣導方式，包括每季以電子郵件通知全體同仁當季違規懲處案件等，提高員工認知並防範類似案件再次發生。

民國一百一十四年台積公司並無任何重大（罰款超過新台幣100萬元）的違法情事，包括無任何非金錢的處罰案件。此外，台積公司未接獲違反內線交易、洗錢或其他財務、會計或競爭反托拉斯法相關案件舉報，亦無違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失相關之舉報案件。不符合前述規定而接獲的罰款表列如下：

單位：新台幣元

年度	民國110年	民國111年	民國112年	民國113年	民國114年
金額	0	0	0	0	0

總計民國一百一十四年台積公司自審計暨風險委員會吹哨者舉報程序、員工申訴直通車及違反從業道德行為舉報系統所收受舉報事件共465件，其中322件與員工關係／人員管理相關，128件屬其他類別（如員工詢問個人權益或私人領域問題等），與違反從業道德行為相關舉報件數為15件。以上舉報經從業道德委員會調查成立，決定懲處的違反從業道德案件共二件。民國一百一十四年，台積公司已針對上述違規事件，再次對員工、供應商重申業務往來時應遵循的從業道德規範。關於台積公司所接獲之舉報及所進行之調查與舉報類型的相關數據，請參考以下表格。

案件數	民國110年	民國111年	民國112年	民國113年	民國114年
總收受舉報案件數 與從業道德相關舉報案件 經調查後認定違反從業道德之案件	327 17 4	335 11 4	348 13 5	358 16 1	465 15 2（註一）
性騷擾申訴處理委員會 經性騷擾申訴處理委員會調查成立之案件	14 11	19 14	35 23	50 28	45 28（註二）

註一：一起案件為同仁涉及藉故苛扣廠商款項，中飽私囊，涉案同仁予以解雇處分；另一起案件為同仁未迴避利益衝突規範，於私人活動時透過廠商取得價格優惠，相關涉案同仁予以警告處分。
註二：涉案同仁均已依情節輕重接受公司不同程度之懲處。由於案件分別涉及不同態樣的不當行為，台積公司於民國一百一十四年度性騷擾防治課程中，除持續教育員工性騷擾行為的可能態樣以及後果外，並依照政府修法強調權勢性騷擾的不當態樣及加重懲罰的警示提醒外，亦重申公司之申訴管道及處理辦法，藉此強化並提升同仁的自我意識及認知。

經調查成立之事件類別	民國110年	民國111年	民國112年	民國113年	民國114年
貪腐或舞弊	4	4	2	1	1
歧視或騷擾	11	14	23	28	28
客戶個人資料	0	0	0	0	0
利益衝突	-	-	1	0	1
內線交易或洗錢	-	-	0	0	0
反托拉斯法	0	0	0	0	0
其他	-	-	0	2	0

違反從業道德規範行為之懲處

對於任何可能違反從業道德之行為，台積公司秉持毋枉毋縱的嚴肅態度看待所有經確認屬實之個案，對於違反者，如為員工，依台積公司程序予以懲處，包含終止僱傭之懲處，並反映於違反從業道德規範同仁之年度績效；如係供應商，則會終止業務往來關係等嚴厲懲戒措施。必要時並將採取法律行動。

3.5.1 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		（一）「誠信正直」是台積公司的文化中最重要的核心價值。台積公司秉持一貫的道德標準來從事所有業務活動。台積公司制定有「台積電從業道德規範政策」（以下稱「從業道德規範」）嚴格要求每位員工必須履行誠信政策，並於年報及永續報告中詳細說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。	無
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		（二）從業道德規範是台積公司實踐以上價值理念的最核心指引。它要求所有台積公司同仁，包括子公司的成員，都必須肩負起維護高度道德標準、公司聲譽與遵守法令的重要責任。具體之從業道德行為規範要求，請參閱年報相關內容。又為了使同仁時常保持對於誠信行為的認識，台積公司除將從業道德相關規範的相關規章文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過例如教育課程、海報、電子郵件等多元方式對同仁進行公司核心價值及遵循法規規定之宣導。此外，為確保台積公司的行為符合法規與從業道德規範的高度要求，針對不誠信行為，台積公司提供了多種舉報系統，請詳見評估項目三。 對於任何可能違反從業道德之行為，台積公司秉持毋枉毋縱的嚴肅態度看待所有經確認屬實之個案，對於違反者，如為員工，除影響其個人年度績效評核外，亦採取包含終止僱傭之懲處；如係供應商，則會終止業務往來關係等嚴厲的懲戒措施。必要時並將採取法律行動。	
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		（三）在從業道德規範的架構之下，台積公司就不同法規遵循領域分別訂有相關規章或指引，這些領域包括：公司治理、證券法規、反賄賂及反貪腐、反騷擾、反歧視、勞動法規、反托拉斯（公平競爭）、環境保護、安全與衛生、出口管控、財務報告編製、內線交易、智慧財產權、機密資訊保護、個人資料保護、文件資料保存及銷毀及無衝突原物料採購（無衝突礦產）等，以上的具體規範對於落實台積公司的從業道德規範至關重要。台積公司提供「年度從業道德與法規遵循」教育訓練（0.5小時線上必修課程），內容涵括各個不同的重要法規遵循主題，受訓對象包含台積公司的子公司同仁，參與課程且通過課程測試者，總計達到85,124人。此外，台積公司、台積公司子公司，以及所有的同仁，均必須詳加瞭解業務相關的法令及規章，並做出正確的商業與道德判斷。台積公司之內部稽核部門在確保從業道德與法規遵循上亦扮演重要的角色。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案，俾落實稽核成效。	

（接次頁）

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)台積公司期待並且採取實際的行動來協助客戶、供應商等商業夥伴或其他有業務往來的各界人士（例如顧問或其他有權代表台積公司從事商業行為之人）能瞭解並認同台積公司的從業道德標準及文化。舉例而言，台積公司要求其所有供應商出具尊重並願意確實遵行台積的從業道德標準及文化的書面承諾。此外，除進行相關稽核外，並透過實體研討會或線上課程提供教育訓練、宣導台積公司之從業道德規範，與供應商進行實務經驗分享與交流。台積公司也透過各項客戶稽核活動與問卷，向客戶傳達台積公司的從業道德標準，並進行相關議題的交流。	無
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)為了善盡誠信經營之監督責任，台積公司董事會建立了各式組織與管道，例如審計暨風險委員會、薪酬暨人才發展委員會、隸屬審計暨風險委員會的財務專家顧問、內部稽核等。台積公司主要由法務長及直接向法務長報告的公司法務與法規遵循處協助推動公司誠信經營，法務長並每季定期向董事會報告其執行情形。此外，負責員工申訴直通車舉報系統之資深主管及內部稽核亦會定期向董事會報告相關執行情形。台積公司經理人，尤其是總裁、財務長及法務長，在董事會的監督之下，必須確保台積公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且易懂的。	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)根據台積公司從業道德規範，所有同仁均需主動申報任何實際或潛在利益衝突之情形，新進員工於入職時進行申報，特定職級及職務同仁也必須每年度進行利益衝突申報。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計劃，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司一向注重確保其財務報導流程及其控制的正確性及完整性，並針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。此外，透過年度企業內控自評，台積公司各部門及子公司，均必須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)遵法教育訓練是台積公司法規遵循計劃中最重要的項目之一。透過定期推出的法規推廣與訓練課程，不僅讓台積公司同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾。相關教育訓練課程，請詳見評估項目一。對於台積的供應商，台積公司亦透過實體研討會或線上課程邀集宣導台積公司之從業道德規範，以確保其確實了解台積公司之誠信經營規範。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)台積公司訂定相關政策，並建立「違反從業道德舉報系統」、「吹哨者舉報程序」及其他多元之舉報管道，以處理並聽取來自內部及外界的聲音，維護利害關係人與公司權益，並允許匿名舉報。若同仁察覺身邊有疑似不符從業道德的情況發生時，有責任隨時向直屬主管、人力資源最高主管或循前述的舉報管道進行舉報。對不同被檢舉對象皆指派適當之受理專責人員。	無
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二)對於所接獲的舉報及後續之調查，台積公司均採取保密與嚴謹之態度進行，並已明定在內部規章中。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)台積公司嚴格禁止對於善意舉報或協助調查之人實施任何形式的報復手段，並已明定在內部規章中。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		台積公司於公司內部網站（中英文版）放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢。台積公司亦於對外網站（http://www.tsmc.com, 中英文版）放置年報（同時放置於公開資訊觀測站）及永續報告書以揭露「台積電從業道德規範政策」及推動成效。	無

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

台積公司訂有從業道德規範，公司所有同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本該規範及相關辦法之規定。台積公司從業道德規範運作情形與規範之內容並無差異，請參閱本年報「3.5 從業道德」說明（第58-62頁）。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

有關台積公司從業道德規範運作情形，請參閱本年報「3.5 從業道德」說明（58-62頁）。

3.6 法規遵循

台積公司的法規遵循體系是由一系列的法令追蹤評估、規章與法規遵循計劃的制定與落實、遵法教育訓練與暢通的舉報管道所構築而成。

法令追蹤評估

台積公司的營運區域遍及全球。為了確保遵守各國相關法令，台積公司一向密切注意任何可能會對公司業務及財務有重大影響的國內、外政策與法令動向。法務組織亦定期將所取得之最新法規動態通知各業務相關部門、經營管理階層與審計暨風險委員會，協助公司內部各組織能落實法規要求。台積公司對於促成法令的完善也始終不遺餘力，而我們對於政府機關提供之法規建言，亦經常獲得建設性的回應。未來台積公司仍將持續鑑別法規議題，並在參與公共政策變革方面貢獻心力，期能協助創造優質的法規及產業經營環境。

規章與法規遵循計劃的制定與落實

台積公司就不同法規遵循領域分別訂有相關規章或指引，這些領域包括：公司治理、證券法規、反賄賂及反貪腐、反騷擾、反歧視、勞動法規、反托拉斯（公平競爭）、環境保護、安全與衛生、出口管控、財務報告編製、內線交易、智慧財產權、機密資訊保護、個人資料保護、文件資料保存及銷毀，以及非衝突原物料採購（非衝突礦產）等。我們相信，以上的具體規範，對於落實台積公司的從業道德標準與法規遵循計劃至關重要。此外，台積公司、台積公司所有同仁以及台積子公司，均必須詳加瞭解業務相關的法令及內部規章，並做出正確的商業與道德判斷。

遵法教育訓練

遵法教育訓練是台積公司法規遵循計劃中最重要的項目之一。台積公司定期提供法規宣導與訓練課程，不僅讓同仁了解最新或與其業務相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循法規及從業道德規範的堅定承諾。茲舉其重要內容如下：

- 多樣化的法規宣導方式：台積公司透過多樣的法規宣導活動，充實同仁各項法規遵循的資訊來源。這些活動包括如：寄送宣傳電子郵件、在廠區內張貼宣傳海報，在公司內部網站上提供法規遵循規章與指引、教育宣導文章、遵法要訣及常見問答集，使同仁可隨時接觸及取得法規新知。
- 針對不同業務屬性的客製化面對面訓練課程：對於重要的特定法令、規章，台積公司提供客製化面對面訓練課程。這些客製化課程均根據同仁不同之業務職責而訂有必須完訓的要求，以確保同仁確實熟悉相關的法規及公司相關政策。
- 線上課程滿足同仁隨時進修的需求：為利同仁彈性安排時間，隨時掌握法規遵循重點，台積公司開辦各項線上課程，涵蓋主題包括：公司治理、證券法規、反賄賂及反貪腐、反騷擾、反歧視、勞動法規、反托拉斯（公平競爭）、環境保護、安全與衛生、出口管控、財務報告編制、內線交易、智慧財產權、機密資訊保護、個人資料保護、文件資料保存即銷毀及非衝突原物料採購（非衝突礦產）等，並隨著適用法規或台積公司內部規章的變動而加以更新，以確保課程內容的即時性與正確性。
- 法務團隊的持續進修：台積公司法務團隊同仁積極參與在台灣及其他國家舉辦的外部專業課程以即時吸收法規資訊，並追蹤各項專業法律領域的最新動態，所有具備律師資格的法務同仁，並均依照所取得律師資格之司法區域的要求，持續進修，完成相關律師在職教育。此外，法務團隊亦不定期邀請外部專家舉行講座，以掌握重要法規發展。

舉報管道

台積公司提供多種舉報管道，以確保台積公司的行為符合法規與從業道德規範的高度要求，有關舉報管道說明，請參閱本年報「3.5 從業道德」（第58-62頁）。

重要成果

台積公司於民國一百一十四年在法規遵循議題上達成了數個重要的成果。在外部交流方面，台積公司除恪盡遵法義務外，亦秉持企業社會責任的精神，對現行或在立法中之法規提供建言，或協助國內法規與國際接軌，以建全產業投資環境、促進經濟發展。台積公司除持續關注公司、證券交易、智慧財產與環境保護相關之議題並參與相關活動外，且與外部機構分享台積公司在營業秘密、勞工人權、法規遵循體系以及舉報管道方面的實務經驗。

在內部教育訓練方面，台積公司向同仁提供了多樣的法規遵循課程，茲舉其重要者如下：

- 從業道德與法規遵循：提供「年度從業道德與法規遵循」教育訓練（0.5小時線上必修課程），本課程內容涵括三個部分：（1）誠信正直、迴避利益衝突；（2）反賄賂及反貪腐、個人資料保護法、內線交易、反托拉斯（公平競爭）等不同的重要法規遵循主題；及（3）台積公司舉報管道及反報復政策，明確說明舉報系統的使用方式、對舉報事件的調查處理程序，以及對於善意舉報者的保護。民國一百一十四年，參與本課程之同仁（包含台積公司及其子公司同仁）且通過課程測試者，總計達到85,124人次。
- 出口管控：台積公司的出口管控系統與政策建置完成多年，並獲經濟部國際貿易署核發「內部管控制度（Internal Compliance Program, ICP）」出口商之認證，旨在確保台積公司之資訊、技術、產品、原物料及設備等之出口均符合法令。台積公司實施「No ECCN, No Shipment」管控措施，要求客戶必須告知台積公司有關其產品的最終用途（End Use）、出口管控分類號（ECCN）以及相關之資訊，俾供判斷該項貨品交易是否須申請出口許可。此外，為確保相關人員深入瞭解相關規範，於民國一百一十四年間台積公司除海報宣導外，亦進行了多場面對面會議訓練外，並提供線上課程，對業務相關同仁給予相關法規遵循訓練。
- 供應商管理：台積公司針對於台灣設有營業據點之供應商，透過台積公司永續供應鏈環安衛論壇，就從業道德、環保、職業安全等重要議題進行實務經驗分享與交流，民國一百一十四年計有105家供應商，計408人參與（包括線上會議方式參與）。
- 無衝突原物料之供應鏈：身為全球高科技產業供應鏈的領導者，台積公司體認到採購「無衝突（conflict-free）」的原物料，並藉此提倡人道精神與實踐人性尊嚴等社會道德準則，是台積公司所應善盡的企業社會責任。基此信念，台積公司已依循產業的領先作為採取一系列的法規遵循措施，要求供應商每年填寫「衝突礦產調查表」並簽署「無衝突礦產聲明」，持續為建立無衝突原物料之供應鏈而努力。
- 個人資料保護：鑑於個人資料保護之重要性，台積公司定期檢視既有的「隱私與個人資料保護準則」，以及對外與對內的隱私權相關政策，依最近的法規內容及相關風險情況，每年定期宣導隱私權及個人資料保護的課程，以強化員工個人資料保護的意識並確保其遵循相關法規。此外，法務、人力資源及資訊相關部門主管每年召開個人資料保護委員會會議，協助執行及監督該準則之遵循，並於該委員會下設立個人資料保護工作小組，以集會方式協助台積公司各部門，使其業務執行與系統建立均能確實遵守該準則。
- 反托拉斯法規遵循：台積公司根據每年度反托拉斯風險評估結果，辨識公司內部反托拉斯潛在風險較高的部門。為提升重點部門同仁對於競爭法及反托拉斯法規重要性之認知，與日常工作中相關議題的遵法意識，台積公司擬定反托拉斯培訓計劃，為位於國內、北美、歐洲、亞太、日本及大陸地區的全球業務部門及其他相關部門同仁，進行多場面對面或線上反托拉斯培訓課程。
- 內線交易法規遵循：台積公司為落實內線交易的法規遵循，並強化同仁對內線交易法令的認知與遵循，除透過「年度從業道德與法規遵循」介紹內線交易基本概念，不定期以海報宣導重要觀念，亦提供線上進階課程，民國一百一十四年，總計有680名同仁完成此一內線交易線上進階課程（為0.5小時課程），同仁通過測試比例達100%。

3.7 內部控制制度執行狀況

3.7.1 內部控制聲明書

台灣積體電路製造股份有限公司

內部控制制度聲明書

中華民國一百一十五年二月十日

本公司民國一百一十四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

1. 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
2. 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
3. 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：（1）控制環境，（2）風險評估，（3）控制作業，（4）資訊及溝通，及（5）監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
4. 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
5. 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一百一十四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
6. 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
7. 本聲明書業經本公司民國一百一十五年二月十日董事會通過，出席董事十人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣積體電路製造股份有限公司

董事長暨總裁：魏哲家

3.7.2 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

3.8 與公司財務有關人士之資訊

本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形

證照	人數	
	內部稽核	財務
中華民國會計師（CPA）	3	68
美國會計師（US CPA）	3	28
國際內部稽核師（CIA）	7	4
財務分析師（CFA）	-	6
管理會計師（CMA）	-	1
財金風險管理分析師（FRM）	-	2
舞弊稽核師（CFE）	3	-

3.9 會計師資訊

3.9.1 簽證會計師公費資訊

本公司會計師公費應經審計暨風險委員會核准後呈送董事會核准，董事會並授權審計暨風險委員會決議任何不超過原核准公費百分之十的費用增加。

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費（註）	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳世宗及林尚志	114/01/01~114/12/31	91,637	8,152	99,789	-

註：主要係稅務簽證相關之費用。

3.9.2 更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更換日期	114年11月11日經董事會通過		
更換原因及說明	基於相關法令規定會計師輪調的必要，本公司自民國115年起會簽會計師將由林尚志會計師更換為陳彥君會計師。主辦會計師將繼續由吳世宗會計師擔任。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人／情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受（繼續）委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項（本準則第十條第五款第一目之四至七應加以揭露者）	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	吳世宗、陳彥君會計師
委任之日期	114年11月11日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目之三事項之復函：無。

3.9.3 本公司之董事長、董事、總經理、負責財務或會計事務之經理人，於最近一年度任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業：無。

3.9.4 會計師獨立性及適任性之評估

本公司審計暨風險委員會每年藉以下標準評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向董事會報告評估之結果：

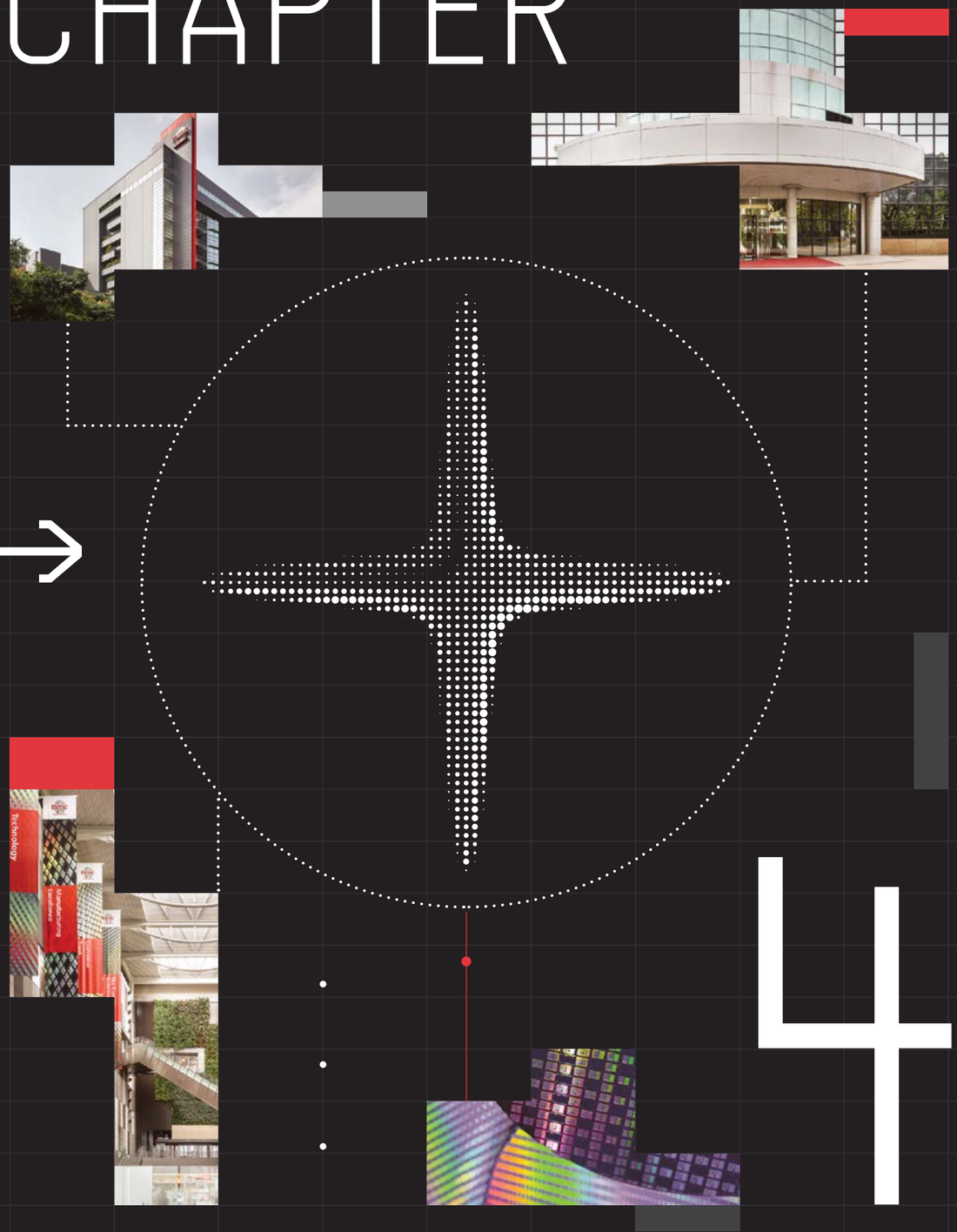
一、會計師之獨立性聲明

二、會計師所提供之審計或非審計服務皆需經過審計暨風險委員會事先之審核，以確保非審計服務不會影響審計之結果

三、同一會計師未連續執行簽證服務超過五年

四、每年透過會計師問卷及參考由金融監督管理委員會發布之審計品質指標（AQIs），針對會計師財務利益、商業關係、聘僱關係等面向評估，以彙整對會計師獨立性及適任性之評估結果

CHAPTER



4

資本與股份

台積公司持續提升研發費用至79億2,000萬美元，以擴大我們的技術領先與差異化優勢

4.1 資本及股份

4.1.1 股本來源

單位：股／新台幣元　　截至民國一百一十五年二月二十八日止

民國年/月	每股面額	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產擴充股本者	核准日期(年/月/日)與文號
114/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,932,615,521	259,326,155,210	註銷限制員工權利新股：1,177,210元	無	114/06/04竹商字第1140016761號
114/11	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,932,524,521	259,325,245,210	註銷限制員工權利新股：910,000元	無	114/11/25竹商字第1140036788號

註：本公司民國一百一十一年度、民國一百一十二年度及民國一百一十三年度限制員工權利新股，於民國一百一十五年三月一日依既得條件達成結果分別收回32,060股、81,394股及41,000股並將辦理註銷。

4.1.2 資本及股份

單位：股　　截至民國一百一十五年二月二十八日止

股份種類	核定股本		合計
	已上市股份	未發行股份	
記名式普通股	25,932,524,521	2,117,475,479	28,050,000,000

總括申報制度相關資訊：無。

4.1.3 主要股東名單

普通股

持股基準日：民國一百一十四年十二月十七日（註）

主要股東名稱	持有股數	持股比例
花旗託管台積電存託憑證專戶	5,313,592,968	20.49%
行政院國家發展基金管理會	1,653,709,980	6.38%
花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	538,629,101	2.08%
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	470,454,846	1.81%
中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	416,782,820	1.61%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	355,197,748	1.37%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	328,625,605	1.27%
新制勞工退休基金	309,948,796	1.20%
渣打託管iShares新興市場ETF	250,902,123	0.97%
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲太平洋基金投資專戶	184,520,799	0.71%

註：此為民國一百一十四年第二季現金股利發放之配息基準日。

4.1.4 董事、經理人及持股10%以上大股東股權變動情形

普通股

單位：股

職稱 姓名	民國114年度		民國115年1月1日至民國115年2月28日	
	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長暨總裁 魏哲家	824,175	-	-	-
董事 曾繁城	-	-	-	-
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人： 葉俊顯（註一）	-	-	-	-
	-	-	-	-
獨立董事 彼得・邦菲爵士	-	-	-	-
獨立董事 麥克・史賓林特	-	-	-	-
獨立董事 摩西・蓋弗瑞洛夫	-	-	-	-
獨立董事 拉斐爾・萊夫	-	-	-	-
獨立董事 烏蘇拉・伯恩斯	-	-	-	-
獨立董事 琳恩・埃爾森漢斯	-	-	-	-
獨立董事 林全	-	-	-	-
執行副總經理暨共同營運長 秦永沛	174,562	-	-	-
執行副總經理暨共同營運長 米玉傑	173,375	-	-	-
資深副總經理暨副共同營運長／資訊安全長 侯永清	153,639	-	-	-
資深副總經理暨副共同營運長 張曉強	149,387	-	-	-
資深副總經理 何麗梅	164,850	-	-	-
資深副總經理 羅唯仁（註二）	2,850	-	-	-
執行顧問 瑞克・凱希迪（註三）	-	-	-	-
資深副總經理／前資訊安全長 林錦坤（註二）	112,100	-	-	-
資深副總經理暨法務長／公司治理主管 方淑華	109,725	50,000	-	-
資深副總經理暨財務長兼發言人 黃仁昭	110,456	-	-	-
資深副總經理 王英郎	95,475	-	-	-
資深副總經理、台積資深科技院士 張宗生	95,475	-	-	-
資深副總經理 吳顯揚	95,950	-	-	-
資深副總經理 葉主輝	96,162	-	-	-
副總經理、台積卓越科技院士 余振華（註二）	71,962	-	-	-
副總經理 曹敏	95,950	-	-	-

（接次頁）

職稱 姓名	民國114年度		民國115年1月1日至民國115年2月28日	
	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
副總經理／JASM執行長 廖永豪	61,512	-	-	-
副總經理 章勳明	61,037	-	-	-
副總經理 游秋山	61,987	-	-	-
副總經理 何軍	60,799	-	-	-
副總經理暨資訊長 林宏達	61,037	-	-	-
副總經理 李俊賢	77,154	-	225	-
副總經理 莊子壽	61,037	-	-	-
副總經理、台積資深科技院士 魯立忠	64,749	-	-	-
副總經理 徐國晉	61,987	-	-	-
副總經理／台積公司亞利桑那子公司執行長 莊瑞萍	44,557	-	-	-
副總經理 李文如（註二）	-	-	-	-
副總經理 陳培宏（註四）	-	-	-	-
副總經理 黃遠國（註五）	-	-	-	-
副總經理 田博仁（註五）	-	-	2,000	-
副總經理 林學仕（註五）	-	-	-	-
副總經理 袁立本（註五）	-	-	-	-

註一：行政院國家發展基金管理會原派任本公司董事代表人劉鎮清先生，於民國一百一十四年九月一日改派葉俊顯博士擔任。
註二：資深副總經理林錦坤先生於民國一百一十四年四月十日退休；副總經理余振華博士於民國一百一十四年七月八日退休；副總經理李文如女士於民國一百一十四年七月十三日離職；資深副總經理羅唯仁博士於民國一百一十四年七月二十七日退休。其持有股份自當日起不再申報。
註三：資深副總經理瑞克・凱希迪於民國一百一十四年七月一日起轉任執行顧問，其持有股份自當日起不再申報，並於民國一百一十五年一月三十一日退休。
註四：陳培宏先生於民國一百一十四年二月十二日獲擢升為副總經理，其持有股份自當日起開始申報。
註五：黃遠國先生、田博仁先生、林學仕博士及袁立本博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為副總經理，其持有股份自當日起開始申報。

4.1.5 股權移轉之相對人為關係人者：無。

4.1.6 股權質押之相對人為關係人者：無。

4.1.7 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資料

普通股

持股基準日：民國一百一十四年十二月十七日（註）

姓名	本人持有股數		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義合計 持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
花旗託管台積電存託憑證專戶	5,313,592,968	20.49%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
行政院國家發展基金管理會 代表人：葉俊顯	1,653,709,980	6.38%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
	-	-	-	-	-	-	無	無
花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	538,629,101	2.08%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	470,454,846	1.81%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	416,782,820	1.61%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	355,197,748	1.37%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	328,625,605	1.27%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
新制勞工退休基金	309,948,796	1.20%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
渣打託管iShares新興市場ETF	250,902,123	0.97%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲太平洋基金投資專戶	184,520,799	0.71%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無

（接次頁）

註：此為民國一百一十四年第二季現金股利發放之配息基準日。

4.1.8 長期投資綜合持股比例

截至民國一百一十四年十二月三十一日止

長期投資	本公司投資（1）		董事、經理人及 直接或間接控制事業之投資（2）		綜合投資（1）+（2）	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
按權益法計價						
TSMC Partners, Ltd.	988,268,244	100%	-	-	988,268,244	100%
TSMC Global Ltd.	36,984	100%	-	-	36,984	100%
TSMC North America	11,000,000	100%	-	-	11,000,000	100%
TSMC Europe B.V.	200	100%	-	-	200	100%
TSMC Japan Limited	6,000	100%	-	-	6,000	100%
TSMC Korea Limited	80,000	100%	-	-	80,000	100%
TSMC Design Technology Japan, Inc.	15,000	100%	-	-	15,000	100%
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	49,000	100%	-	-	49,000	100%
台積電（中國）有限公司	不適用（註一）	100%	不適用（註一）	-	不適用（註一）	100%
台積電（南京）有限公司	不適用（註一）	100%	不適用（註一）	-	不適用（註一）	100%
TSMC Arizona Corporation	21,250,000 （註二）	100%	-	-	21,250,000 （註二）	100%
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.	3,010,894	72.65%	-	-	3,010,894	72.65%
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH	805,000	70.00%	-	-	805,000	70.00%
采鈺科技股份有限公司	213,619,000	67.25%（註三）	-	-	213,619,000	67.25%
Systems on Silicon Manufacturing Co. Pte. Ltd.	313,603	38.79%	-	-	313,603	38.79%
世界先進積體電路股份有限公司	506,709,324	27.55%（註四）	300,744,837	16.36%（註五）	807,454,161	43.91%
精材科技股份有限公司	111,281,925	41.01%	-	-	111,281,925	41.01%
創意電子股份有限公司	46,687,859	34.84%	-	-	46,687,859	34.84%
Emerging Fund L.P.	不適用（註一）	99.90%	不適用（註一）	-	不適用（註一）	99.90%

註一：不適用，非股份有限公司未發行股票。台積公司之投資係以股權比例表示。
註二：TSMC Arizona Corporation已於民國一百一十五年一月及民國一百一十五年二月完成增資，增資後本公司持有股數增加為24,000,000股，持股比率為100%。
註三：至民國一百一十四年十二月，本公司持股比計算係以采鈺科技股份有限公司實際流通在外股數為基礎，尚未既得之RSA股數不予列入。
註四：至民國一百一十四年十二月，本公司持股比計算係以世界先進積體電路股份有限公司實際流通在外股數為基礎，尚未既得之RSA股數不予列入。
註五：本公司董事行政院國家發展基金管理會所持有之股權為16.25%。其他董事及經理人則持有0.11%。

4.1.9 股利政策與盈餘分派情形

除中華民國法律及台積公司章程另有規定，台積公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。台積公司盈餘之分派得以現金股利、股票股利或兩者兼有之方式為之，惟根據公司章程，盈餘之分派以現金股利為優先，股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十（50%）為原則，股票股利分派須經中華民國金融監督管理委員會核准。

台積公司之公司章程授權董事會得於每季終了後決議分派季度現金股利。本公司將於董事會核准後六個月內配發現金股利。民國一百一十四年各季度現金股利之金額與配發日期如下表所示。台積公司將維持每年及每季穩定且持續成長的現金股利。

民國一百一十四年各季度盈餘分派案

單位：新台幣元

期間	核准日期（註一）	配發日期（註一）	每股現金股利	盈餘分派總金額
民國一百一十四年第一季	114/05/13	114/10/09	新台幣5.00001754元（註二）	129,663,077,605
民國一百一十四年第二季	114/08/12	115/01/08	新台幣5.00001118元（註二）	129,662,912,605
民國一百一十四年第三季	114/11/11	115/04/09	新台幣6.00003573元（註二）	155,595,147,126
民國一百一十四年第四季	115/02/10	115/07/09	新台幣6.0元（註三）	155,595,147,126

註一：民國年/月/日。
註二：經董事會授權，依普通股配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整每股現金股利。
註三：每股實際現金股利，將依普通股配息基準日本公司實際流通在外股份總數調整之。

4.1.10 董事及員工酬勞

依本公司之章程規定，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不高於0.3%作為董事酬勞，及不低於1%作為員工酬勞（其中不低於30%作為基層員工酬勞）。

台積公司於民國一百一十五年二月十日董事會通過配發之本公司一百一十四年度應付員工現金酬勞係依當年度獲利狀況按一定比率估列，董事酬勞則係依預期發放金額估計入帳。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

民國一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞

本公司民國一百一十四年度董事酬勞為新台幣156,305仟元，以現金方式發放。

本公司民國一百一十四年度員工酬勞（分紅）為新台幣103,072,958仟元，經民國一百一十五年第一季董事會決議通過，以現金方式發放。

註：本公司已於民國一百一十四年每季季後發放業績獎金新台幣103,072,958仟元。上述員工酬勞（分紅）將於民國一百一十五年七月發放。

民國一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞

本公司民國一百一十三年度董事酬勞為新台幣358,989仟元，員工酬勞（分紅）為新台幣70,296,283仟元，皆以現金方式發放。上述董事酬勞及員工酬勞已於民國一百一十三年度綜合損益表中費用化，實際發放數並無差異。

4.1.11 本次無償配股對公司民國一百一十四年營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

4.1.12 買回本公司股份情形：無。

4.2 公司債辦理情形

4.2.1 公司債

新台幣公司債

單位：新台幣元　　截至民國一百一十五年二月二十八日止

公司債種類		國內109年度第1期無擔保普通公司債	國內109年度第2期無擔保普通公司債	國內109年度第3期無擔保普通公司債	國內109年度第4期無擔保普通公司債	國內109年度第5期無擔保普通公司債	國內109年度第6期無擔保普通公司債（綠色債券）
發行日期（註）		109/03/23	109/04/15	109/05/29	109/07/14	109/09/03	109/12/02
面額		10,000,000					
發行價格		依面額發行					
總額		24,000,000,000	21,600,000,000	14,400,000,000	13,900,000,000	15,600,000,000	12,000,000,000
利率（年息）		甲券：0.58% 乙券：0.62% 丙券：0.64%	甲券：0.52% 乙券：0.58% 丙券：0.60%	甲券：0.55% 乙券：0.60% 丙券：0.64%	甲券：0.58% 乙券：0.65% 丙券：0.67%	甲券：0.50% 乙券：0.58% 丙券：0.60%	甲券：0.40% 乙券：0.44% 丙券：0.48%
期限與到期日（註）		甲券：5年期 到期日：114/03/23 乙券：7年期 到期日：116/03/23 丙券：10年期 到期日：119/03/23	甲券：5年期 到期日：114/04/15 乙券：7年期 到期日：116/04/15 丙券：10年期 到期日：119/04/15	甲券：5年期 到期日：114/05/29 乙券：7年期 到期日：116/05/29 丙券：10年期 到期日：119/05/29	甲券：5年期 到期日：114/07/14 乙券：7年期 到期日：116/07/14 丙券：10年期 到期日：119/07/14	甲券：5年期 到期日：114/09/03 乙券：7年期 到期日：116/09/03 丙券：10年期 到期日：119/09/03	甲券：5年期 到期日：114/12/02 乙券：7年期 到期日：116/12/02 丙券：10年期 到期日：119/12/02
償還方法		到期一次還本			到期日最後兩年分別還本二分之一		
未償還金額		21,000,000,000	15,700,000,000	9,900,000,000	8,200,000,000	10,800,000,000	10,400,000,000
信用評等機構名稱、評等日期（註）、公司債評等結果		不適用					
承銷機構（主辦承銷商）		元大證券股份有限公司	元富證券股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司					
保證機構		無					
簽證律師		一誠聯合法律事務所					
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所					
贖回或提前清償之條款		無					
限制條款		無					
附其他權利	發行及轉換辦法	無					
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用					
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無					
交換標的委託保管機構名稱		無					

（接次頁）

公司債種類		國內109年度第7期 無擔保普通公司債	國內110年度第1期 無擔保普通公司債	國內110年度第2期 無擔保普通公司債	國內110年度第3期 無擔保普通公司債	國內110年度第4期 無擔保普通公司債	國內110年度第6期 無擔保普通公司債	國內110年度第7期 無擔保普通公司債	國內111年度第1期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內111年度第2期 無擔保普通公司債	國內111年度第3期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內111年度第4期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內111年度第5期 無擔保普通公司債	國內111年度第6期 無擔保普通公司債 （綠色債券）
發行日期（註）		109/12/29	110/03/30	110/05/03	110/06/25	110/08/19	110/10/05	110/12/09	111/01/12	111/03/29	111/05/20	111/07/27	111/08/25	111/10/20
面額		10,000,000												
發行價格		依面額發行												
總額		18,500,000,000	21,100,000,000	19,200,000,000	19,700,000,000	21,600,000,000	16,300,000,000	16,700,000,000	5,400,000,000	14,200,000,000	6,100,000,000	13,900,000,000	15,600,000,000	10,200,000,000
利率（年息）		甲券：0.36% 乙券：0.41% 丙券：0.45%	甲券：0.50% 乙券：0.55% 丙券：0.60%	甲券：0.50% 乙券：0.58% 丙券：0.65%	甲券：0.52% 乙券：0.58% 丙券：0.65%	甲券：0.485% 乙券：0.50% 丙券：0.55% 丁券：0.62%	甲券：0.535% 乙券：0.54% 丙券：0.60% 丁券：0.62%	甲券：0.65% 乙券：0.675% 丙券：0.72%	甲券：0.63% 乙券：0.72%	甲券：0.84% 乙券：0.85% 丙券：0.90%	1.50%	甲券：1.60% 乙券：1.70% 丙券：1.75% 丁券：1.95%	甲券：1.65% 乙券：1.65% 丙券：1.65% 丁券：1.82%	甲券：1.75% 乙券：1.80% 丙券：2.00%
期限與到期日（註）		甲券：5年期 到期日：114/12/29 乙券：7年期 到期日：116/12/29 丙券：10年期 到期日：119/12/29	甲券：5年期 到期日：115/03/30 乙券：7年期 到期日：117/03/30 丙券：10年期 到期日：120/03/30	甲券：5年期 到期日：115/05/03 乙券：7年期 到期日：117/05/03 丙券：10年期 到期日：120/05/03	甲券：5年期 到期日：115/06/25 乙券：7年期 到期日：117/06/25 丙券：10年期 到期日：120/06/25	甲券：4年期 到期日：114/08/19 乙券：5年期 到期日：115/08/19 丙券：7年期 到期日：117/08/19 丁券：10年期 到期日：120/08/19	甲券：4.5年期 到期日：115/04/05 乙券：5年期 到期日：115/10/05 丙券：7年期 到期日：117/10/05 丁券：10年期 到期日：120/10/05	甲券：5年期 到期日：115/12/09 乙券：5.5年期 到期日：116/06/09 丙券：7年期 到期日：117/12/09	甲券：5年期 到期日：116/01/12 乙券：7年期 到期日：118/01/12	甲券：4.5年期 到期日：115/09/29 乙券：5年期 到期日：116/03/29 丙券：7年期 到期日：118/03/29	5年期 到期日：116/05/20	甲券：4年期 到期日：115/07/27 乙券：5年期 到期日：116/07/27 丙券：7年期 到期日：118/07/27 丁券：10年期 到期日：121/07/27	甲券：4年10個月 到期日：116/06/25 乙券：5年期 到期日：116/08/25 丙券：7年期 到期日：118/08/25 丁券：10年期 到期日：121/08/25	甲券：5年期 到期日：116/10/20 乙券：7年期 到期日：118/10/20 丙券：10年期 到期日：121/10/20
償還方法		到期日最後兩年分別還本二分之一	到期一次還本											
未償還金額		16,600,000,000	21,100,000,000	19,200,000,000	19,700,000,000	17,600,000,000	16,300,000,000	16,700,000,000	5,400,000,000	14,200,000,000	6,100,000,000	13,900,000,000	15,600,000,000	10,200,000,000
信用評等機構名稱、評等日期（註）、公司債評等結果		不適用												
承銷機構（主辦承銷商）		凱基證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	群益金鼎證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司												
保證機構		無												
簽證律師		一誠聯合法律事務所												
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所												
贖回或提前清償之條款		無												
限制條款		無												
附其他權利	發行及轉換辦法	無												
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用												
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無												
交換標的委託保管機構名稱		無												

（接次頁）

公司債種類		國內112年度第1期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內112年度第2期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內112年度第3期 無擔保普通公司債	國內112年度第4期 無擔保普通公司債	國內112年度第5期 無擔保普通公司債	國內113年度第1期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內113年度第2期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內114年度第1期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內114年度第2期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內114年度第3期 無擔保普通公司債 （綠色債券）	國內114年度第4期 無擔保普通公司債 （10年期為綠色債券）	國內114年度第5期 無擔保普通公司債 （綠色債券）
發行日期（註）		112/03/28	112/05/03	112/06/01	112/08/16	112/10/16	113/03/15	113/05/17	114/03/28	114/06/02	114/07/09	114/09/18	114/11/20
面額		10,000,000											
發行價格		依面額發行											
總額		19,300,000,000	20,700,000,000	20,000,000,000	15,900,000,000	9,800,000,000	22,800,000,000	11,500,000,000	19,200,000,000	14,100,000,000	12,300,000,000	17,800,000,000	23,500,000,000
利率（年息）		甲券：1.54% 乙券：1.60% 丙券：1.78%	甲券：1.60% 乙券：1.65% 丙券：1.82%	甲券：1.60% 乙券：1.65% 丙券：1.80%	甲券：1.60% 乙券：1.65% 丙券：1.76%	甲券：1.62% 乙券：1.76%	甲券：1.64% 乙券：1.76%	甲券：1.98% 乙券：2.10%	甲券：1.90% 乙券：2.05%	甲券：1.92% 乙券：2.05%	甲券：1.92% 乙券：2.05%	甲券：1.66% 乙券：1.73%	甲券：1.50% 乙券：1.53% 丙券：1.58%
期限與到期日（註）		甲券：5年期 到期日：117/03/28 乙券：7年期 到期日：119/03/28 丙券：10年期 到期日：122/03/28	甲券：5年期 到期日：117/05/03 乙券：7年期 到期日：119/05/03 丙券：10年期 到期日：122/05/03	甲券：5年期 到期日：117/06/01 乙券：7年期 到期日：119/06/01 丙券：10年期 到期日：122/06/01	甲券：5年期 到期日：117/08/16 乙券：7年期 到期日：119/08/16 丙券：10年期 到期日：122/08/16	甲券：5年期 到期日：117/10/16 乙券：10年期 到期日：122/10/16	甲券：5年期 到期日：118/03/15 乙券：10年期 到期日：123/03/15	甲券：5年期 到期日：118/05/17 乙券：10年期 到期日：123/05/17	甲券：5年期 到期日：119/03/28 乙券：10年期 到期日：124/03/28	甲券：5年期 到期日：119/06/02 乙券：10年期 到期日：124/06/02	甲券：5年期 到期日：119/07/09 乙券：10年期 到期日：124/07/09	甲券：5年期 到期日：119/09/18 乙券：10年期 到期日：124/09/18	甲券：5年期 到期日：119/11/20 乙券：7年期 到期日：121/11/20 丙券：10年期 到期日：124/11/20
償還方法		到期一次還本											
未償還金額		19,300,000,000	20,700,000,000	20,000,000,000	15,900,000,000	9,800,000,000	22,800,000,000	11,500,000,000	19,200,000,000	14,100,000,000	12,300,000,000	17,800,000,000	23,500,000,000
信用評等機構名稱、評等日期（註）、公司債評等結果		不適用											
承銷機構（主辦承銷商）		元大證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司	國泰世華商業銀行股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	永豐金證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	凱基證券股份有限公司	元大證券股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司	統一綜合證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司											
保證機構		無											
簽證律師		一誠聯合法律事務所											
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所											
贖回或提前清償之條款		無											
限制條款		無											
附其他權利	發行及轉換辦法	無											
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用											
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無											
交換標的委託保管機構名稱		無											

註：民國年/月/日。

境內美元公司債

截至民國一百一十五年二月二十八日止

公司債種類		109年度第1期美元無擔保普通公司債	110年度第5期美元無擔保普通公司債
發行日期（註）		109/09/22	110/09/23
面額		美金1,000,000元	
掛牌地點		中華民國證券櫃檯買賣中心	
發行價格		依面額發行	
總額		美金1,000,000,000元	美金1,000,000,000元
利率（年息）		2.70%	3.10%
期限與到期日（註）		40年期 到期日：149/09/22	30年期 到期日：140/09/23
償還方法		到期一次還本	
未償還金額		美金1,000,000,000元	美金1,000,000,000元
信用評等機構名稱、評等日期（註）、公司債評等結果		不適用	
承銷機構		美商高盛亞洲證券有限公司臺北分公司 凱基證券股份有限公司（主辦承銷商）	
受託人		兆豐國際商業銀行股份有限公司	
保證機構		無	
簽證律師／法律顧問		一誠聯合法律事務所	
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所	
贖回或提前清償之條款		發行人有權於發行屆滿五年之日及其後每屆滿周年日可提前贖回	
限制條款		無	
附其他權利	發行及轉換辦法	無	
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	
交換標的委託保管機構名稱		無	

註：民國年/月/日。

境外美元公司債

截至民國一百一十五年二月二十八日止

發行公司		TSMC Global Ltd.（註一）	TSMC Global Ltd.（註一）	TSMC Arizona Corporation（註一）	TSMC Arizona Corporation（註一）	TSMC Global Ltd.（註一）
公司債種類		海外無擔保主順位公司債（註二）	海外無擔保主順位公司債（註二）	海外無擔保主順位公司債（註二）	海外無擔保主順位公司債（註二）	海外無擔保主順位公司債（註二）
發行日期（註三）		109/09/28	110/04/23	110/10/25	111/04/22	111/07/22
面額		美金200,000元，超過部分以美金1,000元為單位增加				
掛牌地點		新加坡交易所				
發行價格		民國114年到期之公司債：以面額99.907%發行 民國116年到期之公司債：以面額99.603%發行 民國119年到期之公司債：以面額99.083%發行	民國115年到期之公司債：以面額99.759%發行 民國117年到期之公司債：以面額99.751%發行 民國120年到期之公司債：以面額99.831%發行	民國115年到期之公司債：以面額99.976%發行 民國120年到期之公司債：以面額99.561%發行 民國130年到期之公司債：以面額98.898%發行 民國140年到期之公司債：以面額98.658%發行	民國116年到期之公司債：以面額99.829%發行 民國118年到期之公司債：以面額99.843%發行 民國121年到期之公司債：以面額99.742%發行 民國141年到期之公司債：以面額99.771%發行	民國116年到期之公司債：以面額99.951%發行 民國121年到期之公司債：以面額99.124%發行
總額		美金3,000,000,000元	美金3,500,000,000元	美金4,500,000,000元	美金3,500,000,000元	美金1,000,000,000元
利率（年息）		民國114年到期之公司債：0.75% 民國116年到期之公司債：1.00% 民國119年到期之公司債：1.375%	民國115年到期之公司債：1.25% 民國117年到期之公司債：1.75% 民國120年到期之公司債：2.25%	民國115年到期之公司債：1.75% 民國120年到期之公司債：2.50% 民國130年到期之公司債：3.125% 民國140年到期之公司債：3.25%	民國116年到期之公司債：3.875% 民國118年到期之公司債：4.125% 民國121年到期之公司債：4.250% 民國141年到期之公司債：4.500%	民國116年到期之公司債：4.375% 民國121年到期之公司債：4.625%
期限與到期日（註三）		民國114年到期之公司債：5年期 到期日：114/09/28 民國116年到期之公司債：7年期 到期日：116/09/28 民國119年到期之公司債：10年期 到期日：119/09/28	民國115年到期之公司債：5年期 到期日：115/04/23 民國117年到期之公司債：7年期 到期日：117/04/23 民國120年到期之公司債：10年期 到期日：120/04/23	民國115年到期之公司債：5年期 到期日：115/10/25 民國120年到期之公司債：10年期 到期日：120/10/25 民國130年到期之公司債：20年期 到期日：130/10/25 民國140年到期之公司債：30年期 到期日：140/10/25	民國116年到期之公司債：5年期 到期日：116/04/22 民國118年到期之公司債：7年期 到期日：118/04/22 民國121年到期之公司債：10年期 到期日：121/04/22 民國141年到期之公司債：30年期 到期日：141/04/22	民國116年到期之公司債：5年期 到期日：116/07/22 民國121年到期之公司債：10年期 到期日：121/07/22
償還方法		到期一次還本				
未償還金額		美金2,000,000,000元	美金3,500,000,000元	美金4,500,000,000元	美金3,500,000,000元	美金1,000,000,000元
信用評等機構名稱、評等日期（註三）、公司債評等結果		Aa3（穆迪，109/09/21） AA-（標準普爾，109/09/21）	Aa3（穆迪，110/04/19） AA-（標準普爾，110/04/18）	Aa3（穆迪，110/10/19） AA-（標準普爾，110/10/18）	Aa3（穆迪，111/04/19） AA-（標準普爾，111/04/18）	Aa3（穆迪，111/07/19） AA-（標準普爾，111/07/18）
承銷機構		Goldman Sachs International為主辦承銷商		Goldman Sachs & Co. LLC為主辦承銷商		Goldman Sachs International為主辦承銷商
受託人		Citicorp International Limited		Citibank, N.A.		Citicorp International Limited
保證機構		台積公司				
簽證律師／法律顧問		Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP Harney Westwood & Riegels 理律法律事務所		Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP Fennemore Craig, P.C. 理律法律事務所		Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP Harney Westwood & Riegels 理律法律事務所
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所				
贖回或提前清償之條款		發行人有權選擇於任何時間以合約規定之贖回價格贖回本公司債之全部或部分				
限制條款		無				
附其他權利	發行及轉換辦法	無				
	已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用				
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無				
交換標的委託保管機構名稱		無				

註一：台積公司百分之百持股子公司。
註二：由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。
註三：民國年/月/日。

4.2.2 轉換公司債資料：無。

4.2.3 交換公司債資料：無。

4.2.4 總括申報發行公司債情形：無。

4.2.5 附認股權公司債資料：無。

4.3 特別股辦理情形

4.3.1 特別股：無。

4.3.2 附認股權特別股資料：無。

4.4 海外存託憑證辦理情形

發行日期（註一）	86/10/08	87/11/20	88/01/12~ 88/01/14	88/07/15	88/08/23~ 88/09/09	89/02/22~ 89/03/08	89/04/17	89/06/07~ 89/06/15	90/05/17~ 90/06/11	90/11/27	91/02/07~ 91/02/08	91/11/21~ 91/12/19	92/07/14~ 92/07/21	92/11/14	94/08/10~ 94/09/08	96/05/23
發行總金額（US$百萬）	595	185	36	296	159	379	225	1,168	539	321	1,002	160	909	1,077	1,402	2,563
單位發行價格（US$）	24.78	15.26	17.75	24.516	28.964	57.79	56.16	35.75	20.63	16.03	16.75	8.73	10.40	10.77	8.60	10.68
發行單位總數（單位）	24,000,000	12,094,000	2,000,000	12,094,000	5,486,000	6,560,000	4,000,000	32,667,800	26,110,000	20,000,000	59,800,000	18,348,000	87,357,200	100,000,000	163,027,500	240,000,000
表彰有價證券之數額	每單位存託憑證表彰台積電普通股5股															
表彰有價證券之來源	本公司股東所持有之台積電普通股							現金增資及本公司股東所持有之台積電普通股	本公司股東所持有之台積電普通股							
發行及存續期間相關費用之分擔方式	（註四）							（註五）	（註四）							
發行及交易地點	紐約證券交易所															
存託憑證持有人之權利與義務	權利義務與普通股相同															
受託人	不適用															
存託機構	Citibank, N.A.－New York															
保管機構（註二）	花旗銀行台北分行															
未兌回餘額（單位）（註三）	至民國115年2月28日止，餘額總數為1,062,690,167單位。															
存託契約及保管契約之重要約定事項	詳如存託契約及保管契約															

每單位市價（US$；來源：Bloomberg）	114/01/01~ 114/12/31 （註一）	最高	310.14
		最低	141.37
		平均	230.30
	115/01/01~ 115/02/28 （註一）	最高	387.73
		最低	318.01
		平均	345.21

註一：民國年/月/日。
註二：自民國九十八年起，花旗銀行台北分行之銀行名稱變更為花旗（台灣）銀行。
註三：本公司美國存託憑證自民國八十六年於紐約證券交易所上市以來，總計發行813,544,500單位。若將歷年所發放之股票股利計入，發行總數則為1,147,835,205單位（本公司民國八十七年、八十八年、八十九年、九十年、九十一年、九十二年、九十三年、九十四年、九十五年、九十六年、九十七年及九十八年股票股利之發放，其配股率分別為45%、23%、28%、40%、10%、8%、14.08668%、4.99971%、2.99903%、0.49991%、0.50417%及0.49998%）。截至民國一百一十五年二月二十八日止，投資人總計兌回85,145,038單位，故本公司美國存託憑證流通餘額總數為1,062,690,167單位。
註四：發行費用由釋股股東負擔，存續期間相關費用由發行公司負擔。
註五：發行費用由發行公司及釋股股東按比例負擔，存續期間相關費用由發行公司負擔。

4.5 員工認股權憑證辦理情形

4.5.1 員工認股權憑證辦理情形：無。

4.5.2 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

4.6 限制員工權利新股辦理情形

4.6.1 限制員工權利新股辦理情形

截至民國一百一十五年三月一日止

限制員工權利新股種類	民國一百一十年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	民國一百一十年八月六日／2,600,000股
發行日期	民國一百一十一年三月一日
已發行限制員工權利新股股數	1,387,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.00535%
員工限制權利新股之既得條件	1. 高階主管自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：(1) 於各既得期間屆滿日仍在職；(2) 各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事；(3) 達成本公司所設定高階主管績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為「S」（註）（含）以上）與公司營運成果指標。（註：「S」代表「優良」） 2. 各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%，以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，詳細說明如下。 3. 將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下表本公司股東總報酬率（TSR）（註）指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬委員會評估本公司ESG成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR** ／ **既得股數比例** 優於指數 X 個百分點 ／ 50% ＋ X * 2.5%，最高為100% 與指數持平 ／ 50% 落後指數 X 個百分點 ／ 50% - X * 2.5%，最低為0% 註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。
員工限制權利新股之受限制權利	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，高階主管不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 既得期間高階主管不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 3. 除前述限制外，高階主管依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託／保管契約執行之。 4. 高階主管未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託／保管機構代為行使之。 5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託／保管，於達成既得條件後才得交付高階主管；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

（接次頁）

限制員工權利新股之保管情形	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，高階主管不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 限制員工權利新股交付信託／保管期間應由本公司全權代理高階主管與股票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1. 高階主管未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 2. 自願離職、資遣、解雇：尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 3. 留職停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依所定既得條件外，需再依高階主管於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 4. 退休：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；各年度可既得之實際股份，依所定之既得條件辦理，個人績效考核等第視為「S」。 5. 一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：尚未既得之限制員工權利新股，既得股數以本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR指數持平計算，且不另依ESG成果調整。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該高階主管領受其應既得之股份。 6. 調職：(1) 高階主管請調至子公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照「自願離職」之方式處理。(2) 經本公司指派轉任子公司、關係企業或其他公司之高階主管，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司子公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長與總裁參考轉任之子公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 7. 高階主管向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 8. 高階主管自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 9. 高階主管終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託／保管帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	783,557股
已解除限制權利新股之股數	603,443股
未解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

限制員工權利新股種類	民國一百一十一年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	民國一百一十一年七月二十五日／3,065,000股
發行日期	民國一百一十二年三月一日
已發行限制員工權利新股股數	2,110,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.00814%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：(1) 於各既得期間屆滿日仍在職；(2) 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3) 達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為「S」（註）（含）以上）與公司營運成果指標。（註：「S」代表「優良」） 2. 各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%，以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，詳細說明如下。 3. 本公司符合資格條件之經理人：將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下表本公司股東總報酬率（TSR）（註）指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬委員會評估本公司ESG成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR** ／ **既得股數比例** 優於指數 X 個百分點 ／ 50% ＋ X * 2.5%，最高為100% 與指數持平 ／ 50% 落後指數 X 個百分點 ／ 50% - X * 2.5%，最低為0% 註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。 4. 本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工：各年度可既得股數以本公司於各既得日前一年度經會計師查核簽證之合併財務報告為依據，依下表計算之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **門檻值** ／ **目標值** ／ **權重** ／ **既得股數比例** 營業收入成長率 ／ 10% ／ 15% ／ 三分之一 ／ ●＜門檻值：0% 毛利率 ／ 15% ／ 53% ／ 三分之一 ／ ●＝門檻值：50% 股東權益報酬率 ／ 20% ／ 25% ／ 三分之一 ／ ●≧目標值：100% ●介於門檻值與目標值：以內插法計算
員工限制權利新股之受限制權利	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託／保管契約執行之。 4. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託／保管機構代為行使之。 5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託／保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

（接次頁）

限制員工權利新股之保管情形	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 限制員工權利新股交付信託／保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1. 員工未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 2. 自願離職、資遣、解雇：尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 3. 留職停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依所定既得條件外，需再依員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 4. 退休：員工退休後，完全符合以下要求者，尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；若違反以下任一要求，尚未既得之限制員工權利新股視為未達既得條件，個別情況之豁免，由董事長及總裁核定： (1) 未從事全職的工作。 (2) 未從事任何與台積公司競爭之事項，包含但不限於：加入競爭公司、提供任何與台積公司競爭的服務、建立任何涉及提供半導體製程或服務之公司或事業，或聘僱、誘導、或試圖誘使任何台積公司的員工從事與台積公司競爭的服務。 尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；各年度可既得之實際股份，依所定之既得條件辦理，個人績效考核等第視為「S」。 5. 一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：尚未既得之限制員工權利新股，本公司符合資格條件之經理人之既得股數以本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR指數持平計算，且不另依ESG成果調整；本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工則以本公司營業收入成長率、毛利率、與股東權益報酬率皆等於門檻值計算。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。 6. 調職：(1) 員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照「自願離職」之方式處理。(2) 經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長與總裁參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 7. 員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 8. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 9. 員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託／保管帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	1,113,440股
已解除限制權利新股之股數	996,560股
未解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

限制員工權利新股種類	民國一百一十二年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	民國一百一十二年十二月二十八日／6,249,000股
發行日期	民國一百一十三年三月一日
已發行限制員工權利新股股數	2,960,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.01141%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：(1) 於各既得期間屆滿日仍在職；(2) 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3) 達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為「S」（註）（含）以上）與公司營運成果指標。（註：「S」代表「優良」） 2. 各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%，以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，詳細說明如下。 3. 本公司符合資格條件之經理人：將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下表本公司股東總報酬率（TSR）（註）指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬暨人才發展委員會評估本公司ESG成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR** ／ **既得股數比例** 優於指數 X 個百分點 ／ 50% ＋ X * 2.5%，最高為100% 與指數持平 ／ 50% 落後指數 X 個百分點 ／ 50% - X * 2.5%，最低為0% 註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。 4. 本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工：各年度可既得股數以本公司於各既得日前一年度經會計師查核簽證之合併財務報告為依據，依下表計算之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **門檻值** ／ **目標值** ／ **權重** ／ **既得股數比例** 營業收入成長率 ／ 10% ／ 15% ／ 三分之一 ／ ● <門檻值：0% 毛利率 ／ 15% ／ 53% ／ 三分之一 ／ ● =門檻值：50% 股東權益報酬率 ／ 20% ／ 25% ／ 三分之一 ／ ● ≧目標值：100% ● 介於門檻值與目標值：以內插法計算
員工限制權利新股之受限制權利	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託／保管契約執行之。 4. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託／保管機構代為行使之。 5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託／保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

（接次頁）

限制員工權利新股之保管情形	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 限制員工權利新股交付信託／保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1. 員工未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 2. 自願離職、資遣、解雇：尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 3. 留職停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依所定既得條件外，需再依員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 4. 退休：員工退休後，完全符合以下要求者，尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；若違反以下任一要求，尚未既得之限制員工權利新股視為未達既得條件，個別情況之豁免，由董事長及總裁核定： (1) 未從事全職的工作。 (2) 未從事任何與台積公司競爭之事項，包含但不限於：加入競爭公司、提供任何與台積公司競爭的服務、建立任何涉及提供半導體製程或服務之公司或事業，或聘僱、誘導、或試圖誘使任何台積公司的員工從事與台積公司競爭的服務。 尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；各年度可既得之實際股份，依所定之既得條件辦理，個人績效考核等第視為「S」。 5. 一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：尚未既得之限制員工權利新股，本公司符合資格條件之經理人之既得股數以本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR指數持平計算，且不另依ESG成果調整；本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工則以本公司營業收入成長率、毛利率、與股東權益報酬率皆等於門檻值計算。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。 6. 調職：(1) 員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照「自願離職」之方式處理。(2) 經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長與總裁參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 7. 員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 8. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 9. 員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託／保管帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	155,394股
已解除限制權利新股之股數	2,102,106股
未解除限制權利新股之股數	702,500股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0.00271%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

限制員工權利新股種類	民國一百一十三年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	民國一百一十三年七月三十一日／4,185,000股
發行日期	民國一百一十三年九月一日
已發行限制員工權利新股股數	2,353,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	1,832,000股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.00907%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：(1) 於各既得期間屆滿日仍在職；(2) 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事；(3) 達成本公司所設定員工績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為「S」（註）（含）以上）與公司營運成果指標。（註：「S」代表「優良」） 2. 各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%，以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，詳細說明如下。 3. 本公司符合資格條件之經理人：將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下表本公司股東總報酬率（TSR）（註）指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬暨人才發展委員會評估本公司ESG成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR** ／ **既得股數比例** 優於指數 X 個百分點 ／ 50% ＋ X * 2.5%，最高為100% 與指數持平 ／ 50% 落後指數 X 個百分點 ／ 50% - X * 2.5%，最低為0% 註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。 4. 本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工：各年度可既得股數以本公司於各既得日前一年度經會計師查核簽證之合併財務報告為依據，依下表計算之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 **門檻值** ／ **目標值** ／ **權重** ／ **既得股數比例** 營業收入成長率 ／ 10% ／ 15% ／ 三分之一 毛利率 ／ 15% ／ 53% ／ 三分之一 股東權益報酬率 ／ 20% ／ 25% ／ 三分之一 • <門檻值：0% • =門檻值：50% • ≧目標值：100% • 介於門檻值與目標值：以內插法計算
員工限制權利新股之受限制權利	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 3. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託／保管契約執行之。 4. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託／保管機構代為行使之。 5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託／保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

（接次頁）

限制員工權利新股之保管情形	1. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託／保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 限制員工權利新股交付信託／保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1. 員工未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 2. 自願離職、資遣、解雇：尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 3. 留職停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依本條第（三）項所定既得條件外，需再依員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 4. 退休：員工退休後，完全符合以下要求者，尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；若違反以下要求，尚未既得之限制員工權利新股視為未達既得條件，個別情況之豁免，由董事長及總裁核定： 未從事任何與本公司或本公司從屬公司競爭之事項，包含但不限於：加入競爭公司、提供任何與本公司或本公司從屬公司競爭的服務、建立任何涉及提供半導體製程或服務之公司或事業，或聘僱、誘導、或試圖誘使任何本公司或本公司從屬公司的員工從事與本公司或本公司從屬公司競爭的服務。 尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；各年度可既得之實際股份，依所定之既得條件辦理，個人績效考核等第視為「S」。 5. 一般死亡或因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：尚未既得之限制員工權利新股會視為立刻既得。本公司符合資格條件之經理人之既得股數以本公司TSR相對標準普爾500 IT指數TSR指數持平計算，且不另依ESG成果調整；本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工則以本公司營業收入成長率、毛利率、與股東權益報酬率皆等於門檻值計算。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。 6. 調職：(1) 員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時，其尚未既得之限制員工權利新股應比照「自願離職」之方式處理。(2) 經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。而其個人績效評核由本公司之董事長與總裁參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。 7. 員工向本公司以書面聲明自願放棄被授予之限制員工權利新股者，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 8. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。 9. 員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託／保管帳戶之代理授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	132,000股
已解除限制權利新股之股數	1,102,000股
未解除限制權利新股之股數	1,119,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0.00432%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

4.6.2 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

單位：股／新台幣仟元

截至民國一百一十五年三月一日止

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率（註一）	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格（元）	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率（註一）	未解除限制之股數	發行價格（元）	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率（註一）
經理人及員工	董事長暨總裁	魏哲家	8,810,000	0.03397%	4,804,109	0	0	0.01853%	1,821,500	0	0	0.00702%
	資深副總經理暨財務長兼發言人	黃仁昭										
	執行副總經理暨共同營運長	秦永沛										
	執行副總經理暨共同營運長	米玉傑										
	資深副總經理暨副共同營運長／資訊安全長	侯永清										
	資深副總經理暨副共同營運長	張曉強										
	資深副總經理	何麗梅										
	資深副總經理	羅唯仁（註二）										
	資深副總經理／前資訊安全長	林錦坤（註二）										
	資深副總經理	王建光（註二）										
	資深副總經理暨法務長／公司治理主管	方淑華										
	資深副總經理	王英郎（註三）										
	資深副總經理、台積資深科技院士	張宗生（註三、四）										
	資深副總經理	吳顯揚（註三）										
	資深副總經理	葉主輝（註三）										
	副總經理	馬慧凡（註二）										
	副總經理、台積卓越科技院士	余振華（註二）										
	副總經理	曹敏										
	副總經理	廖德堆（註二）										
	副總經理／JASM執行長	廖永豪										
	副總經理	章勳明										
	副總經理	游秋山										
	副總經理	何軍										
	副總經理暨資訊長	林宏達										
	副總經理	李俊賢										
	副總經理	莊子壽										
	副總經理、台積資深科技院士	魯立忠（註四）										
	副總經理	徐國晉										
	副總經理／台積公司亞利桑那子公司執行長	莊瑞萍										
	副總經理	李文如（註二）										
	員工	黃源昌（註二）										

註一：係以民國一百一十四年二月二十四日於經濟部列示已發行股份總數計算。
註二：資深副總經理王建光先生於民國一百一十一年五月七日退休；副總經理馬慧凡女士於民國一百一十一年十一月一日退休；副總經理廖德堆博士於民國一百一十一年十一月十一日退休；黃源昌先生於民國一百一十一年五月一日退休。資深副總經理林錦坤先生於民國一百一十四年四月十日退休；副總經理余振華博士於民國一百一十四年七月八日退休；副總經理李文如女士於民國一百一十四年七月十三日離職；資深副總經理羅唯仁博士於民國一百一十四年七月二十七日退休。
註三：王英郎博士、張宗生博士、吳顯揚博士及葉主輝博士於民國一百一十五年二月十日獲擢升為資深副總經理。
註四：張宗生博士及魯立忠博士於民國一百一十四年六月十七日獲擢升為台積資深科技院士。

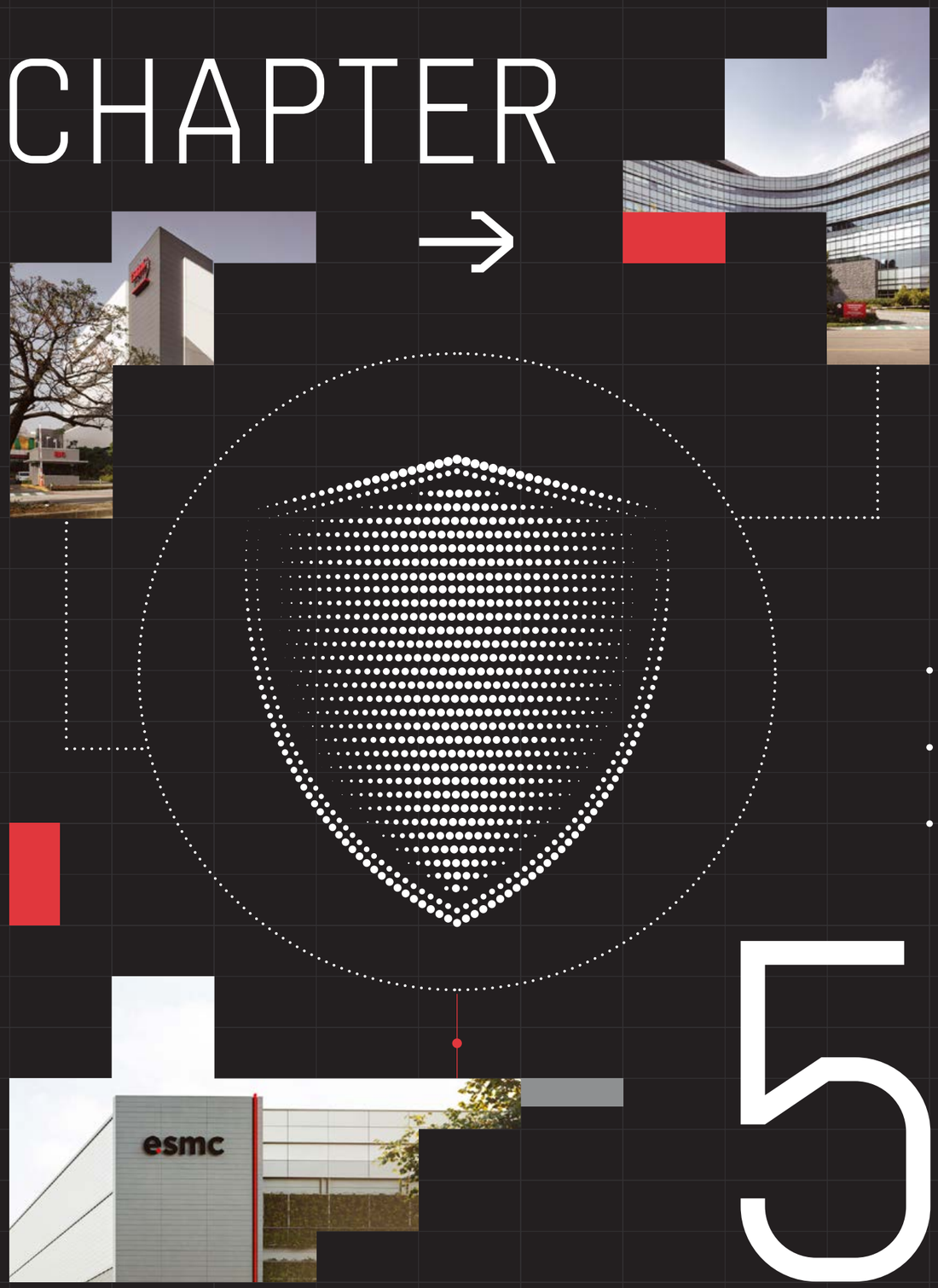
4.7 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

4.8 資金運用計劃執行情形

台積公司於國內發行公司債募集之資金依其資金運用計劃及實際需求分配，截至民國一百一十四年底止，尚未完成之資金運用計劃執行情形表列如下：

計劃項目	募集資金	資金運用計劃	執行情形
114年度第2期無擔保普通公司債（綠色債券）	新台幣141億元	支應台積公司綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出	新建擴建廠房設備：截至民國一百一十四年底止，資金運用之累計實際執行進度為88.80%，高於原先預定執行進度之16.21%，係因依工程進度請款。資金運用依原計劃項目依序執行，預定效益與實際達成情形無重大差異。 其他：截至民國一百一十四年底止，資金運用之累計實際執行進度為17.69%，高於原先預定執行進度之0%，係因依廠商供電量請款。資金運用依原計劃項目依序執行，預定效益與實際達成情形無重大差異。
114年度第3期無擔保普通公司債（綠色債券）	新台幣123億元	支應台積公司綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出	新建擴建廠房設備：資金運用預定於民國一百一十五年第二季開始執行。 其他：資金運用預定於民國一百一十五年第三季開始執行。
114年度第4期無擔保普通公司債（10年期為綠色債券）	新台幣178億元	支應台積公司新建擴建廠房設備、綠建築、使用再生能源及綠色環保相關之支出	新建擴建廠房設備：截至民國一百一十四年底止，資金運用之累計實際執行進度為88.21%，同於預期進度。資金運用依原計劃項目依序執行，預定效益與實際達成情形無重大差異。 其他：資金運用預定於民國一百一十六年第一季開始執行。
114年度第5期無擔保普通公司債（綠色債券）	新台幣235億元	支應台積公司綠建築及綠色環保相關之資本支出	新建擴建廠房設備：截至民國一百一十四年底止，資金運用之累計實際執行進度為15.19%，高於原先預定執行進度之0%，係因依工程進度請款。資金運用依原計劃項目依序執行，預定效益與實際達成情形無重大差異。

CHAPTER



5

營運概況

台積公司提供305種不同的製程技術，為534個客戶生產
1萬2,682種不同產品

5.1 業務內容

5.1.1 業務範圍

身為專業積體電路製造服務的創始者與領導者之一，台積公司提供全面整合的積體電路製造服務，包括領先的先進製程技術、特殊製程技術、先進光罩技術、TSMC 3DFabric®先進矽堆疊與封裝解決方案、優異的量產能力與品質，以及完備的設計生態系統支援，來滿足客戶日益多樣化的需求。台積公司致力於提供客戶無與倫比的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功，因此贏得來自全球客戶的信任，而公司也獲致極大的成長與成功。

台積公司於民國一百一十四年技術進展包括：

邏輯製程技術

- A14技術是台積公司下一世代尖端邏輯技術。A14透過先進的尺寸微縮，在全節點效能、功耗和面積方面實現了提升，為創新樹立新的標竿。該技術為高效能運算、智慧型手機，以及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）應用提供了最佳的解決方案，目前研發進展順利。
- TSMC A16™技術採用奈米片（Nanosheet）電晶體架構及創新的背面電軌（Backside Power Rail）解決方案，大幅提升邏輯密度及效能。與N2P相比，此一技術將在功耗、性能和面積方面進一步拓展台積公司的技術領先地位。
- 2奈米（N2）技術開發於民國一百一十四年在良率和效能提升方面均取得卓越進展。N2技術採用台積公司第一代奈米片電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，依預定時程已於民國一百一十四年量產。
- 3奈米鰭式場效電晶體（Fin Field-Effect Transistor, FinFET）（N3）技術於民國一百一十四年邁入第四年量產，應用於客戶智慧型手機及高效能運算（High Performance Computing, HPC）產品。
- N3增強型（N3 Enhanced, N3E）技術係N3技術的強化版，持續針對行動通訊與高效能運算應用提供領先業界的優勢，於民國一百一十四年邁入第三年量產。
- N3強效版（N3P）技術係N3E技術的強化版，進一步針對行動通訊與高效能運算應用提供領先業界的優勢，於民國一百一十四年邁入第二年量產。
- N3精簡型（N3C）技術在N3P基礎上，提供精簡的設計單元、具備成本效益及簡化的製程。憑藉向後兼容的設計規則，N3C可實現矽智財（IP）無縫接軌的重複使用和最小化的設計投入。客戶已於民國一百一十四年開始投片，預計於民國一百一十五年開始量產。
- N3X技術係為高效能運算應用量身打造，於民國一百一十二年推出。此一技術於民國一百一十三年完成驗證，並於民國一百一十四年開始量產。
- 4奈米FinFET（N4）技術為5奈米FinFET（N5）技術的強化版，已於民國一百一十四年邁入第四年量產。
- N4強效版（N4P）技術，相較於N4具備額外的效能提升，於民國一百一十四年邁入第三年量產。
- N4精簡型強效版（N4C）技術，以嶄新的製程改善，提供相較於N4P具備額外的高密度元件和更簡化的製造流程，於民國一百一十四年開始接受客戶產品投片。
- N4X技術於民國一百一十年推出。此一技術係台積公司首次針對高效能運算產品所量身打造，在台積公司5奈米系列製程技術中，展現極致效能與最高運作時脈，於民國一百一十四年邁入第二年量產。
- 5奈米FinFET強效版（N5 Plus, N5P）技術為N5技術的效能強化版，於民國一百一十四年邁入第五年量產，應用於客戶智慧型手機及高效能運算產品。
- 6奈米FinFET（N6）技術於民國一百一十四年邁入第六年量產，並廣泛應用於智慧型手機、高效能運算，以及消費性電子產品。
- N6e®超低功耗（Ultra-Low Power, ULP）技術服務其製程設計套件（Process Design Kit, PDK）和低電壓靜態隨機存取記憶體（Low Vdd SRAM）、超低漏電隨機靜態存取記憶體（ULL_SRAM），以及低電壓標準元件庫（Low Vdd Standard Cell Libraries）的智財生態體系已發布，並被穿戴應用所採用。此一技術於民國一百一十四年邁入第二年量產，提供更全面的產品。
- 7奈米FinFET（N7）系列技術已廣泛被客戶應用於量產5G及高效能運算產品多年，並於民國一百一十四年邁入消費性電子與車用產品量產的第五年。
- N12e®技術服務於民國一百一十四年持續被眾多的產品應用所採用，包含微控制器（Microcontroller Unit, MCU）、應用處理器、記憶體控制器及物聯網互聯，與語音／影像人工智慧產品等。此一技術服務更進一步提供更多低電壓及低漏電元件的解決方案，以達到速度及功耗的最佳化。
- 22奈米超低漏電（Ultra-Low Leakage, ULL）（22ULL）技術於民國一百一十四年邁入第七年量產，並已推廣到各種應用上，包含無線連結產品，例如藍芽、Wi-Fi應用於物聯網，以及微控制器、數位化電視晶片、智慧型手機等等。

特殊製程技術

- N3A技術基於台積公司N3E技術，是台積公司迄今為止最先進的車用規格製程。台積公司於民國一百一十二年推出Auto Early（N3AE）解決方案，提供汽車製程設計套件，支援車用客戶採用業界最先進的3奈米製程技術來設計車用電子應用產品。N3A 1.0版製程設計套件已於民國一百一十四年供客戶使用，該技術完成車用規格認證，並提供汽車設計開發平台（Automotive Design Enablement Platform, ADEP）。
- N4 Auto Early（N4AE）基於台積公司N4P技術，旨在民國一百一十四年實現車用規格（Automotive Grade）技術，目標是在一百一十五年底前完成汽車製程認證。
- N4C射頻（Radio Frequency, RF）（N4C RF）技術，係N4P RF下一代技術，預計於民國一百一十五年推出。
- 5奈米FinFET車用（N5A）技術自民國一百一十二年開始接獲多個客戶產品投片，其中部分產品已完成原型製作，通過汽車應用認證，並於民國一百一十四年成功利用台積公司的汽車服務套件（Application Service Package, ASP）開始量產。
- 第二代N6RF（N6 RF+）技術已經完成開發，其1.1版製程設計套件已於民國一百一十四年推出。
- 12FFC+射頻技術製程持續精進，提供更精進的f_T/f_{MAX}射頻模型和窄線寬的超厚銅（Ultra-Thick Metal, UTM），以及極窄線寬的高電阻製程，此技術已為客戶的4G及5G手機射頻和物聯網無線連接產品邁入第三年量產。
- 16奈米FinFET精簡型（16nm FinFET Compact, 16FFC）射頻增強版（Enhancement III）技術正在開發中，並持續精進16FFC RF技術，預計於民國一百一十五年推出。16FFC RF技術於民國一百一十年接獲多個客戶產品的投片，其增強版（Enhancement I/II）技術於民國一百一十一年開發完成，支援28/39/47千兆赫茲（GHz）毫米波射頻前端模組（mmWave RF Front-End Module）與77GHz/79GHz汽車雷達等運用。
- 16奈米磁阻式隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random-Access Memory, MRAM）技術，係台積公司第二代MRAM技術，於民國一百一十四年通過車用規格認證，其晶片故障率在經過100萬次循環後低於百萬分之一（Parts Per Million, PPM）。
- N12e®電阻式隨機存取記憶體（Resistive Random-Access Memory, RRAM）技術服務是台積公司第三代RRAM解決方案，具備成本和可靠性的平衡，已於民國一百一十四年通過商規生產認證。
- 22奈米RRAM技術，係台積公司第二代RRAM技術，已於民國一百一十四年通過高耐久性10萬次循環資格認證，適用於高耐久性產品應用，並提供多樣的記憶體巨集（Macros）選擇。
- 28奈米高壓（High Voltage, HV）技術應用於智慧型手機有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode, OLED）顯示器應用，於民國一百一十四年邁入第二年量產。
- 十二吋晶圓40奈米絕緣層上覆矽（40nm Silicon On Insulator, N40SOI）技術提供領先業界的競爭優勢，並於民國一百一十四年邁入第四年量產。
- 80奈米高壓技術應用於擴增實境／虛擬實境（Augmented Reality, AR/Virtual Reality, VR）裝置中微型矽基板有機發光二極體顯示器（micro-OLED-on-Silicon backplanes display），於民國一百一十四年進入第五年量產。它提供每英吋超過3,000畫素的超高像素密度，提升近眼應用的視覺品質。
- 先進40奈米雙載子–互補式金屬氧化半導體–擴散金屬氧化半導體第二代（Bipolar-CMOS-DMOS, BCD G2）技術之PDK已於民國一百一十四年準備就緒。
- 具有競爭力的90奈米BCD技術已接獲多個客戶產品的投片並於民國一百一十四年邁入第二年量產。此一技術係繼0.18微米BCD技術之後的下一世代技術平台，針對高數位內容產品，例如充電晶片（Charger ICs）、音訊放大器晶片（Audio Amplifier ICs）。另外，針對伺服器應用所做的元件持續優化（Continuous Improvement Plan, CIP）亦在進行中，預期PDK將會在民國一百一十五年準備就緒。
- 0.13微米BCD技術持續優化，此一技術係針對消費性電子產品（Digital Consumer Electronics, DCE）和車用市場，其PDK已於民國一百一十三年準備就緒。
- 台積公司已將0.18微米BCD Gen-2技術擴展到100伏來支援48伏供電系統在人工智慧伺服器和電動車的諸多應用，其PDK已於民國一百一十四年準備就緒。此外，0.18微米BCD Gen-3滿足車規應用的嵌入式非揮發性記憶體（Embedded Non-Volatile Memory, eNVM）方案，預計於民國一百一十五年完成驗證。

- 互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）技術持續精進，進一步強化客戶先進影像感測器產品效能。民國一百一十四年，台積公司協助客戶量產先進高動態範圍的產品進入智慧型手機及車用市場。
- 針對矽光子（Silicon Photonics）技術，台積公司所開發創新的COUPE（Compact Universal Photonics Engine）三維立體光子堆疊技術，能夠整合矽光子晶片與電路控制晶片（Electrical Control Chip）成為單晶片的光學引擎。此光學引擎能夠與高速運算晶片共構封裝，提供低耗能與高速資料傳輸，於民國一百一十四年已與多家客戶實現每秒200吉位元(Gigabits Per Second, Gbps)，此外，台積公司也在開發整合共構封裝光學引擎（Co-Packaged Optics, CPO）解決方案，以降低資料中心資料交換的能源消耗，預計在民國一百一十五年邁入量產。

TSMC 3DFabric®－台積公司先進三維矽堆疊（3D Silicon Stacking）及封裝解決方案

- TSMC-SoIC®（系統整合晶片）晶片對晶圓（Chip-on-Wafer, CoW）3D垂直整合解決方案，為高效能計算產品提供高密度互連佈線的小晶片架構。3奈米晶片堆疊技術於民國一百一十四年成功邁入量產。
- TSMC-COUPE™（緊湊型通用光子引擎）利用TSMC-SoIC®晶片對晶圓堆疊解決方案整合矽光子與電路控制晶片，用於高速與低功耗數據傳輸產品，開發進度符合計劃，預計於民國一百一十五年進入量產。
- CoWoS®先進封裝服務整合多個系統單晶片（System-on-Chip, SoC）以及高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory, HBM），以提升高效能計算產品的卓越計算能力和記憶體頻寬。其中CoWoS®-S（CoWoS® with Silicon interposer）具備高密度的互連佈線以及嵌入式深溝槽電容（Embedded Deep Trench Capacitor, eDTC），已量產多年。
- CoWoS®-R（CoWoS® with Redistribution Layer Interposer）先進封裝服務，提供多層線路重佈層（Redistribution Layer, RDL），能夠簡化產品設計，支援較大尺寸的高性能計算產品。此一技術於民國一百一十四年邁入第三年量產。
- CoWoS®-L先進封裝服務結合線路重佈層（RDL）和高密度嵌入式局部矽基互連（Local Silicon Interconnect, LSI）、嵌入式深溝槽電容（eDTC），以及能夠整合各種嵌入式晶片的優勢協助高效能產品擴展至更大尺寸。此一技術於民國一百一十四年邁入第二年量產，且亦已被多個採用較大光罩尺寸基板技術的產品採用，預計於民國一百一十五年進入量產。
- TSMC-SoW™系統級晶圓解決方案實現了晶圓級異質整合，使下一世代數據中心的運算晶片具備更高的能源效率、更高的頻寬和更高的晶片密度。第一代（僅整合邏輯晶片）產品在民國一百一十四年邁入第二年量產。第二代將整合邏輯和高頻寬記憶體，開發進度符合計劃。
- 針對先進智慧型手機應用的整合型扇出層疊封裝（Integrated Fan-Out Package-on-Package, InFO-PoP）技術能夠整合系統單晶片與動態隨機存取記憶體，採用背面線路重佈層的產品於民國一百一十四年進入量產。
- 應用於2奈米晶圓覆晶封裝的細小間距陣列銅凸塊（Cu Bump）技術成功於民國一百一十四年進入量產。

5.1.2 客戶產品用途

民國一百一十四年，台積公司為534個客戶生產1萬2,682種不同的產品，應用範圍涵蓋廣泛的電子應用，包括人工智慧和高效能運算伺服器、有線與無線通訊系統產品、汽車與工業用設備、個人電腦與其周邊產品、資訊應用產品，以及包括數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子、智慧物聯網及穿戴式裝置，與其他許多應用。

終端電子產品的快速演進，將促使客戶採用台積公司創新的技術與服務以追求差異化，同時也會更促進台積公司自身的技術發展。台積公司始終深信成功將屬於產業趨勢的領導者而非追隨者。

5.2 技術領導地位

5.2.1 研發團隊之組織與投資

半導體產業的特點是技術變革迅速，經常引入新技術以滿足客戶的需要。台積公司認為，為了在專業積體電路製造服務領域中保持對競爭對手的領先地位，公司必須在整個半導體行業中繼續技術領先。

民國一百一十四年，台積公司持續投資研究與開發，全年研發總支出占營收之6.5%，此一研發投資規模相當於或超越了許多其他高科技領導公司的規模。

公司持續在研發方面投入大量資金，以保持在先進製程技術開發中的領先地位。這些努力使客戶能夠比競爭對手和許多整合元件製造商更早的使用先進製程技術，例如用於量產的7奈米、5奈米和3奈米技術。此外，公司預計將製程技術進一步推進到2奈米及以下，以維持其技術領導地位。

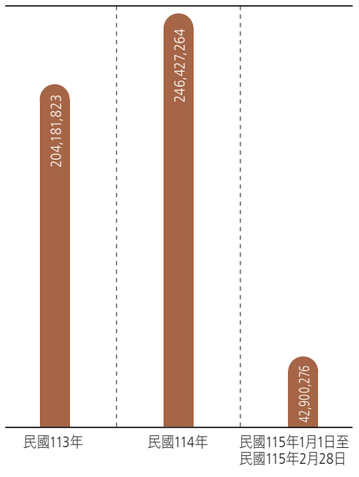
民國一百一十四年，隨著2奈米技術發展從基礎製程制定階段進展到良率提升階段，台積公司在16埃（A16）及14埃（A14）技術開發方面取得了良好進展，得以進一步改善速度、功耗、密度及成本。此外，台積公司繼續推進A14以下技術的探索性研究。台積公司並將繼續投資成熟技術的研發，為客戶提供功能豐富的製程能力。

台積公司的研發工作分為中央的研發活動和各個晶圓廠進行的活動。中央的研發活動主要致力於開發新的邏輯、SoC、衍生產品和封裝／系統級封裝（SIP）技術，以及具有成本效益的3D晶圓級系統整合解決方案，包括TSMC-SoIC®、CoWoS®、TSMC-SoW™以及TSMC COUPE™等。晶圓廠層面的研發活動主要集中在升級製程製造技術上。

台積公司長期以來與多家世界級研究機構保持者緊密的合作關係，包括美國的Semiconductor Research Corporation（SRC）及比利時的Interuniversity Microelectronics Centre（IMEC）。公司亦持續擴大與全球頂尖大學的研究合作，達到半導體技術進步和培育未來人才的兩大目標。

研發支出

金額：新台幣仟元



5.2.2 民國一百一十四年研究發展成果

研究發展組織卓越成果

- **2奈米製程技術**

民國一百一十四年，台積公司2奈米研發著重於基礎製程優化、良率精進、電晶體及導線R/C效能改善以及可靠性驗證。本年度內，客戶完成矽智財（Silicon intellectual property, IP）設計與可靠性驗證，以及持續驗證客戶新產品設計定案。台積公司並且發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米家族製程技術效能提升。

- **16埃製程技術**

民國一百一十四年，為提高邏輯密度與功耗效能，更有效地支援高效能運算裝置，A16平台製程技術的開發得到明顯的進展。建構在2奈米製程技術以及設計法則，在相同的設計尺寸下，A16平台製程技術加入晶背供電網路，將提供優越的速度、功耗，以及密度的改善。

- **14埃製程技術**

台積公司在民國一百一十四年，持續全面開發A14平台製程技術，並取得了重大進展。A14平台製程技術在速度、功耗、密度和成本方面，較2奈米平台製程技術有顯著提升。開發活動主要集中在基礎製程制定、良率提升、電晶體及導線R/C效能改善。民國一百一十五年，台積公司將持續進行A14平台製程技術的全面開發。

- **微影技術**

民國一百一十四年，台積公司在微影技術發展上持續投入。本年度重點包括支援2奈米技術的試產與量產，確保製程穩定推進。同時展開A16製程技術的開發與試產準備，並持續進行A14及更先進技術的開發。微影研發團隊致力於提升製程良率與效能，精進極紫外光（EUV）曝光機的應用效率，改善製程堆疊誤差，降低材料缺陷，並開發及應用新的光罩保護膜與基材。公司亦已啟動高數值孔徑極紫外光曝光機的微影技術開發，以支持台積公司在先進製程關鍵技術領域的持續演進。

- **光罩技術**

民國一百一十四年，台積公司研發組織在14埃米及未來更先進製程需求下，持續精進極紫外光光罩技術。透過優化EUV光罩薄板吸收層材料組成、提升多重電子束光

罩曝光機解析度、完善製程條件，實現曲線圖案在極小線寬下的均勻度控制、製作可靠度、以及光罩層疊精準度。同時持續開發先進電子束檢測機台及新材料修復技術，有效減少光罩缺陷，以進一步提升晶圓良率及產能。在未來先進製程領域，台積公司將持續投入新EUV光罩材料開發與製程技術創新。

導線與封裝技術整合

台積公司將晶圓級晶片到晶片製程之細間距連接技術命名為3DFabric®，其中包括晶圓級前段和後段技術。台積公司的前段技術TSMC-SoIC®（系統整合晶片）支持先進矽技術的3D晶片堆疊。台積公司先進的後段技術，包括將晶片嵌入預製的線路重佈層（RDL）上的CoWoS®以及實現晶圓級異質整合的TSMC-SoW™系統級晶圓技術。台積公司的3DFabric®通過整合晶圓級前段和後段技術，在產品設計方面提供了極大的靈活性，以滿足未來計算系統整合及擴充的需求。

●三維積體電路（3DIC）與系統整合晶片（TSMC-SoIC®）

TSMC-SoIC®是一個創新的晶圓級前段3DIC晶片堆疊平台，具有出色的鍵合密度、互連頻寬、電源效率和良好的堆疊靈活性。它透過系統級的微縮，實現了摩爾定律的延伸，帶來了可持續的性能提升和相應的成本效益。SoIC整合晶片隨後可透過傳統封裝或台積公司嶄新的3DFabric®技術（如CoWoS®或TSMC-SoW™）進行組裝，應用於下一代HPC、人工智慧（AI）和行動應用。SoIC系列將推出多個演進版本以釋放更多創新，包括支援先進SoC（N2及更高製程）相容性的SoIC Gen-2製程，以及實現矽光子解決方案的緊湊通用光子引擎（COUPE）。台積公司將繼續追求SoIC的技術改進，並與公司的先進矽技術共同優化，以進一步提升電晶體密度、系統PPA（功耗、性能和面積）和成本。

●CoWoS®

作為領先的2.5D先進封裝技術，CoWoS®自民國一百一十二年以來因AI需求激增，正經歷著強勁的成長。3.5倍光罩尺寸的CoWoS®-L已於民國一百一十三年投入生產，而5.5倍光罩尺寸的CoWoS®-L也即將完成驗證，以滿足更高的封裝性能目標。9.5倍光罩尺寸CoWoS®-L的進一步演進開發也進展順利。同時，用於超高端網路交換器的CoWoS®共同封裝光學器件（CPO）正在開發中，它將基於中介層的CoW模組和基於COUPE的光學I/O整合到一個封裝中，以實現更高的數據頻寬並降低系統功耗。

●TSMC-SoW™

系統級晶圓技術為資料中心的運算晶片提供了晶圓級異質整合，從而提高了功率效率、增加頻寬及提高晶片密度。第一代產品專注於邏輯，已於民國一百一十三年開始量產。第二代產品目前正在開發中，並將邏輯與高頻寬記憶體（HBM）整合。

●先進導線技術

台積公司正開發最先進的後段製程互連技術，以滿足晶片對於更快速度與更低功耗的需求。民國一百一十四年，公司開發了新穎的圖案化方法與互連結構，以強化晶片效能。此外，在新材料開發方面也取得重大進展，成功降低導線電阻與電容。這些創新有助於我們的客戶提供更具吸引力與競爭力的產品。

技術研究

台積公司的技術研究在低維電晶體領域持續保持領先，不斷創新元件和材料，以實現極限微縮邏輯電晶體更高的性能和更低的功耗。在民國一百一十四年超大型積體電路技術與電路研討會（Symposium on VLSI Technology and Circuits, Symp. VLSI）上，台積公司展示了碳奈米管（CNT）奈米片P-型場效電晶體（PFET），在-0.5V V_{DS}下，展現了創紀錄的性能（I_{MAX}=0.9 mA/μm）和極低的漏電（I_{MIN}=20 pA/μm）。在民國一百一十四年的國際電子元件會議（IEDM），台積公司展示了二維過渡金屬硫屬化合物（TMD）通道電晶體的重大進展。這項研究聚焦於三個關鍵領域：提升奈米片（NS）通道機械強度的製程整合、利用原子層沉積（ALD）磊晶接觸金屬和磷摻雜的創新接觸工程，以及優化的介電材料。這些共同的努力使載子遷移率提升了1.6倍。

台積公司也持續研究用於人工智慧及高效能運算（HPC）應用之新興高密度、非揮發性記憶體。在民國一百一十四年的IEDM，台積公司展示了一種新型C型自旋軌道轉矩磁阻式隨機存取記憶體（SOT-MRAM），其首次採用了內建磁各向異性（Magnetic Anisotropy, MA）的圓形磁穿隧接面（Magnetic Tunnel Junction, MTJ）。此C型SOT-MRAM在無磁場的條件下運行，同時保持強大的資料保存能力及卓越的性能。此外，C型元件的單元尺寸縮小了48%，切換電流降低了25%，為需要兼具成本效益與高效能的非揮發性記憶體的新興應用提供了一個極具吸引力的解決方案。

由於功率密度更高及散熱能力較差，晶片內部的散熱已成為CMOS技術三維整合的關鍵問題。在民國一百一十四年的IEDM，台積公司展示了氮化鋁（AlN）薄膜作為一種極具潛力且可擴展的三維積體電路散熱材料。小於500奈米厚的複晶氮化鋁薄膜實現了極高的垂直及水平熱導率，分別達到100 $Wm^{-1}K^{-1}$及30 $Wm^{-1}K^{-1}$。

台積公司持續推動AI及HPC應用硬體加速器的尖端發展。在民國一百一十四年三月的《自然》（Nature）期刊文章中，台積公司發表了一款混合精度、異質電阻式隨機存取記憶體（RRAM）及靜態隨機存取記憶體（SRAM）記憶體內運算（CIM）人工智慧邊緣處理器。這項研究展示了在極小精度損失下，達到領先業界的運算能源效率。此外，在民國一百一十四年的國際固態電路會議（International Solid-State Circuits Conference, ISSCC）會議上，台積公司也發表了一款16奈米MX微縮放（Microscaling, MX）多模式增益單元CIM巨集。此巨集是首款支援MX微縮放、整數（Integer）及浮點（Floating-Point）格式的同類產品，實現了最高的MX乘積累加運算（MX Multiply-Accumulate, MX-MAC）能源效率。

特殊製程技術

台積公司提供多樣化的新製程技術以協助客戶廣泛解決各類產品的應用：

●混合訊號／射頻

在民國一百一十四年，半導體產業格局呈現明顯的分化：尖端邏輯製程與高階高效能主力製程節點並存。2奈米和3奈米製程驅動旗艦智慧型手機SoC與最新的AI加速器，而4奈米和6奈米製程節點則鞏固了其作為無線、網路、物聯網和高效能運算（HPC）互連關鍵基礎的地位。邊緣AI與MS/RF技術的融合正由先進的半導體節點（特別是4奈米和6奈米製程）推動，以實現高效能和超低功耗。台積公司的MS/RF技術是基於經過產品驗證的邏輯製程平台，並提供全面的SPICE模型和PDK支援。4奈米和6奈米射頻技術將為邊緣AI應用提供高速無線連接。台積公司已開發新型4奈米低閃爍噪音元件，旨在滿足嚴苛的信噪比（SNR）指標要求。16奈米射頻技術正針對毫米波汽車雷達應用進行最佳化。台積公司將持續改進我們的MS和RF技術產品，以協助客戶創新並加速產品成功。。

●電源IC／雙極-互補式金屬氧化半導體-雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）

由於邊緣人工智慧（Edge AI）運算的普及，對行動裝置電源管理晶片（PMIC）的需求日益嚴苛，不僅要求更高的功率密度、卓越的能效比，更追求極致的微型化。台積公司深刻洞察此市場趨勢，已成功開發並推出兩代領先業界的BCD技術平台。民國一百一十四年，台積公司發布了基於55奈米BCD技術的新5伏製程設計套件（Process Design Kit, PDK），為客戶在高性能、小尺寸PMIC設計上提供強力支援。第二代40奈米超低功耗（ULP）BCD製程已於今年導入量產，同時，將操作電壓推升至45伏的開發已進入可靠度驗證階段，大幅的延伸了40奈米BCD製程應用範圍。

●微機電系統

民國一百一十四年，台積公司的壓電微機電（PizeoMEMS）平台技術，經驗證可使用於冷卻高效運算的AI相關裝置，有效降低高頻運算晶片的工作溫度。此外，完成新一代高壓電容式超音波感測器（Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer, CMUT）之可靠度驗證。未來計劃包含開發穿戴式超音波感測技術等應用。

●面板驅動

民國一百一十四年，台積公司完成了16奈米高壓技術平台可靠度認證並且通過了客戶測試晶片良率的驗證。公司將於民國一百一十五年開始進入產品良率的驗證階段。此外，為了在高壓面板驅動技術保有領先的地位，公司正在開發16奈米高效能版的高壓製程，其具備更高性能的高壓和中壓元件以及更低功率的邏輯元件，以利於客戶設計更具競爭力的OLED面板驅動IC。預計將於民國一百一十五年開始進入客戶測試晶片良率的驗證。

●互補金屬氧化物半導體影像感測器

台積公司在民國一百一十四年取得了多項成就。在行動應用方面，我們開發的3D-MiM（Gen-1）嵌入式 LOFIC（橫向溢出集合電容）像素已應用於高階智慧型手機，其動

態範圍從90dB顯著提升至110dB。此外，新開發的Gen-3 3D-MiM儲存電容器（與Gen-1相比，電容提升12倍）已通過製程驗證，預計於民國一百一十五年開始量產。在先進的小像素開發中，我們利用三片晶圓堆疊和雙背面深溝槽隔離（dual-BDTI）技術，成功展示出全球最小的0.43微米間距四光電二極體CMOS影像感測器，並在民國一百一十四年於IEDM上發表。同時，另一種針對先進畫素的低成本製程解決方案，也使用傳統的兩片晶圓堆疊與雙背面深溝槽隔離，成功開發出0.6微米間距的像素，實現1萬顆電子的全井電容，同時在60℃下保持1e-/s的極低暗電流。光偵測器開發方面，用於AI應用中光學I/O，7微米畫素間距新型崩潰式光電二極體（APD）正在開發中，此APD在極低功率消耗下，運作頻率已超過2GHz，符合業界要求。此外，Ge/Si異質結SPAD（單光子崩潰二極體）也取得了重大進展，包括暗計數率（DCR）降低了約10倍，和提升性能均勻性。這項成果也在民國一百一十四年IEDM發表。

●新興記憶體／記憶體晶圓堆疊技術

民國一百一十四年，台積公司在新興記憶體（Emerging Memory）技術領域達成數項重要的里程碑。台積公司提供電阻式隨機存取記憶體技術，作為低成本嵌入式非揮發性記憶體（Embedded Non-volatile Memory, NVM）解決方案，支援對價格敏感的物聯網市場。40奈米、28奈米和22奈米已進入量產，12奈米通過消費型規格的驗證，12奈米車規等級驗證正在進行中，6奈米也已進入開發階段。

台積公司持續致力於磁性記憶體（MRAM）技術的研發，其具有非常高速讀寫速度及高達百萬次讀寫的耐用性，並支援焊錫回焊以及極佳高溫數據保存能力，台積公司於民國一百一十四年成功完成16奈米車規等級MRAM的驗證，並已提供此產品以滿足客戶對高規格記憶體的需求。為因應市場發展，台積公司同步推進12奈米車規等級MRAM及5奈米高讀寫速度MRAM的研發，致力支援未來客戶於車用電子、消費電子、資料中心與通訊設備、工業應用及邊緣式AI等多元領域的應用需求。

民國一百一十四年，台積公司持續發展晶圓堆疊技術，開發邏輯晶圓和動態隨機存取記憶體異質製程平台，發展55奈米、6奈米、3奈米邏輯晶圓與單晶圓記憶體堆疊製程技術，55奈米已最先量產並維持穩定的良率。台積公司並將推演至先進邏輯晶圓（6奈米、3奈米）與多晶圓記憶體鍵結堆疊，以達成更快速的運算能力與更高的記憶體頻寬，晶圓堆疊技術適用於AI晶片與資料中心的需求，也應用於手機晶片與挖礦晶片的相關產品。此新型記憶體架構也相容於先進封裝技術，能滿足寬廣的產品應用與縮短產品開發時程。

5.2.3 技術平台

台積公司提供客戶具備完整設計基礎架構的先進技術平台，以達成優化設計的效能、功耗與面積及生產週期，其中包括電子設計自動化（Electronic Design Automation, EDA）設計流程、通過矽晶片驗證的元件資料庫及矽智財，以及模擬與驗證用的設計套件，例如製程設計套件（PDK）及技術文件。

針對2奈米、3奈米、4奈米技術及TSMC A16™、3DFabric®等先進技術，台積公司提供客戶在產品不同設計階段所需的電子設計自動化工具、功能及矽智財解決方案，以滿足客戶產品的需求。為了能夠結合台積公司開放創新平台生態系統的矽智財，以協助客戶規劃新的產品設計定案，開放創新平台生態系統提供一個入口網站，這個網站連結客戶至一個由13個電子設計自動化夥伴、七個雲端（Cloud）夥伴、37個IP夥伴、29個設計中心（Design Center Alliance, DCA）夥伴及八個價值聚合（Value Chain Aggregator, VCA）設計服務夥伴解決方案提供者，以及台積公司3DFabric®聯盟，這是由23間擁有三維積體電路（3DIC）專業能力的半導體企業夥伴所組成的生態系統。

5.2.4 協助客戶開始設計

台積公司開放創新平台致力於為客戶提供必要的工具、方法和支援，確保其在晶圓廠製造的設計能成功驗證並量產。台積公司的開放創新平台為促進客戶的設計流程提供了堅實的基礎，並作為客戶創新設計理念與其在矽晶片和先進封裝技術中成功實現之間的橋樑。客戶得以透過台積公司內部開發的矽智財，結合開放創新平台夥伴提供的矽智財與電子設計自動化工具進行晶片設計。

技術檔案與製程設計套件

電子設計自動化工具的驗證是奠定矽智財和客戶設計實現的基礎。其目的在於確保功能符合台積公司製程技術要求，且驗證結果和相關資訊可在TSMC-Online上取得。相對應的技術檔案及製程設計套件，可提供客戶下載並與經認證的電子設計自動化工具配合使用。從0.5微米到A16製程，台積公司提供廣泛的製程設計套件，支援數位邏輯、混合訊號、射頻、高壓驅動器、CMOS影像感測器（CIS）以及嵌入式快閃技術等應用領域。除此之外，台積公司提供技術文件，包括設計法則檢查（Design Rule Check, DRC）、布局與電路比較（Layout Versus Schematic, LVS）、寄生元件參數萃取（RC Extraction）、自動布局與繞線（Place-and-Route）及布局編輯器（Layout Editor）以確保電子自動化工具支援其製程技術。截至民國一百一十四年，台積公司已經提供客戶超過5萬8,000個的技術文件和約4,000個製程設計套件。

元件資料庫與矽智財

矽智財是積體電路設計所需要的基本元件，台積公司和生態夥伴針對客戶不同的設計應用需求提供了不同種類的矽智財，包括了基礎矽智財、類比／混合訊號矽智財、嵌入式記憶矽智財、介面矽智財和軟智財。台積公司與其設計聯盟合作夥伴為客戶提供了豐富的可重複利用矽智財，對許多電路設計來說，這些矽智財是不可或缺的基本元件。為了支援3DIC客戶的需求，台積公司也於民國一百零八年開始提供3DIC矽智財。民國一百一十四年，台積公司擴增其元件資料庫與矽智財內容，涵蓋從0.5微米到A16製程總數約9萬3,000個，較民國一百一十三年成長12%。

設計方法與流程

參考設計流程是建立在經過驗證的電子設計自動化工具上，提供客戶健全的設計流程方法上的創新來幫助提高生產力。民國一百一十四年，台積公司透過開放創新平台的合作，發表針對行動及高效能運算平台設計應用之A16 Digital以及Custom Design參考設計流程，已準備完成供客戶採用。除了製程技術方面的進步，台積公司同時延伸了類比設計移轉中N2至A16的移轉支援，及N6RF+至N4PRF射頻設計移轉相關的參考設計流程，亦持續開發並提供3DFabric®設計解決方案，支援3D晶片堆疊和2.5D先進封裝技術，包含為降低3DIC設計的困難度而支援的IEEE P3537標準的解決方案，進而幫助客戶有效地提升他們在系統設計上的生產力。這些參考設計流程提供具有優化效能、功耗與面積（PPA）的解決方案，並進一步整合了AI和機器學習（ML）技術，在晶片設計流程的各個階段實現更快的設計創建和驗證。

5.2.5 智慧財產

長期以來，台積公司本於全方位「智權管理全體系」，以專利與營業秘密雙軌保護研發創新與營運發展，鼓勵公司創新文化，強化全面競爭優勢，落實企業永續發展願景，並由法務長每年向董事會報告智慧財產管理執行情形。

台積公司的專利管理全體系，包括專利管理策略，例如全球專利部署、前瞻發明挖掘、專利版圖擴建、專利實施運用；以及專利管理制度，例如智權分級評審、專利競賽獎勵、專利宣導教育、專利人才培訓。台積公司藉由創新專利策略、嚴謹管理制度及多元風險控管，規劃前瞻近中長程技術專利藍圖；應用專利地圖競爭情報監控分析；舉辦前瞻發明論壇挖掘核心技術創新；鎖定關鍵技術指標擴建專利家族；專利佈署申請維護全程分級管理，經由專利申請品質管理強化保護範圍，持續建構大規模且質量並重的全球專利戰略版圖；多元運用發揮專利資產實用活化價值。截至民國一百一十四年底，台積公司全球專利申請總數累計超過11萬4,000件，包括民國一百一十四年申請逾9,600件，美國專利申請數名列第二，台灣專利申請數排名第一；全球專利獲准總數累計近7萬9,000件，包括民國一百一十四年獲准逾7,700件專利，美國專利獲准數名列第二，台灣專利獲准數排名第一。此外，當年度美國專利獲准率近100%。

營業秘密管理與策略方面，台積公司在民國一百零二年起首創營業秘密註冊制度，並陸續推動多項智慧管理措施。於民國一百一十三年創立「營業秘密永續智慧管理中心」，串接共11項自行開發的系統，進行資源整合、發揮綜效。民國一百一十四年接續將「新探人才線上線下融合服務專案」由前段製程工廠擴大實施到後段先進封裝工廠，強化公司永續創新文化及競爭優勢。台積公司頒發年度金質營業秘密獎，從民國一百零二年起至民國一百一十四年底共頒發3,858件金質營業秘密獎，且總註冊案

件已累計高達65萬6,387件，展現強大的創新動能與潛力。另外於民國一百一十年起新創綠色營業秘密註冊專欄，至民國一百一十四年底為止註冊案件累計總數量共為2,416件，包括民國一百一十四年註冊的528件，展現出同仁持續對綠色營業秘密的重視。台積公司與台灣科學園區同業公會共同首度舉辦2025年營業秘密智慧管理博覽會。由營業秘密智慧管理同學會，不同產業及規模的十家會員公司包括台積公司等，設立實體展示攤位及公益分享論壇，並用實際的成功案例，現身說法建立營業秘密註冊制度及推動智慧管理的經驗與心得，當天吸引近300位科學園區廠商及其他關心營業秘密管理的同道報名參加。

台積公司於民國一百一十年十二月取得經濟部產業發展署之「台灣智慧財產管理制度（TIPS）」最高等級AAA級驗證，於民國一百一十三年再次驗證通過，效期自民國一百一十四年一月一日起至民國一百一十六年十二月三十一日。

台積公司技術與智權團隊從研發初期至量產階段全程緊密合作，積極布局建構每一世代關鍵創新之技術智權戰略版圖，涵蓋最新製程技術，確保公司在半導體產業之技術領先地位；台積公司以專利與營業秘密雙軌保護製程技術、設計方案、產銷營運，護駕公司本業持續成功，同時策略運用智權保衛反制與交互授權談判，維護公司全球營運自由。

5.2.6 大學合作計劃

近年來台積公司與台灣多所知名大學密切合作，共同執行各項產學計劃，這些合作鼓勵更多大學教授從事尖端的半導體研究，例如新的半導體元件、製程、材料及製造技術，以及支援電子應用的特殊製程技術和綠色製造等領域，同時，這些計劃提供對前述各領域有興趣的學生參與實作訓練，賦能學生，使其畢業後投入半導體產業，一展所長。

民國一百零二年起，台積公司陸續於國立陽明交通大學、國立臺灣大學、國立成功大學及國立清華大學成立聯合研發中心。過去十二年共有超過400位教授及5,200位電子、電機、物理、材料、化學、化工及機械工程領域頂尖學生加入中心。自民國一百一十一年起，台積公司更支持國立臺灣大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中山大學，以及國立中興大學設立半導體或重點科技研究學院，持續提供經費支持台灣半導體領域前瞻研究，並規劃獎學金計劃鼓勵有志投入半導體領域的同學。

為強化國內半導體人才質量，並吸引更多優秀學生加入半導體產業，台積公司於民國一百零八年與國立清華大學開辦台積公司X清華大學半導體學程，截至民國一百一十四年合作學校已擴展至國立成功大學、國立陽明交通大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立中正大學、逢甲大學、元智大學、中原大學、國立臺灣師範大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立高雄科技大學、國立高雄大學，以及國立高雄師範大學等19所學校，至今共有超過19,000位學生參與學程。

此外，台積公司亦與麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州大學柏克萊分校、新加坡國立大學、普林斯頓大學、康乃爾大學、芝加哥大學、南洋理工大學、加州大學洛杉磯分校、東京大學、加州大學聖地牙哥分校等逾30所國外頂尖大學，進行策略研究計劃，專注於創新的電晶體、導線技術、材料、元件模擬及電路設計的研究。

台積公司大學晶圓快捷專案

台積公司成立「大學晶圓快捷專案」（TSMC University Shuttle Program）之目的，係提供全球頂尖大學傑出教授使用可靠的矽製程技術以研發創新的電路設計觀念。民國一百一十四年，台積公司擴大7奈米技術的產學合作，將更多具有研究動力的教授、優秀的研究生與專業的台積公司主管集結起來，以促進先進的矽設計技術開發，實現創新與新世代半導體人才的培育，並促進產學的緊密合作。大學晶圓快捷專案提供台積公司矽製程技術，支援數位和類比／混合訊號電路、射頻設計、非揮發性記憶體，以及超低功耗設計。台積公司及大學晶圓快捷專案的參與者藉由這個專案達成雙贏的合作，讓研究生得以實現令人興奮的設計，並且在不同終端產品的應用上展現創新。

5.2.7 未來研發計劃

為了保持技術領先地位，台積公司計劃持續在研發方面進行大量投資。在台積公司的A16及A14先進CMOS邏輯技術開發推進中，公司的探索性研發工作將聚焦於A14之後的技術，三維電晶體、新型記憶體和低電阻導線等領域，這些工作旨在為未來創新技術平台的發展奠定堅實基礎。台積公司的3DFabric®先進封裝研發，正在開發子系統整合的創新，以進一步提升先進CMOS邏輯應用。公司繼續加強對新型特殊技術的關注，例如邊緣AI和智慧物聯網應用的射頻及三維智能感測器。台積公司的研究持續開發可能在未來十年及更長時間內採用的新材料、製程、元件和記憶體。公司也持續與學術界和產業聯盟的外部研究機構合作，旨在提前了解和採用對客戶而言，具有成本效益的未來技術和製造解決方案。憑藉一支高度勝任且專注的研發團隊，以及其對創新的不懈承諾，台積公司對於能夠通過為客戶提供先進且具有競爭力的半導體技術，推動未來多年的業務增長和獲利能力充滿信心。

台積公司未來主要研發計劃摘要

計劃名稱	計劃內容
2奈米邏輯技術平台應用	支援系統單晶片技術的三維CMOS製程技術平台
16埃邏輯技術平台應用	支援系統單晶片技術的三維CMOS製程技術平台
14埃及以下邏輯技術平台應用	支援系統單晶片技術的三維CMOS製程技術平台
三維積體電路	因應三維積體電路（3DIC）整合趨勢，開發更具成本效益及更具尺寸、效能優勢的解決方案
下一世代的微影技術	發展下一世代極紫外光及相關曝光技術
長期研究	特殊系統單晶片技術（包括新興記憶體、微機電、射頻、類比晶片）及未來八至十年的電晶體技術
以上計劃之研發經費約占民國一百一十五年總研發預算之89%，而總研發預算預估約占民國一百一十五年全年營收的7%。	

5.3 卓越製造

5.3.1 超大晶圓廠（GIGAFAB® Facilities）

在半導體製造產業中，台積公司持續扮演關鍵角色，並以提供穩定可靠的產能作為核心目標。目前，台積公司旗下擁有四座尖端的十二吋超大型晶圓廠，分別為晶圓十二廠、晶圓十四廠、晶圓十五廠及晶圓十八廠。截至民國一百一十四年，這四大廠區的總產能已突破1,300萬片十二吋晶圓，其提供的製程技術涵蓋0.13微米至3奈米等全世代及其半世代設計。

展望未來，台積公司持續拓展先進製程版圖。在新竹與高雄全面深化2奈米先進生產基地的同時，亦同步擴大位於嘉義與台南的先進封裝產能，並積極展開台中1.4奈米廠的建置。這些策略性布局旨在靈活應對市場需求變化，為人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術高速發展與其他應用提供所需的晶圓產能支援。

此外，為進一步強化全球服務網絡，台積公司持續擴大在美國亞利桑那州與日本熊本的海外生產基地，並於德國德勒斯登設立新的生產據點。透過這些全球布局，台積公司的全球營運將更趨成熟與穩健。

5.3.2 品質與良率精進

隨著先進製程發展，積體電路線寬持續微縮，同時多樣化產品組合亦加深製程管控上的挑戰。為追求品質卓越與製造卓越，台積公司的製程管制系統整合多項智能應用，透過智慧偵測（Intelligent Detection）、智慧診斷（Smart Diagnosis）與自主學習（Self-Learning），運用最新資訊技術，達成最嚴格的製程管制標準，進而促使台積公司在良率精進與品質管制取得卓著成效。

同時，台積公司長期深耕人工智慧（AI）相關領域，將機器學習（Machine Learning）、類神經網路（Neural Network）與電腦視覺（Computer Vision）等先進技術，廣泛應用於良率分析、製程控制、機台失效偵測、虛擬量測，以及晶圓缺陷檢測等多元生產環節，實現生產現場情境的全面優化。在此基礎上，台積公司亦積極導入生成式AI（Generative AI）技術，透過結合半導體生產專家知識，有效加速先進製程變異偵測與工程分析，進而極大化製程精準控制能力。

為持續精進與擴展，台積公司持續將前段廠區的智慧製造系統延伸至後段廠區，建立從晶圓（Wafer）到封裝（Die packaging）各生產階段的完整製程管理鏈。同時，此智慧製造體系亦已涵蓋全球廠區，以實現全方位、一致且高品質的製程管理。

5.3.3 生產與營運效能

因應人工智慧（AI）趨勢下，高效能運算（High Performance Computing）、行動裝置（Mobile）、車用電子（Automotive）與物聯網（Internet of Things）等應用所帶動的強勁高階晶片需求，台積公司在穩健擴廠的同時，亦致力於提升產能彈性調度與機台生產效率。

為支援更彈性的產能調度，台積公司不斷加速佈建自動物料搬運系統（Automated Material Handling System, AMHS），透過延伸自動搬運服務串連晶圓廠區，大幅提升生產流程的高效性與穩定度，進而顯著擴增產能。針對生產先進封裝的自動化搬運需求，台積公司亦成功開發新型AMHS晶圓搬運車，能彈性支援多種後段專用晶圓載具，確保產能順利擴充。在強化營運韌性方面，台積公司積極研發「自動化傳送之地震防震減災復歸系統」，藉由創新科技加速因地震後的復歸效率，有效應對自然災害挑戰。

為最大化機台生產效能，台積公司將AI架構整合至智慧派工系統，此舉不僅優化排程引擎，使其具備強大的平行處理能力，更成功擴展了排程處理範疇並顯著加速運算效能。透過這些創新，公司進一步鞏固並擴大了在機台生產效率方面與競爭者的領先優勢。

5.3.4 數位轉型

台積公司正深化數位轉型策略，逐步將自動化工廠進化為智能製造基地。這項轉型的核心目標，即是透過賦能員工，全面提升其專業技能與整體價值。透過虛實整合技術，致力提升人員數位協作能力，藉由智慧穿戴裝置，異地團隊得以高效協作；同時，台積公司亦積極導入機器人應用，以創新策略全面提升人員生產力。

同時，台積公司更全面推動低程式碼（Low-Code）平台應用於作業流程自動化，不僅大幅降低了系統開發的技術門檻，更使長年累積的半導體製造經驗得以快速有效地轉換為標準化系統流程。同時，公司亦深耕資訊視覺化與自主分析系統的建置，協助同仁發揮創意，自行建立客製化報表與研究工具，從而實現工作效率與品質的顯著提升。

綜觀上述，透過全球化的智慧製造體系，以及全面賦能的人員數位化能力，確保全球各廠區營運效率與製造品質的高度一致性，最終實現全球一體化製造的宏偉目標。

5.3.5 原物料暨供應鏈管理

民國一百一十四年，在各晶圓廠營運、品質管理及相關業務單位的合作下，台積公司持續與供應商合作檢視並解決如產能不足、品質缺陷與潛在供應鏈風險問題。台積公司也與供應商合作，促進先進物料的研發、製程創新、品質強化與供應鏈節能減碳，朝永續供應鏈目標邁進，共創雙贏效益。

主要原物料供應狀況

主要原物料名稱	供應商	市場狀況	採購策略
矽晶圓	A公司 B公司 C公司 D公司 E公司	供需平衡／良好	● 矽晶圓供應商必須通過台積公司嚴格的品質認證程序。 ● 台積公司向多個不同供應商購買矽晶圓，以確保量產無虞，並分散採購風險。 ● 推動矽晶圓的品質改善以維持台積公司的技術領先地位。 ● 台積公司定期檢討矽晶圓供應商的產品品質、交貨狀況、成本、永續管理及服務績效各方面表現，並將結果列為未來採購決策參考。 ● 定期稽核供應商的品管系統，以確保台積公司能持續提供高品質的產品。 ● 為了優化成本面與供給面的管理，台積公司採取多種方式與供應商合作。
製程用化學原料	F公司 G公司 H公司 I公司 J公司	供需平衡／良好	● 多數供應商在台積公司主要生產基地附近設立新營運據點，因而大幅提升供應鏈效能並降低供應風險。 ● 定期檢查供應商產品，確保其符合台積公司規格需求及供貨品質。 ● 為了有效地管理成本和供應鏈，台積公司與供應商合作採取了多種策略。 ● 台積公司鼓勵並且與化學材料供應商合作，實施創新的綠色製造精進方案。
黃光製程材料	K公司 L公司 M公司 N公司 O公司	供需平衡／良好	● 台積公司與供應商密切合作，共同開發適合台積公司製程應用及成本需求的材料。 ● 台積公司定期與供應商檢討供貨品質、交貨狀況、廠商永續經營及綠色環保計劃，共同擬定強化方案並檢視執行狀況，以確保供應鏈持續進步。
氣體	P公司 Q公司 R公司 S公司 T公司	供需平衡／良好	● 多數供應商在不同地理位置都有生產廠房，有助於台積公司降低採購風險。 ● 台積公司定期稽核供應商，以確保廠商符合台積公司標準。
研磨液、研磨墊、鑽石碟	U公司 V公司 W公司 X公司 Y公司	供需平衡／良好	● 台積公司與供應商密切合作，共同開發適合台積公司製程應用及成本需求的材料。 ● 台積公司定期與供應商檢討供貨品質、交貨狀況、廠商永續經營及綠色環保計劃，共同擬定強化方案並檢視執行狀況，以確保供應鏈持續進步。 ● 為提升供應鏈效能、降低供應風險，台積公司的多數關鍵供應商已經移廠或計劃設廠在台積公司主要生產基地附近。

最近二年度占全年度合併進貨淨額10%以上之供應商資料

單位：新台幣仟元

名稱	民國114年			民國113年		
	金額	占全年度進貨淨額比率（%）	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率（%）	與發行人之關係
甲公司	27,209,602	26%	無	18,225,314	19%	無
乙公司	20,552,324	19%	無	19,640,121	21%	無
丙公司	10,271,830	10%	無	7,158,534	7%	無
其他	47,865,229	45%	-	50,596,085	53%	-
進貨淨額	105,898,985	100%	-	95,620,054	100%	-

● **增減變動原因：**進貨金額與比例變動主要係因客戶產品需求變動所致。

5.3.6 品質暨可靠性

台積公司致力於提供卓越的半導體製造服務給全球客戶。為達到客戶滿意的目標，台積公司竭力於各方面提供優異品質，塑造精益求精，不斷改善的企業文化。台積公司採取各種遏制及預防措施，以避免客戶受到產品缺陷的影響。

在技術發展階段，品質暨可靠性組織即協助客戶將優越的產品可靠性的需求導入設計中。民國一百一十四年，品質暨可靠性組織與研發組織在先進邏輯製程技術、特殊製程技術及先進封裝技術的開發及品質認證持續進行合作，以確保元件特性、製程良率與產品可靠性均能達到對客戶的承諾。

針對先進邏輯製程技術，繼N3及其性能強化版N3P鰭式場效電晶體技術成功量產之後，品質暨可靠性組織亦成功完成第一代奈米片（Nanosheet）之N2製程技術和產品品質及可靠性認證作業。在特殊製程技術領域，品質暨可靠性組

織成功完成第一個使用16奈米鰭式場效電晶體的高壓顯示驅動積體電路（DDIC）製程與產品的可靠性認證的關鍵里程碑，並完成12奈米嵌入電阻式隨機存取記憶體（RRAM）消費型規格與16奈米磁性隨機存取記憶體（MRAM）第一級車用電子技術驗證。針對先進封裝技術，台積公司整合前段晶圓製程與後段晶片封裝，提供先進封裝解決方案，開發重點從原本的矽中介層技術轉移到多個局部矽互連（LSI）的重構中介層。民國一百一十四年，品質暨可靠性組織完成認證CoWoS®先進封裝解決方案在5.5倍光罩尺寸中介層的認證並計劃於民國一百一十五年導入量產，以滿足人工智慧與高效能運算的更高性能目標。在整合型扇出層疊封裝技術（InFO_PoP）方面，台積公司持續領先業界進行N3P相關晶片量產，實現更高效率與更低功耗，以支援行動應用的需求。

為了持續降低產品缺陷、精進製程控制、及早發現異常，以及避免品質事件的影響，品質暨可靠性組織與其他營運組織共同合作，應用先進的人工智慧技術輔助統計手法持續優化品質工具，精進晶圓廠的即時防禦系統。品質暨可靠性組織亦與晶圓廠共同合作，強化並延伸了車用產品的設計法則應用，並將車用品質系統進化至2.0版，其中包含了加嚴晶圓廠的線上及電性測試的製程能力要求，以及異常晶圓的處理。為了滿足汽車產品客戶的低百萬分之不良數（Defect Parts Per Million, DPPM）要求，品質暨可靠性組織也提供專用的資源，進行客戶退貨分析及即時的物性故障分析（Physical Failure Analysis, PFA）以便進行製程改善。

品質暨可靠性組織積極推進多項數位轉型任務，涵蓋實驗室機台及分析自動化、缺陷自動偵測與分類、智能統計製程管制及量測等領域，透過先進數位科技與平台的整合運用，實現台積公司數位轉型的目標，尤其在公司持續擴廠的同時，藉由數位轉型方案的推動，有效應對人才需求的挑戰。展望民國一百一十五年，品質暨可靠性組織將繼續推動自動化工作流程及人工智慧技術的應用，以追求品質與效率的卓越表現，進一步鞏固台積公司的整體競爭力。

品質暨可靠性組織的供應鏈管理策略聚焦於「品質卓越」、「責任供應鏈」、「綠色製造」與「永續經營」四大核心領域。在專業技術的基礎上，運用最佳標準化方法持續協助供應商優化改善，同時設立了先進的化學分析實驗室，專責監控原物料品質，並積極支援研發團隊在尖端材料領域實現技術突破。

民國一百一十四年，品質暨可靠性組織在供應鏈管理策略中更加強調「共好」理念。除了對供應商進行品質稽核外，還與智能工程中心、奈米材料中心、資材供應鏈管理、廠務等單位及技術委員會緊密合作，選定重點扶植的供應商，展開了駐廠輔導計劃。不同於傳統的稽核督導方式，台積公司的各領域專家深入供應商生產工廠，針對主管及一線作業人員進行統計製程管制的實作與演練，協助建立重要製程即時監控系統，並提供產線自動化設計與投資策略的資源支持與意見交流。展望民國一百一十五年，品質暨可靠性組織將持續深化此管理策略，逐步提升供應鏈的品質管理能力，推動其數位轉型，進一步促進供應鏈的持續改善與在地競爭力。

為提升員工解決問題的能力及發展相關的品質系統及方法，台積公司全面推行持續改善活動，舉辦全公司性的競賽及訓練課程。為鞏固台積公司良好的品質文化，自民國一百一十一年起，品質暨可靠性組織於新進員工訓練中開辦品質文化課程，幫助新進員工建立正確品質價值觀，有助於加速融入與適應職務。除了公司內部跨組織的學習交流外，台積公司亦透過參與「台灣持續改善競賽」，期望能以台積公司的經驗分享，促進其他在地產業的發展與進步。民國一百一十四年，台積公司在「台灣持續改善競賽」共獲得了五個金塔獎、三個銀塔獎及四個最佳改善創新獎的傑出成績。同時，品質暨可靠性組織鼓勵在地原物料供應商參加「台灣持續改善競賽」，以提升供應商的品質文化。民國一百一十四年，在地原物料供應商於「台灣持續改善競賽」共獲得三個金塔獎、二個銀塔獎、五個銅塔獎及二個最佳改善創新獎的傑出成績。

藉由技術發展的品質認證、半導體製造服務的即時防禦系統與創新方法應用，以及持續改善的品質文化，民國一百一十四年，台積公司未發生任何因安全疑慮而導致產品被客戶召回的情況。同時，台積公司品質管理系統通過第三者稽核認證，符合汽車產業品質標準IATF 16949: 2016及國際電工協會電子零件品質認證制度IECQ QC 080000: 2017的要求。民國一百一十四年，台積公司的後段封裝測試廠區也持續通過了美國國家標準協會ANSI/ESD S20.20靜電放電防護標準的認證。定期的客戶回饋也指出，台積公司所出貨的產品持續符合或超越客戶對品質及可靠性的要求。台積公司以優良且可靠的產品品質，協助客戶在高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子及消費性電子產品等主要成長市場上搶得先機，並強化競爭力。

5.4 客戶信任

5.4.1 客戶

台積公司的客戶遍布全球且產品種類眾多，包括無晶圓廠設計公司、系統公司和整合元件製造商，在半導體產業的各個領域中表現傑出。

客戶服務

台積公司致力於為客戶提供最優質的服務，深信卓越的客戶服務是提高客戶滿意度、穩固現有客戶和吸引新客戶的關鍵基石。為此，台積公司成立了一支全力以赴的客戶服務團隊擔任主要聯繫窗口，促進與客戶在產品設計、光罩製作、晶圓製造和3DFabric®先進矽堆疊與封裝解決方案等範疇的無縫溝通和協調，確保在每一步都提供世界級的服務。台積公司通過不斷提高客戶滿意度，贏得客戶信任，進而維持公司營收及獲利，同時鞏固其作為可信賴的合作夥伴。

為了促進與客戶的即時互動，台積公司的「TSMC-Online」服務系統提供積極主動的設計、工程及後勤協作服務，讓客戶可以一天24小時、一星期七天隨時掌握重要訊息。其中，TSMC-Online的設計協作著重於資料的可用性及可取得性，可提供客戶在每一設計階段完整、準確及最新的資訊；工程協作可提供客戶晶圓及3DFabric®先進封裝解決方案，包括製程、良率、電性測試分析及品質暨可靠度的相關資訊；後勤協作則包含晶圓製造、先進封裝、測試及運送相關的資訊。此外，客戶還可以透過TSMC-Online生成客製化報表，以滿足其系統自動化的需求。

客戶滿意度

台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查（Annual Customer Satisfaction Survey, ACSS），以確保客戶滿意度及需求得到充分的瞭解。此滿意度調查係由中立的第三方顧問公司針對台積公司大部分的現有客戶，透過網路調查或訪談來進行。此外，台積公司的客戶服務團隊每季亦對客戶進行商業及技術評核會議（Quarterly Business/Technical Review, QBR/QTR），讓客戶可以定期將意見回饋給台積公司。針對客戶的意見，台積公司會定期檢視、分析並提出適當的改善計劃，形成一個完整的客戶滿意度處理程序。透過問卷、客戶意見的檢視，台積公司更能與客戶保持密切聯繫，提供更好的服務並提升合作品質。

客戶資訊保護

在客戶資訊保護方面，台積公司遵循相關的法規及國際標準，並已通過ISO 27001國際資訊安全管理認證。除此之外，台積公司也建立了相關的資訊保護政策及標準程序以確保唯有被授權的相關人員能夠存取特定客戶的工程及生產資訊。

最近二年度占全年度合併營業收入淨額10%以上之客戶資料

單位：新台幣仟元

名稱	民國114年			民國113年		
	金額	占全年度營業收入淨額比率（%）	與發行人之關係	金額	占全年度營業收入淨額比率（%）	與發行人之關係
甲客戶	726,974,278	19%	無	352,271,213	12%	無
乙客戶	645,178,671	17%	無	624,345,477	22%	無
其他	2,436,901,323	64%	-	1,917,691,009	66%	-
營業收入淨額	3,809,054,272	100%	-	2,894,307,699	100%	-

● **增減變動原因：**銷貨金額與比例變動主要係客戶產品需求變動所致。

5.4.2 開放創新平台（Open Innovation Platform®）

「開放創新平台」是台積大同盟重要的一部分。在台積公司，透過「開放創新平台」與外部夥伴的密切合作，實現創新的核心價值。經由「從外到裡」與外部合作夥伴積極協作，整合傳統「從裡到外」的模式，進而加速全面創新。

台積公司的「開放創新平台」是一個全面完整的設計技術架構，涵蓋所有關鍵性的積體電路設計範疇，有效降低設計時可能遇到的種種障礙，改善設計時程及提高首次投片即成功的機會。透過使用台積公司的製程技術和「開放創新平台」合作夥伴的解決方案，促進了半導體產業能快速採用尖端創新的技術解決方案。

台積公司的「開放創新平台」主要建構了一組生態系統介面，藉由台積公司所開發、支援的合作平台，給供應鏈帶來全方位的創新。台積公司主動、精確及品質優先（Active Accuracy Assurance, AAA）的績效是「開放創新平台」成功的關鍵，為生態系統介面及合作平台提供了精確及品質上的保證。

台積公司的開放創新模式（Open Innovation® model）彙集客戶與夥伴的創新思維，秉持縮短設計時間、降低量產時程、加速產品上市時間，最終是加快獲利時程的共同目標，此模式有以下特色：

- 電子設計自動化聯盟成立於民國一百年，擁有積體電路製造服務領域最早且最全面完整的電子設計自動化（EDA）驗證流程。此流程涵蓋了先進積體電路和封裝開發的各個階段，為創新方法提供設計參考流程，並及時提供新製程所需的設計工具套件。
- 矽智財聯盟於民國九十七年開放創新平台啟動時成立，提供積體電路製造服務領域最全面且穩健的矽驗證智慧財產權（IP）和元件資料庫。IP品質評估透過TSMC9000計劃以及資料庫品質與管理計劃進行。
- 雲端聯盟於民國一百零七年成立，透過提供在雲端實現半導體設計的架構，提高了設計工作的可擴展性、機動性和靈活性，加速積體電路和系統設計的上市時間，滿足了多樣化的客戶需求。針對市場領先的雲端服務供應商（CSP）基礎架構亦同步提供雲端EDA的認證。
- 設計中心聯盟和價值鏈聯盟也於民國九十七年隨開放創新平台啟動時一同成立，提供全方位的設計服務。它們支援客戶在半導體設計不同的階段和整個價值鏈中對設計資源和專業能力的需求，滿足客戶多樣化的專案範圍和要求。
- 台積公司3DFabric®聯盟是民國一百一十一年最新成立的聯盟，涵蓋了EDA、IP、測試、DCA/VCA、記憶體、基板和半導體專業封測代工（OSAT）等領域的合作夥伴。其使命是推動3DIC生態系統的創新和發展，透過3D堆疊和先進封裝整合多個晶片／小晶片，以協助客戶實現系統級設計。
- 台積公司開放創新平台聯盟包含了13家電子設計自動化夥伴、七家雲端夥伴、37家矽智財夥伴、29家設計中心聯盟（DCA）夥伴、八家價值鏈聚合（VCA）設計服務的夥伴以及23家台積公司3DFabric®聯盟夥伴。
- 為了有效率的生產力，台積公司的開放創新平台合作夥伴管理入口網站，有助於促進與生態系統夥伴之間的溝通。這個入口網站有高度直觀性使用的介面，並可於TSMC-Online直接連結進入。

台積公司和這些夥伴們在一開始設計時便主動積極地展開及早、深入的合作，以克服在先進製程中日益複雜的設計挑戰。經由這種更及早更密集的合作模式，台積公司的開放創新平台在客戶需要時，及時提供可靠的EDA工具、關鍵性的矽智財以及高品質的設計服務，以提供所需的設計基礎設施。客戶成功的關鍵在於當製程技術成熟量產時，能充分利用其優勢。這使得台積公司製程技術、開放創新平台設計解決方案與客戶產品設計之間能達到共同最佳化，亦即設計技術協同優化（DTCO）。這些設計生態系統解決方案幫助客戶抓住主要市場機會，包括高性能運算（HPC）、智慧型手機、物聯網（IoT）、汽車和數位消費性電子產品。

台積公司於民國一百一十四年在北美舉辦開放創新平台生態系統論壇，這個年度盛會展現了台積公司如何和生態夥伴們透過開放創新平台，共同在台積公司先進製程的基礎上開發設計解決方案。在會中，台積公司闡述了完整的2奈米技術家族及TSMC A16™在功耗、效能及面積上的全節點微縮趨勢，並提供高密度及高效能元件資料庫及設計解決方案，支援智慧手機和高效能運算設計應用。台積公司亦說明類比電晶體的設計解決方案已經準備完善，可以增加矽智財的良率及提升類比設計的生產力，並提供了設計解決方案以實現電子設計和設計流程自動化，從而支援類比設計移轉。同時，台積公司強調與生態系統合作夥伴擴大合作，以推動人工智慧應用，從而全面提高設計品質和生產力。

為了應對更複雜的系統級設計不斷增長的需求，台積公司與在電子設計自動化、矽智財、設計服務（DCA/VCA）、記憶體、基板和半導體專業封測（OSAT）方面擁有3DIC專業知識之台積公司3DFabric®聯盟合作夥伴，提供針對3D晶片堆疊及2.5D先進封裝的解決方案，以及符合IEEE P3537開放標準的電子自動化工具，透過使用3DFabric®先進封裝解決方案的TSMC-SoIC®、CoWoS®、TSMC-SoW™以及TSMC COUPE™等服務，輔助在系統設計上多個晶片／小晶片的整合，達到系統與製程共同最佳化。

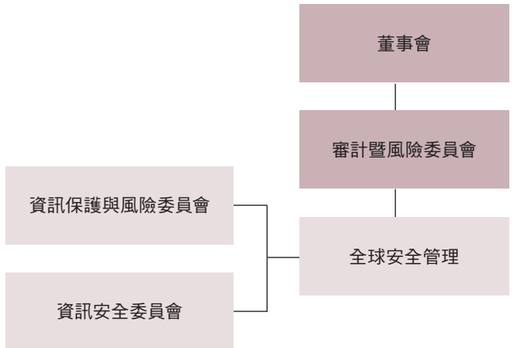
5.5 資通安全管理

5.5.1 資通安全政策與組織

台積公司致力於為其客戶、股東和合作夥伴提供資訊安全與機密資訊保護。為此，台積公司制定及實施嚴謹的資訊安全相關政策、程序和措施，並持續更新，如台積公司《資訊安全宣言》中所宣示。

台積公司於民國一百一十一年依循台灣金管會法令設置資訊安全長（Chief Information Security Officer, CISO），民國一百一十四年起，由資深副總經理暨副共同營運長侯永清擔任資訊安全長，主要職責是統籌規劃全公司資源及資訊安全政策與方針的推行與溝通。台積公司另設有專責資安單位「全球安全管理組織（Global Security Management, GSM）」，負責資訊安全的推行、規劃、監控及管理作業。為進一步強化資訊安全治理，台積公司成立資訊保護與風險委員會（PIP and Risk Committee）與資訊安全委員會（IT Security Committee），由資訊安全長擔任委員會主席、副總級主管參與委員會，定期召開會議檢視及決議重要資訊安全政策與計劃執行，並與公司資訊技術及相關單位組織協同合作，強化資訊安全防護及管理機制。全球安全管理組織主管每半年向審計暨風險委員會彙報資安風險管理、全球資安風險趨勢、公司資訊安全政策、計劃與執行成效，審計暨風險委員會主席並於董事會中報告資訊安全監管與風險控制措施執行成效。

全球安全管理組織架構



5.5.2 資通安全管理策略與資源

為達成台積公司的資安目標並維持競爭力,全球安全管理組織積極深化資訊安全、機密資訊保護機制與實體安全管理以維護台積公司的競爭力，更明訂資訊安全政策、程序與指引，持續進行管理制度強化，並執行全方位的風險管控，以達到台積公司資訊安全管理的目標。此外，全球安全管理組織定期執行資安風險評估，依據風險影響的大小、機率以及改善風險所需成本以設定優先序，採用規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）的方法，架構多層的資安防禦，並建立資訊安全關鍵績效指標。台積公司於民國一百一十四年投資總計超過新台幣10億元強化資訊安全，超過千名員工負責資訊安全相關業務，另有超過1,800名外部警勤人員負責資安檢查服務的相關工作。

5.5.3 資安事件處理與通報

台積公司已建置企業風險管理機制與資安事件處理標準程序，明訂相關流程與措施，包含資安事件通報程序、指派負責人員處理重大資通安全事件、評估遭受之損失及進一步的必要因應措施、評估資安風險可能對公司財務與營運的影響及其因應措施。民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司無重大資安事件造成的財務損失與營運影響。

5.6 人才資本

員工是台積公司最重要的資產，公司致力於提供員工有意義的工作內容、持續學習、健康安全且共融的環境，以及優質的薪酬與福利。同時，也鼓勵員工在工作之外，用心經營家庭，發展興趣，擴大社會參與，並擁有快樂人生。

5.6.1 人權政策與具體作為

台積公司深信尊重人權與打造有尊嚴的工作環境至關重要，承諾支持國際人權準則及規範，同時恪守全球各營運據點所在地法規，平等對待並尊重所有人員。台積公司人權政策適用於全體經理人及員工（受台積公司雇用從事工作獲取薪資或報酬者）、關係企業、供應商、承攬商、夥伴（客戶、社區）等利害關係人，致力杜絕任何人權侵害。

管理方針

●人權治理架構

台積公司建立以董事會為最高層級的人權治理架構，由「ESG委員會」成立跨部門的人權工作小組，包括客戶服務、企業永續、環保安全衛生、人力資源、資訊技術、企業資訊安全、資材管理、法務、營運、品質暨可靠性、研究發展等各功能組織，有系統且有效地推動人權管理作為；除定期向「ESG指導委員會」報告推動進展，同時每季由「ESG委員會」主席向董事會轄下的「提名及公司治理暨永續委員會」報告人權管理作為與執行成果。

●盡職調查

台積公司依循《經濟合作與發展組織－責任商業行為盡職調查指南（OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct）》中盡職調查流程，將負責任商業行為融入政策與管理體系、定期辨識與評估風險、推動預防／減緩措施與追蹤機制。

●教育訓練與宣導

台積公司規劃人權保障訓練課程，傳達人權概念及其重要性、可觸及的申訴管道，以及台積公司於管理、預防、補救人權侵害相關措施，建立尊重人權的意識與文化。

●申訴管道

台積公司建構完整的申訴管道與溝通架構，同時致力保護申訴者安全，若有人員發現可能侵害人權的事實，均可以匿名舉報或其他多元的溝通機制，向台積公司回饋意見或舉報疑似違規行為，啟動對應的處理程序。

●補救機制

一旦確認由台積公司所導致或促成的人權侵害事件，台積公司將基於事件型態啟動補救機制，並於必要時與相關利害關係人合作，防止事件再次發生。

●溝通與揭露

台積公司依顯著人權議題逐項鑑別受影響對象，建立堅實信任關係，並以多元、開放、雙向的溝通管道，傾聽利害關係人意見，並定期於公司ESG網站、永續報告書與人權報告書中，揭露人權管理的目標、作為、績效與進展。

民國一百一十四年中，台積公司持續利用「負責任商業聯盟」（Responsible Business Alliance, RBA）設計的標準化風險評估範本（Self-Assessment Questionnaire, SAQ），自行鑑別業務中「勞工、健康與安全、環境、道德規範」相關實質作為、風險以及管理體系。台灣各廠區SAQ自評分數皆達到80分以上的「低風險」範圍內。

台積公司積極建立同仁對商業與人權的基礎認知，並深化對《人權政策》的理解，民國一百一十四年開設「認識台積人權政策－營造零騷擾工作環境，杜絕性騷擾」線上課程，總完訓人數為8萬0,938人，期許同仁將尊重人權的價值觀融入日常決策與行動，實踐台積公司的人權承諾。

台積公司遵守法令並尊重所有員工集體協商和集會結社自由，公司不會干預、也不介入。台積公司定期舉辦晶園會議（原勞資會議），並透過多元及完善的內部溝通架構，傾聽員工的意見並即時做出適切回應，務期強化公司經營團隊與員工間的良好溝通，確保和諧的員工關係。

5.6.2 共融職場

台積公司致力推動創新，為全球最複雜的技術挑戰提供解決方案；為此，公司鼓勵所有員工，無論其背景或身分，在各層級角色中能各司其職做出貢獻。共融職場的營造呼應台積公司的核心價值和經營理念，透過積極建立開放型管理模式，公司鼓勵不同人才加入半導體產業。

呼應《台積全球共融職場宣言》，公司透過三大面向–創造共融的員工體驗、透過員工資源團體支持多元人才，以及連結外部資源與合作夥伴，實踐人才願景，營造共融的工作環境。在員工體驗旅程的每個階段檢視相關流程與政策，確保多元化人才招募管道及培育制度。民國一百一十四年台積公司持續舉辦GIW Month全球共融職場系列活動，促進同仁歸屬感與盟友支持，也拓展共融職場行動家專案至全球，鼓勵所有同仁付諸具體行動。在支持多元人才方面，除了原有員工資源團體（Employee Resource Groups, ERGs）Women@tsmc、Global Family@tsmc、Accessibility@tsmc，以及美國在地Veterans@tsmc之外，亦於總部成立Pride@tsmc，聚焦性別、性傾向、種族／國籍、身心障礙，以及美國退伍軍人身份等領域。ERGs對全體員工開放，不論是否具備相關身分，均可參與展現支持。連結外部資源方面，台積公司與國際接軌，和專業協會建立合作關係，確保對標國際最佳實踐做法。合作夥伴包括全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance, GSA）、Disability:IN等全球組織，並與Out & Equal合作推動LGBTQ+族群共融，同時深化與全球半導體聯盟GSA Talent Initiative（GTI）的合作，推動STEM領域女性領導力，號召更多企業共同參與；也透過網站改版，加深利害關係人的溝通和了解。

台積公司也為全體同仁規劃不同角色的學習架構及重點課程，支持同仁了解共融職場的內涵，協助覺察無意識偏見（Unconscious Bias），培養識別並正確應對偏見的能力，提升相關意識，亦推出跨文化學習方案，支持同仁與多元背景的同儕有效合作。

5.6.3 人力結構

截至民國一百一十四年底，台積公司之全球員工總數為9萬557人，其中包括9,582位主管人員、4萬4,690位專業人員、1萬1,368位助理人員以及2萬4,917位技術人員。另外，截至民國一百一十五年二月底止，台積公司人力結構及女性主管占比如下列二表所示：

人力結構

		民國113年底	民國114年底	民國115年2月底
工作類別	主管人員	8,737	9,582	9,744
	專業人員	40,477	44,690	45,064
	助理人員	10,207	11,368	11,451
	技術人員	24,404	24,917	25,094
總計		83,825	90,557	91,353
性別	男性（%）	66.3%	67.0%	67.0%
	女性（%）	33.7%	33.0%	33.0%
學歷	博士	3.7%	3.6%	3.6%
	碩士	48.5%	49.8%	50.0%
	學士	29.9%	29.7%	29.7%
	其他高等教育學位	7.5%	7.0%	6.9%
	高中含以下	10.5%	9.9%	9.8%
平均年齡（歲）		36.2	36.3	36.4
平均服務年資（年）		8.7	8.9	8.9

女性主管占比

	民國113年底	民國114年底	民國115年2月底
初階管理階層女性占比	15.0%	15.6%	15.6%
中階管理階層女性占比	14.0%	14.1%	14.2%
高階管理階層女性占比	11.4%	6.3%	5.7%

註：初階管理階層為第一線主管，高階管理階層為副總經理以上及總裁。

5.6.4 人才招募

台積公司的成功與成長，關鍵要素來自全體「志同道合」的員工。為強化持續成長的動能，台積公司透過公開、公平的程序積極招聘各級優秀人才。除了以「品格」與「才能」作為用人的首要條件外，更以適才適所為依據，不因國籍、種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙等因素而有差別待遇。

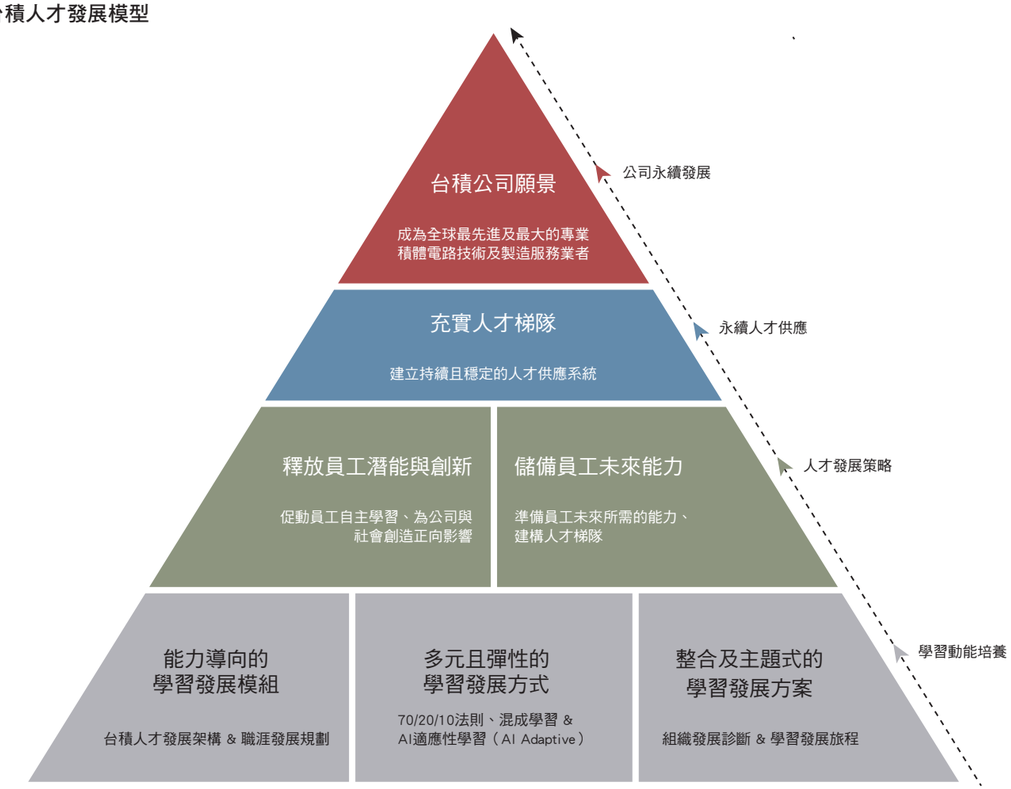
台積公司堅持核心價值，持續為了遠大的願景而努力。為配合營運持續成長伴隨而來的人員需求，台積公司致力擴展招募管道，以吸引各級優秀人才加入，民國一百一十四年在全球共聘用超過9,200名員工。

5.6.5 人才發展

台積公司深信人才是企業成長的基石，並致力實現人才願景，透過激發同仁的最佳潛能，使其在職場中充分發揮，進而建立持續且穩定的人才供應系統，確保台積公司的長期競爭力與永續發展。為實踐此一願景，台積公司以「台積人才發展模型（TSMC Talent Development Model）」為基石，擘畫兩大策略：「釋放員工潛能與創新」－促動員工自主學習，為公司與社會創造正向的影響，及「儲備員工未來能力」－準備員工未來所需的工作能力，建構人才梯隊。

依循人才發展的兩大策略，台積公司建構以能力為導向的學習發展模組，不僅重視核心特質（品格、毅力、耐壓力、自動自發、創新、判斷力、器識與多領域的知識），更結合職涯發展規劃，針對不同職務、專業及組織需求，發展同仁的領導、專業及共通能力。同時，公司提供多元且彈性的學習發展方式，透過經驗學習（占70%）、回饋與指導（占20%）、教育訓練（占10%）的70/20/10法則，並搭配混成學習與導入未來的AI適應性學習（AI Adaptive）。此外，針對日益複雜的組織生態與多元需求，台積公司預先布局人才，從組織發展診斷出發，客製不同角色、職級與組織的學習發展旅程，整合及系統性地培養員工所需能力，支持員工與公司持續成長與突破。

台積人才發展模型



民國一百一十四年，台積公司提供實體課程1萬79堂（包含面授課程與線上直播課程）、線上學習資源4萬410堂（包含內部與外部學習平台），總訓練時數逾818萬小時，共計逾357萬人次參與課程，平均每位同仁訓練時數90.4小時，總訓練費用達新台幣13億8,100萬元，平均每位同仁訓練費用達新台幣1萬,5200元，較前一年增加約23.1%（註）。

5.6.6 有競爭力的整體薪酬

台積公司每年檢核並設定人才競爭市場標竿企業，除了參考包含標竿企業之市場薪資調查報告外，也參考產業整體薪資調查資料，並收集市場相關薪資資訊後，進行薪酬競爭力分析，以制定相關薪酬策略。

台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。

每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。

秉持同樣的理念，台積公司子公司員工之薪酬，除了依據當地勞動市場狀況訂定具競爭力之薪資水準外，也參照當地法令、業界實務及各子公司之整體營運績效分別發給年度獎金，以鼓勵員工長期貢獻並與公司共同成長。

除了上述具競爭力的薪酬外，為鼓勵同仁擁有公司股票，共享公司長期成長的美好果實，台積公司於民國一百一十一年制定全球員工購股計劃，適用於本公司及本公司100%持有子公司之全體正職員工，並於民國一百一十三年將計劃範圍涵蓋主要持股海外子公司之全體正職員工。

為強化台積公司經理人其與股東利益之連結，因此，台積公司於民國一百零九年制定經理人持股規範（Corporate Officer Shareholding Guidelines），要求董事長、總裁，以及經理人之持股價值應為年度本薪的一定倍數，董事長及總裁為18倍，經理人為九倍或三倍，（三倍只適用台積公司於海外雇用之經理人），經理人應於受任命為經理人後三年內達成上述要求之持股價值目標；且經理人在受僱期間，皆須維持公司要求之持股價值。另外，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理（Environmental, Social and Governance, ESG）成果，台積公司從民國一百一十年至民國一百一十三年，每年制定限制員工權利新股發行辦法。自民國一百一十四年起，台積公司制定年度長期激勵獎金辦法並擴大績效指標範圍除原有連結股東利益ESG成果更連結公司財務指標。透過多元且明確的量化指標強化管理階層長期並持續創造公司收益、股東價值同時提高ESG目標達成績效。

5.6.7 優於法令的福利制度

台積公司提供優於法定標準的福利制度，每年除了12天國定假日外，另給予額外之紀念日休假；為緩解同仁上下班人潮支持同仁家庭照顧需求並打造共融職場，公司於民國一百一十二年起實施分流上下班並持續優化相關彈性配套；為了支持同仁用行動實踐公司「讓社會更好」的永續願景，公司自民國一百一十二年起，一年提供一天志工假；除了依法為員工加保勞工保險及全民健康保險外，並規劃團體綜合保險，除公費提供包括壽險、意外險、醫療險、癌症險、重大疾病險、生育保險金及因公出差之海外差旅險保障，也提供多樣的自費團體綜合保險，讓員工以優惠方案為其眷屬、子女及父母加保；員工於法定留職停薪期間，持續為員工付費加保公司團體綜合保險，延續相關保障；為照顧服務未滿一年新進同仁的休假需求，每服務滿二個月即給予一日特別休假；當遇有服役、重大傷病等情事需長期請假時，也可申請留職停薪，期間屆滿後再申請復職。另外，有退休金、急難補助、結婚生育禮金、喪儀補助、特約商店折扣等，使員工安居樂業。

註：為與國際市場研究資訊（Training Magazine）對準訓練費用之定義，包含訓練費用、訓練衍生相關費用及訓練人力薪資，自民國一百一十一年起，訓練人力薪資計入年度訓練費用。

因應員工人數持續成長且結構組成多元化，為提升對員工生活與家庭照護的支持，於民國一百一十三年起，台積公司於現行的福利制度之外新推出「全球彈性福利計劃（TSMC Global Flexible Benefit Plan, tFlex）」，分為「醫療與保險、家庭照顧、健康生活、個人發展與公益活動」四大類別，提供全球正職員工每人約美金250元（台灣地區員工為新台幣8,000元）等值的彈性福利點數，可自主選擇自身生涯階段所需的福利項目申請兌換金額。

台積公司依各地法令提供哺（集）乳室以支持員工持續哺（集）乳之需求。員工在育嬰期間除可依法申請留職停薪，公司亦提供完善的假勤管理制度，讓員工能夠更彈性地運用於育嬰及照護子女。民國一百一十二年起，公司推出了優化的台積寶寶茁壯計劃2.0，將第二胎的產假從12週延長至16週，第三胎則從16週延長至20週，同時也提供最高新台幣2萬元的生育補助（職工福利委員會1萬元以及生育保險金最高1萬元）。

為進一步營造家庭友善職場環境，台積公司於民國一百一十四年推出台積寶寶茁壯計劃3.0。這項全面的計劃為從孕前、懷孕、生產到幼兒（未滿1歲、2至6歲及未滿12歲）的每個階段提供相應資源。它亦提供生育教育課程與育兒諮詢服務，為員工在各個家庭階段提供全面支持。除了這些計劃，於台灣設置四所幼兒園，並提供假日STEAM（science, technology, engineering, art and math）科普營隊，陪伴員工子女成長。

為了全方位照顧員工身心健康，各廠區設置24小時健康中心，配置優於法規的職業健康專業人員（包含醫師、護理師、心理師）與特約臨場服務勞工健康醫師，並與多家合作醫院及EAP（Employee Assistance Program）服務廠商共同照護員工的身心健康。除提供所有員工每年健檢外，並為任職每滿五年的員工，提供五項進階健康檢查，進一步守護同仁的健康。

- 台積公司也積極推動員工建立運動習慣，補助成立70個社團，更規劃完善運動設施，定期舉辦各項運動賽事等，鼓勵員工透過社團活動，結合同樣興趣的愛好者。
- 為幫助員工兼顧工作與生活平衡，台積公司提供便捷的服務及設施：各廠區提供員工餐廳、便利商店等餐飲及生活服務。
- 台積公司提供全方位健康管理服務：包括廠區門診服務、健檢追蹤管理、員工協助服務方案等。
- 台積公司也提供多元員工福利方案：舉辦文康、藝文活動，社團，提供完善的運動休閒空間、廠區附設幼兒園，照顧員工托兒需求外，並有節慶禮金、急難救助等補助。

台積公司海外據點亦依據當地法令，設計符合當地的假勤與保險制度。在中國大陸、北美、歐洲地區，台積公司皆提供優於法令的休假天數；在海外據點，台積公司也提供優於法令的人身及醫療保險。

5.6.8 多元員工獎勵方案

台積公司透過各種員工獎勵方案，表彰優秀團隊與個人，並肯定員工在不同領域的卓越貢獻，鼓勵員工積極追求持續成長，精益求精，提升整體競爭力。台積公司提供的多元員工獎勵方案包括：

- 台積科技院評選：表彰個人專業技術對公司有重大貢獻之傑出成就專家。
- 台積電模範員工：表彰個人工作表現對公司有傑出貢獻之技術人員。
- 廠區自主舉辦優良事蹟及優良精進案例選拔：鼓勵同仁持續為公司創造價值。
- 年資服務獎勵：感謝資深員工對公司長期的承諾與貢獻。
- 師鐸獎：表揚傑出的公司內部講師在員工訓練課程中的貢獻。

除上述獎勵方案，各組織亦舉辦鼓勵創新的獎項活動，例如：Idea Forum、優良案例發表會及ESG Award，以表彰同仁持續發想並落實創新做法。台積公司亦積極舉薦同仁參加外界各項優秀人才選拔，其中多名優秀同仁於民國一百一十四年獲得各園區模範勞工及優秀／優良從業人員、台灣持續改善競賽、國家傑出經理獎及經濟部產業創新獎、國科會傑出科技貢獻獎等全國性獎項。

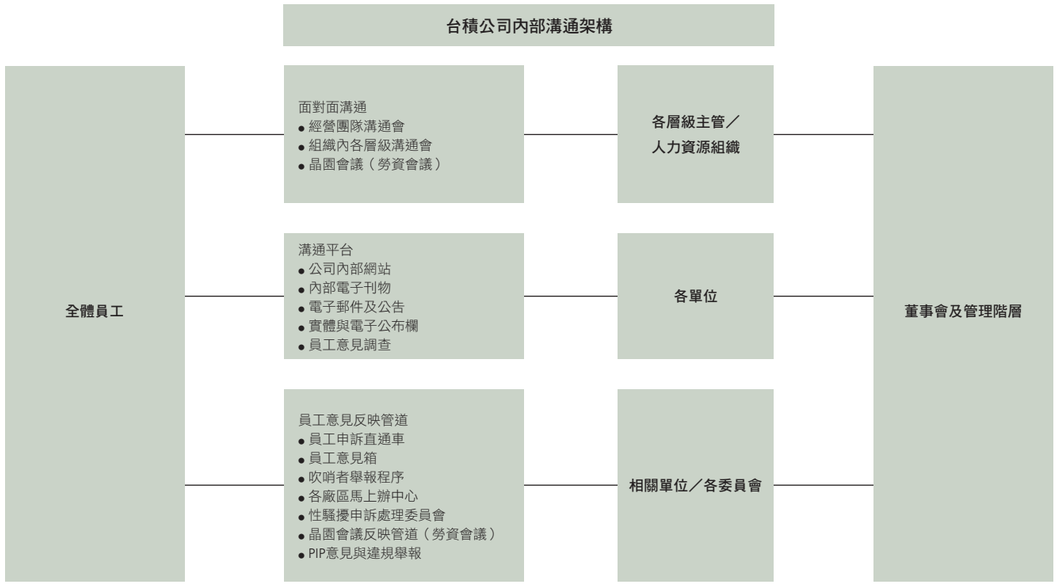
5.6.9 員工參與

台積公司致力打造具挑戰且有樂趣的工作環境，透過推動各種員工溝通、照顧、福利及獎勵機制，持續提升員工認同感及參與度。

台積公司建構的多元溝通管道，包括：

- 各組織／層級主管對同仁溝通會：舉辦如經營團隊溝通會及組織內各層級溝通會等，藉此傳遞公司重要訊息。
- 每季舉行晶園會議（勞資會議），向員工說明企業營運概況，並共同討論員工關切的議題。
- 每二年舉行「核心價值員工意見調查」，從全體同仁的角度了解全體同仁對於公司核心價值的落實程度。
- 每二年舉行「全球員工意見調查」，以了解同仁的工作體驗與敬業度。
- 依需求不定期與特定組織同仁進行組織氣候調查、員工服務滿意度調查，並針對員工意見規劃及執行改善方案。
- 公司內部網站：發布創辦人及歷任董事長談話、董事長暨總裁談話、公司重要訊息、近期活動宣傳及其他同仁感興趣的主題等內容。
- 內部電子刊物：報導公司重要活動，分享表現卓越的團隊或個人故事，藉此深化員工對公司核心價值的連結。
- 針對重大管理、財務、稽核及從業道德等各項問題，提供三項申訴管道：
  - 吹哨者（Whistleblower）舉報程序，直接通報審計暨風險委員會主席（獨立董事）；
  - 違反從業道德行為（Irregular Business Conduct）舉報系統，由總裁指派之從業道德委員會統籌；
  - 員工申訴直通車（Ombudsman）舉報系統，由總裁指派公司資深主管統籌負責。
- 員工意見箱：提供員工對於工作及工作環境問題與建議的管道。
- 各廠區「馬上辦中心」關注員工反映個人工作與生活上的相關議題，其主要服務對象為直接人員。
- 性騷擾申訴處理委員會：為提供免於性騷擾威脅的工作環境，特別提供此申訴管道；性騷擾申訴處理委員會由總裁指派人力資源、法務及其他組織等主管共三名組成。台灣亦依照法令設有調查小組包含外部專家，進行案件調查。

員工溝通管道



民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司並無因勞資糾紛而遭受損失。然而，本公司有因勞動檢查結果被裁定違反法令事項，被處以罰鍰如下：《114年4月17日竹環字第1140012798號》函裁定因正常工作時間連同延長工作時間超過規定，違反勞動基準法第32條第2項，被處以罰鍰新台幣40萬元；《114年5月8日竹環字第1140014905號》函裁定因正常工作時間連同延長工作時間超過規定，違反勞動基準法第32條第2項，被處以罰鍰新台幣45萬元；《114年9月4日竹環字第1140028822號》函裁定因正常工作時間連同延長工作時間超過規定，違反勞動基準法第32條第2項，被處以罰鍰新台幣45萬元。

本公司持續檢視工時管理作業流程及透過工時管理指標系統，提醒員工及時完成加班申請，並同時提醒主管即時有效的處理相關申請並關懷員工工時情形，以強化相關規範之溝通與宣導。

5.6.10 人才留任

民國一百一十四年台積公司再次執行「台積公司全球員工意見調查」，由台積公司及其全球子公司之全體正式員工共76,279名同仁參與，填答率高達88%。與民國一百一十二年調查結果相比，台積員工體驗的四大構面一願景一致性、工作效能、整體薪酬以及團隊領導，均取得了顯著進步。此外，台積員工對領導階層的信心、公司整體競爭力、成長機會、授權與薪酬等方面的認同超越全球高績效常模公司，這進一步鞏固了員工對公司的信任與滿意度。令人驕傲的是，「永續敬業度」方面締造歷史紀錄一首次顯著優於全球高績效企業。

展望未來，台積公司將持續以員工體驗為核心，聚焦以下三大關鍵驅動因素，攜手全體同仁積極建構更具競爭力的工作環境：

1. 透過強化主管的領導能力，建立具心理安全感的團隊文化，鼓勵員工積極提出創新想法。
2. 強化員工發展：持續開發並提供多元化、豐富的學習資源，並結合員工發展需求。
3. 積極探索更多創新且多元的鼓勵肯定措施，以提升員工參與度與滿意度，進一步促進人才穩定性。

台積公司於民國一百一十四年推出「文化精進方案2.0」，將台積核心價值深度融入員工體驗生命週期之各個關鍵階段，涵蓋徵才、招募、入職、發展與留任。為此，台積公司遴選了16位公司文化大使，並重新規劃新進同仁及新任主管的培訓課程，旨在深化員工對台積核心價值的理解與認同。

此外，截至民國一百一十四年，台積公司已在全球舉辦超過500場案例討論工作坊，民國一百一十四年尤其聚焦台積日本子公司JASM，成功舉辦了六場文化推廣工作坊，促進跨區域、跨世代對公司核心價值的共識，並建立內部文化素養，吸引及留任更多志同道合的優秀人才。未來，台積公司將持續推進並完善全球文化策略與藍圖，以期全面提升台積公司及其全球子公司同仁對企業文化的歸屬感與認同度。

民國一百一十四年，台積公司的離職率為2.9%，民國一百一十三年為3.5%，均低於10%的健康離職率範圍內。

註：係根據韋茱韜悅「高績效企業員工體驗模型（High Performance Employee Experience Model）」

5.6.11 退休制度

台積公司依台灣《勞動基準法》訂定確定福利退休計劃並設立勞工退休準備金監督委員會，並根據《勞工退休金條例》訂定確定提撥退休計劃，自民國九十四年七月一日起施行。針對海外營運所在地也依據當地勞動基準法令及勞工退休相關規範訂定員工退休辦法。前述勞工退休準備金監督委員會依法每季召開會議並執行勞工退休金相關監督事項。台積公司針對各別退休辦法依法提存退休準備金，並聘請精算顧問公司針對確定福利退休計劃進行退休金精算評估，以符合法令對於上市公司財報公開揭露的要求，同時也確保退休金足額提撥。相關提撥率及提撥金額詳見台積公司民國一百一十四年度合併財務報表44-47頁。得益於公司良好的財務狀況，能夠保障員工未來請領退休金的權益，也確保穩固的退休金提撥與給付，更進一步鼓勵員工在公司服務能有長遠的規劃和投入。

5.7 重要契約

除一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂重要契約。另本公司於財務報告亦揭露「重大或有負債及未認列之合約承諾」，請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告。

公開資訊觀測站連結：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home

CHAPTER

6

財務概況

台積公司的營收總額的大約74%是來自7奈米和更先進的製程技術

6.1 財務狀況及經營結果

6.1.1 財務狀況分析

台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國114年	民國113年	增減金額	增減比率（%）
流動資產	3,817,130,817	3,088,352,120	728,778,697	24%
長期投資（註一）	172,370,373	149,040,373	23,330,000	16%
不動產、廠房及設備	3,691,840,916	3,234,980,070	456,860,846	14%
使用權資產	43,918,910	40,128,391	3,790,519	9%
無形資產	24,952,615	26,282,520	(1,329,905)	-5%
其他資產（註二）	182,810,247	153,154,526	29,655,721	19%
資產總額	7,933,023,878	6,691,938,000	1,241,085,878	19%
流動負債	1,458,019,289	1,264,524,964	193,494,325	15%
非流動負債	1,014,209,306	1,103,837,171	(89,627,865)	-8%
負債總額	2,472,228,595	2,368,362,135	103,866,460	4%
股本	259,325,245	259,327,332	(2,087)	0%
資本公積	73,445,601	73,260,765	184,836	0%
保留盈餘	5,103,501,560	3,917,252,023	1,186,249,537	30%
其他權益	(16,676,412)	38,705,047	(55,381,459)	-143%
歸屬於母公司業主之權益	5,419,595,994	4,288,545,167	1,131,050,827	26%
權益總額	5,460,795,283	4,323,575,865	1,137,219,418	26%

註一：長期投資包含非流動之透過損益按公允價值衡量之金融資產、非流動之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、非流動之按攤銷後成本衡量之金融資產及採用權益法之投資。
註二：其他資產係包含遞延所得稅資產、存出保證金及其他非流動資產。

- **增減比例超過20%之變動分析：**

流動資產增加：主要係現金及約當現金增加所致。

保留盈餘增加：主要係本年度淨利，部分因分配盈餘而抵銷。

其他權益減少：主要係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加所致。

歸屬於母公司業主之權益增加：主要係保留盈餘增加所致。

權益總額增加：主要係歸屬於母公司業主之權益增加所致。

- **最近二年度財務狀況變動影響：**對財務狀況無顯著影響。
- **未來因應計劃：**不適用。

台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國114年	民國113年	增減金額	增減比率（%）
流動資產	1,630,955,164	1,609,565,096	21,390,068	1%
長期投資（註一）	2,493,853,020	1,759,646,229	734,206,791	42%
不動產、廠房及設備	2,991,673,431	2,537,292,611	454,380,820	18%
使用權資產	41,870,717	37,899,147	3,971,570	10%
無形資產	19,574,877	20,452,082	(877,205)	-4%
其他資產（註二）	98,287,124	72,394,135	25,892,989	36%
資產總額	7,276,214,333	6,037,249,300	1,238,965,033	21%
流動負債	1,305,953,219	1,173,346,326	132,606,893	11%
非流動負債	550,665,120	575,357,807	(24,692,687)	-4%
負債總額	1,856,618,339	1,748,704,133	107,914,206	6%
股本	259,325,245	259,327,332	(2,087)	0%
資本公積	73,445,601	73,260,765	184,836	0%
保留盈餘	5,103,501,560	3,917,252,023	1,186,249,537	30%
其他權益	(16,676,412)	38,705,047	(55,381,459)	-143%
權益總額	5,419,595,994	4,288,545,167	1,131,050,827	26%

註一：長期投資包含非流動之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及採用權益法之投資。
註二：其他資產係包含遞延所得稅資產、存出保證金及其他非流動資產。

- **增減比例超過20%之變動分析：**

長期投資增加：主要係採用權益法之投資增加所致。

其他資產增加：主要係其他非流動資產增加所致。

資產總額增加：主要係長期投資及不動產、廠房及設備增加所致。

保留盈餘增加：主要係本年度淨利，部分因分配盈餘而抵銷。

其他權益減少：主要係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加所致。

權益總額增加：主要係保留盈餘增加所致。

- **最近二年度財務狀況變動影響：**對財務狀況無顯著影響。
- **未來因應計劃：**不適用。

6.1.2 財務績效分析

台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國114年	民國113年	增減金額	增減比率（%）
營業收入淨額	3,809,054,272	2,894,307,699	914,746,573	32%
營業成本	1,527,760,293	1,269,954,135	257,806,158	20%
營業毛利	2,281,293,979	1,624,353,564	656,940,415	40%
營業費用	345,649,630	301,070,315	44,579,315	15%
其他營業收益及費損淨額	447,328	(1,230,199)	1,677,527	NM
營業淨利	1,936,091,677	1,322,053,050	614,038,627	46%
營業外收入及支出	105,571,163	83,785,585	21,785,578	26%
稅前淨利	2,041,662,840	1,405,838,635	635,824,205	45%
所得稅費用	326,266,060	233,406,876	92,859,184	40%
本年度淨利	1,715,396,780	1,172,431,759	542,965,021	46%
其他綜合（損）益（稅後淨額）	(56,326,519)	71,585,646	(127,912,165)	-179%
本年度綜合損益總額	1,659,070,261	1,244,017,405	415,052,856	33%
本年度歸屬予母公司業主淨利	1,717,882,627	1,173,267,703	544,614,924	46%
本年度歸屬予母公司業主綜合損益	1,661,253,891	1,245,836,616	415,417,275	33%

● **增減比例超過20%的變動分析**

營業收入淨額增加：主要係本年度平均銷售單價提高及晶圓出貨量增加，部分受匯率變動所抵銷。

營業成本增加：主要係因營業收入增加，致營業成本隨之增加。

營業毛利增加：主要係產能利用率上升及成本改善所致，部分受匯率變動所抵銷。

其他營業收益及費損淨額增加：主要係因本年度認列較低之處分及報廢不動產、廠房及設備淨損，及認列減損迴轉利益所致。

營業淨利增加：主要係因營業毛利增加所致。

營業外收入及支出增加：主要係因本年度利息收入增加所致。

稅前淨利增加：主要係因營業淨利增加所致。

所得稅費用及本年度淨利增加：主要係因稅前淨利增加所致。

其他綜合（損）益（稅後淨額）減少：主要係因本年度國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加所致。

本年度綜合損益總額、本年度歸屬予母公司業主淨利及本年度歸屬予母公司業主綜合損益增加：主要係本年度淨利增加所致。

● **預期未來一年銷售數量及其依據：**請參照「1. 致股東報告書」。

● **最近二年度財務績效變動影響：**對財務績效無顯著影響。

● **未來因應計劃：**不適用。

台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

項目	民國114年	民國113年	增減金額	增減比率（%）
營業收入淨額	3,784,388,760	2,880,383,350	904,005,410	31%
營業成本	1,564,313,067	1,306,140,916	258,172,151	20%
營業毛利	2,220,075,693	1,574,242,434	645,833,259	41%
營業費用	312,921,396	255,546,895	57,374,501	22%
其他營業收益及費損淨額	(663,339)	(1,549,447)	886,108	57%
營業淨利	1,906,490,958	1,317,146,092	589,344,866	45%
營業外收入及支出	137,498,724	90,462,877	47,035,847	52%
稅前淨利	2,043,989,682	1,407,608,969	636,380,713	45%
所得稅費用	326,107,055	234,341,266	91,765,789	39%
本年度淨利	1,717,882,627	1,173,267,703	544,614,924	46%
其他綜合（損）益（稅後淨額）	(56,628,736)	72,568,913	(129,197,649)	-178%
本年度綜合損益總額	1,661,253,891	1,245,836,616	415,417,275	33%

● **增減比例超過20%的變動分析**

營業收入淨額增加：主要係本年度平均銷售單價提高及晶圓出貨量增加，部分受匯率變動所抵銷。

營業成本增加：主要係因營業收入增加，致營業成本隨之增加。

營業毛利增加：主要係產能利用率上升及成本改善所致，部分受匯率變動所抵銷。

營業費用增加：主要係研究發展費用增加所致。

其他營業收益及費損淨額增加：主要係因本年度認列較低之處分及報廢不動產、廠房及設備淨損，及認列減損迴轉利益所致。

營業淨利增加：主要係因營業毛利增加所致。

營業外收入及支出增加：主要係本年度採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額增加所致。

稅前淨利增加：主要係因營業淨利增加所致。

所得稅費用及本年度淨利增加：主要係因稅前淨利增加所致。

其他綜合（損）益（稅後淨額）減少：主要係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加所致。

本年度綜合損益總額增加：主要係本年度淨利增加所致。

● **預期未來一年銷售數量及其依據：**請參照「1. 致股東報告書」。

● **最近二年度財務績效變動影響：**對財務績效無顯著影響。

● **未來因應計劃：**不適用。

6.1.3 現金流量分析

台積公司及子公司財務報表

單位：新台幣仟元

年初現金餘額（民國113年12月31日）	全年來自營業活動淨現金流量（民國114年）	全年因投資活動淨現金流量（民國114年）	全年因籌資活動淨現金流量（民國114年）	全年因匯率變動對現金及約當現金之影響（民國114年）	現金剩餘數額（民國114年12月31日）	流動性不足之改善計劃	
						投資計劃	融資計劃
2,127,627,043	2,274,975,625	(1,144,393,407)	(440,344,692)	(50,008,167)	2,767,856,402	無	無

- **本年度現金流量變動分析**

營業活動之現金流入約22,750億：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。

投資活動之現金流出約11,444億：主要係用於資本支出。

籌資活動之現金流出約4,403億：主要係因發放現金股利。

- **流動性不足之改善計劃及流動性分析：**無現金流動性不足之情形。
- **未來一年現金流動性分析：**不適用。

台積公司財務報表

單位：新台幣仟元

年初現金餘額（民國113年12月31日）	全年來自營業活動淨現金流量（民國114年）	全年因投資活動淨現金流量（民國114年）	全年因籌資活動淨現金流量（民國114年）	全年因匯率變動對現金及約當現金之影響（民國114年）	現金剩餘數額（民國114年12月31日）	流動性不足之改善計劃	
						投資計劃	融資計劃
1,035,061,499	2,154,331,121	(1,011,471,597)	(1,102,032,648)	(8,852,943)	1,067,035,432	無	無

- **本年度現金流量變動分析**

營業活動之現金流入約21,543億：主要係包含稅後淨利及折舊、攤銷費用。

投資活動之現金流出約10,115億：主要係用於資本支出。

籌資活動之現金流出約11,020億：主要係因投資子公司及發放現金股利。

- **流動性不足之改善計劃及流動性分析：**無現金流動性不足之情形。
- **未來一年現金流動性分析：**不適用。

6.1.4 重大資本支出及對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

計劃	實際或預計之資金來源	所需資金總額（民國114年及113年）	實際資金運用情形	
			民國114年	民國113年
生產、研發及廠務設備	自有資金及發行公司債	2,196,423,023	1,256,658,618	939,764,405
其他	自有資金	31,994,042	15,751,911	16,242,131
合計		2,228,417,065	1,272,410,529	956,006,536

基於上述之資本支出，民國一百一十四年台積公司產能約增加50萬片約當十二吋晶圓。

6.1.5 轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃

台積公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的。民國一百一十四年，台積公司在合併基礎之下，採權益法之轉投資獲利為新台幣5,496,594仟元，較前一年增加，主要原因為產品需求增加。未來台積公司採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，並持續審慎評估。

6.2 風險管理

6.2.1 風險管理總覽

風險管理政策與架構

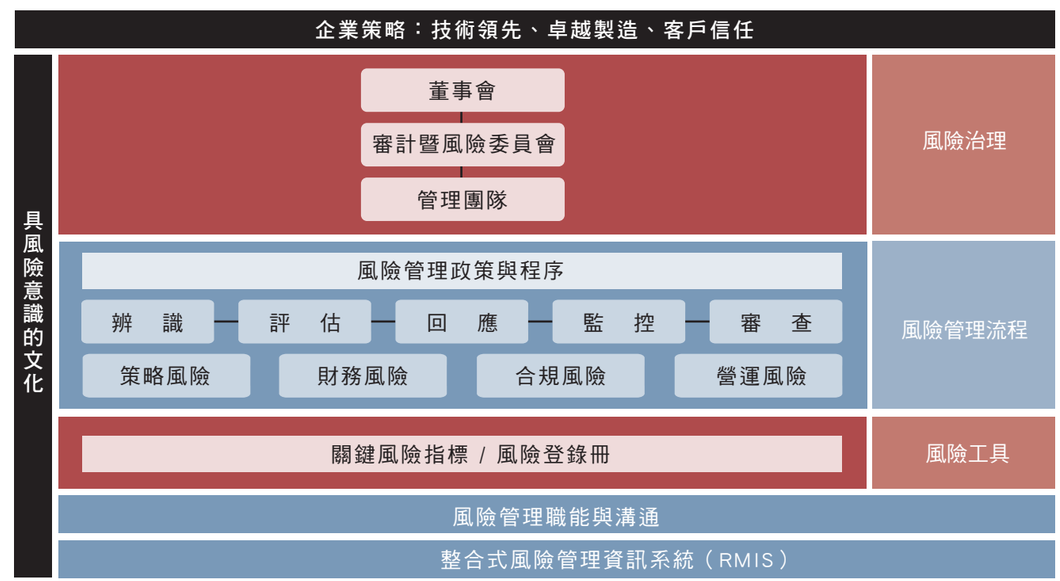
台積公司採行平衡風險與報酬的管理策略，目標在使企業報酬最佳化。這項策略適用於企業的所有層面，包括應對環境、社會和企業治理（ESG）議題的承諾，以提供所有利害關係人長期的永續價值。台積公司的風險管理政策經董事會核准，並由董事長暨總裁簽署，其中闡述了公司承諾維持積極主動且穩固的企業風險管理（ERM）系統，以協助台積公司做出經過深思熟慮、基於風險的決策，從而實現企業願景，並保障台積公司及其利害關係人的利益。

台積公司依循國際標準化組織（ISO）31000: 2018風險管理系統，並參照COSO委員會之企業風險管理整合架構，建構風險治理組織，整合營運及業務流程，以強化整體風險管理能力。

台積公司的企業風險管理架構是一種系統化的方法，使其能應對商業環境中不斷變化的動態，並把握商機。企業風險管理架構明確規定了風險治理結構、整合業務營運的管理流程，以及協助識別、評估、應對、監控和審查風險的工具。在風險評估和優先順序設定過程，應用風險準則矩陣，評估對財務、營運、聲譽和法規遵循的潛在影響的可能性。

正式培訓和溝通計劃旨在建立風險能力並培養風險意識文化，有助於管理階層在實施企業策略時做基於風險的決策。針對風險管理框架和流程進行內部及外部審計，以識別提升風險管理系統有效性的機會。台積公司體認其系統和流程提供合理但並非絕對的保證，因此持續努力提高其管理及應對風險以及利用機會的能力。

企業風險管理架構及程序

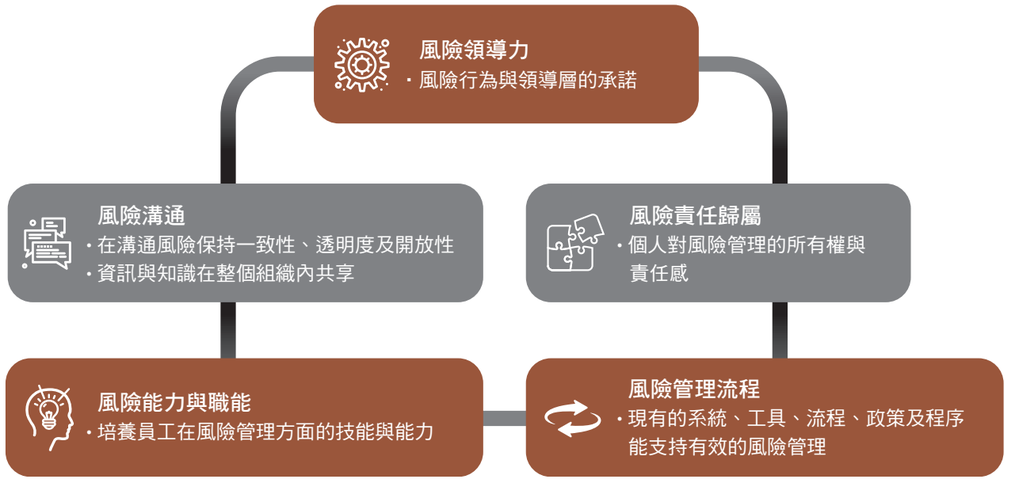


具風險意識的文化

健全的風險意識文化是有效風險控管的關鍵。台積公司風險意識文化的關鍵維度包括：

- 風險領導力：高階主管層對推動風險管理有堅定的態度與承諾，鼓勵風險意識並做出基於風險的決策。
- 風險責任歸屬：員工應對其職責範圍內的風險管理負責，並具備明確的風險歸屬。為強化風險當責，風險管理指標被納入管理階層的績效評估中，藉此強化實施風險管理框架。
- 風險溝通：台積公司在分享緊迫風險議題的資訊時，保持一致性、透明度與開放性，包括事件報告、虛驚事件以及經驗教訓的交流。
- 風險能力與職能：台積公司風險管理學院的目標是提升包括董事會和管理層在內所有層級員工的風險管理能力。
- 風險管理流程：以建立系統、工具、流程、政策和程序支持有效的風險管理。風險管理已融入日常營運中，並由風險胃納聲明及關鍵風險指標評估的引導。

風險意識文化構面



風險胃納與風險管理範疇

台積公司已界定風險胃納聲明，概述公司為實現企業目標而願意承擔的風險性質和範圍，包括：

- 應審慎評估公司所承擔的風險，確保與商業酬報相稱，並與公司的策略、投資、財務和企業目標一致。
- 應將風險考量整合到營運流程中，並將風險控制在各廠處、功能組織和公司的風險容忍度（風險指標）之內。
- 台積公司不投資或參與任何超出風險容忍度的業務活動。
- 台積公司不允許影響安全相關的違規或過失、違反法律法規以及詐欺、賄賂和貪污腐敗等行為。

新興風險

面對動態的商業環境，台積公司體認到全球及新興風險對企業策略的影響。台積公司持續審視所面對的環境，以鑑別可能影響公司的業務或營運的風險。在相關的情況下，這些風險將於各種內部論壇和風險管理指導委員會進行審查和討論，以確定是否需要採取任何進一步的行動和應對措施。台積公司致力以平衡及全面的方式評估所有重大風險，為其利害關係人提供可持續的長期價值。

台積公司的關鍵新興風險包括：

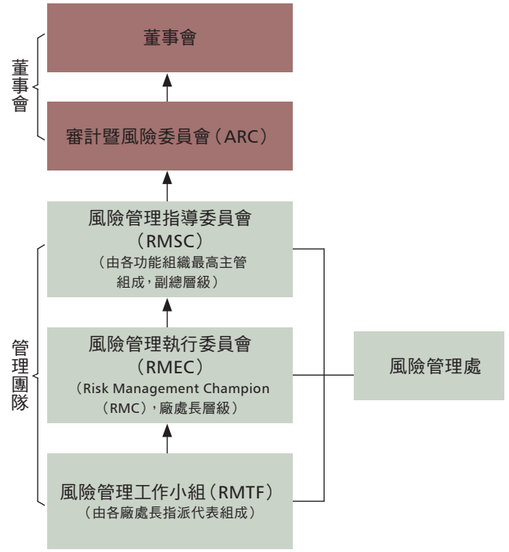
- 更趨複雜的網路空間：人工智慧、量子計算和雲端技術的進步以及地緣政治緊張局勢加劇了網路安全風險。與台積公司息息相關的關鍵產業，如半導體生態系統和基礎設施（電力和電信），自身脆弱性也逐漸擴大。網路事件足以影響供應鏈、營運和聲譽，衍生中斷、法律審查和財務損失等問題。其潛在負面影響包括營運中斷、信任下降、違規、聲譽受損以及營運復原和法律糾紛相關成本。定期性審查等應對措施包括透由審計暨風險委員會、多層防禦、模擬演練、零信任系統、邊界防禦、外部情報協作以及審計及提升風險意識等方式達成。
- 高科技產業的去全球化和碎片化：各國對於自身國家安全憂慮升高，加速在半導體自給自足的投資，刺激美、中、歐盟及日本等主要經濟體採取出口限制、關稅和保護主義。國內外包和友岸外包等措施打亂原有的供應鏈生態，拉高生產成本，而限制貿易、技術流動和市場開放性等措施正斷傷全球化。台積公司所面臨挑戰包括成本上升、運營風險、合規複雜性、供應鏈效率低下和商機損失等。風險控包括建構本地供應鏈、加強營運持續架構、關注法規更新、業務多元化以及爭取補貼以適應地緣經濟變化。
- 2050年ESG轉型的挑戰：台積公司將2050年訂為淨零排放目標年，以符合國際標準及客戶對永續性的要求。台灣可再生能源基礎設施有限，而台積公司多數廠區都設在台灣，阻礙台積公司進步並影響運營、聲譽和客戶期許。無法落實淨零目標將影響台積公司聲譽、運營延誤、客戶流失、衝擊營收以及無法落實永續性相關規範。風險管控措施包括成立再生能源工作小組、低碳供應鏈管理、優化能源利用、部署先進溫室氣體技術、取得碳權份額、建蓋符合綠色認證工廠、創新碳捕獲以及與政府合作拓展再生能源。

風險管理組織

台積公司的風險管理結合了董事會與管理階層，將有效的風險管理措施整合到公司的業務決策和營運中。董事會對風險治理負有整體責任，並授權審計暨風險委員會（ARC）引導管理階層制定並執行企業風險管理（ERM）架構。風險的辨識與日常處理則由經理階層有效執行風險管理策略、政策與流程。在執行層面，風險管理治理結構包括風險管理指導委員會（RMSC）、風險管理執行委員會（RMEC）、風險管理專案小組和風險管理處。

為協助審計暨風險委員會建立和監督積極且有效的風險管理體系，風險管理處與台積公司內部的各個功能部門和晶圓廠合作，應用企業風險管理框架評估並緩解風險。透過同時監控和執行風險相關政策和準則，並推動相關措施來達成。每六個月，在風險管理處向審計暨風險委員會報告後，審計暨風險委員會主席會向董事會報告台積公司的風險概況和風險緩解措施。

風險管理組織圖



各風險管理組織的角色和權責定義如下：

風險管理指導委員會

- 根據當前及預期的總體經濟、技術、法規、環境和社會發展及趨勢，就整體風險胃納、風險忍受度、風險策略和資源配置向董事會提供建議。
- 審查並監督風險管理框架、政策和程序的適用性與績效。
- 透過宏觀視角審視台積公司所面臨的關鍵風險，並核准風險緩解措施的優先順序，從而向董事會提供建議和確信。
- 從上而下為風險管理定調，支持風險管理相關的倡議與活動，以培養所需的風險文化、意識和能力，有效管理關鍵風險和新型風險，包括釐清風險權責。

- 確保將風險管理納入策略性業務發展和營運規劃、日常管理和決策過程。
- 針對策略風險的管理和機會的運用，向董事會提出行動建議。
- 審查並建議風險管理活動的進展、成效以及從中汲取的經驗。
- 向審計暨風險委員會報告並執行董事會所做的決策。

風險管理執行委員會

- 識別可能影響台積公司實現其目標和／或其業務營運持續有效性與效率的潛在和新興風險。
- 執行威脅與風險評估，制定緩解計劃，包括事件管理計劃，提供支持及分配足夠資源以實現及時有效的緩解。
- 領導並推動跨職能專案小組、會議或其他活動，以確保風險得到充分且有效的緩解，包括與風險管理處和各個其他相關功能組織合作。
- 定義關鍵風險指標（KRIs），以主動監控風險動態並及時有效應對。
- 在晶圓廠和部門建立風險意識文化並提升風險能力，包括但不限於培訓、演練和持續改進。
- 確保並改進風險管理機制的有效性，包括根本原因分析和行動計劃，以防止重大事件或高風險事件，以根據內部及／或外部審查中主要發現，防止再次發生。
- 向風險管理指導委員會報告有效性審查進度、風險管理活動和倡議、從事件或風險事件中汲取的經驗，並執行風險管理指導委員會所做的決策。

風險管理工作小組

- 識別並評估可能影響台積公司實現其業務目標的潛在風險和威脅，並根據風險情境部署風險緩解計劃，執行風險預防及緩解措施。
- 組織及／或參與跨功能組織會議，以處理涉及多個專業領域、部門或功能組織／晶圓廠的風險議題。
- 參與風險管理倡議和活動的規劃與執行。
- 審查各功能組織或晶圓廠針對重大事件或高風險事件的調查及其主要發現，同時監督行動計劃的有效性。

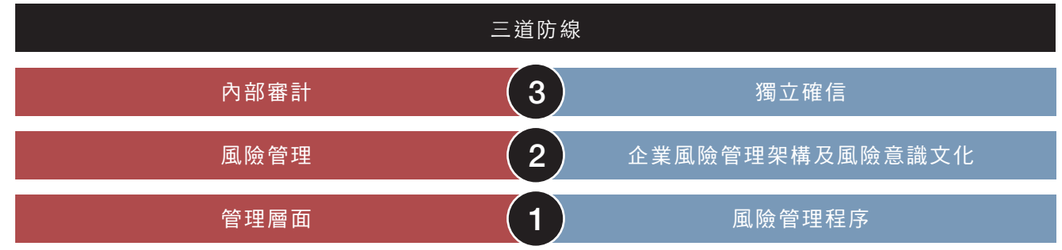
風險管理處

- 協助董事會建立並監督積極有效的風險管理和業務連續性機制，包括風險胃納和容忍度、風險策略和管理框架、政策和程序。
- 透過持續的培訓、溝通和意識計劃，強化風險意識文化與風險管理能力。
- 識別並分析公司風險的來源和類別，並定期與風險權責者審查其影響。
- 協助風險管理委員會和風險權責者實施風險管理活動和措施，以識別和管理風險，包括審查緩解計劃、業務連續性、危機和事件管理計劃；並透過書面報告、管理層討論和會議，審查風險管理活動的有效性。
- 協調跨部門和跨功能組織在風險管理營運和決策上的互動與溝通，包括執行風險管理指導委員會的決策。
- 就持續改進與標竿學習（benchmarking）的最佳實務與標準，諮詢管理層、顧問及同業。
- 準備時常因應監管機構、政府機構、保險公司／經紀人及客戶要求而需不定期提交給利害關係人的報告，包括關於公司風險管理系統實施情況的年度報告。
- 協助向審計暨風險委員會（ARC）、風險管理指導委員會（RMSC）和風險管理執行委員會（RMEC）提交半年度風險管理報告。

三道防線

台積公司採用三道防線模式，確保其風險管理系統的充分性與有效性。

- 在第一道防線中，管理階層由其各自的功能部門和委員會（例如風險管理執行委員會）提供支援，該委員會由Risk Management Champions（RMCs）組成，負責識別、評估和緩解風險（包括策略性、財務性、營運相關和法規遵循風險）。針對特定的風險領域，成立風險管理工作小組。在台積公司企業風險管理框架的指導下，根據台積公司的風險胃納，實施並執行適當的政策與程序，以應對風險。
- 在第二道防線中，台積公司制定其風險管理政策，以監督和治理第一道防線管理階層所執行的營運和活動。風險管理指導委員會協助董事會監督風險管理框架的充分性與有效性。風險管理處與功能部門和業務管理部門協同合作，確保相關政策和流程的設計與實施能有效管理風險，並培養具備風險意識的企業文化。
- 第三道防線包括獨立確信的機制，包括內部及外部稽核。台積公司定期對風險管理框架和流程進行內部及外部稽核，以識別提升風險管理及其流程有效性的機會。內部稽核處每季向審計暨風險委員會報告。



民國一百一十四年風險管理主要措施

台積公司加強風險管理計劃而採取的主要措施：

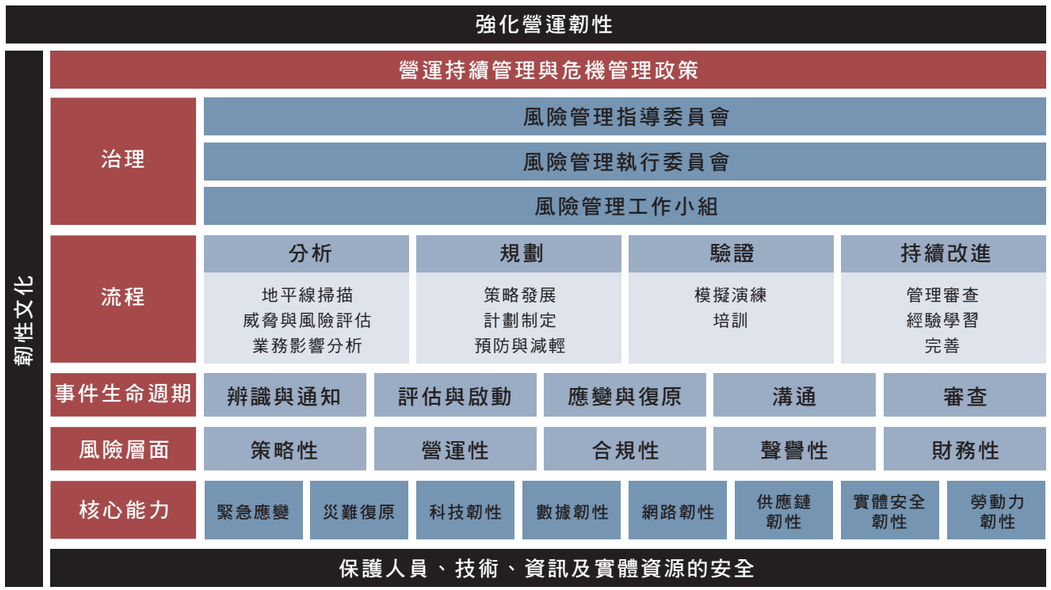
強化風險治理	優化流程	實施工具與技術	培養風險意識文化與培訓	深化利害關係人參與	強化確信
● 晶圓廠區風險管理成熟度標竿 ● 將風險管理指標納入績效管理中	● 投資與專案風險管理 ● 營運持續性管理（BCM）審查 ● 正式化危機管理架構和溝通協議	● 風險管理流程的數位化：風險管理資訊系統（RMIS）	● 董事會風險管理培訓 ● 風險意識文化調查 ● 台積公司風險管理研討會 ● 風險管理溝通與宣傳 ● 風險管理學院的員工培訓課程	● 利害關係人參與（客戶、合作夥伴、政府、供應商、保險公司）	● 向董事會和高階領導層提供有關風險管理系統充分性和有效性的確信。 ● 促進與行業合作夥伴和同業的外部交流

營運持續及危機管理

台積公司致力透過遵循營運持續管理標準，有效應對潛在營運中斷風險，以維持營運韌性及營運持續。公司已鑑別主要的天然及人為災害風險，包括地震、洪水、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體/化學品洩漏、流行病、網路攻擊、供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢、惡意破壞、恐怖主義、關鍵設施及設備故障失效和水／電／天然氣中斷。

為降低危機事件對營運的衝擊，風險管理處進行危機前風險評估、應變程序及復原計劃，並且持續進行演練，以驗證緊急應變、危機管理及營運持續之演練，加強行動準備。在重大事件或危機事件中，遵循危機管理準則。中央危機指揮中心（C4）由董事長暨總裁領導，由關鍵功能組織的資深人員組成，提供指導和決策，以保持應變準備，包括及時與關鍵利害關係人的溝通。

台積公司的營運持續管理及危機管理（BCM ＆ CM）框架引導公司有效和迅速地應對營運中斷，從而維護公司和利害關係人的利益。BCM ＆ CM框架概述了治理架構、流程和能力，以確保在整個事件生命週期中，能及時且有效的應對。整體的營運韌性有賴於韌性文化的鞏固。



6.2.2 策略風險

科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

●產業發展

電子產業與半導體市場一向深受景氣循環、產品需求時常快速變化的重大影響，這樣的市場特性也對台積公司所在的積體電路製造服務業產生影響，因此台積公司的營收與獲利也可能受到客戶下單波動的影響。

電子產業與半導體產業不時面臨重大且持續不景氣及產能過剩的情況，台積公司目前及未來業務需求皆取決於電子產品及半導體公司的需求，上述產業不景氣及產能過剩的情況將導致整體半導體製造服務業及台積公司的業務需求下降。如果台積公司不能透過降低成本或其他措施來有效抵銷需求下降的影響，在不景氣及產能過剩期間，公司營收、利潤與獲利率均會受到衝擊。

●技術變革

因應半導體產業與其技術的不斷變化，台積公司的競爭利器為持續開發更先進製程技術，以及製造功能更多的產品。此外，台積公司也持續開發新的衍生技術。倘若台積公司無法洞察技術的改變並迅速發展創新技術，或遇到競爭者無預期地取得其他的技術，台積公司將可能無法以具競爭力的條件提供服務。舉例來說，全球的人工智慧（AI）急遽發展已經對客戶的先進半導體晶片需求以及台積所在的市場動態造成顯著影響，因此，台積公司持續發展相關技術、產品、服務以滿足客戶需求和人工智慧產業變化的能力，將會對公司於此領域有效競爭非常關鍵。此外，台積公司的客戶已加快其向市場推出新產品和服務的週期，如果台積公司無法達到縮短產品上市時間的要求，可能將面臨失去這些客戶的風險。由於人工智慧（AI）相關產品，例如AI智慧型手機、AI個人電腦以及AI加速器等已經改變全球電子產業的發展方向，加上競爭越來越激烈以及客戶集中度增高等因素，前述這些風險的影響強度已然增加（有關這些風險之詳細描述，請參閱本章節相關段落）。

伴隨先進製程技術而來的不確定性與不穩定性，也對達成預期的產品品質與良率帶來挑戰。如果台積公司未能克服這些挑戰，可能導致營收損失與增加額外成本，以及造成業務損失或喪失客戶信任。如果台積公司無法克服上述挑戰，公司的競爭力可能降低，且營收將可能大幅衰退。台積公司也相信於內部營運中有效的使用AI技術對長期的成功相當重要。當AI技術快速演變，如果台積公司無法如同競爭者一般有效的導入新的AI技術於內部營運上，將會傷害公司的競爭地位。

如果台積公司無法克服上述因素，可能會造成競爭力下降以及收入大幅減少。有關上述風險之因應措施，請參閱本年報「2.2.4 台積公司之市場定位、差異化與策略」說明（第19-21頁）。

●資訊技術安全

台積公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免嚴重的網路攻擊。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，台積公司的系統可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因此停擺直至解決方案出現。重大網路攻擊還可能導致營業秘密和其他機密資訊的丟失或洩露，例如客戶和其他利害關係人的專有資訊以及員工的個人資料。台積公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響，例如，隨著人工智慧的不斷發展，網路攻擊者還可以利用人工智慧來開發惡意程式碼和複雜的網路釣魚攻擊。

惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、惡意軟體或勒索軟體導入台積公司的網路系統，以干擾公司的營運、對台積公司進行勒索、取得電腦系統控制權、窺探公司機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以進一步加強公司的網路安全系統；也可能使台積公司因涉入此類違規行為相關的法律訴訟或監管調查，而承擔重大法律責任。

台積公司過去曾經因遭受惡意軟體帶來的攻擊，未來也可能面臨類似的攻擊。為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，台積公司已落實及持續更新嚴謹的資安措施，全面提升全球各地區網際網路服務、辦公室、晶圓廠、資料中心的安全性及雲端平台的安全防護能力，確保台積公司營運的穩定性和資料的完整性，也得以使台積公司在國際安全評鑑中得分遠高於業界平均水平，顯示出台積公司在資安領域的持續投入和高度重視。

民國一百一十四年，台積公司更重點強化資安防禦策略，達成了多項關鍵目標，包括：應用程式安全以提升軟體生命週期中的資訊安全；持續精進資料中心的全方位自動化掃描防護，保障基礎設施的韌性與防護能力；強化特權帳號管理機制，管控了高權限存取，降低了潛在的威脅風險；透過強化區域資訊技術與區域辦公室的本地安全防護，並輔以總部對區域資訊技術服務的集中管理，有效提升在地資安應變與管理能力；持續完善關鍵資料保護措施，確保所有重要資料的完整性、機密性與可用性；應用人工智慧，提升資安防護的效率與事件應變速度。透過這些具體行動的落實，台積公司建立更為堅固與智能的資安防禦體系，有效應對不斷演變的網路威脅。

此外，為降低供應鏈風險，台積公司持續深化供應鏈資安韌性，聚焦127家關鍵供應商與其協同合作，運用第三方資安風險評級服務及關鍵控制措施輔導，協助供應商改善資訊安全成熟度，不僅提升了供應商的安全保障能力，並加強台積公司與供應商之間的信任與溝通，促進了整個供應鏈的資安防護能力。台積公司作為核心推動者，於民國一百一十四年進一步攜手數位發展部與SEMI國際半導體產業協會等夥伴，共同推動並正式發布「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」。此舉將SEMI E187標準從源頭導入供應鏈，要求設備供應商通過資安認證，強化了供應鏈的資安防護韌性。台積公司持續強化自身與供應鏈資訊安全，善盡企業社會責任，自民國一百一十年起連續五年獲得TCSA台灣企業永續獎－資訊安全領袖獎。

此外，台積公司需要分享高度敏感及機密的資訊給台積公司雇用的第三方服務廠商，以使其能提供相關服務給台積公司及其全球關係企業。儘管台積公司在和第三方服務廠商簽訂之服務合約中，要求嚴格遵守保密及／或網路安全規定，但不能保證每個第三方服務廠商都將嚴守這些義務。而且，上述服務廠商亦會有遭受網路攻擊的風險。若台積公司或其服務廠商無法及時解決這些網路攻擊所造成的技術性問題，或確保台積公司（及屬於本公司客戶或其他第三方）的數據完整性及可用性，或維持控制

住公司或其服務廠商的電腦系統，皆可能嚴重損及台積公司對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可能因此遭受重大不利影響。

需求及平均售價下滑之風險

公司的營收主要來自在智慧型手機、高效能運算（包含人工智慧應用）、物聯網、車用電子與消費性電子產品等領域使用台積公司產品的客戶群。其中任何因素如特定零組件之供給短缺、電力供應受限或環境、社會及公司治理（ESG）之疑慮所造成之終端市場成長衰退或趨緩，都將導致對全球積體電路製造服務業的需求顯著下滑，對台積公司的產品與服務需求亦可能隨之降低，公司的營收便可能受到衝擊。同時，積體電路製造之廠房設備建置需要大量的投資，當廠房開始營運後，便成為整體營運成本中之大宗固定成本資產，因台積公司廠房設備多數屬於自有，這些占整體營運成本中顯著比例的固定成本並不會隨著客戶需求或產能利用率降低而減少，因此，當客戶需求下滑，公司的獲利率將會受到顯著影響。相反地，當產品需求提升與產能利用率上升時，固定成本得以分攤在增加的產出上，將有助於公司的獲利表現。此外，終端產品平均銷售價格持續下滑的趨勢，也勢將擠壓內裝零組件的價格；若終端產品平均售價繼續下滑，台積公司所製造的零組件，其價格壓力也可能導致營收、獲利率與利潤降低。

競爭之風險

專業積體電路製造服務產業的競爭激烈，台積公司不僅與其他積體電路製造服務業者競爭，也與一些整合元件製造商競爭。某些競爭者可能取得比台積公司更先進的技術，而某些競爭者可能取得比台積公司更大的財務或其他資源，例如可能取得來自政府直接或間接的補助、刺激經濟措施的資金或台積公司可能無法取得的其他獎勵補助。美國、中國、歐洲、南韓和日本政府提供了廣泛多樣的獎勵計劃以促進其國內半導體產業之發展，例如美國在西元2022年發布的《晶片與科學法案》（the Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022, the “U.S. CHIPS Act”）即提供財務上的補貼及獎勵誘因以促進美國國內半導體產業的發展。民國一百一十三年十一月，TSMC Arizona Corporation與美國商務部達成協議，根據《晶片與科學法案》獲得某些獎勵補助，其中包括最高達66億美元的直接融資總額和最高達50億美元的貸款。民國一百一十三年十二月，European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH與德國政府達成協定，根據《歐洲晶片法》（the European Chips Act（EU）2023/1781）獲得最高達50億歐元的國家補助。雖然於某些台積公司目前已經拓展或是計劃拓展產能的區域與國家中之政府已經擴大或是將來可能擴大對台積公司的財務獎勵計劃，這並不保證台積公司能於未來獲得與台積公司期待相符的財務獎勵。此外，任何台積公司所獲得的財務獎勵計劃都將可能被授予國家附加特定獎勵條件，例如限制台積公司在對授予國家而言具國家安全顧慮的特定國家的擴產計劃，以及限制台積公司與對授予國家而言具國家安全顧慮的特定國家組織之間關於任何可能引發國家安全顧慮的技術或產品的共同研發或技術授權行為，更或者，授予國家可能尋求收回已經提供給台積公司的資金，或者於未來取消、減少、否認我們要求的補貼或獎勵。這可能大幅度增加台積公司的成本並造成營運的負面影響。未遵守公司可能獲得的補貼或獎勵的條款和條件，可能會導致未來應收補助款項的全部或部分被延遲或取消，並迫使我們償還已收到的全部或部分補貼或獎勵。即使公司符合補貼的條件和要求，補貼授予者也可能延遲甚或無法提供補貼。雖然公司預期將繼續受益於政府的補貼和獎勵措施，但未能獲得公司尋求的補貼或獎勵、未能充分利用該補貼或獎勵、或未能遵守補貼或獎勵的條款和條件，可能會影響台積公司實現其原訂計劃目標的能力，並對台積公司的業務、營運成果及財務狀況產生不利影響。

此外，台積公司的競爭對手可能會不時對單一或多個製程採取積極的低價策略，也可能瓜分那些尋求分散供應鏈之客戶的訂單。競爭對手的這些競爭行為，可能導致台積公司客戶群減少、售價降低或兩者皆具。如果台積公司不能有效率地在技術、製造產能、產品品質、供應鏈多元化與彈性、以及客戶滿意度方面與這些對手競爭，台積公司將可能面臨流失客戶的風險，且利益率和獲利可能會下降。

國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

台積公司經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令，並訂定相關風險管理程序。民國一百一十四年及截至年報刊印日止，與本公司營運有關之重要法令變動如下：

台積公司產品的製造、組裝及測試要求使用的化學品和材料須符合國際頒布的環境、氣候相關、健康及安全法律法規以及國際協議例如「巴黎協定」。民國一百零四年七月一日生效並於民國一百一十二年二月修訂的台灣「氣候變遷因應法」，設定民國一百三十九年台灣實現淨零排放的目標，並建立了碳費制度以徵收碳費。對直接和間接排放量達到一定閾值的排放者，自民國一百一十四年開始徵收碳費。鑒於台積公司台灣各廠區的排放量皆超過目前法規徵收閾值，我們將於民國一百一十五年首次支付（民國一百一十四年）碳費，此將導致我們製造成本增加。此外，中華民國立法機構隨時審視各種環境問題，以制定與環境保護和氣候變遷相關的法律和法規，此類法律法規的影響目前尚無法確定。

其他相關政策及法令的變化對台積公司的財務業務尚不會造成重大影響。

6.2.3 營運風險

天然及人為災害

台積公司致力於遵循營運持續管理標準，強化有效應變營運中斷風險的能力，以維持營運韌性。台積公司的營運易受到各種天然或人為災害而中斷，例如地震、水災、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體／化學品洩漏或溢出、流行病、網路攻擊、供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢、惡意破壞、恐怖主義。此外，關鍵設施及設備故障失效，以及水／電／天然氣等公用事業服務中斷，也可能干擾公司營運。

台積公司多數的生產據點、供應商、客戶以及半導體製造服務的上游供應商均位於易受到天然災害影響之區域。這些地點亦可能受到水、電供應短缺的衝擊，而對台積公司營運造成影響。在民國一百一十三年四月和民國一百一十四年一月，台灣發生了多次地震，對台積公司的庫存、工廠設施及機械設備造成了損害。台積公司分別在民國一百一十三年第二季度和民國一百一十四年第一季度確認了地震造成的損失，扣除了保險理賠後，損失約新台幣30億元和新台幣53億元。如果一次或多次天然及人為災害導致台積公司、其客戶或供應商的營運長期中斷，或台積公司的任何工廠或供應商設施因危害性事件而造成損壞或停止營運，均可能會顯著降低產能並導致重要客戶流失。此外，公司客戶的營運中斷也可能降低對其產品和服務的需求。因此，這兩種情況都可能對其營運和財務績效產生不利且實質性的影響。

為了因應氣候變遷加劇可能帶來的乾旱缺水風險，台積公司除了廠區製程節水外，也自行建置工業再生水及配合政府市政再生水的供應，以減緩乾旱時的供水風險。台積公司營運持續計劃涵括乾旱缺水的因應作為，包含節水措施及使用替代水源。對水情進行密切監測，包括壓力測試和演習，以驗證台積公司的應對計劃。

受到電力供應商供電服務或同一電網其他用戶的影響，台積公司偶爾會遭遇電力供應短缺、中斷、壓降或突波而影響生產。政府的能源政策可能進一步加劇供電短缺或中斷風險。若台積公司的晶圓廠無法獲得可靠且不間斷的電力供應，滿足客戶訂單的能力將受到削弱。此外，台積公司已受到並將持續面臨公用事業費用的上漲。例如自民國一百一十三年四月一日起，台積公司適用較高的電費費率，較民國一百一十二年適用的費率預估提高25%。民國一百一十三年十月，電價費率進一步上漲了14%。電費的上漲可能會增加公司的製造成本，因而對財務績效產生不利的影響。此外，由於氣候變遷，嚴重的天氣事件（例如乾旱）以及政府因應這些嚴重天氣事件所採取的措施，可能對台積公司的運營以及其供應商的生產造成重大影響。例如，政府因應乾旱所採取的措施，包括限水和節水，可能會對台積公司的運營或其擴展計劃造成中斷。

如果諸類事件若持續較長的時間，台積公司的營運與財務績效可能會受到實質性的不利影響。

台積公司持續加強營運持續管理，包括定期風險評估與風險抵減，進行統一情境的營運持續管理（BCM）演練，成立專案小組，針對緊急事件的衍生影響、替代解決方案進行分析，並提出緊急應變、危機溝通、復原計劃與預防措施，確保能將人員安全、營運及資產衝擊降至最低。為維持營運持續計劃的有效性，台積公司定期檢視營運持續計劃並依演練及執行成效予以修正改進。在台灣和日本，台積公司持續改進其地震應急響應、機台錨固和隔震設施，以及機台搶救和生產恢復的準備。這些改進已整合到新晶圓廠的設計和流程中。

台積公司致力於維護完整的風險管理系統以保護人員安全、天然資源保存與資產保護。為有效因應可能的緊急狀況及天然災害，每一個廠區的管理都有就風險預防、緊急應變、危機管理及營運持續等面向發展出全方位的應對計劃與流程。台積公司所有晶圓廠均已取得環境管理系

統（ISO 14001）及職業安全衛生管理系統（ISO 45001）的驗證，所有位於台灣的廠區亦均取得「台灣職業安全衛生管理系統」（TOSHMS）認證，同時新建廠房也必須於取得工廠登記證後的18個月內取得前述之認證。

台積公司與其許多供應商在製程中使用的易燃性化學品及有毒物質，亦有造成火災、爆炸及影響環境的風險，除了維持各項風險預防與保護系統外，台積公司也有火災與意外災害保險。即便如此，台積公司的風險管理與保險仍可能無法涵蓋所有潛在損失，若任何一座晶圓廠或供應商之設備因火災、爆炸或環境事件而導致損害或停工，將導致台積公司產能減少並失去重要客戶，並對台積公司的財務績效造成負面影響。

台積公司持續監控對其營運造成影響之破壞性威脅，並調整計劃以確保營運韌性。

產能擴充之可能風險及因應措施

台積公司針對其產品與服務，定期進行市場長期需求預測，以對產能作整體之規劃。依據市場需求，公司持續擴充產能以符合市場對其產品與服務的需求，包括於台灣、美國亞利桑那州、日本熊本縣以及德國德勒斯登。

實施這些產能擴充計劃會造成營運成本增加，且其增加幅度可能很大。例如公司需要建置新設施、添購機器設備、擴充及訓練人員以操作新機器設備，如果市場需求未能實現，及／或台積公司無法相對地提高營收，這些成本的增加將對其財務表現產生負面的影響。

此外，因需求預測會隨著市場環境的動態變化而隨時發生顯著的改變，當需求減少時，台積公司會暫停或停止部分廠區的生產線或機台運作；而當後續需求在短時間內快速增加時，台積公司可能會無法即時地恢復產能來把握住景氣好轉時的所有需求。在這種情況之下，其財務業績和競爭力可能會受到不利影響。

為減輕上述產能擴充之可能風險，台積公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，公司會及時地調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響。

新建廠之可能風險

台積公司目前正在進行多個擴建計劃，包括在全球的新廠設計及興建工程，而全球性擴廠將對管理、財務及其他資源有相當程度的需求。台積公司預期在全球性擴廠和營運方面面臨一定的挑戰，其中包含但不限於：

- 擴廠計畫造成的成本增加、於多個據點建立各類原物料之供應鏈、對台積公司能維持現有生產力及製造效率的影響，因為有生態系統的支持，以及多個營運據點之人才吸引及留任；
- 工人短缺、材料供應鏈中斷以及興建工程問題皆可能使建廠時程受到延宕，可能進一步令台積公司承擔大幅增加的成本以及無法達成原訂產能擴充計劃；
- 天然或人為災害，例如地震、水災、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體／化學品洩漏、流行病、網路攻擊、供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢、勞工問題、惡意破壞、關鍵設施及設備故障失效、水／電／天然氣等公用設施供應中斷等事件，可能造成台積公司的營運中斷；
- 台積公司未來的營運擴充計劃可能受限於工業用地與能源的不足而無法充分執行；
- 外國法規之遵循，以及台積公司的措施被認定為未遵循相關法規而遭受罰則之風險；
- 管理多個營運據點及跨系統間不同之資訊技術基礎架構，以及在全世界遭受網路攻擊之風險；
- 政府補助及其他獎勵計劃出現對台積公司不利之改變，包括未收到、延遲和政府可能收回補助；
- 於新的營運據點建立接受工作文化差異，以及營運管理地理距離分布廣泛之員工的挑戰；以及在不同的就業環境和勞動法規與規範之挑戰；
- 針對台積公司的智慧財產權侵權指控與維權行動增加；及
- 營運所在地之各國稅務法規帶來潛在的不利影響。

若台積公司無法克服上述挑戰，則可能對公司業務、財務狀況及經營結果造成負面影響。

銷售集中之風險及因應措施

近年來，台積公司的客戶群與客戶的業務性質出現顯著變化。儘管台積公司在全球各地擁有數百位客戶，但來自前十大客戶的營業收入淨額，在民國一百一十二年、一百一十三年與一百一十四年，各約占公司當年營業收入淨額的70%、76%及78%。台積公司最大客戶占台積公司民國一百一十二年、一百一十三年，與一百一十四年當年營業收入淨額各為25%、22%及19%。台積公司第二大客戶占台積公司民國一百一十二年、一百一十三年，與一百一十四年當年營業收入淨額各為11%、12%及17%。

較集中的客戶群可能使得台積公司收入淨額受到大客戶季節性需求變化的影響，並且導致台積公司營運產生不同的季節性模式。客戶集中度的產生，部分來自電子產業的結構性改變，轉由高效能運算及智慧型手機應用及其內容相關的應用程式與軟體所主導的局面。

目前僅有少數客戶成功利用這個新的商業模式典範。同時，台積公司已觀察到客戶業務模式產生本質上的轉變，以因應此一新的商業模式典範。例如，更多的系統公司開發自己設計的半導體晶片並直接與積體電路製造服務公司合作，使得產品及服務能在多變的終端市場脫穎而出。他們的產品和服務成長不穩定或無法持續，特別是在人工智慧領域，這些變動的商業模式可能會導致我們的營收出現顯著波動。

同時，由於全球半導體產業競爭日益激烈，有些台積公司客戶已經開始進行產業整併以保持競爭優勢。此一產業整併係以合併與收購的方式進行；如果有越多台積公司主要客戶進行整併，台積公司的客戶總數將會進一步減少。此外，針對台積公司特定主要客戶的法令限制，例如出口管控措施，亦可能影響台積公司為該等客戶提供產品的能力，或減少該等客戶對台積公司產品及服務的需求，因此影響該等客戶的營運。

倘若其中一位或多位主要客戶，因競爭壓力升高、產業整併、適用法令限制改變、產品設計、製造採購或委外製造的策略或做法改變、客戶存貨調節時間的影響、重要客戶經營模式的改變，而停止或顯著縮減採購規模，將可能對台積公司的營運與財務表現產生負面影響。

採購集中之風險及因應措施

- **原物料**

台積公司需及時並以合理的市場價格獲得生產營運所需之足夠原物料，例如矽晶圓、製程用氣體、化學原料、光阻劑等。過去曾發生特定供應商或半導體業的原物料供應短缺狀況，導致業界短暫的價格調整與交期延誤。此外，原物料原產國發生重大天災、貿易壁壘、政治或經濟動盪（包括軍事衝突），以及通貨膨脹問題也可能會嚴重影響該原物料的供應或調漲價格。再者，由於部分台積公司所採購的原物料是由單一廠商所供應，可能會出現供貨無法滿足需求或無法及時找到替代來源的風險。進口和國內生產限制也可能影響台積公司獲得充足原材料供應與符合品質要求的原物料。此外，近期貿易緊張局勢可能導致價格上漲，甚至因關稅、出口管制或其他非關稅壁壘而導致原物料無法供應。如果台積公司無法適時取得充足且必要的原物料或是原物料價格顯著上漲，台積公司的營收與利潤可能會因而有不利的影響。

為降低供應鏈風險與有效管理成本，台積公司已及早與主要供應商就原物料品質與產能管理等議題進行廣泛磋商，為可能的增產或減產需求做好準備；同時成立專責團隊對供應商進行現場或遠端稽核，以將供應鏈最佳實踐延伸至上游供應鏈。此外，因應新產品產能的變動，台積公司持續改善庫存監控系統，提高需求預測的準確度，以確保供應鏈維持足夠庫存水位。台積公司訂定了一套供應鏈風險評估，要求關鍵供應商在勞工、道德、環境、安全與衛生及持續營運計劃方面必須符合標準。台積公司除致力開發新供應商並與合格供應商檢視未來產能需求計劃外，亦持續鼓勵供應商透過分散生產廠區，降低供應鏈風險，強化生產成本競爭力，並即時支援台積海外工廠需求。

- **設備**

台積公司的營運成長及產能的持續擴充計劃，仰賴來自市場中少數的供應商以得到所需的設備及相關服務，因此可能面臨供應商供給有限且交貨期長的情況，為了優化供應鏈管理，台積公司針對交貨前置期進行評估及預測，以期能夠盡量降低供應鏈風險對營運成本的影響，台積公司也並與各供應商持續擬定多項商務合作模式與風險控管應變措施，以縮短機台的採購前置期，而為了因應全球性的業務擴展，台積公司亦加強對當地法規政策及供應鏈風險的了解。若台積公司無法及時取得所需設備與相關零組件，將影響台積公司執行產能擴充計劃和即時掌握高度時間敏感性的商機。此外，持續的貿易緊張將可能導致台積公司無法及時取得關鍵機台與零組件，其中包括出口許可證延遲給予或被拒絕，以及額外出口管控

措施或其他的關稅、非關稅壁壘等，若台積公司無法以合理價格及時取得所需設備以滿足客戶對技術及產品產能的需求，將可能對財務及營運造成負面影響。

有關智慧財產權之風險

台積公司得以成功地保持競爭優勢並持續成長，原因之一是不斷強化智慧財產權版圖。雖然台積公司積極地主張及保護智慧財產權，但無法保證可以適當地防止專有技術、軟體、營業秘密或know-how等智財權利被侵害或不當使用。此外，當公司業務及營業模式拓展至新領域時，台積公司無法保證可以獨立開發從事業務所需之技術、專利、軟體、營業秘密或know-how，或在不知情的狀況下，不會侵害到他人之智慧財產權。因此，台積公司可能在某種程度上需倚賴他人的技術及專利授權。當倚賴他人授權時，台積公司亦難保證未來能夠以合理條件取得任何或所有必須的授權。而當缺乏必須的授權時，台積公司可能有被第三方主張侵權損害賠償責任甚或聲請法院禁制令的風險，以及客戶依合約請求及主張本公司負擔或賠償客戶因第三方侵權主張所遭受之損害。

台積公司不定期會接獲包括非實施專利實體（Non-practicing Entities）及半導體公司等第三方的通知，主張本公司之技術、製程，或所製造之半導體產品之設計智財或客戶使用前述半導體產品有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。由於產業的本質、市場地位及擴大在海外的製造營運使然，本公司未來可能會接獲更多上述通知。由好訟、資金充足之非實施專利實體所提出的專利訴訟或主張，對金錢上之請求以及向法院提出之禁制令聲請格外強烈。美國專利商標局的第三方複審程序日前有所調整，此項新制限制當事人參與撤銷錯誤核發專利，並可能鼓舞專利權人而導致此類主張增加，進而損害本公司就相關主張達成合理解決方案的能力。這些訴訟及主張可能會增加本公司的營運成本，如果這些專利主張實體成功阻攔本公司所提供的產品及服務之交易，亦可能會嚴重干擾本公司的營運。再者，隨著台積公司的製造營運擴大至部分國外區域，本公司就智慧財產權被侵害之風險管理亦面臨更高的挑戰。縱使本公司努力採取有力的措施以減輕在該等新區域內智慧財產權被侵害的風險，仍無法保證本公司所採取的保護措施足以避免所有潛在的他人侵權行為。

如果台積公司無法取得或維持特定的技術或智慧財產權的授權或未能防止本公司的智慧財產權被侵害，且因此發生相關訴訟時，可能：（一）導致台積公司無法製造特定產品、銷售特定服務，或使用特定技術；及（二）減弱本公司對因侵害本公司智慧財產權而獲益的競爭對手的競爭力，因此將減少本公司產生營收之機會。

台積公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益的可能損失。這些措施包括：策略性地取得某些特定半導體公司或其它科技公司的必要授權、即時取得源自台積公司內部及外部的智慧財產權，以對於台積公司的技術及業務進行防禦性及／或攻擊性的防護，以及積極抵禦浮濫的專利訴訟。

訴訟或非訴訟事件

如半導體產業其他多數公司常見的情形，台積公司不定期會接獲第三人的通知，主張台積公司的技術、製程或台積公司製造之半導體產品的設計或客戶之使用，有侵害他人專利或其他智慧財產權之虞。這些主張有時導致雙方間的訴訟（台積公司或為原告或為被告）及台積公司支付和解金。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少可能造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。此外，台積公司亦須遵守相關地區競爭法的規範並受到主管機關之監理，該等競爭法主管機關對台積公司發動之執法程序若其結果對台積公司不利，可能會損害台積公司之業務或影響台積公司之營運策略，從而對台積公司營運成果或展望造成負面影響，並使台積公司面臨潛在高度法律責任。

目前台積公司重大的法律事件如下：

Longitude Licensing Ltd.及Marlin Semiconductor Limited（合稱「Marlin」）於民國一百一十四年二月，在美國國際貿易委員會（ITC）及美國東德州地方法院對台積公司及其客戶就五件美國專利提起專利權侵害調查及訴訟，ITC業於民國一百一十四年三月二十一日立案，東德州地方法院則於民國一百一十四年四月二十三日因ITC調查案繫屬中依法令規定暫停訴訟程序。本公司尚無法預知訴訟或調查結果且無法可靠估計該或有負債。

除前述法律案件之外，截至年報刊印日止，並無其他台積公司為案件主體的重大法律案件。

進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司並未進行任何併購。

招募人才之風險及因應措施

台積公司的成長仰賴管理階層、專業技術人員及各類專業人才的持續服務及貢獻。倘若公司因人員離職、人才短缺、人才挖角、移民管制而導致人員流失，或因市場對產品及服務的需求改變而失去人才，公司可能會因為無法及時招募到足夠的優秀人才而面臨業務受到嚴重影響的狀況。由於人才招募競爭激烈，台積公司亦可能面臨無法確保及時滿足內部人才需求的挑戰。

為了降低人才短缺的風險，台積公司除了鼓勵職務輪調，落實在職訓練與認證制度，讓員工在實際工作場域能夠持續學習，精進工作效能外，更打造多元招募管道，持續在台灣及海外招募，廣納多元化及優秀人才。同時，台積公司也強化產學合作，提早掌握優秀人才，為未來人才的延攬鋪路。

未來研發計劃及預計投入之研發費用

請參閱本年報第107頁之「5.2.7 未來研發計劃」說明。

企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台積公司以「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」的核心價值建立了良好的全球企業形象。公司的正面形象也體現了卓越的經營、嚴謹的公司治理，以及良好企業公民的永續責任，台積公司持續在經濟、環境和社會面向追求創新。

民國一百一十四年，台積公司在營運發展、公司治理、專利成果、獲利成長、投資人關係、環境保護、企業永續等方面屢獲殊榮，包括連續第24年獲選為「道瓊領先指數」的組成企業（原道瓊永續世界指數；截至2026年3月，道瓊領先指數尚未公告其2025年成分股）、持續獲得天下雜誌「天下人才永續獎」肯定、台灣永續能源研究基金會「2025 TCSA台灣企業永續獎」、台灣十大永續典範企業獎、年度最佳報告書獎、氣候領袖獎、循環經濟領袖獎、永續供應鏈領袖獎、水資源管理領袖獎、資訊安全領袖獎；標準普爾S&P Global「2025年永續年鑑－永續年鑑成員」、連續第11年入選證交所「公司治理評鑑」前5%公司、財富雜誌「2025全球最受推崇企業」之一、「全球500大企業」、ISS-oekom企業評比「最佳」等級、普華永道（PwC）「2025全球市值總額百強企業」、調研與媒體公司企業騎士及非營利組織As You Sow所發布之「2025清淨低碳全球200大企業」、世界標竿聯盟「全球2,000大最具影響力公司（SDG2000）」、MSCI「全球精選指數」、「新興市場精選指數」成分股及MSCI ESG Research的MSCI ESG評等－AA評等。

台積公司落實永續營運，民國一百一十四年，由董事長暨總裁魏哲家博士擔任主席的「ESG指導委員會」舉行第六屆「TSMC ESG Award」，表彰公司內部組織呼應ESG五大方向（包括綠色製造、建立責任供應鏈、打造健康共融職場、培育人才、關懷弱勢）並落實ESG行動方案於日常業務中，同時，鼓勵員工提出永續層面的創新思維，透過評估員工提案之可行性，台積公司導入資源、付諸實現，把握驅動正向改變的機會。相較於第五屆的4,330件永續提案，第六屆共計收到5,841個創新點子，為公司創新的永續文化挹注源源動能。

台積公司致力透過遵循營運持續管理標準，有效應對如地震、洪水、颱風、乾旱、海嘯、沙塵暴、野火、火山爆發、火災、氣體／化學品洩漏、流行病、網路攻擊、供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢、惡意破壞、關鍵設施及設備故障失效、水／電／天然氣等供應短缺等自然及人為災害風險。台積公司亦執行危機前風險評估、訂定應變程序及復原計劃。在重大突發或危機事件中，台積公司遵循危機管理準則，中央危機指揮中心（C4）由董事長暨總裁領導，關鍵功能組織的資深管理人員組成，提供指導和決策，以確保應變準備，包括及時與關鍵利益相關者溝通。民國一百一十四年，台積公司獲Sustainalytics「ESG風險評比」評為低永續風險公司。

台積公司進一步加強了營運持續管理，包括定期風險評估和緩解策略，運用統一的情境實施營運持續管理演練，及成立專責工作小組。台積公司亦透過舉辦風險管理及營運持續管理工作坊與突發事件指揮官培訓，深化海外子公司及辦公室的風險管理機制。這些努力的目標均在強化台積公司全球布局的營運韌性，並提高在營運準備上的風險意識。

一旦上述危機發生，台積公司總部及全球營運據點之相關人員，均能啟動完備的緊急應變措施，免除或降低意外事件對人員的生命安全、環境、財產及營運之影響，並於早期階段即涵蓋企業公共關係處之參與，由企業公共關係處統一擔任對外發言代表，以確保危機發生時與利害關係人的溝通管道暢通，及溝通訊息的及時、清楚且一致。

經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司並無任何經營權改變的風險發生。

未遵循出口管控、環保及氣候變遷相關法規及協議，或未即時取得營運所需相關核可之風險

由於台積公司在許多地區從事生產活動，且客戶散布於世界各地，因此受到許多國家或地方法令的規範。例如，在製造、封裝與測試產品時需使用受出口管制法令與法規約束的設備，以及金屬、化學品與材料，需符合國際環保、氣候變遷、安全衛生及人道主義禁止強迫勞動的無衝突礦產來源等相關規定、法令及準則。台積公司若無法符合與時俱進的相關法規，或未及時申報資訊或文件至相關主管機關時，可能會導致：

- 遭受重大處罰並負相關法律責任，例如否決進出口許可或第三方訴訟、刑事或行政訴訟
- 暫時或永久停止生產相關產品
- 暫時或永久無法購買或使用特定生產之關鍵化學品或材料
- 製造、封裝與測試製程難以轉換
- 來自客戶的質疑使公司處於極為不利的競爭劣勢，例如若公司無法滿足相關法規或客戶要求，因而喪失收入
- 限制台積公司營運與產品銷售
- 喪失原有的租稅優惠，包括終止現有的租稅優惠及無權享有租稅減免，以及繳回公司不符合資格的租稅補貼
- 損害公司商譽及聲譽

台積公司在半導體供應鏈中的角色先天限制了其對包含其所製造半導體晶片的最終產品之下游使用或使用者的能見度，從而阻礙了台積公司充分確保其所製造的半導體晶片不會被轉移（包括經由台積公司的客戶與第三方）到非預期的最終用途或最終使用者的能力。此外，對某些晶片的出口管制通常取決於晶片產品的特定功能或技術效能特徵，而這些特徵可能是晶圓廠無法獨立驗證的。如果台積公司的客戶的行為或產品被認定落入前開出口管制範圍，且相關產品出口並未取得必要的許可，則台積公司可能被認定違反可適用的出口管制或制裁相關法律，這可能使台積公司遭受聲譽損害、政府調查、相關法律程序導致的處罰或其他財務風險，以及其他負面後果。民國一百一十三年十月，台積公司通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品，此後，台積公司即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。即使台積公司盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規，仍不能保證其商務活動不會被發現有未遵守出口管制法規之情形。

台積公司受多個司法管轄區的反托拉斯法規約束，並不時收到執法機關的相關詢問。隨著台積公司在半導體製造產業的成功，以及外界對半導體產業集中度的批評日益增加，有時甚至直接指向台積公司，台積公司面臨反壟斷調查的風險增加。任何潛在反壟斷調查程序的不利結果都可能損害台積公司的業務並分散管理階層的注意力，從而對台積公司的營運成果或前景產生重大不利影響，並使台積公司可能承擔重大法律責任。

為了符合相關法規，例如環境及氣候相關法令與要求，將可能使台積公司必須採取以下措施：（一）購買、使用並設置防治設備；（二）執行防治計劃，例如減緩氣候變遷方案及空氣污染減量計劃；（三）修改本身產品設計與製程，或導致花費更高成本，例如支付公司排放超過適用閾值而產生的碳費，以及取得再生能源、再生能源憑證或碳權、替代性原料／化學品或更貴或更稀有的化學品來進行生產。

如果無法及時取得營運所需相關核可，恐妨礙台積公司的營運與財務。例如當台積公司進行新建廠或擴廠專案時，如果無法及時取得環保相關的核可，恐延遲或限制新建廠或擴廠計劃進而造成成本增加，也會對台積公司的業務和營運產生不利影響。由於社會大眾對環保議題的日益關注，即使台積公司營運符合所有相關法律的規定，仍可能因為公眾關注以及來自社會、環保議題的壓力，使台積公司的營運及擴廠計劃受到不利的影響或延遲。

台積公司認為氣候變遷應被視為重要的企業風險，必須對此做好管控以提升企業競爭力。台積公司針對氣候變遷相關風險及管控措施，請參考本年報第162-163頁之「7.2.1 環境保護」之「氣候變遷與能源管理」。

6.2.4 財務風險

經濟風險之影響及因應措施

任何未來系統性的政治、經濟或金融危機或市場波動，包括但不僅限於利率和匯率變動、通貨膨脹或通貨緊縮以及主要經濟體的經濟、財政和貨幣政策的變化，都可能造成半導體產業整體之營收及獲利大幅下降。若經濟狀況或台積公司之客戶之財務狀況惡化，台積公司之產品及服務需求可能減少，且可能需提撥額外之會計準備，進而減少台積公司之營收及獲利。舉例而言，軍事衝突所導致的地緣政治不穩定，引發供應鏈中斷、通貨膨脹、法規不確定性增加以及金融市場波動等問題，皆可能對全球經濟造成更廣泛的負面影響。

- **利率變動**

台積公司的利率風險主要來自於其投資部位及金融債務。利率變動會影響公司現金及約當現金暨固定收益證券所產生的利息收入、固定收益證券的公允價值，以及金融債務所需支付的利息費用。

台積公司的投資政策目的是在保障本金及支持流動性的前提下追求收益。一般而言，該政策要求須投資於投資等級之證券，且對單一發行人設定信用曝險金額之上限。台積公司的固定收益投資大部分為固定利率證券，且被分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量或按攤銷後成本衡量之金融資產。分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，其公允價值的變動認列於其他綜合損益；而分類為按攤銷後成本衡量之金融資產，公允價值的變動不影響其帳面金額，惟二者皆須於出售時認列損益。

台積公司大部分的金融債務為固定利率且以攤銷後成本衡量，故利率變動不會影響其未來現金流量或帳面金額。台積公司已經且未來亦可能透過利率衍生性商品來規避部分固定收益投資及預期發行之債務的利率風險，但此避險操作僅能降低少部分因利率波動造成的財務影響。

- **匯率變動**

台積公司幾乎所有營收皆為美元計價，且超過一半以上的資本支出係以非新台幣支付，主要為美元、歐元及日幣。因此，新台幣對這些貨幣的任何重大不利波動，尤其是美元對新台幣走弱，對台積公司以新台幣表達之營收及獲利可能造成不利影響。舉例來說，根據台積公司民國一百一十四年的營運結果，美元對新台幣每貶值1個百分點，會造成台積公司的營業利益率下降0.3個百分點。

相反地，當美元相對其他主要貨幣大幅升值時，對台積公司的客戶及台積公司本身所提供之產品和服務需求可能會降低，並因此對台積公司的營收造成不利影響。台積公司使用外幣衍生性金融商品合約，包括遠期外匯合約或外匯交換合約等，及非衍生性金融工具，例如外幣借款及銀行存款等，來規避非新台幣計價之貨幣性資產與負債、國外營運機構淨投資以及部分預期交易可能產生之匯率風險。這些避險可減少資產及負債受匯率變動的影響，但無法完全消除。

新台幣對美元的匯率變化也可能會對台積公司普通股股價轉換成美元之價值、美國存託憑證之股價及新台幣現金股利轉換成美元後之價值產生影響。

- **通貨膨脹**

台積公司的通貨膨脹風險主要來自生產產品所需之原物料與機器設備成本、薪資及員工福利費用、電費以及建廠相關成本的上漲。雖然通貨膨脹之影響目前並未對台積公司之財務狀況及營運成果造成重大影響，然若通貨膨脹持續升溫，而台積公司的產品與服務之銷售價格未有與成本相對應之上漲，則可能會對台積公司的獲利產生不利影響。

- **稅務法規變動或實施新稅法**

於台積公司經營業務的國家或地區內，若現行稅務法規有進行修訂或實施新稅法的情形時，可能會對台積公司的獲利產生不利影響。

台積公司在世界各地經營與拓展業務，同時遵循各個營運據點所屬國家之稅法規定。由於主要的營運與製造活動是在台灣，所以台積公司主要是受到中華民國政府稅法之規範，稅法和法規的任何不利變動都會增加公司的有效稅率，並對經營成果產生不利影響。經濟合作暨發展組織（OECD）開展中的稅基侵蝕與利潤轉移（BEPS）行動計劃，可能讓外國司法管轄區的稅法發生變動，進而增加台積公司稅負的不確定性，並對經營成果產生不利影響。

為了控管稅務風險，台積公司一直密切注意任何可能影響公司財務的國內外政策與法令，同時訂定風險管理程序，蒐集資訊、分析潛在的稅務影響，並研擬因應對策。

融資之風險

在市場不穩定時，台積公司未必能以商業上合理的條件及時獲得足夠的融資。若此情形發生，且台積公司又需透過融資以支應公司的資本需求時，則台積公司可能被迫於獲得融資前削減、修改或是延遲產能擴充計劃。

高風險／高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易之風險管理及因應措施

民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司並未從事高風險／高槓桿的財務投資；台積公司所從事的衍生性金融商品交易均是以避險為目的，而不是交易或投機性之操作；台積公司及本公司之子公司所從事之背書保證與資金貸與均是提供予本公司及／或本公司百分之百持有之子公司，這些背書保證與資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。

為了控管財務交易風險，台積公司已依據金融監督管理委員會的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運管理為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

減損損失之風險及因應措施

依據Taiwan-IFRSs，當有資產減損之跡象發生時，公司必須針對其有形資產、使用權資產及無形資產進行減損評估。在符合某些條件之下，台積公司必須認列減損損失。台積公司目前無法預測未來發生資產減損的程度或時間，以及任何必須認列之資產減損是否將對台積公司之稅後淨利產生重大不利之影響。

至於在任何時點進行減損損失之認定時，主要係以當時針對未來數年營運成果所做出的評估來判斷，因此減損損失較可能發生在營運成果已經出現衰退之期間。有形資產、使用權資產及無形資產（商譽除外）之減損評估過程中，台積公司依據資產使用模式及半導體產業特性，估計特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損，任何由於經濟狀況之變遷或公司策略所帶來之估計改變均可能在未來造成重大減損或迴轉已認列之減損損失。

6.2.5 其他風險

台積公司之董事或持股超過10%之大股東，股權之大量移轉或更換對台積公司可能之影響、風險及因應措施

台積公司現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。

截至年報刊印日止，台積公司無持股超過10%之股東。

貿易政策之風險

由於台積公司之營收主要來自於對全球主要經濟體之銷售（請參閱本年報「2.2.4 台積公司之市場定位、差異化與策略」說明第19-21頁），各主要經濟體貿易政策之變動（例如對特定產品提高關稅、執行進出口管控以及採取其他貿易壁壘措施）可能影響台積公司或其客戶的銷售，從而影響台積公司之營運成果。例如，在民國一百一十四年四月，美國總統宣布對來自所有國家進口至美國的貨物徵收百分之十的基準關稅，並根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對美國大多數貿易夥伴徵收稅率不一的對等關稅。對等關稅的徵收延遲至民國一百一十四年八月，儘管前述關稅排除了半導體、半導體製造設備及相關衍生產品（合稱「半導體項目」），但仍然影響了台積公司在美國的營運成本。對等關稅在民國一百一十五年二月被美國最高法院裁定為非法。儘管該裁定否定了IEEPA作為徵稅依據的基礎，但其對美國關稅與貿易方針、國際貿易活動以及全球經濟的更廣泛影響為何仍不確定。在美國最高法院作出裁決後，美國根據《1974年貿易法》第122條徵收了替代性質的新的關稅，美國貿易代表署並於民國一百一十五年三月，根據《1974年貿易法》第301條的權力，針對被指控製造業產能過剩以及未就強迫勞動問題採取行動的多個經濟體，包括台灣，展開了兩項調查，這可能導致針對台灣的貿易行動，例如徵收額外關稅。此外，在民國一百一十四年四月，美國政府針對半導體項目的進口展開了第232條調查，結果在民國一百一十四年十二月頒布公告，對符合特定技術性能門檻的某些先進運算晶片及衍生產品徵收百分之二十五的從價關稅，除非這些產品是為了用於美國國內指定用途而進口。該公告還預示，在進一步的貿易談判後，可能會對半導體項目徵收更廣泛的關稅，並附帶一項關稅抵銷計劃，旨在激勵美國國內製造業。此外，在民國一百一十五年一月，美國宣布與台灣達成貿易與投資協議，該協議把根據IEEPA對台灣商品徵收的對等關稅率降低至不超過百分之十五，另給予投資美國製造的台灣半導體製造商第232條關稅最優惠待遇。然而，有關美國最高法院廢除IEEPA對等關稅的裁決的影響，以及第232條關稅最優惠待遇細節，包括任何抵銷措施具體內容，仍不清楚。對進入美國的半導體和含有晶片成分的產品徵收的任何關稅，都可能導致購買此類產品的成本增加，從而可能導致對台積公司產品和服務的需求下降，並對台積公司的業務和未來增長產生不利影響。而對進入美國的半導體製造設備徵收的任何關稅，都可能導致台積公司美國製造業務的成本增加，並降低台積公司的盈利能力。

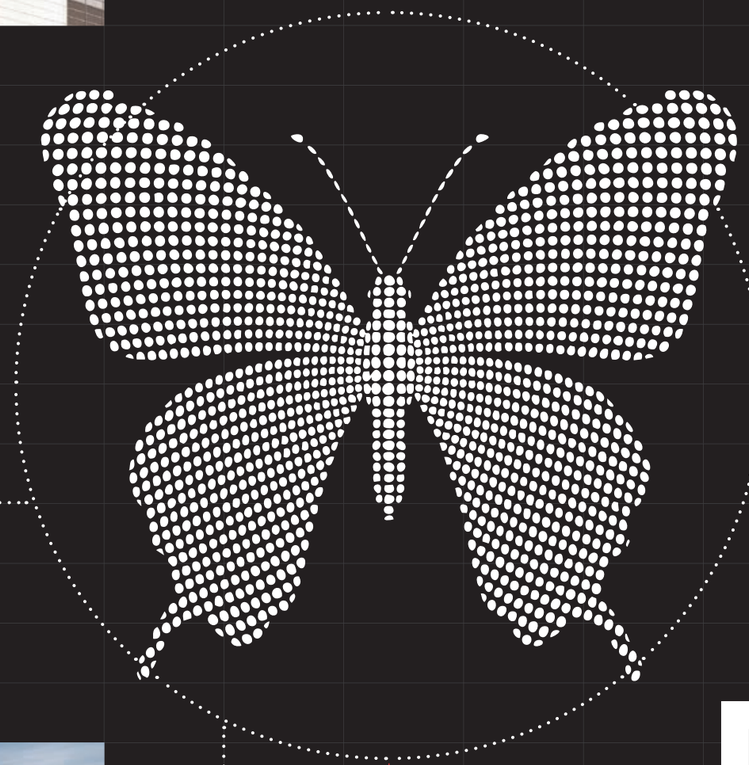
此外，任何針對特定國家和實體施加的出口管制和制裁、任何此類措施域外管轄權的擴張、針對特定實體的半導體銷售禁令，不僅會影響台積公司繼續向這些客戶提供產品的能力，還會影響客戶對我們產品的需求， 甚至可能導致半導體供應鏈的變化。舉例言之，在民國一百一十一年十月及民國一百一十二年十月，美國對於受美國出口管制法規管轄的特定高速運算晶片輸往特定國家（包括中國大陸）時，採取更嚴格的出口管制要求（簡稱「十月規則」），民國一百一十四年一月，美國再次發布出口管制新規以進一步強化其對高速運算晶片出口的限制，根據該等新規，台積公司出口16奈米及以下晶片至世界各國時除符合特定條件得以豁免外，皆須取得美國出口許可，此要求可能會使台積公司的部分產品出貨受到禁止或延遲，從而導致台積公司的營運成果受到不利影響。十月規則並要求運送受美國出口管制法規管轄的物項至中國大陸從事先進製程的晶圓廠，以及美國人員協助此等晶圓廠或特定半導體物項於中國大陸的開發與製造，皆須取得美國政府核發的出口許可。對此，台積公司之南京子公司已取得「經認證終端使用者（Validated End-User, VEU）」之授權，該授權允許南京子公司於取得來自美國之特定出口物項時無需逐筆申請出口許可。雖然該VEU授權已於民國一百一十四年十二月到期，美國商務部接著授予台積電（南京）有限公司（台積電南京）一項年度出口許可證，允許美國出口管制物項供應給台積電南京，這確保了台積電南京晶圓廠營運和產品交付不會中斷。然而，無法保證此年度出口許可證不會被終止，或者將來能夠及時獲得延展。

另一方面，受到貿易管制影響的國家也可能採取反制措施，從而對包括台積公司在內的跨國企業帶來重大的潛在法律風險。舉例言之，中國大陸在民國一百一十年一月發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，該辦法允許中國公民、法人向跨國企業尋求民事救濟，以賠償因該跨國企業遵守外國法律對其造成的損失。

世界各國對貿易加諸的障礙，包括保護主義措施、制裁和進出口管制（包含但不限於前段所述之出口管制措施），可能增加台積公司的生產成本、限制台積公司所需原物料和設備的供應，並降低台積公司產品價格的競爭力，亦可能影響台積公司或其客戶的銷售。民國一百一十四年及截至本年報刊印日止，台積公司的營運成果尚未因此受到擴張的出口管制規定或為因應這些規定而採取的新規則或措施的重大影響。惟隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對台積公司的業務及營運產生負面影響，並可能令台積公司面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

台積公司持續關注近來相關主要經濟體間的貿易政策及措施變動，並將根據後續發展採取相對的因應措施。

CHAPTER



企業永續 (ESG)

台積公司是全球唯一連續24年入圍道瓊領先世界指數組成企業的半導體公司

(原道瓊永續世界指數；截至2026年3月，道瓊領先指數尚未公告其2025年成分股)

7.1 概述

秉持「誠信正直、強化環保、關懷弱勢」三大使命，台積公司積極履行企業公民責任，除謀求本業最大成就，亦致力於ESG（環境Environmental、社會Social、治理Governance）三大面向精益求精，與員工、股東／投資人、客戶、供應商／承攬商、政府／公協會、社區等利害關係人攜手合作，持續創造淨正向效益，共同邁向永續未來。

ESG執行方針

《ESG政策》是台積公司永續營運的最高指導原則，其中由台積公司創辦人張忠謀博士親自定義的「ESG矩陣表」，清楚闡明公司ESG的涵蓋範疇，橫軸代表台積公司期許於「道德、商業水準、經濟、法治、關懷地球與下一代、平衡生活／快樂、公益」七大領域樹立永續典範，縱軸則呈現具體行動，包括誠信正直、守法、反對貪腐／不賄賂／不搞政商關係、環保／氣候行動／節能、重視公司治理、提供優質工作、優質股東回饋、推動員工生活平衡、積極鼓勵創新、提供優良工作環境，以及攜手「台積電慈善基金會」、「台積電文教基金會」投入社會參與，深化共好影響力。

台積公司ESG矩陣表

台積公司＼社會	道德	商業水準	經濟	法治	關懷地球與下一代	平衡生活／快樂	公益
誠信正直	V	V					
守法				V			
反對貪腐、不賄賂、不搞政商關係	V	V		V			
環保、氣候行動、節能				V	V		
重視公司治理		V	V	V			
提供優質工作			V			V	
優質股東回饋			V				
推動員工生活平衡						V	
積極鼓勵創新		V	V				
提供優良工作環境						V	
台積電慈善基金會					V	V	V
台積電文教基金會					V	V	V

ESG管理機制

「ESG指導委員會」由董事長擔任主席、「ESG委員會」主席擔任執行秘書，與多位不同領域的高階主管共同審視公司營運相關的ESG議題，並訂定短中長期策略方向與發展目標，致力結合台積公司核心優勢與聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），推動永續發展。

「ESG委員會」依據ESG指導委員會決議，垂直整合資源並橫向串聯跨部門溝通，指示專責組織「企業永續辦公室」（民國一百零八年設置，並於民國一百一十四年更名）與跨組織管理代表，鑑別利害關係人關注、攸關公司營運且能發揮永續影響力的重大議題，設立任務小組並制訂因應策略、目標與行動方案，透過每季會議追蹤執行進展，確保ESG策略具體落實於台積公司日常營運。「ESG委員會」亦每季向董事會／提名及公司治理暨永續委員會報告ESG執行成果與未來計畫，並汲取回饋與建言以持續精進，進一步深化台積公司永續管理。

民國一百一十四年，台積公司ESG主要管理範疇涵蓋綠色製造與供應鏈管理（包括推動科學基礎減量目標（Science Based Targets, SBT）計畫、促進水資源正效益、加速供應鏈去碳化進程等）、共融職場與培育人才（包括落實職場人權改善行動計畫、精進跨文化學習方案等）、社會投入（例如支持偏鄉科普教育推廣、承攬商工安關懷專案、生物多樣性計畫等），以及民國一百一十四年及一百一十五年ESG預算執行與規畫。此外，台積公司以永續報告書為ESG管理工具，並首次發布《責任供應鏈報告》，同時更新《氣候暨自然報告》、《聯合國永續發展目標行動報告》、《永續影響力評價報告》、《人權報告》，以多元的主題式報告回應利害關係人關注議題，共創永續價值。

利害關係人互動與經營

台積公司重視利害關係人權益，建立「Sustainability網站」、「ESG信箱」、「員工意見反映管道」、「違反從業道德行為舉報系統」、「投資人信箱」、「客戶滿意度調查」及「供應鏈員工申訴管道」等多元的溝通平台，並於重大性分析流程中，將利害關係人對永續議題的關注度納為鑑別重大議題的重要維度之一，系統性瞭解並掌握各利害關係人的意見與期待。

民國一百一十四年台積公司與利害關係人的溝通管道

利害關係人	溝通管道
員工	●台積電核心價值員工意見調查、全球員工意見調查 ●職場人權氛圍調查、風險意識文化調查 ●員工教育訓練（論壇、講座、實體與線上課程） ●晶圓會議（勞資會議） ●各組織／階層主管對同仁溝通會，如經營團隊溝通會及組織內各層級溝通會等 ●人力資源業務夥伴及人力資源員工夥伴團隊 ●公司內部網站、電子郵件及公告、實體與電子公布欄 ●提供多元意見溝通管道，如晶圓會議反映管道、員工申訴直通車（Ombudsman）、吹哨者舉報程序、違反從業道德行為舉報系統、性騷擾申訴處理委員會、各廠區馬上辦中心／員工意見箱／各廠健康中心／健康中心網站等
股東／投資人	●股東大會 ●公司年報、永續報告書、主題式報告書（氣候暨自然報告、聯合國永續發展目標行動報告、重大性分析報告、永續影響力評價報告、人權報告、責任供應鏈報告）、美國證期局20-F報告書 ●法人說明會 ●海內外投資機構研討會 ●面對面會議、視訊會議及電話溝通會議、投資人信箱 ●公開資訊觀測站發布重大訊息或於公司網站公布公司各項新聞
客戶	●客戶滿意度調查 ●商業及技術評核 ●客戶會議 ●客戶拜訪或稽核
供應商／承攬商	●環保安全衛生訓練 ●供應商自我評估管理問卷 ●供應商人權精進工作坊及論壇 ●供應商行為準則與永續標準宣導 ●永續供應鏈環安衛論壇、供應鏈環安衛技術論壇 ●關鍵排放源供應商減碳追蹤會議 ●工地安全分享會 ●供應商會議 ●現場輔導稽核 ●供應鏈員工申訴管道 ●Supply Online 360全球責任供應鏈管理平台
政府／公協會	●公協會溝通平台 ●公文、文件或電子郵件往來與參訪 ●提供產業經驗與建言、專題演講 ●會議（例如說明會、公聽會、座談會、研討會、聯誼會、電話溝通）
社區	●志工幹部會議、志工服務活動 ●專案合作與拜訪 ●贊助各項公益、教育專案 ●「把愛送出去」公益平台 ●台積電文教基金會及台積電慈善基金會官方網站 ●Sustainability網站與電子報、ESG信箱、社群網站（臉書與LinkedIn） ●違反從業道德行為舉報系統

ESG指導委員會與ESG委員會成員責任

委員會成員	負責範圍	利害關係人
業務開發	引領訂定具備能源效率的技術藍圖；與客戶聯盟合作，促進更智慧化、更環保的產品創新；成為善盡企業責任的技術領導者，並對外分享相關經驗與成果	員工 客戶 社區
客戶服務	客戶服務與滿意、客戶信任、客戶隱私、負責任商業聯盟及其行為準則	客戶 政府／公協會
環境安全衛生	環境政策與管理系統、全球氣候變遷減緩與調適、污染防治、能源使用效率、碳排放與碳權管理、產品環境責任、環境問題反映機制、環保支出、綠色供應鏈；職業安全衛生政策與管理機制、作業場所安全、職業病預防與健康促進；環保、安全與衛生法規溝通	員工 股東／投資人 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會 社區
財務	財務資訊揭露、股利政策、稅務相關策略	員工 股東／投資人 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會
人力資源	共融職場、人才吸引及留任、人才發展	員工 政府／公協會 社區
企業資訊技術	資訊安全	員工 股東／投資人 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會
投資人關係	妥善處理投資人關心議題、建立長期互信關係、經營有效的雙向溝通、年報編製	股東／投資人
法務	公司治理、從業道德規範、法規遵循（如公平競爭、隱私與個人資料、舉報者保護）、智慧財產、機密資訊保護	員工 政府／公協會 社區
資材管理	原物料與供應鏈風險管理、供應商管理、衝突礦產、負責任商業聯盟及其行為準則、資源循環	股東／投資人 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會
營運	營運環保效率、污染防治、水資源正效益及風險管理、綠色製造	股東／投資人 客戶 供應商／承攬商
公共關係	利害關係人互動與經營、社會衝擊問題申訴機制、媒體關係	員工 股東／投資人 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會 社區
品質暨可靠性	產品品質與可靠性、產品召回管理機制	客戶 供應商／承攬商
研究發展	創新管理、綠色產品	員工 客戶 供應商／承攬商 政府／公協會
風險管理	風險管理、危機處理、緊急應變程序與行動計畫	員工 股東／投資人 客戶 供應商／承攬商
台積電文教基金會	青年培育、教育合作、藝文推廣	社區
台積電慈善基金會	教育培力、健康長壽、保育環境	社區

台積公司接軌全球永續揭露趨勢，已連續第27年發行非財務報告書，展現長期永續承諾。民國一百一十三年，啟動IFRS永續揭露準則導入計畫，成立跨部門專案小組，致力提升資訊透明度；民國一百一十四年，依循IFRS永續揭露準則第S1號（永續相關財務資訊揭露之一般規定）及第S2號（氣候相關揭露），鑑別永續及氣候的風險與機會，評估其財務影響，同時訂定管理指標與目標，持續精進永續管理與資訊揭露，並依台灣主管機關規範定期向董事會匯報執行進度。

台積公司遵循GRI 3重大主題（GRI 3: Material Topics 2021），並參考世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）的動態重大性與歐洲永續發展報告準則（European Sustainability Reporting Standards, ESRS）的雙重重大性原則，以「利害關係人關注度」、「組織營運衝擊」與「永續發展衝擊」三重維度，建構重大性矩陣。鑑別範疇涵蓋台灣廠區（總部、台灣地區所有晶圓廠及先進封測廠）、台積電（中國）、台積電（南京）、TSMC Arizona、TSMC Washington, LLC、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.、采鈺公司及其他子公司，辨識台積公司重大議題，做為永續管理方向指引，同時結合機會與風險雙重視角，規劃議題發展策略並設定永續目標，透過跨部門合作，深化永續影響力。

台積公司的永續報告書編撰除依循GRI準則外，亦遵循氣候相關財務揭露建議書（TCFD Recommendations）、自然相關財務揭露建議書（TNFD Remmendations）、永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）準則及AA1000當責性原則標準（AA1000 AccountAbility Principles），並運用「衝擊報導與投資標準架構（Impact Reporting and Investment Standards, IRIS+）」評估社會投入專案，同時經第三方立恩威國際驗證股份有限公司驗證，其驗證項目及範圍依據DNV VeriSustain™ Protocol、GRI準則、SASB指標及TCFD架構，透過各項標準與驗證機制，確保永續資訊揭露完整透明。

呼應全球永續發展規範，台積公司持續強化ESG治理架構與內控機制，推動數位轉型，並導入數據管理工具，驅動更具效率的永續管理模式，並將ESG理念融入研發、製造、人才發展及供應鏈管理等營運各面向，由內而外落實環境保護、社會責任與公司治理，致力實現永續成長。此外，做為全球唯一連續24年入選道瓊永續世界指數成分股的半導體公司，台積公司不斷深化永續創新，專注實踐ESG五大方向－「綠色製造、建立責任供應鏈、打造健康共融職場、培育人才、關懷弱勢」，透過具體行動創造實質且正向的影響力，攜手利害關係人共同驅動美好的改變。

民國一百一十四年ESG獎項與評等

類別	授獎／評等單位	獎項／評等
ESG	道瓊領先指數	• 道瓊領先指數組成企業（連續24年）
	MSCI精選指數	• MSCI ESG Research的MSCI ESG評等－AA評等 • MSCI全球精選指數成分股 • MSCI新興市場精選指數成分股
	Sustainalytics	• 企業ESG風險評等「低風險」－半導體業
	ISS ESG	• 企業評比「最佳」等級
	富時永續指數系列（FTSE4Good）	• FTSE4Good新興市場指數成分股 • FTSE4Good環球指數成分股 • FTSE4Good臺灣永續指數成分股
	世界標竿聯盟（World Benchmarking Alliance）	• 全球2000大最具影響力公司（SDG2000）
	S&P Global	• 2025永續年鑑－Sustainability Yearbook Member
	時代雜誌（TIME）	• 董事長暨執行長魏哲家博士入選《時代雜誌》AI百大影響力人物
	台灣永續能源研究基金會	• 台灣十大永續典範企業獎首獎 • 台灣100大永續典範企業獎 • 年度最佳報告書 • 循環經濟領袖獎 • 資訊安全領袖獎 • 永續供應鏈領袖獎 • 水資源管理領袖獎 • 氣候領袖獎
	晨星（Morningstar）	• 2026最值得持有永續發展企業

（接次頁）

類別	授獎／評等單位	獎項／評等
經濟、公司治理	Extel 2025 All-Asia Executive Team	• 亞洲最受尊崇企業第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳執行長第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳財務長第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳投資人關係經理人第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳投資人關係團隊第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳投資人關係方案第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳ESG方案第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票 • 亞洲最佳公司董事會企業第一名（科技／半導體業）－機構投資人及券商分析師投票
	IFI Claims Patent Services	• 2025美國前50大專利權人第二名
	富比世雜誌（Forbes）	• 全球2000強企業名單
	財富雜誌（FORTUNE）	• 2025全球最受推崇企業之一 • 全球500大企業
	品牌金融（Brand Finance）	• 2025全球品牌金融500強
	今周刊	• 兩岸三地1000大企業
	臺灣證券交易所	• 「公司治理評鑑」前5%公司
	資誠聯合會計師事務所	• 全球市值百大企業
	經濟部智慧財產局	• 本國專利申請排名第一名 • 本國專利獲准排名第一名
	經濟部產業發展署	• 台灣智慧財產管理規範（TIPS）AAA級驗證通過
	德國聯邦資訊安全局	• 資訊共同安全準則（ISO/IEC 15408 EAL6）廠區驗證
	財團法人中衛發展中心	• 台灣持續改善競賽「金塔獎」－晶圓二廠、晶圓五廠、晶圓十二A廠、晶圓十四A廠 • 台灣持續改善競賽「銀塔獎」－晶圓六廠、晶圓十八B廠、研發製程中心及會計處 • 台灣持續改善競賽「最佳改善創新獎」－晶圓二廠、晶圓五廠、晶圓十二A廠、晶圓十四A廠、晶圓十六廠
	科睿唯安（Clarivate）	• 2025全球百大創新機構
	律商聯訊（LexisNexis）	• 2025全球百大創新動能企業
環保安全衛生	企業騎士（Corporate Knights）及As You Sow	• 2025清淨低碳全球200大企業
	CDP	• 氣候變遷B等級 • 水安全A-等級 • 供應鏈管理A等級
	Alliance for Water Stewardship, AWS	• 白金等級認證－晶圓五廠、晶圓六廠、晶圓十二A廠、晶圓十二B廠、晶圓十四廠第五、六、七期廠房、晶圓十五A廠、晶圓十五B廠、先進封測三廠
	美國綠建築協會	• 「能源與環境設計先導（Leadership in Energy and Environmental Design, LEED）」評量系統「黃金級」認證－晶圓十二廠、晶圓十四廠、晶圓十五廠、晶圓十八廠、晶圓二十三廠、先進封測廠，共57座廠房與辦公大樓
	UL Solutions	• UL 2799鉑金級－台灣廠區、台積電（中國）、台積電（南京）
	環境部	• 國家企業環保獎巨擘獎－晶圓十四B廠 • 國家企業環保獎金級獎－晶圓八廠、晶圓十五廠、晶圓十八廠第一期 • 淨水永續獎－晶圓十五B廠 • 綠色採購績優企業－晶圓二廠、晶圓三廠、晶圓五廠、晶圓八廠、晶圓十二A廠、晶圓十四廠、晶圓十五B廠、先進封測六廠
社會	富比世雜誌（Forbes）	• 2025全球最佳雇主之一
	天下雜誌	• 天下人才永續獎：大型企業製造業組第二名
	遠見雜誌	• ESG職場共融組首獎

7.2 環保、安全與衛生管理

台積公司相信在推動環保、安全與衛生業務時，不但必須符合相關法令規範，也需與國際認同的標準接軌。台積公司的環保政策及安全衛生政策目標在於達成「環境永續發展」及「安全零事故」，並成為世界級環保、安全與衛生管理的標竿企業。為達此目標，台積公司的策略是「遵守法規承諾、促進安全健康、強化資源利用及污染預防、管控環安衛風險、深植環安衛文化、建構綠色供應鏈、善盡企業公民責任」。

台積公司與子公司所有廠區均已取得「環境管理系統」（ISO 14001: 2015）及「職業安全衛生管理系統」（ISO 45001: 2018）驗證。位於台灣的所有廠區及子公司廠區亦已取得「台灣職業安全衛生管理系統」（Taiwan Occupational Safety and Health Management System, TOSHMS）驗證。台積公司落實節約能源，自民國一百年開始導入「ISO 50001能源管理系統」，並取得第三方驗證持續維持其有效性。前述所有驗證，台積公司持續維持其有效性。依據台積公司政策，新建廠必須於取得工廠登記證後的18個月內取得這些驗證。

台積公司秉持不斷精進的精神，積極尋求強化在因應氣候變遷、污染預防與控制、能源及資源節約、廢棄物減量與回收再利用、安全衛生管理、火災爆炸預防及地震危害防阻等各方面的表現，以降低整體的環保、安全與衛生風險。

為因應法規以及客戶對有害物質管理的要求，台積公司自民國九十五年起導入有害物質流程管理系統（IECQ QC 080000 Hazardous Substance Process Management System），目前所有廠區均取得認證並持續維持其有效性。此管理系統使台積公司可確保產品符合客戶及國際法規要求，包括歐盟的有害物質限用指令（Restriction of Hazardous Substances, RoHS）、歐盟化學品註冊、評估、許可和限制法案（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH）、蒙特婁議定書之臭氧層破壞物質（Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer）、電子產品無鹵素標準（The Halogen-free in electronic products initiative）、全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）及其相關物質限制標準等。此外，台積公司持續推動危害物質N-甲基吡咯烷酮（N-Methylpyrrolidinone, NMP）濕蝕刻製程廢止使用計劃，至民國一百一十四年底，僅剩一特殊製程仍努力進行替代評估並預計於民國一百一十五年完成。

台積公司致力於建構最健康職場環境，於民國一百零六年成立公司層級健康促進委員會，依職業病案例或其他健康相關議題不定期召開會議，由副總級主管主持，成員涵蓋各廠廠長、安全衛生環保部門主管、健康中心、人力資源、法務等代表，並邀請外部專家共同探討半導體製程可能衍生的職業疾病風險及擬定職業疾病預防計劃。為了降低員工、供應商、承攬商於工作場所可能的健康風險，台積公司採取嚴格的安全衛生管控措施，以預防職業傷害與疾病，促進員工安全與身心健康。

為降低供應鏈風險與善盡企業公民責任，台積公司不只是做好自身的環境、安全與衛生管理，亦透過稽核與輔導，致力於全面提升供應商及承攬商的環保安全衛生水準。

針對承攬商施工採行重點管理及自主管理，台積公司要求承接第一級高風險工程的承攬商，必須建構ISO 45001管理系統且完成施工人員的技能認證後始得施作，藉此加重承攬商自主管理的責任感，進而提升整個業界對安全文化與技能素質的意識。台積公司每年針對廠務駐廠人員，執行安全意識提升計劃，不但將安全訓練課程標準化，並設計互動式線上教學方式，同時提高教育訓練頻率，以達到強化安全意識及訓練有效性的目的。台積公司亦建立承攬商電子化雙向溝通平台、承攬商安全衛生藍皮書、傷病關懷程序並強化工作安全分析，確保台積公司現場施工的安全規定可以即時且正確地傳達給承攬商，提升施工安全並降低現場作業風險。

台積公司與供應商攜手合作，全面推動供應鏈永續管理。此管理體系涵蓋多個關鍵環節：從制定嚴謹的供應商永續標準、擬定查核計劃、執行查核與追蹤改善，到提供專業輔導與訓練，確保供應商持續進步，對於績效有待提升者，更會提供深入的再輔導，以共同達成永續目標。其中提升供應商環安衛技術能力、火災自主應變、廢水排放強化與生物多樣性議題為民國一百一十四年度重點項目，為實現這些目標，公司為中小企業舉辦了一場關鍵風險研討會，共有來自47家供應商的58名參與者；同時，公司繼續開展面向高級管理人員的供應商ESH改進計劃，吸引了來自五家供應商的26名參與者。此外，連續十年邀請供應商參與台積公司年度緊急應變演習觀摩（累計人數達240位參與者來自234家供應商）、供應鏈永續環安衛論壇及優良案例分享（443位參與者來自230家供應商）並持續舉辦供應鏈環安衛技術論壇針對常見環安衛與ESG熱門議題提供解決方案（217人參與）。台積公司針對供應商製造場域進行環安衛稽核，並積極協助供應商改善環安衛之績效。此外，台積公司亦積極監控供應鏈面臨的氣候變遷潛在風險。我們要求供應商實施碳盤查，並大力鼓勵其推動節能、減碳、省水及減廢等措施，以期共同應對氣候挑戰。

7.2.1 環境保護

氣候變遷與能源管理

● 氣候相關財務揭露

有鑑於氣候變遷對營運可能造成的財務風險，台積公司自民國一百零七年起，開始運用金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）的氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）來鑑別風險及機會，並依鑑別結果建立衡量指標與目標管理。

台積公司氣候相關風險與機會之管理架構

類別	公司管理策略與行動
治理	董事會定期審視氣候變遷相關的風險與機會 ● ESG指導委員會：台積公司氣候變遷管理的最高組織，由董事長擔任主席，ESG委員會主席出任執行秘書，每季審議台積公司氣候變遷策略與目標，並且向董事會／提名及公司治理暨永續委員會報告 ● 節能減碳委員會：台積公司執行及管理氣候變遷風險與機會行動的組織，由營運組織的高階主管擔任主席，每季擬定管理方案、檢視執行狀況與討論未來計劃
策略	透過跨部門討論與鑑別短、中、長期的氣候風險與機會
	運用情境分析，評估重大氣候風險與機會對公司帶來的潛在營運與財務衝擊
	推動低碳製造，邁向淨零排放，並強化氣候韌性
	透過溝通與輔導，提升供應商氣候風險意識與因應能力，並與供應商進行合作，研擬與執行具體減碳作為
風險管理	利用TCFD架構建立台積公司的氣候風險辨識流程
	依據氣候風險之鑑別與排序結果，設定相關因應方案
	將氣候風險鑑別與評估納入企業風險管理（ERM）流程
指標和目標	設定氣候變遷相關的管理指標
	擬定台積公司與供應商減碳目標，定期檢視達成目標的進度

氣候變遷風險與機會財務影響分析與因應

氣候風險	潛在財務影響	氣候機會	潛在財務影響	民國114年因應作為
溫室氣體總量管制與碳稅、碳費	產能擴增受限、營運成本增加	● 參與再生能源計劃 ● 參與碳交易市場	早期購買再生能源，順利擴增產能	● 在台灣簽署再生能源合約已達730萬瓩（7.3 GW） ● 使用約57.8億度再生能源，再生能源使用比例提升至20.1% ● 連續第八年達到海外子公司及全球辦公室100%使用再生能源
淨零排放	● 減碳設備設置與運轉成本增加 ● 購買抵碳產品費用增加	取得公部門獎勵與碳排放抵減合作	累積未來排放抵減所需碳權	● 累計取得含氟溫室氣體與氧化亞氮削減抵換碳權近150萬噸 ● 海外廠購買約31.4萬噸碳權，其中約23.4萬噸，用以抵減範疇一碳排放，達到淨零排放
		開發低碳產品服務，提升客戶產品能效	滿足客戶對節能產品需求，增加營收	● 開發3奈米及2奈米等更先進製程節能產品
環境影響評估承諾	因為再生能源與再生水取得不順，導致先進技術生產受阻	使用再生水	順利建設先進產線	● 使用再生水2,353萬立方公尺／年
新節能減碳技術發展不確定	新製程技術產線用電量提升，導致營運成本增加	興建綠建築	降低營運水電成本	● 取得七張綠建築證照
公司聲譽衝擊	無法滿足利害關係人期待，造成公司聲譽損害	提升企業聲譽	提升利害關係人對台積公司永續評比成績	● 全球唯一連續25年入選道瓊永續發展指數成分股的半導體企業
旱災（自身營運）	生產受影響，導致財務損失、營收下降	提升天災抵禦韌性與能力	強化氣候韌性，降低營運中斷機率與可能損失	● 晶圓二十二廠第二期基地提高5公尺，降低水災風險 ● 晶圓二十廠、二十二廠承諾使用再生水 ● 輔導供應商評估營運設施旱災／水災風險，並執行相關降低風險行動 ● 依據旱災緊急應變措施進行演練
旱災（供應鏈）				
水災（自身營運）				
水災（供應鏈）				
氣溫上升	用電量增加，成本與碳排放量上升	推動低碳綠色生產	節約用電，節省成本	● 節能專案節電約9億度

溫室氣體排放減量與能源管理

台積公司致力成為全球綠色製造的領導者。面對極端氣候帶來的威脅，台積公司從自身做起，訂定管理策略和目標，確立執行控管、建立永續文化。民國一百一十年，台積公司提出「民國一百三十九年淨零排放」的長期目標，並同步設定「民國一百一十四年排放零成長」的短期目標，積極落實各項排碳減量作為，以期於民國一百一十九年碳排放量回歸民國一百零九年水準。

台積公司主動參與世界半導體協會的倡議，並從過往經驗中彙整出全氟化物（PFCs）減量的最佳標竿作為，全面從民國一百零一年起導入施行。民國一百零七年，依據環境部「溫室氣體抵換專案管理辦法」，針對廠區內所執行的溫室氣體減量績效提出認證申請，自民國一百一十一年起累計取得抵換專案減量額度150萬噸二氧化碳。此額度可抵減環境影響評估法中對於新建廠溫室氣體減量的要求，協助公司永續經營並減緩氣候變遷風險。

民國九十四年起，台積公司全面執行溫室氣體盤查，並取得ISO 14064認證。根據廠區每年溫室氣體盤查的結果顯示，主要的直接溫室氣體排放源為半導體製程中廣泛使用的全氟化物，間接排放源則主要來自於電力使用。透過分析盤查所得資料，除可瞭解是否符合國內法規申報要求外，亦是台積公司溫室氣體減量策略的參考基準。台積公司自民國九十四年起已連續21年參與國際揭露與評比機構－CDP，公開揭露氣候變遷管理相關訊息，並藉此持續檢討精進管理作為。

為回應對全球氣候峰會「巴黎協議」的承諾及因應台灣於民國一百零四年公布之「溫室氣體減量及管理法」，台積公司於民國一百零五年成立跨組織的碳管理平台，以法規遵循、節能減碳與碳權取得作為三大工作方向，除積極參與國內各項法規的諮詢與溝通會議外，並成立由營運組織高階主管領導的「節能減碳委員會」規劃短中長期減量目標，交付各晶圓廠節能減碳小組實際執行各項措施。由於台積公司總溫室氣體排放量八成以上源自於電力，所以節能減碳一直是台積公司努力的重點。不僅在新建廠房及辦公室採用節能設計，在營運上亦持續提升工廠能源效率，這些措施除能節省成本，同時也達到減少二氧化碳排放量之目的。自民國一百零五年起，台積公司累計節能已達56億度電。台灣於民國一百一十二年將「溫室氣體減量及管理法」更名為 「氣候變遷因應法」並修正條文，設定民國一百三十九年台灣實現淨零排放的目標，並建立了碳費制度。民國一百一十三年也陸續公告與碳費相關的三項子法，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，並公告碳費徵收費率。對直接和間接排放量達到一定閾值的排放者，自民國一百一十四年開始徵收碳費。鑒於台積公司台灣各廠區的排放量皆超過目前法規徵收閾值，我們將於民國一百一十五年首次支付碳費。台積公司除持續厚植綠色管理於日常運轉，依淨零路徑積極執行各項溫室氣體減量標竿作為外，也將依規定提出自主減量計畫，取得優惠費率以減緩對於公司的財務影響。

民國一百零七年起，台積公司開始積極向台灣再生能源業者洽談購買再生能源，期望於民國一百一十九年底前達到「全公司60%用電量為再生能源」，進而落實民國一百二十九年底前100%使用再生能源的長期承諾。在過去的八年，台積公司海外生產基地與辦公室透過購買再生能源、再生能源憑證與碳權，已全部抵銷用電產生的碳排放，民國一百一十四年，台積公司所有海外據點達成淨零排放。台灣再生能源發展已經進入積極規劃與建設階段，台積公司藉由成立再生能源專案小組，持續與政府溝通，提供政府再生能源發展相關建言，期望與政府合作，加速台灣再生能源發展。台積公司持續洽購再生能源，至民國一百一十四年底，已完成簽約再生能源總裝置容量達730萬瓩（7.3GW），俟相關商業程序完成後，陸續轉供再生能源給台積公司，明確展現出台積公司對聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的積極支持。

台積公司溫室氣體減量目標與達成情形

策略	民國119年目標	民國114年目標及成果	達成情形
持續採用最佳技術減少溫室氣體排放，成為產業低碳製造標竿	單位產品溫室氣體排放量（公噸-二氧化碳當量／十二吋晶圓當量-光罩數）減少30%（基準年：民國109年）	單位產品溫室氣體排放量（公噸-二氧化碳當量／十二吋晶圓當量-光罩數）較基準年增加2%（目標：-10%）	未達成（註）

註：受先進製程產能與碳排量增加、減量計畫與再生能源尚不足以達到目標所需，故未達年度目標，將持續落實節能減碳各項措施。

空氣及水污染防治

台積公司各晶圓廠均設置空氣及水污染防治設備，並符合法規排放標準。此外，各種污染防治設備亦擁有緊急電源在內的備援系統，以降低若設備故障時造成污染物異常排放的風險。台積公司也將所有水污染防治、空氣污染防治設備的運轉狀況，納入中央監控系統，由每日24小時的輪值人員監控，並將系統效率檢知資訊列入重點追蹤項目，以確保空氣及廢水的排放品質。

為了更加強化水資源的永續，台積公司引進可持續水管理標準（AWS Standard），民國一百一十四年，台積公司位於台灣竹中南三座科學園區的AWS認證廠（註）皆取得白金級AWS認證。

為推動水資源永續與秉持台積公司「水宣言」策略，台積公司積極落實環境教育，於民國一百一十四年首次為推廣環境教育而設立對外公開「台積公司環境教育網站」，民眾與機關團體可透過網站了解台積公司的環境教育課程及活動及教育推廣資訊。為全面推動水管理的環境教育理念，「台積電南科再生水廠環境教育學習園區」針對不同年齡層設計多元的水資源學習課程，透過多元化課程及分齡教育形式，提升社會對水資源永續利用的認知與參與度。民國一百一十四年，台積電南科再生水廠已舉辦71場環境教育活動，吸引2,971名參與者，展現台積公司在水管理領域的積極作為與推廣成果，致力於推動水資源永續利用並強化社會環境意識。民國一百一十四年，台積公司持續落實「提升系統產水率、廠務系統排水減量、增加廠務廢水回收、降低系統排水損失」四大節水措施，整體廠務系統增加673萬立方公尺節水量。

善用每一滴水資源是台積公司的水管理目標。除積極落實製程節水外，台積公司攜手產官學單位推動再生水技術發展，並參與台灣科學園區同業公會專業委員會活動，與半導體同業分享節水經驗，共同推動節水，確保園區長期水資源供需平衡。

台積公司於民國一百一十三年正式將「水資源正效益（water positive）」納入水資源管理核心策略，透過開發多元水資源、回收再利用與執行外部水資復育計劃，使補充回饋至當地生態系統的水量大於或等於營運取水量，以在地化策略積極投入水資源復育。例如，JASM於日本熊本致力於地下水復育，已於民國一百一十四年達到800萬立方公尺復育量；TSMC Arizona廠區則透過鹽河水流域改善，提升當地區域用水效率。同時，南科廠區陸續於民國一百一十一年和一百一十二年引入永康及安平再生水，民國一百一十四年再生水日供應量可達6.7萬立方公尺，截至一百一十四年底已取用2,353萬立方公尺再生水，使台灣廠區的替代率達18%。

此外，台積公司與台南市水利局合作採用創新跨區域工業用戶再生水交換模式。由於仁德再生水廠距南科園區超過30公里，且供水量能較低，直接鋪設管線經濟效益不高。因此，台積公司購買仁德再生水並供應鄰近用戶使用，以換取等量自來水額度。仁德再生水廠已於民國一百一十四年九月正式通水，再生水日供應量達0.8萬立方公尺，不僅省下建置管路費用與長距離運輸能耗，亦縮短交通影響時間，展現台積公司全力支持多元水資源政策，持續推動水資源永續管理與創新應用。

註：台積公司AWS認證廠區包括先進封測三廠、晶圓五廠、晶圓十二A/B廠、晶圓十五A/B廠、晶圓六廠、晶圓十四B廠及晶圓十四廠七期等，涵蓋竹中南科所有廠區所在地流域。

最近二年度台積公司用水量統計

年度	總用水量（百萬立方公尺）（註一）	單位產品用水量（公升／十二吋晶圓當量-光罩數）
114年	151	153.3
113年	129	161.0

台積公司用水減量目標與達成情形

策略	民國119年目標	民國114年目標及成果	達成情形
執行減緩氣候風險方案，持續落實日常節水與缺水調適，並開發多元水資源，以及執行外部水資源復育計劃，減少水資源風險	單位產品用水量降低30%（公升／十二吋晶圓當量-光罩數）（基準年：民國99年）	單位產品用水量上升8.8%（目標：-2.7%）	未達成（註二）
	全球水資源正效益達成率65%以上（註三）	全球廠區水資源正效益達成率為21%（目標：17%）	超越目標

註一：包含台積公司台灣廠區與子公司自來水與再生水使用量總和。
註二：受全球景氣循環影響，民國一百一十四年台積公司產能利用率尚未回穩，單位產品用水量未達年度目標，將持續開發多元水資源以降低自來水用量。
註三：因全球擴張及新廠初期運營影響單位產品用水量未達預期，為更宏觀衡量水資源管理成效，台積公司將核心目標轉為聚焦全球水資源正效益達成率，以更全面地評導永續發展策略。

廢棄物管理與資源回收

隨著台積公司近年持續開發先進製程以及於國內外快速擴充產能，廢棄物產出量亦同步攀升，主因在於新製程開發更為複雜、良率穩定度要求以及原物料使用需求增加。

為達到資源永續利用目標，台積公司成立一專責單位統籌廢棄物再利用及清除處理，以製程減廢、廠內再生、廠外回收再利用為優先，無法回收再利用者才進行委外焚化及掩埋處理。另外，亦整合廠務、製程與資源循環管理單位的跨組織合作成立「廢棄物管理指導委員會」，每年年初訂定減量目標及改善計劃，透過調整機台參數、優化製程技術與延長使用週期等措施，減少原物料用量。而民國一百一十四年透過優化異丙醇廢液機台排水設定，每月成功減少約200公噸產出。民國一百零六年，為強化廢棄物流向掌控並降低委外處理廠商未妥善處理之風險，台積公司通過修改公司章程，新增化學材料等四類營業項目，同時設置廠內資源活化設施，將製程活動中所產出廢棄資源轉製成產品，直接提供廠內或販售給其他產業使用。台積公司針對硫酸銅廢液、硫酸鈷廢液、硫酸廢液、硫酸銨廢液、氫氟酸廢液轉製為再生產品，成為廢棄資源回收再製的標竿，同時持續優化再生系統，例如推動「廢硫酸回收系統2.0版」升級，顯著降低設備腐蝕率及催化劑用量，也縮短化學反應時間。繼民國一百一十二年、一百一十三年成功將環戊酮廢液、四甲基氫氧化銨廢液再製為電子級產品，民國一百一十四年更攜手供應商優化蒸餾塔製程技術，找出最佳操作條件強化蒸餾塔的雜質分離效果，有效去除廢液中的混酸與金屬離子，使其符合電子級回用標準，成功將異丙醇廢液轉製為符合台積公司製程品質標準的電子級產品，已陸續導入晶圓廠區使用，打造綠色循環再生體系。此外，台中「零廢製造中心」已於民國一百一十三年正式商轉，涵蓋有機溶劑熱回收廠、氟化鈣污泥、氧化矽污泥及異丙醇回收廠共四大處理廠區，將製程產出的廢棄物轉製為工業級原物料，以及評估發展電子級再生化學品重回半導體製程使用，減少6萬公噸的廢棄物委外處理量。而為鼓勵供應商提升資源再生技術，台積公司亦建立以租代買的循環採購機制，與環境部資源循環署合作首創「化學品租賃」商業模式，其中「廢活性碳再生回用專案」更成國內化學品租賃示範首例，民國一百一十四年也持續擴大租賃範疇。與此同時，台積公司亦積極推動焚化廢棄物轉回收專案，民國一百一十四年啟動有機污泥厭氧消化產生沼氣試驗，測試將有機廢棄物轉化為甲烷燃料進行再利用，亦透過鋁塑分離技術，成功將廢鋁塑包裝袋由焚化轉為回收再利用，製成鋁料與再生塑膠粒，並持續提升回收再利用量。民國一百一十四年全球廢棄物回收率已達98.1%，掩埋率連續16年維持於1%以下，並持續朝民國一百三十九年淨零排放願景邁進。

最近二年度台積公司廢棄物總量與單位晶圓委外廢棄物處理量（註一）

年度	委外一般廢棄物（噸）（註二）	委外有害廢棄物（噸）（註二）	台灣單位晶圓委外廢棄物處理量（註三）(公斤／十二吋晶圓當量-光罩數)	海外子公司單位晶圓委外廢棄物處理量（註四）(公斤／十二吋晶圓當量-光罩數)
114年	388,953	513,279	1.08	1.17
113年	344,056	445,152	1.15	1.38

註一：表格內數據為台積公司初步統計計算結果，尚未經第三方查驗。
註二：數據為全球廠區。
註三：數據為台灣廠區與台灣子公司。
註四：數據為海外廠區。

台積公司廢棄物減量目標與達成情形

策略	民國119年目標	民國114年目標及成果	達成情形
持續推動源頭分類減廢，要求廠商提供低耗量化學品機台	1. 台灣單位晶圓委外廢棄物處理量（公斤／十二吋晶圓當量-光罩數）≦ 0.50 2. 海外子公司單位晶圓委外廢棄物處理量（公斤／十二吋晶圓當量-光罩數）≦ 1.10	1. 台灣單位晶圓委外廢棄物處理量（公斤／十二吋晶圓當量-光罩數）1.08（目標：≦ 1.11） 2. 海外子公司單位晶圓委外廢棄物處理量（公斤／十二吋晶圓當量-光罩數）1.17（目標：≦ 1.36 ）	達成

為確保所有廢棄物妥善處理與回收再利用，台積公司慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，除須具備廢棄物相關合格證書與許可文件外，並積極強化對廠商稽核，例如針對清除廠商，民國一百一十四年起，廠商清運人員於台積公司執行清運作業時，推行實施現場隨堂考措施，以協助清運人員熟悉作業流程並提升安全文化意識，而廢棄物出廠後，要求所有廢棄物清運商加入全球衛星定位系統（GPS）衛星車隊系統，以追蹤所有清運車輛清運路徑及異常停留點；同時，為進一步確保廢棄物獲妥善處理，台積公司定期至廠商端確認現場操作情形及調閱聯單、處理紀錄等資料，比對實際接收廢棄物再利用與處理情形，密切追蹤廢棄物清理廠商回收與再利用實踐狀況，並於民國一百一十一年起陸續導入「廢棄物智能追蹤系統（System of Waste Intelligent Fast Track, S.W.I.F.T.）」。截至民國一百一十四年，已有56%的廢棄物處理廠商建立智能追蹤系統，藉由系統之數位巡檢功能，帶動供應商數位轉型；預計民國一百一十九年推展至全數廢棄物處理廠商，透過人工智慧技術取代現場抽查，提高查核比例及效能。此外，台積公司還對再利用產品進行追蹤調查，要求所有再利用處理廠商須按月回報產銷紀錄，確保再利用產品最終流向為合法去處。

環境會計

為利於內部管理，台積公司建置環境會計制度，鑑別與量化環境成本，並針對環境保護計劃產生的節約或經濟效益進行計算與評估，以便持續推動具經濟效益之環境保護計劃。著眼未來企業環境成本日益攀升，環境會計可使台積公司更能有效管理成本。台積公司環境會計的編制準則是將各類環境支出清楚分類，並訂出獨立的環境會計科目類別，使各單位正確編列年度預算。在經濟效益的評估上，則依據公司環境保護計劃，計算出節能、節水與減少廢棄物的節約成本與回收收益。本報告呈現的環保效益包括實質收入，例如廢棄物回收再利用收益，以及其他因執行環保計劃而節省的成本。民國一百一十四年，台積公司各廠區推動環境保護計劃，加上廢棄物回收再利用，總計帶來超過新台幣96.87億元的經濟效益。

民國一百一十四年台積公司環保支出統計表

單位：新台幣仟元

分類	說明	費用支出	資本支出
1. 減輕環境負荷之直接成本			
（1）污染防治	包括空氣污染防制費用、水污染防治費用、其它污染防治費用	18,320,054	26,335,023
（2）節省資源耗用	為節省資源（例如：水資源）所花費的成本	-	11,225,758
（3）節省能源耗用	為節省用電所花費的成本	-	2,139,355
（4）減少溫室氣體排放	包括（1）製程溫室氣體排放處理設備；（2）購買綠電溢價；（3）購買碳權費用；（4）其他減少溫室氣體直接排放之成本	6,446,090	7,293,556
（5）事業廢棄物處置及回收	為事業廢棄物處理（包括再利用、焚化、掩埋等）費用	7,211,628	313,263
2. 減輕環境負荷之間接成本（環保相關管理費用）	包括（1）員工環保教育支出；（2）環境管理系統架構和認證取得費用；（3）監測環境負荷費用；（4）採購環保產品所增加之費用；（5）環保專責組織相關人事費用	1,461,613	2,221,504
3. 其他環保相關成本	（1）土壤整治及自然環境修復等費用；（2）環境污染損害保險費及政府所課徵環保稅與費用等；（3）環境問題和解、賠償金、罰款及訴訟費用	-	-
總計		33,439,385	49,528,459

民國一百一十四年台積公司位於台灣廠區之環保效益統計表

單位：新台幣仟元

類別	說明	效益
1. 推動環保計劃所節省的費用	節能方案	3,453,667
	節水方案	84,175
	減廢方案	2,134,442
2. 事業廢棄物回收再利用之經濟效益	包括回收廢化學品、廢晶圓、廢靶材、廢電池、廢燈管、廢包材、廢紙箱、廢金屬、廢塑膠及其它廢棄物	4,014,581
總計		9,686,865

綠建築與綠色工廠

自民國九十五年起，台積公司依循台灣「綠建築標準」及美國綠建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）「能源與環境先導設計（Leadership in Energy and Environmental Design, LEED）」，設計出相較於傳統更具節省能源及資源的新廠房與辦公室。台積公司亦逐年改善現有辦公室建築物，以符合美國綠建築LEED標準。自民國九十七年至民國一百一十四年，台積公司共有57座晶圓廠房及辦公棟獲得美國綠建築LEED標章－3座白金級、54座黃金級，32座台灣綠建築（Ecology, Energy Saving, Waste Reduction and Health, EEWH）標章－21座鑽石級、8座黃金級、3座銀級。

環境保護稽查結果違反環保法規事項

民國一百一十四年及截至年報刊印日止，台積公司並無任何違反環保法規事項。

7.2.2 永續產品

台積公司與上游原物料及設備供應商、設計生態系統合作夥伴，以及下游封裝測試業共同合作，以降低對環境所造成的衝擊。經由減少單位生產所消耗的資源與能源，台積公司可以協助客戶生產更先進、更低耗電且更環保的晶片產品，例如：超低功耗（Ultra-Low Power, ULP）及低操作電壓（Low Operating Voltage, Low Vdd）穿戴式裝置及物聯網裝置晶片、低功耗行動通訊晶片、平板顯示器背光系統高效率發光二極體（LED）驅動晶片、室內及室外固態照明LED驅動晶片、通過能源之星（Energy Star）節能認證之低待機耗電交流／直流變壓器晶片、高效能直流無刷馬達晶片、電動車晶片，及低耗電伺服器晶片等綠色產品應用。這些採用台積公司高效節能技術所生產的晶片，有助實現更具永續性的城市基礎建設、更省電節能的交通工具、智慧電網，及更具能源效率的伺服器與數據中心等應用。台積公司除了協助客戶設計低耗能、高效率產品，以降低產品生命週期的資源耗用外，同時亦積極投入綠色製造，進一步為客戶及其他利害關係人創造綠色價值（Green Value）。

台積公司為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦、通訊、消費性、工業應用、電動車、伺服器與數據中心，及其他產品市場。透過台積公司的晶圓製造技術，客戶的設計得以實現並應用在人類生活。這些晶片對於現代社會的進步具有重大的貢獻。台積公司在不斷努力達到獲利成長的同時，也致力同時提升環境保護與社會價值。台積公司對環境及社會具顯著貢獻的產品列舉如下：

台積公司專業積體電路製造服務對環境面的貢獻

1. 持續推進新製程技術以降低晶片耗電及節省資源

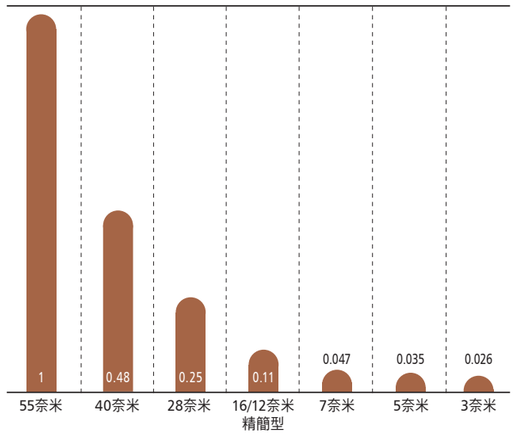
- 台積公司持續推進半導體高階製程技術，為客戶生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，為地球永續發展盡一份心力。半導體製程技術每向前推進一個世代，積體電路線寬就得以持續縮小，使得電晶體愈來愈小，也讓電子產品在完成相同任務或達到相同水準運作效能時所消耗的電力更為降低。此外，根據民國一百零九年工研院產業科技國際策略發展所（Industry, Science and Technology International Strategy Center, ISTI）模型推導分析結果，台積公司每使用1度生產用電，能為全球減省4度電，由內而外實現綠色製造的承諾。（請參考台積公司民國一百零九年度企業社會責任報告第11頁「台積公司永續產品促使全球節能」）
- 台積公司7奈米及更新世代的製程技術快速量產，占全年晶圓銷售比例由民國一百零九年的27%，大幅提升至民國一百一十四年的69%。台積公司的目標是持續投資於製程技術的研發，並增加7奈米及更先進的技術占台積公司晶圓銷售營收的比重，對公司成長及地球永續發展做出貢獻。

7奈米及更先進製程技術對台積公司晶圓銷售貢獻

民國109年	民國110年	民國111年	民國112年	民國113年	民國114年
27%	41%	50%	53%	58%	69%

不同技術的產品晶粒大小比較

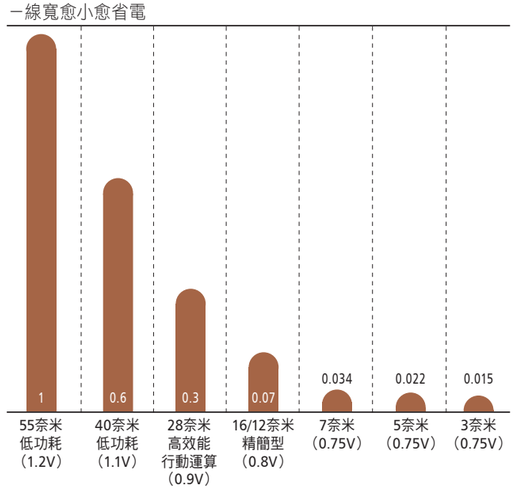
－線寬愈小晶粒愈小



註：邏輯晶片／靜態隨機存取記憶體／輸入輸出的比例影響晶粒大小與耗電量，已重新調整校正。

不同技術的產品使用耗電比較

－線寬愈小愈省電



註：邏輯晶片／靜態隨機存取記憶體／輸入輸出的比例影響晶粒大小與耗電量，已重新調整校正。

2. 提供客戶領先且具備最佳電源效率的電源管理晶片（Power Management IC）技術

- 台積公司領先全球的製造技術，成功協助客戶實現綠色產品的設計與製造，其中電源管理晶片是最具代表性的綠色產品。電源管理晶片是所有電子產品供電及調節用電需求的核心元件，台積公司協助客戶生產優於同業的電源管理晶片，能使電源供應更穩定、更有效率並能降低能耗。台積公司為客戶所生產的電源管理晶片，廣泛應用於全球的電腦、通訊、消費性電子、自動車、伺服器與資料中心等產品或系統之中。

3. 推動領先業界完備的ULP技術平台

- 為因應物聯網市場，例如智能穿戴、智慧家庭、健康照護，以及智慧城市等產品對低耗電的需求，台積公司持續投資擴展及強化ULP製程技術，並提供業界領先且最全面的ULP技術平台來支援多樣的智能邊緣裝置（Smart Edge Device），包括智能手錶、助聽器、心律調整器、連續血糖監測器、環境監測、智慧電網建構。台積公司領先業界的ULP技術已被各種終端智能系統單晶片（Edge AI SoC）和電池供電的應用廣泛採用。包括採用FinFET架構，具備能源效率與高效能以提供更多運算能力及人工智慧推論（AI inferencing）能力的6奈米技術–N6e®技術服務、12奈米技術–N12e®技術服務、22奈米超低漏電（Ultra-Low Leakage, ULL）技術、28奈米ULP技術，以及40奈米ULP技術。台積公司更進一步擴展其Low Vdd技術，以滿足極低功耗（Extreme Low-Power）產品應用。

4. 減少能源消耗的綠色製造

- 台積公司持續研發製造技術，提供更先進、效率更佳的製造服務，持續減少單位產出所消耗的能源、資源與污染物產生量，而在產品使用階段亦能達到低耗能、低污染的目標。半導體製程技術每向前推進一個世代，積體電路線寬就得以持續縮小，使得採用相同電路設計的晶片面積愈來愈小，因此製造單位晶片所耗用的能源、原物料自然也愈來愈少。此外，在卓越製造能力的襄助下，台積公司不斷簡化製造流程及提供更新的設計方法，協助客戶降低在晶片設計及產品製造上的資源浪費，為客戶生產更先進、更節能及更環保的產品。關於民國一百一十四年透過綠色製造實現的整體效益，請參閱本年報第158頁之「環境會計」。

台積公司專業積體電路製造服務對社會面的貢獻

1. 協助客戶實現行動運算及無線通訊晶片創新，使得行動通訊生活更快速便利

- 智慧型手機及平板電腦近年的穩定成長，反映出對行動通訊產品的健康需求，並且帶動基頻處理器（Baseband）、射頻收發器（RF Transceiver）、應用處理器（AP）、無線區域網路（WLAN）、互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）、近場通訊（Near-Field Communication, NFC）、藍芽（Bluetooth）、全球定位系統（Global Positioning Systems, GPS）、超寬頻（Ultra-Wide Band, UWB）、有機發光二極體顯示器驅動晶片（Organic Light-Emitting Diode Display Driver, OLED Display Driver）、電源管理晶片（Power Management IC, PMIC）等晶片產品的快速創新。行動裝置為日常生活帶來極大的便利性，台積公司也在其中貢獻良多，包括：（一）新製程使晶片尺寸更小並具備更快的運算速度，進而使電子產品尺寸也得以縮小。此外，系統單晶片的技術可將更多不同的功能集中在單一晶片上，減少了電子產品需配置的晶片數量，也能使得電子產品系統縮小尺寸；（二）新製程使晶片耗電更少，使行動裝置產品的使用時間更長；及（三）利用3G/4G/5G、無線區域網路／藍芽／超寬頻等更便利的無線通訊能力，使人們可以隨時彼此溝通、處理事務，大幅提高現代生活的生產力與機動性。

2. 協助客戶實現互補金屬氧化物半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）及微機電系統（Micro-Electromechanical Systems, MEMS）晶片創新，提升人類健康與安全及創造綠色產品

- 感測器（Sensor）是使得機器設備具備更高智能、更安全、更便利，以及更環保的必要關鍵。光學感測器、聲波感測器、動作感測器，以及環境感測器、大多是採用CIS或MEMS技術來製造。台積公司持續大力投入開發更先進的CIS及MEMS技術，協助客戶針對新的應用推出創新的產品。在CIS方面，台積公司與客戶共同將產品應用從傳統的紅、綠、藍三原色（Red, Green, Blue, RGB）感測，拓展至三維深度感測（3D Depth Sensing）、光學指紋辨識（Optical Fingerprint），以及近紅外光機器視覺（Near-Infrared Machine Vision）等應用。在MEMS方面，台積公司與客戶共同將產品應用從傳統的動作感測，拓展至麥克風、生物感測（Bio-Sensing），微型揚聲器（Micro-Speaker），以及醫療超音波致動器（Medical Ultrasound Actuator）等應用。台積公司客戶的感測晶片應用於消費性電子、行動通訊、車用電子、工業，以及醫療設備等。這些晶片尺寸越來越小、速度更快、更精確、更具能源效率的優點，能大幅增進生活便利、改善健康、增進安全，以及有利永續發展。

舉例來說，台積公司客戶於民國一百一十四年推出應用於汽車安全系統的最新車用CIS產品，顯著提升CIS動態範圍效能（Dynamic Range Performance），能夠使得先進駕駛輔助系統（Advanced Driver-Assistance System, ADAS）及自動駕駛車輛（Autonomous Vehicle）更聰明、更安全。此外，客戶採用台積公司創新的MEMS技術，成功推出新一代微機電揚聲器，具備更小的尺寸及更佳的高頻響應，使得助聽器及消費性的輔聽裝置能有更彈性的外觀設計、更多的電池空間及更接近自然聲音的品質，進而提升使用者經驗。

3. 台積公司所開發的矽光子（Silicon Photonics）技術以及創新的COUPE（Compact Universal Photonics Engine）三維立體光子堆疊技術，能夠整合矽光子晶片與電路控制晶片（Electrical Control Chip）成為單晶片的光學引擎。此光學引擎能夠與高速運算晶片共構封裝，提供低耗能與高速資料傳輸。台積公司已於民國一百一十四年與多家客戶成功實現每秒200吉位元（Gigabits Per Second, Gbps），也持續開發共構封裝光學引擎（Co-Packaged Optics, CPO）解決方案，以減少資料中心逾50%的資料傳輸能耗。

7.2.3 安全與衛生

安全與衛生管理

台積公司的安全衛生管理架構符合國家及國際標準，透過計劃、執行、查核、行動（P-D-C-A）的管理循環原則，以達成預防意外事故、促進員工安全衛生及保護公司資產。自民國九十八年起，所有位於台灣的廠區均取得「台灣職業安全衛生管理系統」（TOSHMS）認證。國際標準化組織（ISO）於一百零七年發布「職業健康和安全管理系統」（ISO 45001: 2018）條文以取代OHSAS 18001規範，此標準涵蓋規範擴大至領導階級的支持參與、內外部議題的蒐集與規劃、利害關係人的需求與期望、風險鑑別的建置評估、非管理職人員的諮詢與溝通、績效指標

的應用及矯正預防措施有效性的評估。同時，透過管理審查、內部稽核、作業安全分析、自動檢查、安衛巡檢等機制，發掘安全疑慮及改善機會，確保系統精神被有效落實至管理層面。台灣廠區於民國一百零八年全數取得「職業健康和安全管理系統」（ISO 45001）認證，所有子公司亦於民國一百零九年取得ISO 45001認證，以上所有驗證台積公司皆於民國一百一十四年持續維持其有效性。而針對新建廠區，將依台積公司內部規定必須於取得工廠登記證後的18個月內取得前述之驗證。

除了致力於事故預防之外，台積公司亦擬定災害緊急應變程序與傷病關懷程序，期在災害發生時保障公司員工與廠商人員的生命安全，並避免或降低事故災害發生時對社會、環境與作業人員家庭的衝擊。台積公司與供應商定期溝通，將既有生產機台的潛在風險降到最低，並於機台安裝時依循裝機安全管制程序。此外，台積公司更嚴格要求落實高風險作業管制，進行廠務設施與設備耐震評估，以降低地震發生時的損失。

關於傳染病，台積公司建立公司層級的防疫委員會與緊急應變程序，以因應傳染病大流行的現象。

工作環境與員工安全衛生保護

台積公司環保安全衛生政策之重點在於建構安全的工作環境，積極預防職業傷害與疾病，維護員工身心健康，並深化全體員工對環保安全衛生的認知、責任承擔，同時塑造公司環保安全衛生文化。

民國一百一十四年，台積公司之職業災害共58件，人數58人（占民國一百一十四年底員工總人數之0.07%），失能傷害頻率為0.34，符合小於0.4之目標；失能傷害嚴重率為3，符合小於4之目標。台積公司檢討改善對策，例如透過安全文化相關平面或動畫的宣導，強化同仁安全意識；啟動安全文化互動式溝通訓練課程及「安全時刻」活動，將安全融入生活，鼓勵同仁主動討論安全相關議題；為降低運動傷害，規定福委會及部門內舉辦運動類活動前，須完成風險鑑別及危害提醒；持續透過作業觀察、合規查核檢視工作場所可能受傷風險，除定期檢討改善成效外，並重視主管關懷注意同仁身心狀態，確保同仁工作期間之安全。

台積公司的安全與衛生管理之運作方式說明如下：

● 硬體設施安全衛生管理

台積公司除了在建廠及擴廠時符合減低環保、安全與衛生風險的法規與內部標準外，亦針對新機台與新原物料、機台安裝使用核可、安全規則修改、防震設施及其他安全措施等建立管理程序。

台積公司要求所有新進的機台設備須符合半導體設備人因標準（SEMI-S8）相關之人因設計，並採取適當之控制與管理措施降低人因風險。此外，台積公司致力於晶圓傳送盒搬運系統的自動化，以避免人工長期搬運所累積的傷害，目前台積公司十二吋晶圓廠之搬運系統已達全面自動化。

● 新機台與化學物質環保、安全與衛生評估

身為全球半導體產業的技術領先者，台積公司研發階段所使用的新機台或新化學物質日益多樣化。為確保新機台設計符合當地法規與半導體設備安全標準（如SEMI-S2），以及新化學物質對於環境、安全與健康風險可被有效管理，設立台積公司新機台與新化學物質環安衛審查委員會（New Tool and Chemical Committee, NTCC）進行審核把關。涵括源頭管理、風險鑑別與環境監控三大核心，從機、料、人、法、環五大面向，檢視本質安全、材料選用、人員資格、作業方法、人員與環境防護措施，並透過環境監控，預防氣體、化學品暴露、洩漏與廢棄物處理的可控性。民國一百一十四年新機台與新化學物質審核共387件，進廠安裝及使用前均依照前述規範進行風險評估審查。

● 一般安全管理、訓練與稽核

台積公司所有廠區每月、總機構每季均定期舉行環保、安全與衛生委員會會議，同時採取多項預防措施，例如高風險作業管理、承攬商管理、化學品安全管理、個人防護具要求及安全稽核管理等。此外，台積公司亦維持完整之災害應變程序並進行定期演練，藉以將員工與公司資產損失及因災害產生之社會與環境衝擊降至最低。

最近二年度台積公司工安教育訓練

年度	教育訓練人次
114年	358,575
113年	300,533

● 作業環境危害因子管理

為提供員工安全舒適的工作環境，台積公司實施作業現場評估。另外，公司也教導並要求員工必須使用必要的個人防護具，防止員工暴露於作業場所之危害因子。

整體作業環境方面，台積公司每半年均會進行作業環境監測，包含法規所定義的物理性及化學性因子，如二氧化碳濃度、照明、噪音、國內法規規定之危害性化學物質等。此外，台積公司也更進一步對具有潛在健康危害之化學品進行人員暴露評估，並依照不同的評估結果進行分級管理。一旦作業環境發生異常現象，或評估結果顯示對員工的健康有影響，廠區工安環保單位會立即進行作業行為觀察與改善措施，確保危害因子暴露風險降低至可接受的範圍。

● 健康促進專案

為建立友善健康職場與預防職業疾病發生，台積公司建立公司層級的委員會以推行健康促進活動，主要涵蓋下列三大範疇：

（一）暴露評估與健康風險評估：建立暴露評估系統，鑑別高健康風險員工。

（二）危害訓練及危害告知：針對在台積公司所有廠區的員工及承攬商，使用標準化的健康風險訓練教材。使員工及承攬商於台積公司內進行任何作業、提供服務或施工前，皆清楚作業的健康風險及作業現場的健康相關保護措施。

（三）強化高健康風險化學物質管理：要求各供應商所有提供給台積公司的原物料皆須符合法規，並依法明確揭露危害物質。抽樣分析製程中使用的原物料，確認成分是否與供應商之安全資料表中揭露之不含致癌、致畸胎或致生殖突變物質一致。

● 緊急應變

有效之緊急應變執行計劃，須依風險評估結果鑑別出高風險事件，並為各種不同的情境做準備。其範圍應包括所有可能有嚴重結果的事件，並著重於持續改善與演練。台積公司的緊急應變計劃包括對於潛在事故之快速反應、危機處理以及災害復原程序。

台積公司所有廠區每年均舉行緊急應變與疏散演習，除了公司同仁之外，承攬商之駐廠服務人員亦須參與緊急應變計劃與演習，以確保災害應變時合作將災害造成的損失降至最低。民國一百一十四年共舉辦了123場次實體疏散演練，以及71場次滅火訓練。同時，各廠在廠長主持下，邀集廠內及支援單位，至少每二年針對可能的高風險事件如地震、火災及洪水（南科廠區）進行營運持續演習。自民國一百零七年開始，台積公司推動複合型災害緊急應變演習，將地震、火災、化學品洩漏等事故同時納入演習情境，確保緊急應變的快速應變能力，以因應實際災害發生時將損失降至最低。民國一百零九年，台積公司領先國內業界，導入由美國聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）提出的「全災害管理（All-hazard Management）」思維部署防災演習。

台積公司因應COVID-19疫情，亦增加桌上演習輔助防災訓練、減少實兵演習可能產生的群聚感染風險，同時藉此驗證實兵演習流程劇本，使災害應變作為更加周全，降低未來各類型災害造成的營運衝擊；截至民國一百一十四年，除了執行560場實兵演習外，並完成159場桌上演習。

除了工程及廠務部門每季舉行緊急應變演習外，台積公司也針對實驗室、餐廳、宿舍及交通車等人員，舉行如地震、化學品洩漏、氨氣外洩、火災與交通事故等緊急應變演習。為強化火災預防管理，每年進行所有廠區公共危險物品盤查，找出潛在風險，並提升廠區防災管理能力，有效降低火災及違法之風險。

● 新興傳染病應變

台積公司設有環保、安全與衛生專職單位監控全球新興的傳染病，評估其對工作場所的潛在影響，並擬定適切的因應計劃。依據台積公司過去的防疫經驗（如民國九十二年的SARS、民國九十八年的H1N1新型流感、民國一百零四年的MERS中東呼吸症候群冠狀病毒感染症，以及民國

一百零八年至民國一百一十二年的COVID-19），當新興傳染病威脅來臨時，遵照疾病管制署的防疫措施，並立即召開「企業傳染病應變委員會」制定防疫因應策略。這些策略包括教育員工預防與應變常識、制定管理階層因應指引、制定員工病假處理準則和於合適地點設置含酒精的洗手滅菌設施。該委員會還負責監督員工病假狀態，同時擬定營運持續計劃，以解決人力短缺現象並使業務的影響最小化。例如在COVID-19疫情期間，台積公司為保護員工自己、其家人與工作夥伴的身心健康，鼓勵員工在健康無虞之下完整接種疫苗，並滾動式檢討疫情研擬適當防疫措施，如依規定在進入台積公司前完成每日體溫申報及更新疫苗接種資訊，持續落實防疫規範，戴口罩、勤洗手及保持安全社交距離。

●員工身心健康保護

台積公司認為員工的身心健康不僅是維繫企業正常營運的基礎，照顧員工的身心健康亦為企業的責任。為保護與促進員工身心健康，台積公司強化廠區工安環保單位、健康中心之職業健康照護管理人員與職業醫學科專科醫師三方的合作，致力於預防因長時間、夜間工作、輪班等作業引起之腦心血管疾病、母性健康保護與人因高風險危害人員管理等專案之規劃與執行。

台積公司提供多項促進身心健康的資源及舉辦相關活動，不僅保護員工免於受到工作環境中的危害，更積極促進員工的健康。民國一百一十四年，透過有規劃的健康管理措施，依法進行：（一）母性健康保護，共評估與管理478位，完成率100%，皆為第一級（最低風險）管理（無害母體、胎兒或嬰兒健康）；（二）經由分析員工腦心血管罹患情形，合併年度健檢問卷與工時資料擴大進行管理共6,526人，除提供衛教、就醫協助，並將醫師配工建議提供給主管參考，以降低罹病風險；（三）人因高風險族群管理170位，其中二位可能有工作相關風險，已主動協助調整其工作環境以避免可能的風險；（四）為持續打造健康職場環境，台積電結合健康生活型態舉行系列活動，鼓勵同仁於生活中建立良好生活習慣並於每季進行宣傳。

民國一百一十四年，藉由健走App連動家用體重機，台積公司鼓勵在家建立體重量測習慣（共12,500名員工參與，較去年增加74%），公司亦策劃線上互動式衛教線上講座，涵蓋穿戴式裝置與睡眠衛生等主題，共舉辦三場次，吸引了1,332人參與，並於公司診所執行新連續血糖監測科技，共95人參與，上線後可協助同仁在日常生活中透過穿戴手錶或手機即可對血糖進行監測。

心理健康的部分，民國一百一十四年的主題為「五感療癒」並設計專屬捏捏包900個，提升同仁心理健康促進活動的參與率，另延續民國一百一十三年的規劃，包含（一）員工心理健康講座16場次，參與人數共988人；（二）世界心理健康月活動，線上講座參與人數共1,240人；（三）「五感啟動練習」的互動活動共計2,533人，較去年增加48%；台積公司將持續辦理相關健康促進活動，一同照顧員工身心健康。

7.2.4 供應商管理

管理面向

台積公司持續強化供應鏈管理，溝通並鼓勵供應商（包括承攬商）致力於品質、成本效益、交期、供應鏈永續性方面精益求精。藉由與管理階層的定期交流、現場稽核與經驗分享及與主要供應商、承攬商攜手合作，強化夥伴關係，共同追求更好的績效，並對社會做出更大的貢獻。如上述，承攬商進行高風險作業時，須明確定義施工人員所必須採取的安全防護及預防措施；更要求承接廠務高風險工程的承攬商，必須建構職業安全衛生管理系統（ISO 45001或OHSAS 18001），其工作人員則必須完成完整的工作技能訓練。所有承接本公司高風險工程的承攬商已於民國一百一十年底前須取得ISO 45001認證。

永續供應鏈

台積公司在多個永續發展領域與供應商密切合作，包括建立綠色供應鏈、管理碳排放以應對氣候變遷、減少火災風險，以及在環境保護、安全衛生管理和天然災害中的營運計劃等。

自民國一百零四年以來，台積公司加入了負責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA），並致力於透過嚴格的內部審查和政策調整，檢視和改善公司在勞工、健康與安全、環境、道德規範以及管理體系方面的政策和流程，以確保符合「負責任商業聯盟行為準則」的要求。

為了增強供應鏈的永續管理和有效的風險管理，台積公司承諾與供應商攜手合作，確保遵循台灣的環保、安全、衛生及消防法規。此外，台積公司還制定了供應鏈永續標準，其中涵蓋了勞工權益、健康與安全、環境保護、道德規範以及管理系統等方面。台積公司與供應商攜手合作，致力於評估和減緩經濟、環境及社會方面的風險和影響。透過定期舉辦論壇與工作坊進行經驗分享和培訓，台積公司協助供應商提升其永續發展的表現，期望能超越國際標準，並成為全球半導體供應鏈中的典範。

台積公司遵守美國證券交易委員會（U.S. Securities & Exchange Commission, SEC）的「衝突礦物來源揭露規定」（Rule 13p-1 of the U.S. Securities Exchange Act of 1934）。作為全球高科技產業供應鏈的領導者，台積公司確保採購「非衝突（Conflict-free）」的原物料，致力提倡人道精神與實踐人性尊嚴等社會道德準則，列為台積公司善盡企業社會責任之一。基於此信念，台積公司依循領先的行業慣例，作為採取一系列的合規保障措施，包括符合經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）於民國一百年所發布之「受衝突影響與高風險地區之全球責任礦物供應鏈模範政策（Model Supply Chain Policy for a Responsible Global Supply Chain of Mineral from Conflict-Affected and High Risk Areas）」的盡職調查（Due Diligence）框架。

台積公司是負責任商業聯盟（RBA）與全球永續議題e化倡議組織（Global e-Sustainability Initiative, GeSI）堅定的支持者。台積公司作為責任商業聯盟的一員，依循這二個國際組織所發展出的「負責任礦產計劃」（Responsible Minerals Initiative, RMI），要求台積公司供應商採購非衝突的原物料。台積公司除自民國一百年起要求所有供應商即時揭露熔煉廠資訊外，更積極鼓勵供應商向依循特定產業組織（例如RMI）認證為非衝突的熔煉廠來進行採購，並要求供應商積極督促尚未取得此認證的熔煉廠接受「負責任礦產計劃」或其他同等之獨立第三方稽核計劃的檢驗。台積公司要求自身所使用的鉭、錫、鎢及金均須符合「非衝突」的原則。

台積公司將每年對供應商進行持續調查，要求供應商改進與擴大資訊揭露的範圍，以符合法規與客戶的要求。如需更多資訊，請參閱台積公司於美國SEC網站上所申報的Form SD（https://investor.tsmc.com/chinese/sec-filings）。

7.3 台積電文教基金會

民國一百一十四年，台積電文教基金會持續挹注資源於「藝文推廣」、「教育合作」及「青年培育」三大主軸，共計投入逾新台幣17,800萬元；隨著台積公司在全球市場的布局拓展，以及推動永續發展的行動，台積電文教基金會秉持相同精神，持續將台灣藝文展演推向海外舞台，展現台灣的文化魅力，同時將國際級藝文展演帶入台灣，擴展台灣民眾的藝文素養視野。台積電文教基金會更將永續教育、人工智慧議題融入藝文展演及教育活動，以提升青年學子科技素養，加強大眾對於環保永續的意識。

深耕藝術推廣，促進文化交流

台積電文教基金會以永續發展為旨，公益贊助*國家地理雜誌*《鯨之謎》交響音樂會。本場音樂會以好萊塢知名導演－探險家詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）監製的紀錄片為基礎，搭配國家交響樂團的現場演奏，藉由高品質的表演藝術串聯科普知識與環境教育，以喚起民眾對海洋生態保育的重視。

台積電文教基金會致力促進國際文化交流，民國一百一十四年第三度贊助柏林愛樂來台。文教基金會不僅贊助國際樂團來台演出，更促成多項教育活動：「並肩彩排（Side-by-side Rehearsal）」由六位柏林愛樂團員，包括第一小提琴手賽門·貝爾納迪尼（Simon Bernardini）、第二小提琴首席克里斯多夫·霍拉克（Christophe Horák）、長號手耶斯伯·布斯克·索倫森（Jesper Busk Sørensen）、倍低音管手瓦茲拉夫·佛納謝克（Václav Vonášek）、低音提琴手雅努許·維吉克（Janusz Widzyk）以及法國號首席曾韵（Yun Zeng），與48位國家青年交響樂團（NSYO）學子共同練習並提供指導，展現跨世代的音樂傳承與交流；「大師班」則由柏林愛樂成員中的第二小提琴首席克里斯多夫·霍拉克、低音管演奏家瓦茲拉夫·佛納謝克親授12位習樂學子，引領其領略不同的藝術層次；基金會更邀請來自新竹縣峨眉國中、新竹市建華國中音樂班、新竹高中音樂班、陽明交大音樂所、清華大學音樂系所、臺北藝術大學音樂學系等六校，逾230位學子觀摩音樂會彩

排，近距離感受國際頂尖樂團的音樂魅力。活動總計1萬3,323人次參與，以音樂為橋梁，跨越世代與地域，連結世界。

此外，基金會持續將藝文資源帶入台積公司設廠的海外社區，贊助支持國家交響樂團日本巡演，於熊本縣立劇場音樂廳舉行一場精采絕倫的音樂饗宴。於此同時，文教基金會持續的將音樂的種子向下扎根，邀請台灣小提琴家黃俊文舉行大師班，以其深厚演奏的經驗與日本九州地區的四位年輕音樂學子進行切磋，展現了台灣與日本九州的文化交流與連結。

每年定期於台積公司營運所在社區舉辦「台積心築藝術季」，乘著A.I.發展的科技浪潮，本年度以《A.I.－Art &I》作為主題，於新竹、台中及台南策畫一系列跨領域的藝術展演：藝術季首次攜手臺灣當代文化實驗場，將全台唯一巨型移動式戶外沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」自台北移展至新竹清華校園；九件國內外創作者的創意影像與二組現場跨界演出，運用人工智慧、影像生成、衍生藝術與高速運算平台等科技工具所創造的視覺饗宴，吸引逾3,800人次民眾欣賞。由三組創意團隊「明和電機」、「超維度Dimension Plus」、「江戶未來世Hello Edo！」共同合作的劇場節目《新世代浮世繪》，以自製的創意樂器、日本傳統祭典視覺及聽覺元素，再加上賽博龐克（Cyberpunk）風格，創造了極具風格的電子歌舞嘉年華，呈現了科技藝術的另一種風貌。

基金會於藝術季中持續推廣經典戲劇，邀請臺北木偶劇團優雅詮釋《水鬼請戲》陰陽兩界的真摯情感；國光劇團所帶來的青春版《王熙鳳大鬧寧國府》，由京劇大師魏海敏親授劇團當家青衣黃詩雅，生動詮釋京劇經典惡女形象。在古典音樂節目則安排東、西方古典樂壇巨星，分別是蕭邦鋼琴大賽金獎鋼琴家趙成珍（Zhao Cheng-zhen）、以及法國大提琴家高提耶·卡普松（Gautier Capuçon）於藝術季中獻藝；文學講座《漫遊古典森林》由散文大家簡媜主講，引領大眾穿越千年，親炙古典詩人，達到人工智慧（A.I.）無法企及的深度。本年度藝術季共計106場精緻展演，共吸引逾3萬人次社區民眾欣賞。

A.I.教育新篇章，推動素養教育

接軌全球A.I.浪潮，台灣教育正迎來「AI教育元年」，台積電文教基金會贊助支持由親子天下教育創新中心發起的「AI素養普及計畫」，結合產官學界與非營利組織共同推動。該計畫導入麻省理工學院MIT RAISE與跨國教育組織i2Learning共同開發的全球Day of AI課程，透過全台校園深入社區與家庭，回應各界對AI素養教育的需求，開啟多元AI素養對話，計畫將於三年內惠及全台237所國中及小學校教師，影響逾3萬名學子。

與科技素養教育並行，台積電文教基金會持續於國中小校園推動人文及科學基礎素養教育。在基金會推動下，安排600名來自全台偏鄉學童，參觀「美國大都會藝術博物館（The Met）名作展」，並透過專業導覽的帶領及互動，開啟孩子們對藝術世界的想像與好奇；「台積電美育之旅」、「台積電科學之旅」持續進行深化教育課程第三年，除參觀重要藝文與科學展館之常設展，並透過漢字書寫工作坊及半導體科學工作坊，加深學子參訪的知識吸收；基金會與天下雜誌教育基金會、國立清華大學柯華葳教授閱讀研究中心，為期五年的「教師厚學計畫」已邁入第五年，從閱讀理解教學出發，為偏鄉教師打造教育支持系統，並適性教育狀況調整內容，五年期間以從一項計畫教育形塑成新的教學文化，突破偏鄉教師的地域限制，幫助提高學童的讀寫素養，迄今累計逾6,500人次參與。

台積電文教基金會持續推動戲曲藝術傳承，自民國一百一十三年九月啟動第二期為期三年的「戲曲傳承計畫」，持續於國立清華大學與東海大學二校開設全學年課程，並於民國一百一十四年十二月舉行階段性成果演出，累積至今逾400位青年學子受惠；「台積戲苑」則攜手各方戲曲傳承合作夥伴臺灣崑劇團、興傳奇青年劇場以及台北曲藝團舉行專場戲曲推廣、導聆與賞析活動，持續於新竹、台中、台南、高雄地區舉辦，盼更多高中學子認識傳統戲曲之美，共計3,291人次參與。台積電文教基金會持續藉由多元藝文教育，開展素養學習的新契機及視野。

搭造揮灑舞台，助力青年構築夢想

台積電文教基金會重視人才培育，於民國一百一十四年新設「台積電短篇小說新人賞」，鼓勵國內年齡40歲以下青年創作短篇小說，培育青年創作家，增進社會文學風氣，共312人參與；為引領偏鄉國中學子領略文學美感，台積電文教基金會第五年與*聯合文學*雜誌合作，針對桃竹苗地區在學七至九年級學生於峨眉國中舉辦第五屆「台積電青年學生文學營」，累計335人次參與，並將於民國一百一十五年擴大舉辦寒假場次，將針對台南、高雄、屏東在學七至九年級學生舉辦第六屆「台積電青年學生文學營」，盼透過文學營提升文學教育深化扎根。

除文學創作外，台積電文教基金會鼓勵書法寫習風氣，持續舉辦「台積電青年書法暨篆刻大賞」及「台積電硬筆書法大賞」。第18屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」以「臨摹碑帖」作為年度主軸，期望引領學子認識經典碑帖與毛筆書寫，並激發創作與學習興趣；為鼓勵更多學子投入書篆藝術，今年增設「國中組書法組」，並將原臨帖組分齡為「國中臨帖組」與「高中大學臨帖組」，擴大學子揮灑舞台。共計402人次參與；為了讓書法教育向下扎根，文教基金會更開啟了「台積電書法小學堂」，邀請歷屆獲獎者擔任書法教師，於全台十所國小舉辦為期十堂的帶狀書法課程，盼能引領更多學童認識書篆藝術，本年度共計近280名學童參與。

「台積電青年築夢計畫」自民國一百零五年啟動以來，迄今邁入第十屆。為慶祝此計畫十週年，基金會攜手台北市政府青年局及台大創新設計學院於松山文創園區共同策劃一場為期三日的《Off Track》互動展，鼓勵青年世代勇敢突破框架，踏出築夢的第一步；展覽集結九組築夢家共同策展，透過九位夢想實踐家將其奮鬥的理想以展覽的形式呈現給大眾，夢想類型包含「點亮以籃球為名的火炬」以籃球融合教育，陪伴弱勢孩童追夢；「Alpha Tanzania」致力於在東非坦尚尼亞建校，改善教育環境；「楊凱婷－神轎共創」結合傳統文化與科技藝術，傳播台灣文化之美；「陳懷璞－航向全世界」以成為探險家為目標，推動海洋保育；「木島 TimbormosÅ」透過木工技藝讓廢棄行道樹重獲新生，實現循環經濟；「胖胖樹的熱帶雨林」以台語介紹移居植物的故事；「保持通話 Lifting Chaos」聚焦女性主義，開啟私密對話；「孵寶陪育」以科學育兒觀念陪伴新手父母；「浪人食堂」引導大眾了解無家者議題，破除偏見。除了展覽外，築夢家在展覽期間舉辦了11場沙龍活動與大眾進行分享與溝通。同時文教基金會更於網路上公開招募「神秘客」，由神秘客來投票支持夢想，以投票的比例來分配百萬築夢獎金。此展覽吸引逾30名志工熱情加入、90位神秘客深度參與、線上觸及率突破150萬人次，吸引超過2,500人次親臨現場見證這場盛會，企盼透過此互動特展及相關活動，增加青年與大眾對於夢想的想像，喚醒青年面對未來。

7.4 台積電慈善基金會

台積電慈善基金會自民國一百零六年成立以來，由張淑芬董事長帶領台積電慈善基金會以「培力偏鄉」為公益投入主軸，從三大主題建構地方支持系統：教育培力、健康長壽與環境保育。基金會透過對內號召企業志工藉由實體與線上服務關懷社會真實需求；對外也發揮產業網絡優勢，加強與地方政府、企業和大專院校的合作，致力於為偏鄉學校或弱勢教育機構學童，及其背後需要急難經濟支持的家庭環境，挹注學習與醫療社福資源以協助培養長期謀生能力，而能自立改善生活品質。同時持續以「把愛送出去」公益平台串連社會的愛心，深耕在地服務量能、共造社會向上。

台積電慈善基金會於民國一百一十四年持續投入公益並擴大公益專案影響力如下：

- **教育培力**：慈善基金會持續投入志工服務、經濟援助、食物供給與教學軟硬體設備，改善偏鄉教育環境及生活支助。民國一百一十一年起，基金會更重視培養偏鄉學生的就業謀生能力。民國一百一十四年規劃高職就業博覽會，設計職業探索、就業媒合二大主題活動，攜手五地縣市政府雙軌資源協助學子及早錨定目標、獲得更多元的就業選擇，共計超過15,000個活動參與人次。持續第五年的「速效技職培訓計劃」於民國一百一十四年度擴大攜手台積公司供應商，並邀請國際半導體產業協會（SEMI）、104人力銀行、澄霖生醫國際、晨悅健檢及快樂麗康等100多間優質企業，持續為技職學子提供優質工作媒合與探索的機會。 同時也向下扎根，合作多元優質企業及各縣市政府單位，在全台舉行「高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會」與「速效媒合培力營」，創

新打造高中職友善的工作媒合與試探環境，廣獲各地參加學生、家長和企業的熱烈迴響。今年度於桃園、新竹、雲林、屏東與台東等五城市辦理，更結合台積公司供應商夥伴的共好力量，讓超過7,700位年輕學子能提早認識企業品牌，為未來發展思考不同就業路徑，並規劃跨出實際行動。

- **健康長壽：**自民國一百零三年起，即開始連結獨老長輩照護社福團體與醫療單位，提升獨老長輩的健康福祉。民國一百一十一年，台積電慈善基金會與陽明交通大學、關渡醫院合作打造新式智能銀髮運動俱樂部，於民國一百一十二年導入台積志工共同推廣銀髮族群健身，達到預防失能及延緩老化的效益。此外台積電慈善基金會也於民國一百一十二年發展企業志工適性測評系統，不僅提供在職同仁加入志工行列的指引，更鼓勵台積公司退休員工探索自我，搭配台積電志工專屬培訓增能系統，而能持續以專長貢獻社會並經營第二人生舞台。自民國一百一十三年起台積電慈善基金會攜手陽明交通大學、關渡醫院，與日本熊本縣菊陽町及熊本大學，正式締結合作聯盟。結合「企業x醫院／大學x社區」的三角模式，智慧公益落地熊本、打造健康共好社區。此外，熊本大學附設醫院也給予支持，在台積公司熊本廠（JASM）近500位從台灣派駐的同仁們，提供醫療資源協助，讓派駐同仁和家屬得到完善醫療照顧，降低因語言產生的就醫不便。

- **環境保育：**幫助弱勢社福機構增加綠色能源與節能用電，持續執行惜食計劃降低資源浪費。延續民國一百一十年的「公益綠能」專案，民國一百一十四年共協助14間社福機構架設太陽能板，售電總額達新台幣350萬元，未來以每年增加八個以上社福機構為目標。另外，協助九個縣市、共360所偏鄉學校裝設LED節能燈具，12萬名師生受惠，平均為每間學校降低30%電費，節省680萬電費，減少1,285公噸二氧化碳（CO_2）排放，相當於建置6.8座大安森林公園的綠色效益，為社福機構與偏鄉學校挹注永續經營的力量。

7.5 台積i公益平台

台積i公益平台於民國一百零三年上線，員工可使用此內部互動網站，主動提出關懷專案、分享專案成果，提供回應及建議，並即時進行線上資助等活動以回饋社會。

民國一百一十四年，共計有超過2萬2,000人次參與捐款，包含「攜手應援花蓮，發揮專業重建家園」、「攜手協助南台灣，修繕復原守護校園」等公益計劃，以及四個定期定額專案長期支持偏鄉棒球運動與學科教育，累積愛心資助超過新台幣6,000萬元。

自民國一百零三年起，台積i公益平台已累計超過新台幣5億元的愛心捐款。台積公司將持續其關注社會之承諾，鼓勵員工以各種形式關懷及回饋社會。

7.6 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		有關本公司推動永續發展之治理架構，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。 有關本公司推動永續發展專職單位、設置時點、組成、運作及當年度執行情形，以及向董事會報告之頻率，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。 有關本公司董事會對永續發展之督導情形，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		有關本公司風險評估之邊界，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。 有關本公司辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略，請參閱本報告「7.1企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。	無
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		（一）有關本公司環境管理制度及所依據之法規，請參閱本報告「7.2 環保、安全與衛生管理」（第152-165頁）及「6.2.3 未遵循出口管控、環保及氣候變遷相關法規及協議，或未即時取得營運所需相關核可之風險」（第137-143頁）說明。 有關本公司所通過國際相關驗證標準及其所涵蓋範圍，請參閱本報告「7.2 環保、安全與衛生管理」說明（第152-165頁）。	無
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		（二）有關本公司提升能源使用效率及使用再生物料之政策，請參閱本報告「7.2.1 環境保護－氣候變遷與能源管理、廢棄物管理與資源回收」說明（第154、157-158頁）。	
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		（三）有關本公司評估氣候變遷對現在及未來的潛在風險與機會、其評估結果及所採取相關之因應措施，請參閱本報告「7.2.1 環境保護－氣候變遷與能源管理」說明（第154頁）。	
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		（四）有關本公司溫室氣體、用水量及廢棄物最近兩年之統計數據、密集度及資料涵蓋範圍，請參閱本報告「7.2.1 環境保護－氣候變遷與能源管理、溫室氣體排放減量與能源管理、空氣及水污染防治、廢棄物管理與資源回收」說明（第154、155-156、156-157、157-158頁）以及「7.7 上市上櫃公司氣候相關資訊執行情形－最近二年度台積公司溫室氣體排放統計」（第171頁）。 有關本公司溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，請參閱本報告「7.2.1 環境保護」說明（第154-159頁）。 有關本公司各項資訊之驗證情形及其所涵蓋範圍，請參閱本報告「7.2.1 環境保護－氣候變遷與能源管理、溫室氣體排放減量與能源管理、空氣及水污染防治、廢棄物管理與資源回收」說明（第154、155-156、156-157、157-158頁）。	

（接次頁）

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題				無
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		（一）有關本公司保障人權之政策與具體管理方案，以及所依據之相關法規與國際人權公約，請參閱本報告「5.6.1 人權政策與具體作為」說明（第114頁）。	
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		（二）有關本公司之員工福利措施（包含員工薪酬、共融職場、休假、各項津貼、禮金與補助等，請參閱本報告「5.6.6 有競爭力的整體薪酬」、「5.6.2 共融職場」、「5.6.3 人力結構」、「5.6.7 優於法令的福利制度」說明（第115-118頁）。 有關本公司經營績效或成果如何反映於員工薪酬之政策及其實施情形，請參閱本報告「5.6.6 有競爭力的整體薪酬」說明（第117頁）。	
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		（三）有關本公司對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形，請參閱本報告「7.2.3 安全與衛生」說明（第161-164頁）。 有關本公司所取得相關驗證情形及其所涵蓋範圍，請參閱本報告「7.2.3 安全與衛生」說明（第161-164頁）。 有關本公司當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施，請參閱本報告「7.2.3 安全與衛生」說明（第161-164頁）。 當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：民國114年截至年報刊印日止，台積公司及其子公司共發生二起火災事件，此二起火災並未造成人員受傷或死亡。相關改善措施包括（1）宣導員工汽機車保持原廠設計，切勿改裝(包含不加裝非原廠原件如超級電容、不使用非原廠電瓶如將鉛酸電瓶換成鋰鐵電瓶）；（2）提升機台本質安全，要求機台特定物件蓋板須使用不可燃材質並建立其電力元件及設計安全規範且納入採購文件定義。	
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃？	V		（四）有關本公司員工培訓計劃所涵蓋面向、範圍及實施情形，請參閱本報告「5.6.5 人才發展」說明（第116頁）。	
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		（五）本公司並非最終產品製造者，故消費者保護項目不適用。 有關本公司客戶權益政策，請參閱本報告「5.4.1 客戶－客戶資訊保護」說明（第111頁）。	
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		（六）有關本公司供應商管理政策及相關遵循規範，且其內容對供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權應有積極具體之要求，請參閱本報告「7.2.4 供應商管理（第161-164頁）」及「5.6.1 人權政策與具體作為（第114頁）」說明。 有關本公司供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形，請參閱本報告「7.2.4 供應商管理」說明（第164-165頁）。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		有關本公司所參考之國際編製準則或指引，及所編製揭露非財務資訊之報告書，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。 有關本公司永續報告書之第三方驗證機構、驗證項目或範圍及其所依循標準，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 台積公司依循「ESG政策」推動本公司永續發展的具體實踐。有關本公司企業永續運作情形，請參閱本報告「7.1 企業永續（ESG）－概述」說明（第148-152頁）及本公司網站企業永續相關資訊，網址：https://esg.tsmc.com/zh-Hant				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 請參考本公司網站ESG相關資訊，網址：https://esg.tsmc.com/zh-Hant				

7.7 上市上櫃公司氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	● ESG指導委員會：台積公司氣候變遷管理的最高組織，由董事長擔任主席，ESG委員會主席出任執行秘書，每季審議台積公司氣候變遷策略與目標，並且向董事會報告。 ● 節能減碳委員會：台積公司執行及管理氣候變遷風險與機會行動的組織，由營運組織的副總經理擔任主席，每季擬定管理方案、檢視執行狀況與討論未來計劃。
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	台積公司依據TCFD架構，每二年由ESG委員會成員代表鑑別並評估氣候變遷風險及因應措施，找出潛在危機與機會。相關之影響與因應請詳見「氣候變遷風險與機會財務影響分析與因應」表（本報告第154頁）。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	詳見「氣候變遷風險與機會財務影響分析與因應」表（本報告第154頁）。
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	詳見「台積公司氣候相關風險與機會之管理架構」表中之風險管理（本報告第154頁）。
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	台積公司參考IPCC AR6 SSP 58.5極高排放情境進行實體風險分析，並全面檢視各廠區及供應鏈短中長期的潛在風險，除既有的淹水、乾旱、高溫風險，亦增加評估颱風帶來的強風災害、暴雨帶來的土石流與滑坡災害以及海平面上升等風險，同時分析範圍擴大至全球廠區及直接原物料、間接原物料、設備、廠務設施、零配件等五大類關鍵供應鏈。分析結果，乾旱為最顯著的實體風險，主要造成自身生產受缺水影響，導致財務損失與營收下降。
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計劃，說明該計劃內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	台積公司依2050淨零轉型計劃路徑積極執行溫室氣體減量作為，以達成民國129年RE100與民國139年淨零排放。過程中持續導入最佳節能減碳技術降碳排，並持續擴大再生能源使用直到RE100，最終擬使用部分碳抵換達到淨零轉型目標。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	內部碳定價考量碳稅（費）、法規罰鍰、減碳與綠電成本、碳市場價格。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證數量。	（一）民國119年單位產品溫室氣體排放量（公噸-二氧化碳當量／十二吋晶圓當量-光罩數）減少30%，且總排放量回到民國109年水準，民國139 年淨零排放。 （二）民國119 年再生能源占比達60%，民國129年再生能源占比達100%。 民國114年達成進度：單位產品溫室氣體排放量（公噸-二氧化碳當量／十二吋晶圓當量-光罩數）增加2%；使用約57.8億度再生能源，再生能源使用比例提升至20.1%
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計劃	請參閱本報告「7.2.1 環境保護－氣候變遷與能源管理」（第154頁）、「7.2.1 環境保護－溫室氣體排放減量與能源管理」（第155-156頁）及「最近二年度台積公司溫室氣體排放統計」表（第171頁）。

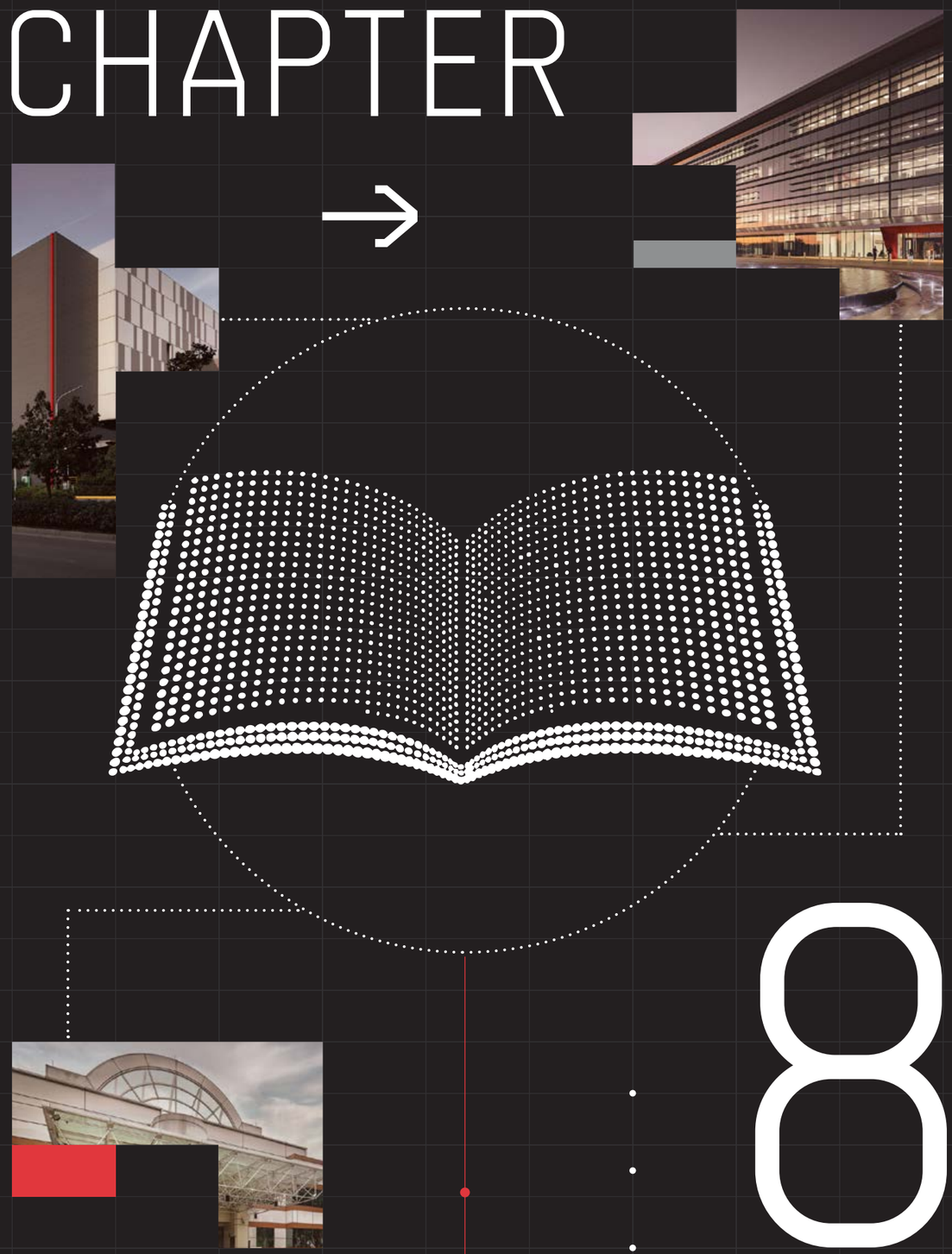
最近二年度台積公司溫室氣體排放統計

單位：公噸二氧化碳當量

年度	範圍	範疇一		範疇二		確信機構	確信準則	確信意見
		總排放量（公噸二氧化碳當量）	密集度（公噸二氧化碳當量／佰萬元）	總排放量（公噸二氧化碳當量）	密集度（公噸二氧化碳當量／佰萬元）			
114年	母公司	1,872,907	0.49	11,130,187	2.94	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	采鈺科技股份有限公司	6,527	0.73	29,665	3.32	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	台積電（中國）有限公司	128,580	4.97	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	台積電（南京）有限公司	69,139	0.98	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	TSMC Washington, LLC	51,899	7.21	0	0	AMN	ISO 14064-3	合理保證等級
	TSMC Arizona Corporation	27,440	0.41	0	0			尚未驗證
	JASM	21,246	1.43	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	3DIC	203	0.18	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
113年	母公司	1,581,312	0.55	10,926,644	3.79	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	采鈺科技股份有限公司	5,043	0.5	30,753	3.07	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	台積電（中國）有限公司	118,141	4.56	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	台積電（南京）有限公司	53,216	0.77	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	TSMC Washington, LLC	54,238	9.12	0	0	AMN	ISO 14064-3	合理保證等級
	JASM	14,241	131.37	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級
	3DIC	196	0.21	0	0	DNV	ISO 14064-3	合理保證等級

註一：溫室氣體包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮。
註二：範疇一：直接排放量，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源。依據聯合國國家溫室氣體盤查指引民國一百零八年修訂版，並使用聯合國政府間氣候變化專門委員會的第五次評估報告中的溫暖潛勢值做計算。
範疇二：能源間接排放量，即來自於外購電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。依據市場係數法計算。

CHAPTER



關係企業暨其他特別記載事項

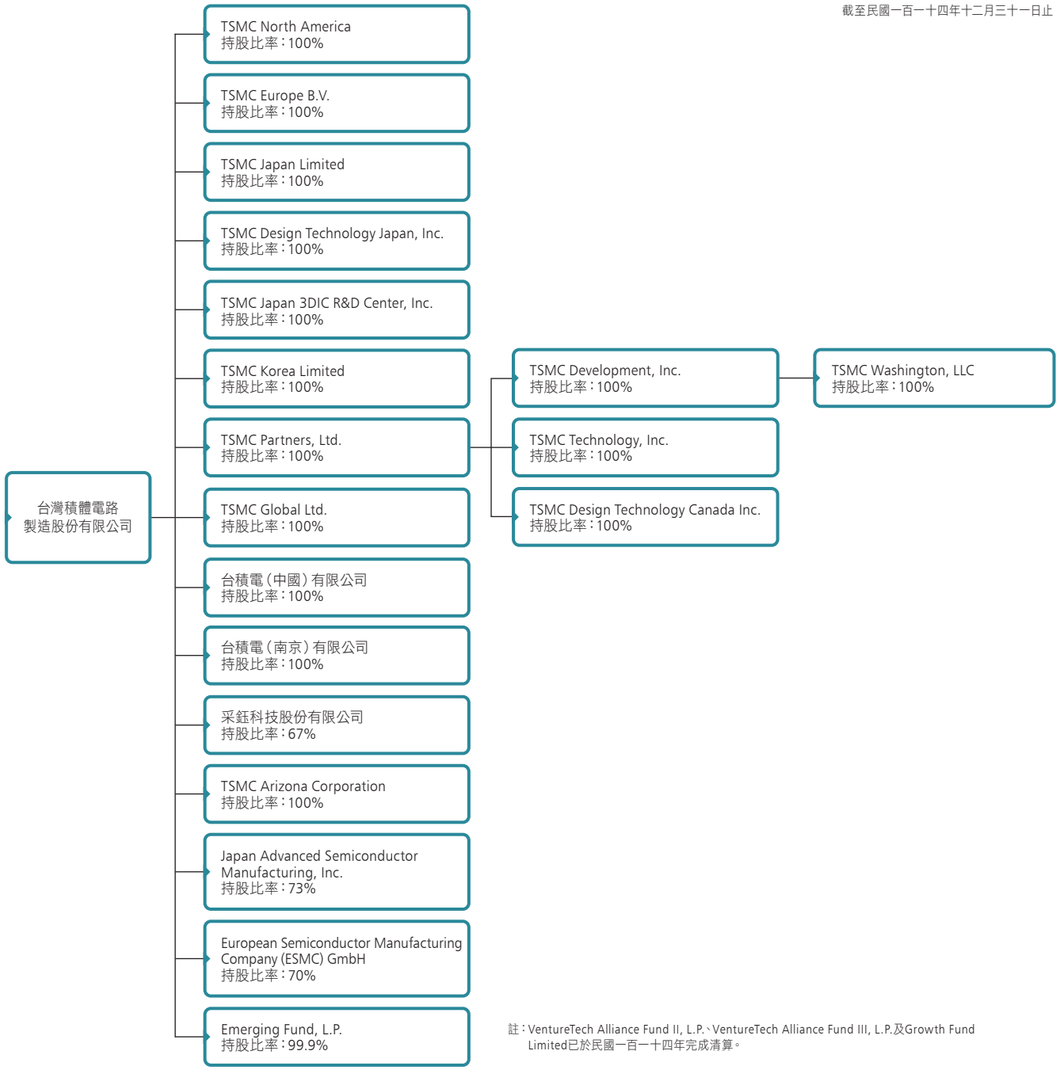
台積公司將持續在全球半導體產業中扮演著關鍵且不可或缺的角色，並為我們客戶的成長提供支持

8.1 關係企業相關資料

有關本公司關係企業合併營業報告書，請參閱本報告「8.1.1 關係企業組織圖」至「8.1.6 各關係企業營運狀況」。

8.1.1 關係企業組織圖（註）

截至民國一百一十四年十二月三十一日止



註：VentureTech Alliance Fund II, L.P.、VentureTech Alliance Fund III, L.P.及Growth Fund Limited已於民國一百一十四年完成清算。

8.1.2 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

台積公司及其關係企業致力於提供最佳的專業積體電路製造服務。美國TSMC Washington, LLC及台積電（中國）有限公司提供八吋晶圓產能支援，台積電（南京）有限公司、美國TSMC Arizona及日本Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.提供十二吋晶圓產能。台積公司於北美、歐洲、日本、中國及南韓等皆設有子公司，提供全球客戶即時的業務與技術服務，並支援專業積體電路製造相關業務，及投資半導體相關新創事業。

8.1.3 各關係企業基本資料

單位：新台幣（US, EUR, JPY, KRW, RMB, CAD）仟元

截至民國一百一十四年十二月三十一日止

企業名稱	設立日期（註一）	註冊地	實收資本額		主要營業或生產項目
TSMC North America	77/01/18	San Jose, California, U.S.	US$	11,000	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務
TSMC Europe B.V.	83/03/04	Amsterdam, The Netherlands	EUR	100	客戶服務及支援業務
TSMC Japan Limited	86/09/10	Yokohama, Japan	JPY	300,000	客戶服務及支援業務
TSMC Korea Limited	95/05/02	Seoul, Korea	KRW	400,000	客戶服務及支援業務
TSMC Design Technology Japan, Inc.	109/01/10	Yokohama, Japan	JPY	750,000	工程支援業務
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	110/03/29	Yokohama, Japan	JPY	2,450,000	工程支援業務
台積電（中國）有限公司	92/08/04	中國上海市	RMB	4,502,080	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計
台積電（南京）有限公司	105/05/16	中國南京市	RMB	6,650,119	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計
TSMC Arizona Corporation	109/11/10	Arizona, U.S.	US$	21（註二）	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.	110/12/10	Kumamoto, Japan	JPY	207,232,200	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH	112/06/30	Dresden, Germany	EUR	1,150	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試
TSMC Technology, Inc.	85/02/20	Delaware, U.S.	US$	0.001	工程支援業務
TSMC Development, Inc.	85/02/16	Delaware, U.S.	US$	0.001	半導體製造相關投資業務
TSMC Washington, LLC	85/06/03	Delaware, U.S.	US$	0	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售與測試
TSMC Partners, Ltd.	87/03/26	British Virgin Islands	US$	988,268	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務
TSMC Design Technology Canada Inc.	96/05/28	Ontario, Canada	CAD	2,434	工程支援業務
TSMC Global Ltd.	95/07/18	British Virgin Islands	US$	36,984,000	一般投資業務
Emerging Fund, L.P.	110/01/27	Cayman Islands	US$	98,715	新創科技事業之投資
采鈺科技股份有限公司	92/12/01	新竹市	NT$	3,182,991	彩色濾光膜產品相關研究、設計、開發、製造、銷售及封裝測試

註一：民國年/月/日。
註二：TSMC Arizona Corporation已於民國一百一十五年一月及民國一百一十五年二月完成增資，增資後實收資本額增加至US$24仟元。

8.1.4 台積公司推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

8.1.5 各關係企業董事監察人及總經理資料

單位：元；股；%

截至民國一百一十四年十二月三十一日止

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數（出資額）	持股比例（出資比例）
TSMC North America	董事 董事 執行長 總經理	方淑華 大衛・凱樂（註一） 大衛・凱樂（註一） Sajiv Dalal	- - - - 台積公司持有11,000,000股	- - - - 100%
TSMC Europe B.V.	董事 董事 總經理	黃仁昭 Paul de Bot（註二） Paul de Bot（註二）	- - - 台積公司持有200股	- - - 100%
TSMC Japan Limited	董事長 董事 總經理	Makoto Onodera 方淑華 Makoto Onodera	- - - 台積公司持有6,000股	- - - 100%
TSMC Korea Limited	董事長 董事 董事	陳威利 萬睿洋 黃仁昭	- - - 台積公司持有80,000股	- - - 100%
TSMC Design Technology Japan, Inc.	董事長 董事 監察人	魯立忠 黃仁昭 鄭子俊	- - - 台積公司持有15,000股	- - - 100%
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	董事長 董事 監察人	何軍 劉大衛 鄭子俊	- - - 台積公司持有49,000股	- - - 100%
台積電（中國）有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	曾繁城 秦永沛 羅鎮球 何麗梅 羅鎮球	- - - - - （台積公司出資額US$596,000,000）	- - - - - （100%）
台積電（南京）有限公司	董事長 董事 董事 董事 監察人 監察人 總經理	何麗梅 秦永沛 侯永清 羅鎮球 黃仁昭 方淑華 羅鎮球	- - - - - - - （台積公司出資額US$1,000,000,000）	- - - - - - - （100%）
TSMC Arizona Corporation	董事 董事 董事 董事 執行長 總經理	莊瑞萍 Rose Castanares 方淑華 黃仁昭 莊瑞萍 Rose Castanares	- - - - - - 台積公司持有21.250,000股（註三）	- - - - - - 100%
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.	董事長 董事 董事 董事 監察人 執行長 總經理	廖永豪 徐宏仁 堀田祐一 高野康浩 鄭子俊 廖永豪 堀田祐一	- - - - - - - 台積公司持有3,010,894股	- - - - - - - 72.65%

（接次頁）

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數（出資額）	持股比例（出資比例）
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH	董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 總經理	莊子壽 郭偉彥 鄭子俊 劉大衛 Stefan Joeres Alexander Gorski Maarten Dirkzwager（註四） Christian Koitzsch	- - - - - - - - 台積公司持有805,000股	- - - - - - - - 70%
TSMC Technology, Inc.	董事長 董事 總經理	黃仁昭 魯立忠 魯立忠	- - - TSMC Partners,Ltd.持有10股	- - - 100%
TSMC Development, Inc.	董事長 董事 總經理	黃仁昭 方淑華 黃仁昭	- - - TSMC Partners, Ltd.持有10股	- - - 100%
TSMC Washington, LLC	董事 董事 總經理	廖永豪 黃仁昭 李汝諒	- - - TSMC Development, Inc.持有293,636,833股	- - - 100%
TSMC Partners, Ltd.	董事 董事 總經理	黃仁昭 方淑華 黃仁昭	- - - 台積公司持有988,268,244股	- - - 100%
TSMC Design Technology Canada Inc.	董事 董事 董事 總經理	魯立忠 Cormac Michael O'Connell 方淑華 魯立忠	- - - - TSMC Partners, Ltd.持有2,300,000股	- - - - 100%
TSMC Global Ltd.	董事 董事	黃仁昭 方淑華	- - 台積公司持有36,984股	- - 100%
Emerging Fund, L.P.	無	無	（台積公司出資額US$98,615,857）	（99.90%）
采鈺科技股份有限公司	董事長 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 執行長暨總經理	關欣 徐宏仁 劉大衛 黃慧珠 張美玲 張秉衡 林翰飛 關欣	264,500股 - - - - - - - 台積公司持有213,619,000股	0.08% - - - - - - - 67.25%

註一：民國一百一十五年一月指派Sajiv Dalal擔任TSMC North America執行長與董事。
註二：民國一百一十五年一月指派Christopher Thomas擔任TSMC Europe B.V.總經理與董事。
註三：TSMC Arizona Corporation已於民國一百一十五年一月及民國一百一十五年二月完成增資，增資後本公司持有股數增加為24,000,000股，持股比率為100%。
註四：民國一百一十五年一月Mike Mevissen替代Maarten Dirkzwager擔任European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH股東委員會代表。

8.1.6 各關係企業營運狀況

單位：新台幣仟元，每股盈餘（虧損）（新台幣元）　　截至民國一百一十四年十二月三十一日止

企業名稱	實收資本額	資產總值	負債總值	淨值	本期營業收入	本期營業利益（損失）	本期（損）益	每股盈餘（虧損）（元）
TSMC North America	345,884	351,715,584	342,945,201	8,770,383	2,939,574,172	1,186,361	1,194,222	108.57
TSMC Europe B.V.	3,700	1,229,508	462,088	767,420	788,557	55,189	77,134	385,670
TSMC Japan Limited	60,390	290,605	161,453	129,152	328,753	12,408	5,123	853.83
TSMC Design Technology Japan, Inc.	150,975	751,728	318,402	433,326	1,003,609	52,853	31,851	2,123.4
TSMC Japan 3DIC R&D Center, Inc.	493,185	1,641,458	139,314	1,502,144	1,154,881	247,483	216,635	4,421.12
TSMC Korea Limited	8,720	45,174	727	44,447	12,303	1,151	1,670	20.88
TSMC Development, Inc.	0.03	38,144,903	0	38,144,903	652,875	251,299	114,205	11,420,500
TSMC Partners, Ltd.	31,075,107	75,934,854	65	75,934,789	2,179,818	2,172,398	2,172,398	2.2
TSMC Global Ltd.	1,162,924,896	1,556,734,787	205,360,549	1,351,374,238	56,345,764	51,520,610	51,520,610	1,904,564.53
TSMC Washington, LLC	0	8,161,406	3,264,396	4,897,010	7,198,993	(660,486)	(401,529)	(1.37)
台積電（中國）有限公司	20,253,507	126,746,252	4,001,507	122,744,745	25,856,182	11,439,528	11,571,415	不適用
台積電（南京）有限公司	29,916,892	166,972,658	21,028,933	145,943,725	70,833,831	27,029,375	27,605,732	不適用
采鈺科技股份有限公司	3,182,991	22,327,282	3,903,820	18,423,462	8,938,168	1,334,779	1,273,995	4.01
TSMC Arizona Corporation	668	917,761,003	272,097,019	645,663,984	66,804,056	5,363,252	16,141,125	796.96
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.	41,715,842	149,424,173	82,736,495	66,687,678	14,819,954	(14,212,783)	(9,767,064)	(2,356.55)
European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH	42,553	82,240,527	25,847,937	56,392,590	0	(1,043,948)	(688,621)	(625.79)
TSMC Technology, Inc.	0.03	5,675,332	3,763,590	1,911,742	6,608,122	317,206	408,763	40,876,300
TSMC Design Technology Canada Inc.	55,881	552,291	80,016	472,275	415,888	37,808	44,729	19.45
VentureTech Alliance Fund III, L.P.（註）	0	0	0	0	445	445	445	不適用
Growth Fund Limited（註）	0	0	0	0	475	445	445	不適用
Emerging Fund, L.P.	3,103,981	4,151,792	33	4,151,759	176,863	158,117	158,117	不適用

註：已於民國一百一十四年完成清算。

8.1.7 關係企業合併財務報表及關係報告書

請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告。

公開資訊觀測站連結: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home

8.2 其他特別記載事項

8.2.1 台積公司民國一百一十四年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

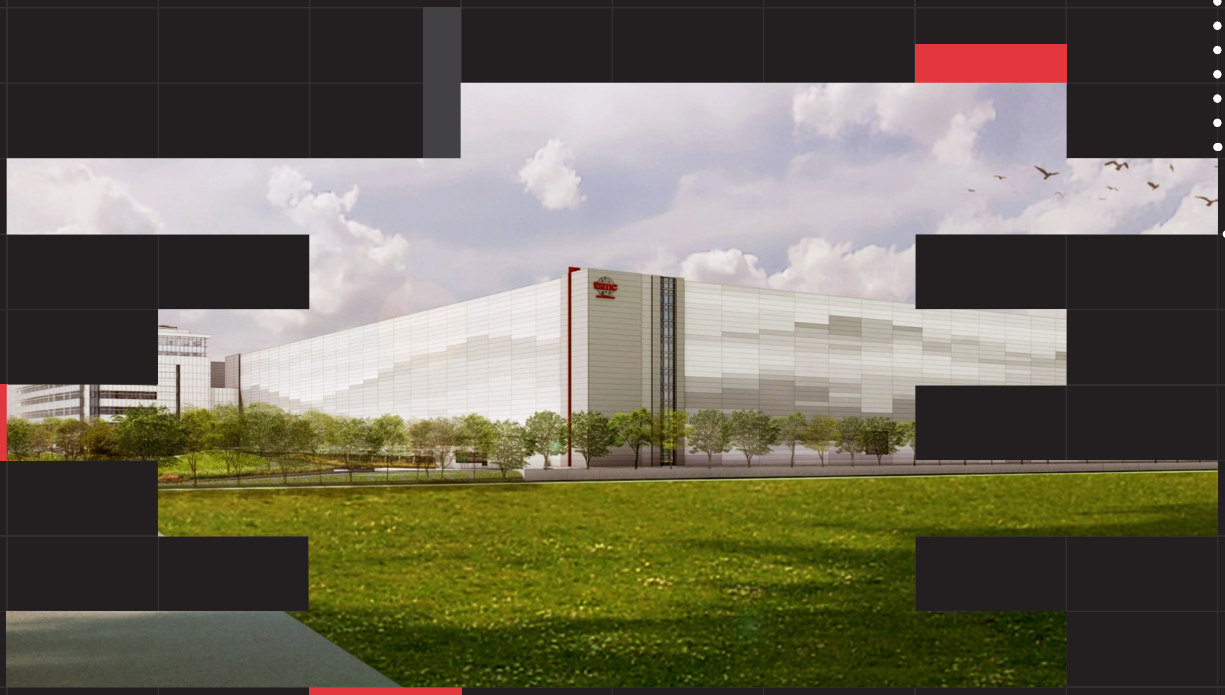
8.2.2 台積公司民國一百一十四年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

8.2.3 其他必要補充說明事項：無。

“

成為全球最先進及最大的專業積體電路技術及製造服務業者，並且與我們無晶圓廠設計公司及整合元件製造商的客戶群共同組成半導體產業中堅強的競爭團隊。

台積公司願景



台灣積體電路製造股份有限公司

董事長 魏哲家

300-096新竹科學園區力行六路8號｜電話：+886-3-5636688｜傳真：+886-3-5637000
https://www.tsmc.com｜本報告書採用再生紙及大豆油墨印製